

# 목 차

분 기 보 고 서 .....	1
【대표이사 등의 확인】 .....	2
I. 회사의 개요 .....	3
1. 회사의 개요 .....	3
2. 회사의 연혁 .....	3
3. 자본금 변동사항 .....	3
4. 주식의 총수 등 .....	3
5. 정관에 관한 사항 .....	3
II. 사업의 내용 .....	4
1. 사업의 개요 .....	4
2. 주요 제품 및 서비스 .....	6
3. 원재료 및 생산설비 .....	7
4. 매출 및 수주상황 .....	13
5. 위험관리 및 파생거래 .....	18
6. 주요계약 및 연구개발활동 .....	25
7. 기타 참고사항 .....	31
III. 재무에 관한 사항 .....	50
1. 요약재무정보 .....	50
2. 연결재무제표 .....	52
3. 연결재무제표 주식 .....	59
4. 재무제표 .....	128
5. 재무제표 주식 .....	134
6. 배당에 관한 사항 .....	194
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 .....	196
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 .....	196
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 .....	200
8. 기타 재무에 관한 사항 .....	201
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 .....	224
V. 회계감사인의 감사의견 등 .....	225
1. 외부감사에 관한 사항 .....	225
2. 내부통제에 관한 사항 .....	230
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 .....	231
1. 이사회에 관한 사항 .....	231
2. 감사제도에 관한 사항 .....	231
3. 주주총회 등에 관한 사항 .....	231
VII. 주주에 관한 사항 .....	232
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 .....	239
1. 임원 및 직원 등의 현황 .....	239
2. 임원의 보수 등 .....	287
IX. 계열회사 등에 관한 사항 .....	289
X. 대주주 등과의 거래내용 .....	290
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 .....	293
1. 공시내용 진행 및 변경사항 .....	293
2. 우발부채 등에 관한 사항 .....	293
3. 제재 등과 관련된 사항 .....	295

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 .....	295
XII. 상세표 .....	296
1. 연결대상 종속회사 현황(상세) .....	296
2. 계열회사 현황(상세) .....	296
3. 타법인출자 현황(상세) .....	296
4. 연구개발실적(상세) .....	297
【 전문가의 확인 】 .....	317
1. 전문가의 확인 .....	317
2. 전문가와의 이해관계 .....	317

# 분기보고서

(제 54 기)

사업연도      2022년 01월 01일      부터  
                  2022년 03월 31일      까지

금융위원회

한국거래소 귀중

2022년      5월      16일

제출대상법인 유형 :

주권상장법인

면제사유발생 :

해당사항 없음

회 사 명 :

삼성전자주식회사

대 표 이 사 :

한 종 희

본 점 소 재 지 :

경기도 수원시 영통구 삼성로 129(매탄동)

(전 화) 031-200-1114

(홈페이지) <http://www.samsung.com/sec>

작 성 책 임 자 :

(직 책) 재경팀장

(성 명) 김 동 욱

(전 화) 031-277-7218

## 【 대표이사 등의 확인 】

### 확 인 서

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당임원으로서  
2022년 1분기 보고서의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여  
직접 확인·검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의  
누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 분기보고서에 표시된  
기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이  
기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제8조의 규정에  
따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.

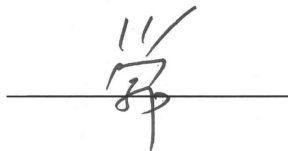
2022. 5. 16

삼성전자 주식회사

대표이사: 한 종 회



신고업무 담당임원: 박 학 규



# I. 회사의 개요

## 1. 회사의 개요

회사의 개요는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기/사업보고서에 기재 예정)

## 2. 회사의 연혁

회사의 연혁은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(사업보고서에 기재 예정)

## 3. 자본금 변동사항

자본금 변동사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(사업보고서에 기재 예정)

## 4. 주식의 총수 등

주식의 총수 등은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기/사업보고서에 기재 예정)

## 5. 정관에 관한 사항

정관에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기/사업보고서에 기재 예정)

## II. 사업의 내용

### 1. 사업의 개요

당사는 본사를 거점으로 한국과 DX 부문 산하 해외 9개 지역총괄 및 DS 부문 산하 해외 5개 지역총괄의 생산·판매법인, SDC 및 Harman 산하 종속기업 등 231개의 종속기업으로 구성된 글로벌 전자 기업입니다.

사업별로 보면, Set 사업은 TV를 비롯하여 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨, HHP(스마트폰 등), 네트워크시스템, 컴퓨터 등을 생산·판매하는 DX(Device eXperience) 부문이 있으며, 부품 사업에는 DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등의 제품을 생산·판매하고 있는 DS 부문과 중소형 OLED 및 TV·모니터용 LCD 등의 디스플레이 패널(DP)을 생산·판매하고 있는 SDC가 있습니다. 또한, 2017년에 인수한 Harman에서는 디지털 콕핏(Digital Cockpit), 텔레매틱스(Telematics), 스피커 등을 생산·판매하고 있습니다.

당사는 2021년 12월 중 기존의 CE 부문과 IM 부문을 DX 부문으로 통합하였으며, 무선사업부의 명칭을 MX(Mobile eXperience)사업부로 변경하였습니다. 또한 내부 조직체계에 맞추어 디스플레이 사업(SDC)을 DS 부문과 별도로 구분하였습니다.

☞ 부문별 사업에 관한 자세한 사항은 '7. 기타 참고사항'의 '다. 사업부문별 현황'과 '라. 사업부문별 요약 재무 현황' 항목을 참조하시기 바랍니다.

지역별로 보면, 국내에서는 DX 부문 및 DS 부문 등을 총괄하는 본사와 31개의 종속기업이 사업을 운영하고 있습니다. 본사는 수원, 구미, 광주, 기흥, 화성, 평택사업장 등으로 구성되어 있으며, 국내 종속기업은 디스플레이 패널을 생산하는 삼성디스플레이(주)와 국내 대리점 판매를 전담하는 삼성전자판매(주), 제품 서비스를 담당하는 삼성전자서비스(주), 제품 운송을 담당하는 삼성전자로지텍(주) 등 비상장 종속기업들로 구성되어 있습니다.

해외(미주, 유럽·CIS, 중동·아프리카, 아시아 등지)에서는 생산, 판매, 연구활동 등을 담당하는 200개의 비상장 종속기업이 운영되고 있습니다.

미주에는 TV, HHP 등 Set제품의 미국 판매를 담당하는 SEA(New Jersey, USA), TV 생산을 담당하는 SII(California, USA), 반도체·DP판매를 담당하는 SSI(California, USA), 반도체 생산을 담당하는 SAS(Texas, USA), Set제품 복합 생산법인 SEDA(Brazil), 전장부품사업 등을 담당하는 Harman(Connecticut, USA) 등을 포함하여 총 46개의 판매·생산 등을 담당하는 법인이 있습니다.

유럽·CIS에는 SEUK(UK), SEG(Germany), SEF(France), SEI(Italy), SERC(Russia)등 Set제품 판매법인과 SEH(Hungary), SERK(Russia) 등 TV 생산법인, 가전제품 생산법인 S EPM(Poland) 등을 포함하여 총 74개의 법인이 운영되고 있습니다.

중동·아프리카에는 SGE(UAE), SSA(South Africa) 등 Set제품 판매법인과 SEEG(Egypt), SSAP(South Africa) 등 TV 생산법인을 포함한 총 20개 법인이 운영되고 있습니다.

아시아(중국 제외)에는 SESP(Singapore), SEAU(Australia), SEPCO(Philippines), SME(Malaysia) 등 판매법인과, HHP 등 생산법인 SEV·SEVT(Vietnam), TV 등 생산법인 SEHC(Vietnam), DP 생산법인 SDV(Vietnam), 복합 생산법인 SIEL(India) 등을 포함한 총 30개의 법인이 운영되고 있습니다.

중국에는 SCIC(Beijing), SEHK(Hong Kong) 등 Set제품 판매법인과 SSS(Shanghai), SSCX(Xian) 등 반도체·DP 판매법인, SSEC(Suzhou) 등 Set제품 생산법인, SCS(Xian) 등 반도체 생산법인을 포함하여 총 30개의 법인이 운영되고 있습니다.

2022년 1분기 당사의 매출은 77조 7,815억원으로 전년 동기 대비 19.0% 증가하였으며, 주요 매출처로는 Apple, Best Buy, Deutsche Telekom, Qualcomm, Supreme Electronics 등(알파벳순)이 있습니다.

## 2. 주요 제품 및 서비스

### 가. 주요 제품 매출

당사는 TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨, HHP 등 완제품과 DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등 반도체 부품 및 디스플레이 패널 등을 생산·판매하고 있습니다. 아울러 Harman을 통해 디지털 콕핏, 텔레매틱스 등을 생산·판매하고 있습니다.

2022년 1분기 매출은 DX 부문이 48조 687억원(61.8%), DS 부문이 26조 8,674억원(34.5%)이며, SDC가 7조 9,705억원(10.2%), Harman은 2조 6,663억원(3.4%)입니다.

(단위 : 억원, %)

부 문	주요 제품	매출액	비중
DX 부문	TV, 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨, HHP, 네트워크시스템, 컴퓨터 등	480,687	61.8%
DS 부문	DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등	268,674	34.5%
SDC	스마트폰용 OLED패널, TV·모니터용 LCD 패널 등	79,705	10.2%
Harman	디지털 콕핏, 텔레매틱스, 스피커 등	26,663	3.4%
기타	부문간 내부거래 제거 등	△77,914	△9.9%
총 계		777,815	100.0%

※ 각 부문별 매출액은 부문 등 간 내부거래를 포함하고 있습니다.

[△는 부(-)의 값임]

※ 세부 제품별 매출은 '4. 매출 및 수주상황' 항목을 참조하시기 바랍니다.

### 나. 주요 제품 등의 가격 변동 현황

2022년 1분기 TV의 평균 판매가격은 전년 대비 약 5% 하락하였으며, HHP는 전년 대비 약 8% 상승하였습니다. 그리고 메모리 평균 판매가격은 전년 대비 약 4% 하락하였으며, 디스플레이 패널(스마트폰용 OLED 패널)은 약 11% 상승하였습니다. 또한 디지털 콕핏의 평균 판매가격은 전년 대비 약 2% 하락하였습니다.



### 3. 원재료 및 생산설비

#### 가. 주요 원재료 현황

당사의 주요 원재료로 DX 부문은 TV·모니터용 디스플레이 패널 등을 CSOT 등에서 공급받고 있으며, Camera Module, 모바일AP 등을 삼성전기(주), Qualcomm 등으로부터 공급받고 있습니다. DS 부문은 Wafer, Chemical 등을 SK실트론(주), 솔브레인(주) 등으로부터, SDC는 FPCA, Window 등을 (주)비에이치, Apple 등으로부터 공급받고 있습니다. Harman은 SOC(System-On-Chip), 자동차용 메모리 등을 NVIDIA, Avnet 등에서 공급받고 있습니다.

(단위 : 억원, %)

부 문	매입유형	품 목	구체적 용도	매입액	비중	주요 매입처
DX 부문	원재료	디스플레이 패널	TV·모니터용 화상신호기	24,888	11.5%	CSOT, AUO, BOE 등
	원재료	Camera Module	HHP 카메라	18,765	8.7%	삼성전기(주), 파트론 등
	원재료	모바일AP	CPU	23,682	10.9%	Qualcomm, MediaTek 등
	원재료	기타	-	148,964	68.9%	
	부문 계			216,299	100.0%	
DS 부문	원재료	Wafer	반도체원판	7,123	16.0%	SK실트론(주), SUMCO 등
	원재료	Chemical	원판가공	5,366	12.0%	솔브레인(주), 동우화인켐(주) 등
	원재료	기타	-	32,146	72.0%	
	부문 계			44,635	100.0%	
SDC	원재료	FPCA	구동회로	7,106	23.2%	(주)비에이치, Apple 등
	원재료	Window	강화유리	4,435	14.5%	Apple, Biel 등
	원재료	기타	-	19,068	62.3%	
	사업 계			30,609	100.0%	
Harman	원재료	SOC(System-On-Chip)	자동차용 제품	1,681	9.8%	NVIDIA, Renesas 등
	원재료	자동차용 메모리	자동차용 제품	1,327	7.8%	Avnet, Microchip 등
	원재료	기타	-	14,081	82.4%	
	사업 계			17,089	100.0%	
기타	원재료	-	-	93	-	
총 계				308,725	-	

※ 매입액은 부문 등 간의 내부거래를 포함하고 있지 않습니다.

※ 비중은 각 부문의 원재료 총매입액 대비 각 품목의 매입액 비중입니다.

※ 주요 매입처 중 삼성전기(주)는 계열회사입니다.

## 나. 주요 원재료 가격 변동 추이

DX 부문의 주요 원재료인 TV·모니터용 디스플레이 패널 가격은 전년 대비 약 42%하락하였고, Camera Module 가격은 전년 대비 약 8% 상승하였으며, 모바일AP 가격은 약 41% 상승하였습니다. DS 부문의 주요 원재료 중 반도체 Wafer 가격은 전년 대비 약 4% 상승하였고, SDC의 FPCA 가격은 약 19% 상승, 강화유리용 Window 가격은 2% 상승하였습니다. Harman의 원재료 중 SOC 가격은 전년 대비 1% 하락하였으며, 자동차용 메모리는 약 4% 상승하였습니다.

## 다. 생산능력, 생산실적, 가동률

(생산능력)

(단위 : 천대, 천개)

부 문	품 목	제54기 1분기	제53기	제52기
DX 부문	영상기기	14,547	54,235	51,538
	HHP	78,150	319,550	321,600
DS 부문	메모리	462,503,956	1,756,009,941	1,230,287,321
SDC	DP	849	3,604	7,274
Harman	디지털 콕핏	2,863	9,066	9,362

※ 생산능력은 주요 제품의 연결 기준입니다.

DX 부문의 주요 품목별 생산능력은 '평균 라인 수'×'시간당 평균 생산실적'×'일 평균 가동시간'×'표준 가동일수'로 산출하였으며, DS 부문의 메모리 생산능력은 1Gb환산 기준으로 환산 생산실적(패키지OUT 기준)을 가동률로 나눠서 생산능력을 산출하고 있습니다. SDC의 경우 라인별 생산 가능한 제품의 총 면적을 8세대 Glass (2200×2500mm)로 환산하고 있으며, Harman의 디지털콕핏 생산능력은 '각 거래처·제품별 생산셀(조립, 테스트) 수'×'각 생산셀별 시간당 생산능력'×'1일 표준 생산시간'×'표준생산일수'로 산출하였습니다.

## (생산실적)

2022년(제54기) 1분기 DX 부문의 영상기기 생산실적은 12,261천대이며 멕시코, 베트남, 브라질, 헝가리 등 세계 각 지역에서 생산되고 있으며, HHP 생산실적은 63,295천대이며 한국(구미), 베트남, 인도, 브라질 등 지역에서 생산되고 있습니다. DS 부문의 메모리 생산실적은 462,504백만개(1Gb 환산 기준)이며 한국(화성, 평택 등), 중국에서 생산하고 있습니다. SDC의 DP 생산실적은 744천개이며 한국(천안, 아산) 등에서 생산 중입니다. Harman의 디지털 콕핏 생산실적은 1,969천개입니다.

(단위 : 천대, 천개)

부 문	품 목	제54기 1분기	제53기	제52기
DX 부문	영상기기	12,261	44,133	48,244
	HHP	63,295	260,501	249,218
DS 부문	메모리	462,503,956	1,756,009,941	1,230,287,321
SDC	DP	744	2,849	5,977
Harman	디지털 콕핏	1,969	6,928	6,116

※ 생산실적은 주요 제품의 연결 기준입니다.

## (가동률)

당사 DX 부문의 2022년(제54기) 1분기 가동률은 생산능력 대비 생산실적으로 산출하였으며, 영상기기 84.3%, HHP 81.0%입니다.

(단위 : 천대)

부 문	품 목	제54기 1분기		
		생산능력 대수	실제 생산 대수	가동률
DX 부문	영상기기	14,547	12,261	84.3%
	HHP	78,150	63,295	81.0%

DS 부문의 메모리 사업과 SDC의 DP 사업은 24시간 3교대 작업을 실시하고 있으며, 2022년(제54기) 1분기 누적 가동일은 휴일을 포함하여 총 90일입니다. 가동률은 가동 가능시간 (가동일 × 생산라인 수 × 24시간) 대비 실제 가동 시간으로 산출하였습니다.

(단위 : 시간)

부 문	품 목	제54기 1분기		
		가동 가능 시간	실제 가동 시간	가동률
DS 부문	메모리	19,440	19,440	100%
SDC	DP	12,960	12,960	100%

Harman의 2022년 1분기 가동률은 생산능력 대비 생산실적으로 산출하였으며 68.8%입니다.

(단위 : 천개)

부문	품 목	제54기 1분기		
		생산능력 개수	실제 생산 개수	가동률
Harman	디지털 콕핏	2,863	1,969	68.8%

## 라. 생산설비 및 투자 현황 등

### (생산과 영업에 중요한 시설 및 설비 등)

당사는 수원사업장을 비롯하여 구미, 광주, 화성, 평택, 아산 등 국내사업장 및 북미, 구주(유럽), 중국 등 해외 DX 부문 산하 9개 지역총괄과 DS 부문 산하 5개 지역총괄, SDC 및 Harman 산하 종속기업 등에서 주요 제품의 생산, 개발, 마케팅, 영업 등의 사업 활동을 수행하고 있습니다.

#### [주요 사업장 현황]

지역	사업장	소재지
국내 (DX 부문, DS 부문, SDC 산하 12개 사업장)	수원사업장	경기도 수원시 영통구 삼성로 129(매탄동)
	서초사업장	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동)
	우면사업장	서울특별시 서초구 성촌길 33(우면동)
	기흥사업장	경기도 용인시 기흥구 삼성로 1(농서동)
	화성사업장	경기도 화성시 삼성전자로 1(반월동)
	평택사업장	경기도 평택시 고덕면 삼성로 114
	천안사업장	충청남도 천안시 서북구 변영로 465 (성성동)
	온양사업장	충청남도 아산시 배방읍 배방로 158 (북수리)
	아산사업장	충청남도 아산시 탕정면 삼성로 181 (명암리)
	구미1사업장	경상북도 구미시 1공단로 244(공단동)
	구미2사업장	경상북도 구미시 3공단3로 302(임수동)
	광주사업장	광주광역시 광산구 하남산단6번로 107(오선동)
해외 (DX 부문 산하 9개 지역총괄)	북미 총괄	85 Challenger Rd., Ridgefield Park, New Jersey, USA
	구주 총괄	2000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey, UK
	중국 총괄	No.31, Jinghui Street, Chaoyang, Beijing, China
	동남아 총괄	30 Pasir Panjang Rd., Mapletree Business City, Singapore
	서남아 총괄	Two Horizon Centre, Golf Course RD, Gurgaon, Haryana, India
	CIS 총괄	31 Novinsky Boulevard, Moscow, Russia
	중동 총괄	Butterfly Building A, Dubai Media City, Dubai, UAE
	아프리카 총괄	2929 William Nicol Drive, Bryanston, Johannesburg, South Africa
	중남미 총괄	Av. Dr. Chucrí Zaidan, 1240 Diamond Tower, São Paulo, Brazil
해외 (DS 부문 산하 5개 지역총괄)	미주 총괄	3655 N. 1st St. San Jose, California, USA
	구주 총괄	Koelner Str. 12, Eschborn, Germany
	중국 총괄	3F, No.458, Fute North Rd., Shanghai, China
	동남아 총괄	3 Church Street, #26-01 Samsung Hub, Singapore
	일본 총괄	Shinagawa Grand Central Tower, Konan, Minato, Tokyo, Japan
Harman	미국 HQ	400 Atlantic St., Stamford, Connecticut, USA

※ Harman의 Automotive 사업은 미국(Novi), 독일(Garching) 등에서, Lifestyle 사업은 미국(Northridge) 등에서 영위하고 있습니다.

당사의 시설 및 설비는 토지, 건물 및 구축물, 기계장치, 건설중인자산 등이 있으며, 2022년 1분기말 현재 장부금액은 149조 6,180억원으로 전년말 대비 3,105억원 감소하였습니다.

(단위 : 억원)

구 분		토지	건물및구축물	기계장치	건설중인자산	기타유형자산	계
기 초	기초장부금액	98,302	388,694	795,263	180,093	36,933	1,499,285
	- 취득원가	99,436	626,515	2,749,096	180,093	119,580	3,774,720
	- 감가상각누계액(손상 포함)	△1,134	△237,821	△1,953,833	-	△82,647	△2,275,435
증 감	일반취득 및 자본적지출	146	3,703	77,668	△3,728	3,200	80,989
	감가상각	△125	△8,602	△77,385	-	△3,978	△90,090
	처분 · 폐기 · 손상	△93	△449	△177	-	△106	△825
	기타	100	2,171	△18,897	23,089	358	6,821
기 말	기말장부금액	98,330	385,517	776,472	199,454	36,407	1,496,180
	- 취득원가	99,526	632,271	2,812,708	199,454	122,868	3,866,827
	- 감가상각누계액(손상 포함)	△1,196	△246,754	△2,036,236	-	△86,461	△2,370,647

※ 토지의 감가상각은 기업회계기준서 제1116호 '리스'에 따른 사용권자산의 감가상각비입니다.

[△는 부(-)의 값임]

※ 기타는 환율변동에 의한 증감액 및 관련 정부보조금 차감 효과 등을 포함하고 있습니다.

※ 주요 유형자산에 대한 시가는 객관적인 시가 판단이 어려워 기재를 생략했습니다.

## (시설투자 현황)

2022년 1분기 중 DS 부문 및 SDC 등의 첨단공정 증설 · 전환과 인프라 투자를 중심으로 7.9조원의 시설투자가 이루어졌습니다. 당사는 2022년에도 주력 사업의 경쟁력강화와 미래 수요 증가 대응을 위한 지속적인 시설투자 계획하에, 시황 변화에 따라 탄력적으로 대응하고, 내실있는 성장을 위한 효율성을 고려하여 시설투자를 추진할 예정입니다.

(단위 : 억원)

구 분	내 용	투자기간	대상자산	투자액
DS 부문	신 · 증설, 보완 등	2022.01~2022.03	건물 · 설비 등	66,599
SDC	신 · 증설, 보완 등	2022.01~2022.03	건물 · 설비 등	7,074
기 타	신 · 증설, 보완 등	2022.01~2022.03	건물 · 설비 등	5,554
합 계				79,227

## 4. 매출 및 수주상황

### 가. 매출실적

2022년 1분기 매출은 77조 7,815억원으로 전년 동기 대비 19.0% 증가하였습니다.  
 부문별로 보면 전년 동기 대비 DX 부문이 13.2% 증가, DS 부문이 39.1% 증가하였으며,  
 SDC가 15.1% 증가, Harman이 12.6% 증가하였습니다.

(단위 : 억원)

부 문	매출유형	품 목	제54기 1분기	제53기	제52기
DX 부문	제·상품, 용역 및 기타매출	TV, 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨, HHP, 네트워크시스템, 컴퓨터 등	480,687	1,662,594	1,489,135
DS 부문	제·상품, 용역 및 기타매출	DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등	268,674	953,872	740,540
SDC	제·상품, 용역 및 기타매출	스마트폰용 OLED, TV·모니터용 LCD 패널 등	79,705	317,125	305,857
Harman	제·상품, 용역 및 기타매출	디지털 콕핏, 텔레매틱스, 스피커 등	26,663	100,399	91,837
기 타	부문간 내부거래 제거 등		△77,914	△237,942	△259,299
합 계			777,815	2,796,048	2,368,070

※ 각 부문별 매출실적은 부문 등 간 내부거래를 포함하고 있습니다.

※ 제53기, 제52기는 2021년 12월의 조직변경을 반영하여 제54기 기준으로 재작성하였습니다. [△는 부(-)의 값임]

(1) 주요 제품별 매출실적

(단위 : 억원)

구 분	제54기 1분기	제53기	제52기
영상기기	87,180	314,974	277,118
무선	312,278	1,046,806	960,217
메모리	200,915	726,022	555,442
DP	79,705	317,125	305,857

※ 각 제품별 매출실적은 부문 등 간 내부거래를 포함하고 있습니다.

(2) 매출유형별 매출실적

(단위 : 억원)

구 분	제54기 1분기	제53기	제52기
제 · 상품	740,047	2,658,785	2,235,963
용역 및 기타매출	37,768	137,263	132,107
계	777,815	2,796,048	2,368,070

※ 기타매출은 로열티수익 등으로 구성되어 있습니다.

(3) 주요 지역별 매출 현황

(단위 : 억원)

구 분		제54기 1분기	제53기	제52기
내수	국내	63,797	221,497	198,331
	미주	166,852	583,805	476,768
수출	유럽	73,163	258,227	235,012
	아시아 · 아프리카	114,824	336,671	315,598
	중국	148,607	597,247	437,403
계		567,243	1,997,447	1,663,112

※ 별도 기준의 내수 · 수출 매출 현황입니다.



## 나. 판매경로 등

### (1) 국내

판매자	판 매 경 로	소비자
생산 및 매입	전속 대리점	소비자
	유통업체(양판점, 할인점, 백화점, 홈쇼핑, 온라인 등)	
	통신사업자(SK텔레콤㈜, ㈜케이티, ㈜LG유플러스)	
	직접판매(B2B 및 온라인)	

### (2) 해외

판매자	판 매 경 로					소비자	
생산법인	판매법인	Retailer					소비자
		Dealer		Retailer			
		Distributor	Dealer		Retailer		
		통신사업자, Automotive OEM					
		직접판매(B2B 및 온라인)					
	물류법인	판매법인	Retailer				
			Dealer		Retailer		
			Distributor	Dealer		Retailer	

### (3) 판매경로별 매출액 비중

경 로	도매	소매	특직판	기타
비 중	20%	26%	50%	4%

## 다. 판매방법 및 조건

### (1) 국내

구 분	판매경로	대금회수조건	부대비용 비용분담
전속	대리점	약정여신조건	사안별 상호 협의하에 일부 분담
유통업체	양판점, 할인점, 백화점, 홈쇼핑, 온라인 등	개별계약조건	사안별 상호 협의하에 일부 분담
통신사업자	SK텔레콤(주), (주)케이티, (주)LG유플러스	개별계약조건	사안별 상호 협의하에 일부 분담 (공동마케팅)
B2B 및 온라인	일반기업체 등	개별계약조건	없 음

### (2) 해외

구 분	판매경로	대금회수조건	부대비용 비용분담
Retailer	소매점	개별계약조건	사안별 상호 협의하에 일부 분담
Dealer	양판점, 할인점, 백화점	개별계약조건	사안별 상호 협의하에 일부 분담
Distributor	현지 거래처 직판 영업	개별계약조건	사안별 상호 협의하에 일부 분담
B2B 및 온라인	일반기업체 등	개별계약조건	없 음

## 라. 판매전략

- 프리미엄 제품을 중심으로 한 시장 우위 강화
- 브랜드, 제품, 서비스를 통해 고객에게 차별화된 가치 제공
- 고객 · 시장 중심의 수요 촉발 마케팅 강화

## 마. 주요 매출처

2022년 1분기 당사의 주요 매출처는 Apple, Best Buy, Deutsche Telekom, Qualcomm, Supreme Electronics 등(알파벳순)입니다. 당사의 주요 5대 매출처에 대한 매출비중은 전체 매출액 대비 약 14% 수준입니다.

## 바. 수주상황

2022년 1분기말 현재 당사 재무제표에 중요한 영향을 미치는 장기공급계약 수주거래는 없습니다.

## 5. 위험관리 및 파생거래

### 가. 재무위험관리정책

당사의 재무위험관리는 영업 활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험, 유동성위험 등을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 당사는 이를 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 재무위험관리정책과 프로그램을 운영하고 있습니다. 위험을 회피하기 위한 파생상품의 이용도 이 프로그램에 포함되어 있습니다.

재무위험관리는 재경팀이 주관하고 있으며, 글로벌 재무위험관리정책을 수립한 후 주기적으로 재무위험 측정, 헷지 및 평가 등을 실행하고 있습니다.

한편 해외 주요 권역별로 지역 금융센터(미국, 영국, 싱가포르, 중국, 브라질, 러시아)에서 환율변동 모니터링 및 환거래 대행을 통해 환율변동위험을 관리하고 있으며, 권역 내 자금을 통합운용하여 유동성위험을 관리하고 있습니다.

당사의 재무위험관리의 주요 대상인 자산은 현금및현금성자산, 단기금융상품, 상각후원가금융자산, 매출채권 등으로 구성되어 있으며, 부채는 매입채무, 차입금 등으로 구성되어 있습니다.

## 나. 주요 재무위험관리

### (1) 시장위험

#### (환율변동위험)

당사는 글로벌 영업 활동을 수행함에 따라 기능통화와 다른 통화로 거래를 하고 있어 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 환율변동위험에 노출되는 주요 통화로는 USD, EUR, INR 등이 있습니다.

당사는 환율변동과는 무관하게 통화별 자산과 부채 규모를 일치하는 수준으로 유지하여 환율변동 영향을 최소화하는데 주력하고 있습니다. 이를 위해 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 금융 거래 발생 시 현지 통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치시킴으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있습니다.

또한, 당사는 효과적인 환율변동위험 관리를 위해 환위험을 주기적으로 모니터링 및 평가하고 있으며 투기적 외환거래는 엄격히 금지하고 있습니다.

### (이자율변동위험)

변동금리부 금융상품의 이자율변동위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치 변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무 활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 당사의 이자율변동위험은 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 당사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운영하고 있습니다.

### (주가변동위험)

당사는 전략적 목적 등으로 기타포괄손익-공정가치금융자산 및 당기손익-공정가치금융자산으로 분류된 지분상품에 투자하고 있습니다. 이를 위하여 직·간접적 투자수단을 이용하고 있습니다.

당분기말 현재 지분상품(상장주식)의 주가가 1% 변동할 경우 기타포괄손익(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향은 107,834백만원(전분기: 65,800백만원)이며, 당기손익(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향은 3,750백만원(전분기: 3,333백만원)입니다.

## (2) 신용위험

신용위험은 통상적인 거래 및 투자 활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소를 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정·관리하고 있습니다. 그리고 위험국가에 소재한 거래처의 매출채권은 보험한도 내에서 적절하게 위험 관리되고 있습니다.

신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당 거래는 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등의 금융상품 거래를 포함합니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 당사는 국제 신용등급이 높은 은행(S&P A등급 이상)에 대해서만 거래를 하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 기존에 거래가 없는 금융기관과의 신규 거래는 재정팀과 지역 금융센터의 승인, 관리, 감독하에 이루어지고 있습니다. 당사가 체결하는 금융계약은 부채비율 제한 조항, 담보제공, 차입금 회수 등의 제약조건이 없는 계약을 위주로 체결하고 있으며, 기타의 경우 별도의 승인을 받아 거래하도록 되어 있습니다.

당사의 금융자산 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 당사의 신용위험 최대노출액을 나타내고 있습니다.

### (3) 유동성위험

대규모 투자가 많은 당사 사업 특성상 적정 유동성의 유지가 매우 중요합니다. 당사는 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금 수준 산정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성을 유지·관리하고 있습니다.

당사는 주기적으로 미래 현금 흐름을 예측하여 유동성위험을 사전 관리하고 있습니다. 권역별로 Cash Pooling을 구축·활용하여 권역 내 개별 법인의 자금이 부족한 경우에도 내부 자금을 활용하여 유동성위험을 효과적으로 관리하고 있습니다. Cash Pooling은 자금 부족 회사와 자금 잉여 회사 간 자금을 공유하는 체제로 개별회사의 유동성위험을 최소화하는 한편 자금운용부담 경감 및 금융비용 절감 등의 효과가 있어 당사의 사업 경쟁력 강화에 기여하고 있습니다.

또한, 만약의 대규모 유동성 필요에 대비하여 본사의 지급보증을 통해 해외 종속기업이 활용할 수 있는 차입한도를 확보하고 있습니다.



#### (4) 자본위험

당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해관계자에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 건전한 자본구조를 유지하는 것입니다. 당사는 신용등급, 부채비율 등의 지표를 이용하여 자본위험을 관리하고 있습니다.

2022년 1분기말 현재 당사는 S&P로부터 AA-, Moody's로부터 Aa3 평가등급을 받고 있으며, 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	제54기 1분기말	제53기말
부 채	124,036,040	121,721,227
자 본	315,290,919	304,899,931
부채비율	39.3%	39.9%

## 다. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황

당사는 환율변동 위험관리 목적 상 장부 통화가 아닌 외화 포지션에 대하여 통화선도 (Currency Forward) 상품을 매매하여 헷지하고 있습니다. 통화선도 상품은 매매목적 및 위험회피목적으로 은행을 통하여 매수 또는 매도하고 있습니다.

2022년 1분기말 현재 당사는 USD, EUR, JPY 등 총 35개 통화에 대하여 2,550건의 통화선도 거래를 체결하고 있으며, 관련 자산·부채 장부금액 및 평가손익은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	자산	부채	평가이익	평가손실
통화선도	132,986	193,147	268,405	425,273

그리고 종속회사인 삼성디스플레이(주)는 Corning Incorporated와 2021년 4월 8일 실행된 주식매매계약에 따라, 보유 중인 Corning 지분증권 일부를 Corning에게 매각할수 있는 풋옵션을 보유하고 있습니다.

또한, 삼성디스플레이(주)는 TCL Technology Group Corporation (TCL) 및 TCL China Star Optoelectronics Technology Co. Ltd. (CSOT)와 2021년 4월 1일 실행된 주주간 계약에 따라 CSOT가 상장기한 내 비상장 시, 삼성디스플레이(주)가 보유 중인 CSOT 지분증권 전부 또는 일부를 TCL에게 매각할 수 있는 풋옵션을 보유하고 있습니다. 2022년 1분기말 현재 해당 풋옵션의 공정가치는 한영회계법인이 평가하였습니다.

## 6. 주요계약 및 연구개발활동

### 가. 경영상의 주요 계약 등

계약 상대방	항 목	내 용
Cisco	계약 유형	상호 특허 사용 계약
	체결시기	2014.01.23
	목적 및 내용	상호 특허 라이선스 체결을 통한 소송 등의 특허 분쟁 리스크 해소
Google	계약 유형	상호 특허 사용 계약
	체결시기 및 기간	2014.01.25 (영구)
	목적 및 내용	상호 특허 라이선스 체결을 통한 소송 등의 특허 분쟁 리스크 해소
	기타 주요내용	영구 라이선스 계약 (향후 10년간 출원될 특허까지 포함)
GlobalFoundries	계약 유형	공정 기술 라이선스 계약
	체결시기	2014.02.28
	목적 및 내용	14nm 공정의 고객기반 확대
InterDigital	계약 유형	특허 사용 계약
	체결시기	2014.06.03
	목적 및 내용	특허 라이선스 체결을 통한 소송 등의 특허 분쟁 리스크 해소
Qualcomm	계약 유형	상호 특허 사용 계약
	체결기간	2018.01.01~2023.12.31
	목적 및 내용	상호 특허 라이선스 · 부제소 계약 체결을 통한 소송 등의 특허 분쟁 리스크 해소
Apple	계약 유형	소취하 계약
	체결시기	2018.06.26
	목적 및 내용	양사 간 미국에서 진행 중인 모든 소송 취하
Nokia	계약 유형	특허 사용 계약
	체결시기	2018.10.19
	목적 및 내용	특허 라이선스 체결을 통한 소송 등의 특허 분쟁 리스크 해소
Microsoft	계약 유형	상호 특허 사용 계약
	체결시기	2019.02.11
	목적 및 내용	상호 특허 라이선스 체결을 통한 소송 등의 특허 분쟁 리스크 해소
Google	계약 유형	EMADA
	체결시기 및 기간	2019.02.27~2022.12.31(연장)
	목적 및 내용	유럽 31개국(EEA) 대상으로 Play Store, YouTube 등 구글 앱 사용에 대한 라이선스 계약
Huawei	계약 유형	상호 특허 사용 계약
	체결시기	2019.02.28
	목적 및 내용	상호 특허 라이선스 체결을 통한 소송 등의 특허 분쟁 리스크 해소
AMD	계약 유형	기술 라이선스 계약
	체결시기	2019.05.30
	목적 및 내용	모바일 및 기타 응용 제품에 활용할 수 있는 그래픽 설계자산 확보

Sharp	계약 유형	상호 특허 사용 계약
	체결시기	2019.07.30
	목적 및 내용	상호 특허 라이선스 체결을 통한 소송 등의 특허 분쟁 리스크 해소
Ericsson	계약 유형	상호 특허 사용 계약
	체결시기	2021.05.07
	목적 및 내용	상호 특허 라이선스 체결을 통한 소송 등의 특허 분쟁 리스크 해소

※ 계약 체결 금액 등 기타 분쟁에 참고가 될 사항은 기재하지 않았습니다.

## 나. 연구개발활동의 개요 및 연구개발비용

당사는 고객의 요구를 먼저 파악하고 발상의 전환을 통해 창조적이고 혁신적인 제품, 미래를 선도하는 기술을 지속적으로 창출하여 세계 시장을 선도해 나가고 있습니다. 또한, 세계 IT업계에서의 위상을 더욱 굳건히 하기 위해 차세대 기술과 원천기술을 확보하여 세계 산업 기술을 이끄는 진정한 선도 기업(Leading Company)이 되도록 최선을 다하고 있습니다.

2022년(제54기) 1분기 당사의 연구개발비용은 5조 9,227억원이며, 이 중 정부보조금으로 차감되거나 자산화된 연구개발비를 제외하고 5조 9,222억원을 당기비용으로 회계처리하였습니다.

[연구개발비용]

(단위 : 백만원, %)

과 목		제54기 1분기	제53기	제52기
연구개발비용 총계		5,922,677	22,596,487	21,229,200
(정부보조금)		△445	△1,053	△8,228
연구개발비용 계		5,922,232	22,595,434	21,220,972
회계 처리	개발비 자산화(무형자산)	-	△193,708	△109,482
	연구개발비(비용)	5,922,232	22,401,726	21,111,490
연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용 총계÷당기매출액×100]		7.6%	8.1%	9.0%

※ 연결 누계기준입니다.

[△는 부(-)의 값임]

※ 비율은 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출 총액을 기준으로 산정하였습니다.

## 다. 연구개발 조직 및 운영

### (국내)

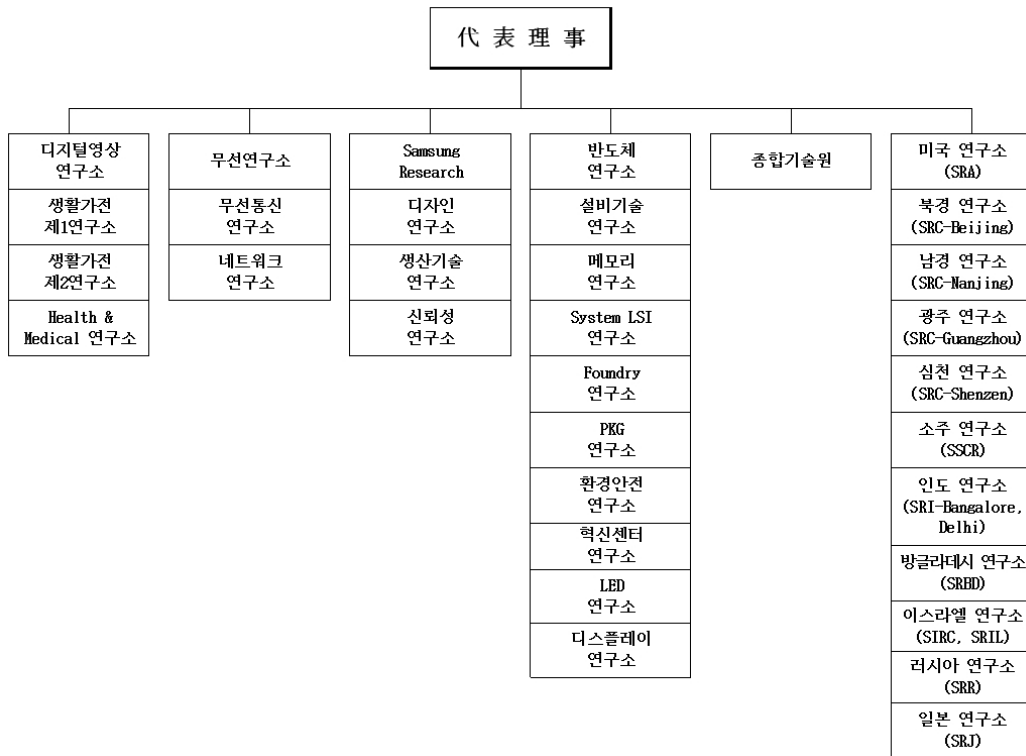
당사는 3계층의 연구개발 조직을 운영하고 있습니다. 1~2년 내에 시장에 선보일 상품화 기술을 개발하는 각 부문 산하 사업부 개발팀, 3~5년 후의 미래 유망 중장기 기술을 개발하는 각 부문 연구소, 그리고 미래 성장엔진에 필요한 핵심 요소 기술을 선행 개발하는 종합기술원 등으로 연구 개발 구조를 체계화하여 운영하고 있습니다.

종합기술원은 미래를 주도할 최첨단 기술의 산실로서 설립된 삼성전자의 중앙연구소로 미래 성장엔진 가시화와 주력사업의 기술 경쟁력 강화 등 전사 차원에서 유망 성장 분야에 대한 연구개발 방향 제시와 창의적 R&D 체제를 구축하고 있습니다.

### (해외)

미국(SRA), 중국(SSCR, SRC-Beijing, SRC-Nanjing, SRC-Guangzhou, SRC-Shenzen), 인도(SRI-Bangalore, SRI-Delhi), 방글라데시(SRBD), 이스라엘(SRIL, SIRC), 러시아(SRR), 일본(SRJ) 등의 지역에 연구개발 조직을 운영하고 있으며 제품 개발 및 기초 기술 연구 등의 연구 활동을 수행 중입니다.

또한, 영국 캠브리지, 러시아 모스크바, 캐나다 토론토·몬트리올, 미국 뉴욕에 AI센터를 설립하여 세계적인 전문가와 한국·미국 등의 AI 연구인력이 함께 AI 분야 기술력을 강화하고 있습니다.



※ 연구개발조직도는 2022년 1분기말 기준입니다.

## 라. 연구개발실적

2022년 1분기 중 당사의 각 부문별 주요 연구개발 실적은 다음과 같습니다.

부문	연구과제 등	연구결과 및 기대효과 등
DX 부문	Neo QLED 8K	• Mini LED 기반 초고화질 & 슬림 8K TV 출시
	Neo QLED 4K	• Mini LED 기반 3개 시리즈, 7개 사이즈 출시
	그랑데 AI 세탁기	• 펌케어 코스 적용된 그랑데 AI 24kg 세탁기 / 그랑데 AI 20kg 건조기 출시
	갤럭시 S22	• Galaxy S22 • S22+ • S22 Ultra 출시
	갤럭시 탭	• Galaxy Tab S8 • S8+ • S8 Ultra 출시
	갤럭시 A	• Galaxy A23 LTE 출시 • Galaxy A13 LTE • 5G 출시
DS 부문	모바일 DRAM	• 업계 최초 LPDDR5X D램 개발
	엑시노스	• 프리미엄 모바일AP 엑시노스 2200 출시
	LSI	• 생체인증카드용 원칩 지문인증 IC(S3B512C) 출시
SDC	QD-Display	• TV형 QD-Display (55" UHD, 65" UHD) • 모니터형 QD-Display (34" QHD)

※상세 현황은 '상세표-4. 연구개발실적(상세)' 참조



## 7. 기타 참고사항

### 가. 지적재산권 관련

당사는 R&D 활동의 지적재산화에도 집중하여 1984년 최초로 미국에 특허를 등록한 이래 현재 세계적으로 총 215,228건의 특허를 보유하고 있으며, 특히 미국에서의 분쟁에 효과적으로 대응하고자 미국에서 가장 많은 특허를 보유하고 있습니다.

(단위 : 건)

[국가별 등록 건수(2022년 1분기말 현재, 연결 기준)]

구분	한국	미국	유럽	중국	일본	기타국가	계
등록건수	47,717	84,668	40,489	19,695	9,002	13,657	215,228

2022년 1분기 중 총 5.9조원의 R&D투자를 통해 국내 특허 2,252건, 미국 특허 1,996건 등을 등록하였습니다.

(단위 : 건)

[주요 국가 연도별 특허등록 건수]

구분	2022년 1분기	2021년	2020년
한국	2,252	8,437	6,648
미국	1,996	8,565	8,520

이 지적재산권은 대부분 스마트폰, 스마트 TV, 메모리, System LSI 등에 관한 특허로써 당사 전략사업 제품에 쓰이거나 향후 활용될 예정이며, 사업 보호의 역할뿐만 아니라 유사 기술·특허가 난립하는 상황에서 경쟁사 견제의 역할도 하고 있습니다. 또한, 미래 신기술 관련 선행 특허 확보를 통하여 향후 신규 사업 진출 시 사업 보호의 역할이 기대되고 있습니다. 당사는 Cisco(2014.01.체결), Google(2014.01.), Qualcomm(2018.01.), Nokia(2018.10.), Microsoft(2019.02.), Sharp(2019.07.), Ericsson(2021.05.) 등과의 특허 라이선스 체결을 통하여, 모바일, 반도체 등 당사 주력사업 및 신사업 분야에서 광범위한 특허 보호망을 확보하고 있습니다.

당사는 상기 특허뿐만 아니라 스마트폰, 스마트 TV 등에 적용된 당사 고유 디자인을보호하고자 디자인특허 확보도 강화하여, 2022년 1분기 중 미국에서 72건의 디자인특허(Design Patent)를 취득하였습니다.

## 나. 환경 관련 규제사항

당사는 법률에서 정하고 있는 각종 제품환경 규제와 사업장관리 환경규제를 철저하게 준수하고 있습니다. 특히 정부의 저탄소 녹색성장 정책에 부응하여 관련 법규에서 요구하는 사업장에서 발생하는 온실가스 배출량과 에너지 사용량을 정부에 신고하고 지속가능보고서 등을 통하여 이해관계자에게 관련 정보를 투명하게 제공하고 있습니다.

### (제품 환경규제 준수)

전자제품은 일반적으로 소비자가 직접 휴대하거나, 가정에 설치하여 사용하고 있어 사용자 건강과 안전에 직·간접적인 영향을 미칠 수 있기 때문에 관련 환경규제가 강화되고 있습니다. 이에 대해 당사는 부품 및 제품의 개발단계부터 제조, 유통, 사용, 폐기 등 제품의 전 과정(Life Cycle)에 걸쳐 환경영향을 최소화하기 위한 활동을 하고있습니다. 유해물질을 제거한 부품 공급을 위해 협력회사 에코파트너 인증 제도를 운영하고 개발단계에서 제품의 친환경 요소(자원 사용 절감, 에너지 절약, 유해 물질 저감, 친환경소재 적용 등)를 제품에 반영하기 위해 에코디자인 평가 제도를 운영하며, 제품 사용 후 발생하는 폐전자제품을 회수하여 재활용하는 폐제품 회수·재활용시스템을 유럽, 북미, 한국, 인도 등 각국에서 운영하고 있습니다. 이러한 활동은 전기·전자 제품 관련 국내외 환경 법규를 준수할 뿐만 아니라 회사와 제품의 차별화 요소로 기여하고 있습니다.

각국 관련 법률은 다음과 같습니다.

1. 폐제품 회수·재활용법 (예: EU WEEE Directive)
2. 유해물질사용 제한 (예: EU RoHS Directive, REACH Regulation)
3. 제품 에너지 소비효율 규정 (예: EU ErP Directive)

## (사업장관리 환경규제 준수)

제품생산과정에서 발생하는 오염물질의 배출을 최소화하기 위하여 대기 오염방지시설, 수질 오염방지시설, 폐기물처리시설과 같은 환경오염방지 시설을 설치하여 운영함으로써 주변 환경에 대한 영향을 최소화 하도록 하고 있습니다.

이러한 사업장의 환경관리는 관련 부처, 지방자치단체의 관리감독을 받고 있으며, 국내 및 글로벌 전 생산 사업장은 국제 환경안전보건경영시스템 인증 (ISO14001, ISO 45001)을 취득하여 법규준수 및 자율관리 체제를 강화하고 있습니다.

국내외 주요한 관련 법률은 다음과 같습니다.

1. 환경오염물질 배출 규제: 「물환경보전법」 「대기환경보전법」 「폐기물관리법」 「소음·진동관리법」 「환경영향평가법」 등
2. 온실가스 배출 관리: 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」 「저탄소 녹색성장 기본법」 등
3. 기타 사업장환경관리법: 「화학물질관리법」 「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」 「악취방지법」 「토양환경보전법」 등

## (온실가스 배출량 및 에너지 사용량 관리)

당사는 「저탄소 녹색성장 기본법」 제42조(기후변화대응 및 에너지의 목표관리) 제6항에 따른 온실가스 에너지 목표관리업체에 해당됩니다. 따라서 동법 제44조(온실가스 배출량 및 에너지 사용량 등의 보고)와 당국의 지침에 따라 제3자 검증을 마친 당사의 온실가스 배출량과 에너지사용량을 2011년 5월부터 정부 당국에 신고하고 이해관계자에게 공개하고 있습니다.

정부에 신고된 당사 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다.

(단위 : tCO<sub>2</sub>-eq, TJ)

구 분	2021년	2020년	2019년
온실가스(tCO <sub>2</sub> -eq)	19,268,916	17,234,522	15,998,397
에너지(TJ)	274,298	255,990	242,345

※ 연결 기준입니다.

※ 대상은 국내 제조사업장, 사옥, 당사 소유 건물, 임차 건물 등입니다.

※ 온실가스 사용실적은 오존파괴물질(ODS) 제외된 기준입니다.

※ 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 정부의 배출량 적합성 평가에 따라 변동될 수 있습니다.

당사는 2015년부터 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」 제8조(할당대상업체의 지정 및 지정취소)에 따라 온실가스 배출권 할당 대상업체에 해당합니다.

## 다. 사업부문별 현황

### [DX 부문]

#### (산업의 특성 등)

DX 부문의 주요 제품인 TV 산업은 1926년 흑백 TV 개발, 1954년 RCA사가 Color TV(21") 양산·판매를 시작한 이래로 트리니트론 브라운관(1967년), 완전평면 브라운관(1996년) 개발 등 기술적인 발전을 거듭해 왔으나, 주요 국가 보급률이 90%를 넘어서면서 브라운관 TV산업의 성장은 정체되었습니다. 그러나 Flat Panel TV(LCD, PDP) 출시, 디지털 방송의 확산 등을 통해 TV 시장은 성장 모멘텀을 되찾았으며, Flat Panel TV는 화질, 디자인 등 제품의 성능 향상과 지속적인 제품가격 하락을 통해 성장을 지속하며 기존의 브라운관 TV 시장을 빠르게 대체하였습니다.

2010년에는 입체감을 느낄 수 있는 3D TV가 출시되었고, 2011년부터 2012년에 걸쳐 인터넷 동영상 서비스 업체의 부상과 스마트기기에 대한 사용자의 관심 확대로 스마트 TV 시장이 태동하였습니다. 이후 2017년에 화질 및 해상도가 혁신적으로 높아진 퀀텀닷 소재를 사용한 QLED TV가 출시되고, 8K와 MICRO LED TV가 상용화되는 등 TV 시장은 끊임없이 진화하고 있습니다.

DX 부문의 또 다른 주요 제품인 휴대폰 산업은 1980년대 초 음성통화만 가능했던 1세대 아날로그 방식으로 시작하여 음성 및 문자 메시지 전송이 가능한 CDMA와 GSM의 2세대 디지털 방식을 거쳐, 음성 데이터뿐만 아니라, 사진, 동영상과 같은 멀티미디어 데이터까지 전송 가능한 WCDMA 등의 3세대 이동통신으로 발전하였습니다. 이후 대용량 데이터의 초고속 전송이 가능한 4세대 LTE 서비스가 전 세계로 확산되어 2021년에 판매된 휴대폰의 75%가 LTE를 지원하고 있습니다(출처: Strategy Analytics 2022.03).

또한, 2019년 초 4차 산업 혁명을 포함하여 미래 변화를 주도할 5세대 이동통신 5G 서비스는 한국과 미국을 시작으로 글로벌 상용화되었으며, 5G 스마트폰은 2020년 2.7억대에서 2021년 6.1억대로 판매가 확대되는 등, 융합 서비스 및 기반 산업의 생태계 조성을 가속화하고 있습니다(출처: Strategy Analytics 2022.02).

스마트폰 시장은 2007년 이후 큰 폭으로 성장하여 2021년 전체 휴대폰 판매량 중 스마트폰의 비중은 77% 수준, 피쳐폰의 비중은 일부 성장 시장에서의 수요로 인해 23% 수준입니다(출처: Strategy Analytics 2022.02). 또한 스마트폰 보급률은 2021년 52%에서 2022년 53%로 소폭 증가할 것으로 전망됩니다(출처: Strategy Analytics 2021.12).

스마트폰 시장이 성숙함에 따라 고성능 AP, 대화면 AMOLED Display, 폴더블 폼팩터, 멀티 카메라, 센서, 방수·방진, 생체 인식 등과 같은 하드웨어뿐 아니라 플랫폼 기반의 Application, UX, Game, Media, Advertisement, Mobile Payment, AI, AR 등 소프트웨어 경쟁력의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다.

## (국내외 시장여건 등)

2021년에는 프리미엄 TV 시장 수요 창출을 위한 화질, 사운드, 폼팩터 혁신 노력이 지속되었지만, TV 전체 시장 수요는 글로벌 물류 대란 및 공급망 차질 영향 등으로 약 2억 1,354만 대로 감소하였습니다. 2022년도 원자재 공급 불안정 확대에 따른 인플레이션 악화 등으로 TV 전체 시장 수요는 2억 1,164만대로 역성장 할 것으로 전망됩니다(출처: Omdia, '21.4분기 전망).

### < TV 시장점유율 추이 >

제 품	2022년 1분기	2021년	2020년
TV	29.9%	29.5%	31.9%

※ 시장점유율은 외부조사기관인 Omdia의 세계시장점유율 자료(금액 기준)를 활용하였습니다.  
(2022년 1분기 시장점유율은 당사 추정치입니다.)

또한 스마트폰 시장은 2021년 13.6억대에서 2022년 13.8억대로 확대가 전망됩니다(출처: Strategy Analytics 2022.03). 그동안 교체수요의 감소 등으로 역성장을 지속했던 태블릿 시장은 코로나19(COVID-19)의 영향 등으로 비대면 수요가 지속됨에 따라 2021년 1.8억대에서 2022년 1.7억대 수준으로 유지될 것으로 전망됩니다(출처: Strategy Analytics 2022.03).

## < 스마트폰 시장점유율 추이 >

제 품	2022년 1분기	2021년	2020년
스마트폰	23.7%	20.0%	19.6%

※ 시장점유율은 외부조사기관인 Strategy Analytics의 세계 시장점유율 자료(수량 기준)를 활용하였습니다.

## (영업의 개황 등)

당사는 2006년 이후 2021년까지 16년 연속으로 TV 판매 1위를 달성하였습니다.

2018년 당사는 세계 최초로 8K TV를 글로벌 시장에 공개하여 다시 한번 TV 산업의프리미엄 제품 리더십을 주도하였습니다. QLED 라인업은 중형에서 초대형까지 다양한 사이즈를 구비하여 소비자에게 폭넓은 선택을 할 수 있는 기회를 제공하였고, 화질도 한층 더 개선되었다는 전문가와 소비자의 평가를 받았습니다. 당사는 QLED뿐만 아니라 UHD 라인업에서도 초대형 사이즈를 구비해서 견조한 실적을 기록하였습니다.

2020년 당사는 코로나19(COVID-19)로 인한 전 세계 경제위기 상황에서도 QLED 4K·8K TV와 Lifestyle TV 신제품(The Terrace, The Premiere, The Sero 등)을 통해 시장 리더십과 지배력을 확대하였습니다.

2021년에는 명암비와 화질을 획기적으로 개선한 Neo QLED TV를 출시하여 프리미엄 제품군을 확대하였습니다. 또한 Lifestyle 제품과 Sound Bar제품의 판매 비중도 상승하고 있으며, TV 플러스, 홈 트레이닝, 게임 등 다양한 스마트 생태계에 참여하는 업체들도 확대되고 있습니다. 특히, 당사는 2021년부터 제품 재질부터 패키징(Packaging)에 이르기까지 친환경 사업에 앞장서는 한편, 접근성을 발전시켜서 시각·청각 장애인도 불편없이 제품을 사용할 수 있도록 지원하고 있습니다.

2022년에는 Neo QLED 8K 혁신 기술들을 중심으로 75" 이상 초대형 프리미엄 시장 점유율을 확대해가는 한편, 더 프리스타일 제품을 도입하여 라이프스타일 라인업을 더욱 보강할 계획입니다. 친환경 기술을 적극 도입하여 해양 플라스틱 재활용 소재를일부 제품에 적용하고, 친환경 리모컨을 신제품 전 모델로 확대 예정입니다.

또한 당사는 주력 사업인 휴대폰 시장에서 글로벌 1위의 위상을 유지하고 있으며, 특히 스마트폰은 2011년 이후 11년 연속 글로벌 1위의 입지를 확고히 하고 있습니다.

또한, 휴대폰 뿐만 아니라 전체 모바일 시장에서의 사업 위상을 강화하기 위해 태블릿과 웨어러블, 액세서리 등의 제품과 함께 서비스, 온라인, B2B 등 미래 성장 동력이 될 수 있는 육성 사업을 적극적으로 확대해 나가고 있습니다.

당사는 프리미엄에서 보급형까지 다양하고 경쟁력 있는 스마트폰 라인업을 활용하여 지역별 시장 상황과 경쟁 환경에 최적화된 제품 포트폴리오를 운영하고 있습니다. 특히 프리미엄 스마트폰은 대화면 Infinity Display에 더해 Dynamic AMOLED 2X(120Hz) 지원, 혁신적인 컨투어 컷(Contour Cut) 디자인 적용, UWB(Ultra Wideband)를 활용한 디지털키 및 콘텐츠 공유, 방수·방진, 고속 유·무선 충전, 초음파 방식의 온스크린 지문 인식, AI 기술을 활용한 고화질 사진 및 고배율 촬영, 8K 동영상 등 고객의 Needs에 기반한 차별화된 기능을 지속해서 선보이고 있습니다.

2019년에는 세계 최초 5G 스마트폰 출시로 5G 시장 리더십을 선점하고 폴더블 디스플레이를 탑재한 '갤럭시 폴드'로 신규 시장을 개척한 데 이어, 2020년에는 상하로 접히는 '갤럭시 Z 플립'과 한층 더 진화된 '갤럭시 Z 폴드2'를 출시하여 폴더블 대중화를 선도하였습니다.

2021년에는 독보적인 장인정신을 기반으로 내구성을 대폭 강화한 3세대 갤럭시 Z 시리즈를 출시 하였습니다. '갤럭시 Z 폴드3'와 '갤럭시 Z 플립3'은 폴더블 스마트폰 최초의 IPX8 등급의 방수기능, 전작 대비 약 80% 향상된 디스플레이 내구성, 20만번의 폴딩 테스트 검증, 언더 디스플레이 카메라, 멀티 태스킹, 멀티 액티브 윈도우, 오토 프레임밍, 듀얼 프리뷰 등 혁신적인 기술과 사용 편의성을 확대하여 최고의 사용자 경험을 제공하고 있습니다. 또한, 빠르게 변화하는 시장과 고객 Needs에 민첩하게 대응하기 위해 중저가 스마트폰에도 5G, 쿼드 카메라, 대화면 Infinity Display, 대용량 배터리 등을 적극적으로 채택하여 제품 경쟁력을 높이고 있습니다.



스마트폰 외에도 대화면 디스플레이의 멀티 태스킹이 가능한 태블릿, 혁신적인 피트니스 및 웰니스 기능이 대거 탑재된 스마트 워치와 풍부하고 뛰어난 사운드 경험을 제공하는 무선 이어폰이 포함된 웨어러블 제품, 급속 무선 충전을 지원하는 충전 스탠드 제품 등 다양한 Galaxy Eco 제품군을 통해 당사 스마트폰을 사용하는 고객에게 더욱 풍부하고 편리한 모바일 경험을 제공하고 있습니다.

당사는 제품과 더불어 그동안 Samsung Pay, Samsung Health, SmartThings 등의 실용적이고 가치 있는 서비스를 제공해 왔으며, 스마트폰 외에도 TV, 냉장고, 에어컨 등 다양한 제품군에 Bixby를 적용하여 고객이 어느 기기를 사용하더라도 일관되고 끊김 없는 경험을 할 수 있는 Multi Device Experience를 제공하고 있습니다.

또한, Ecosystem 확장을 위한 전략적 파트너십도 강화하고 있으며, 5G, AI, IoT, Cloud, AR, Digital Wallet, Mobile B2B 시장 등 미래 성장에 대비한 투자를 지속하여 업계 최고 수준의 R&D 역량을 바탕으로 고객에게 새로운 가치를 끊임없이 제공할 것입니다.

## [DS 부문]

### (산업의 특성 등)

반도체는 일반적으로 정보를 저장하고 기억하는 메모리 반도체와 연산과 추론 등 논리적인 정보처리 기능을 하는 System LSI(비메모리 반도체)로 구분됩니다.

메모리 반도체는 읽고(Read) 쓸 수(Write) 있는 램(RAM, Random Access Memory) 제품과 읽기만 할 수 있는 롬(ROM, Read Only Memory) 제품으로 구분됩니다.

램(RAM)은 전원이 꺼지면 기억된 내용은 지워져 휘발성 메모리(Volatile Memory)라고 하며, 컴퓨터의 주기억 장치, 응용프로그램의 일시적 로딩>Loading), 데이터의 일시적 저장 등에 사용됩니다. 롬(ROM)은 전원이 꺼져도 Data가 지워지지 않는 비휘발성 메모리로 대표적으로 입출력 시스템이나 IC카드 등에 사용됩니다.

System LSI 제품은 응용처에 따라 종류가 다양하며, 중앙처리 장치인 CPU(Central Processing Unit), 그래픽 처리 장치인 GPU(Graphics Processing Unit), ISP(Image Signal Processor), Modem(Modulator-Demodulator) 등을 내장한 모바일 기기용 SOC(System On Chip)가 가장 대표적인 제품입니다. 당사는 스마트폰, 태블릿 등 모바일용 SOC 제품과 이미지 센서, OLED용 DDI(Display Driver IC) 등을 공급하고 있습니다.

한편, 주문형 반도체(Foundry 서비스)는 다른 업체가 설계한 반도체를 위탁 생산해서 공급해 주는 사업으로, 일반 제조업의 OEM 공급과 비슷한 개념의 '수탁 반도체 제조 사업'입니다. 반도체 공정 기술의 고도화와 투자 부담의 증가로 생산 시설을 보유하지 않은 팹리스(Fabless) 업체가 증가하고 있으며, 이러한 팹리스 업체 제품의 위탁생산을 담당하고 있습니다.

## (국내외 시장여건 등)

메모리 시장은 디지털 전환 가속화 속에 생산, 유통, 소비 등 전 부문에 걸친 비대면 산업 성장과 더불어 New Normal 시대의 IT 기기 및 데이터 사용 확대로 응용처 전반에서 견조한 수요를 보이고 있습니다.

데이터센터 중심의 투자 확대와 신규 CPU 출시에 따른 메모리 고용량화로 서버 수요가 강세인 상황에서, 고사양 제품군 위주 PC 수요 견조세, 인도/아프리카 등 이머징 마켓의 5G 확산에 따른 모바일 출하 회복이 수요 성장을 견인하고 있습니다.

반면, 러시아-우크라이나 전쟁 및 인플레이션 심화 등 거시경제 악화 우려에 따른 IT수요 변동 가능성과 주요 IC(Integrated Circuit) 부품 수급 제약 및 글로벌 공급망 차질 등의 악영향으로 시황 불확실성도 상존하고 있습니다.

당사는 고용량·차별화 제품의 출시를 통한 제품 경쟁력 우위를 활용하여 시장 경쟁력을 제고하고, 불확실한 시장 상황에 대응하기 위해 고객사들의 수요에 영향을 미칠수 있는 공급망 차질 등 다양한 이슈를 선제적으로 파악하여 고객 수요에 적기 대응하고 있습니다.

### < DRAM 시장점유율 추이 >

제 품	2022년 1분기	2021년	2020년
DRAM	43.5%	43.0%	42.7%

※ 시장점유율은 외부조사기관인 DRAMeXchange의 세계시장점유율 자료(금액 기준)를 활용하였습니다.

## (영업의 개황 등)

당사는 메모리 사업에서 기술 리더십을 통한 원가 경쟁력 우위를 유지하고, 고부가/고용량 중심 제품 포트폴리오 운영과 더불어 고객이 원하는 제품을 적기 공급할 수 있는 제품 경쟁력을 강화하고 있습니다.

세계 최초로 Multi-step EUV가 본격 적용된 차세대 DRAM 양산 체계를 선제적으로 갖추고, 7세대 V-NAND 채용 SSD 등 선단 제품 라인업을 확보하여 생산 및 원가 경쟁력을 강화함으로써 5G, AI 등 차세대성장 분야에서의 리더십을 공고히 할 예정입니다.

또한 당사는 불확실한 시장 상황에서도 선단공정을 기반으로 차별화된 제품을 확대하고, 다양한 제품 라인업을 활용하여 응용처별로 최적의 대응을 함으로써 메모리 1위 업체로서 지속적으로 시장을 선도해 나갈 것입니다.

System LSI는 글로벌 반도체 공급 부족의 심화로 고객들의 부품 수요 대비 Foundry공급 물량이 제한적인 상황으로, 당사는 Supply Chain 강화 및 공급처 다변화를 통한공급확대로 수요 증가에 대응하면서, 판매가격을 인상하여 매출을 증대시켜 나가고 있습니다. 또한 주요 제품군들의 제품 라인업 강화를 통한 고객확대, Fab 다변화 및 생산능력 확보, 제품경쟁력 향상을 위한 신기술 개발 및 기존 기술과의 융복합 등을 통해 새로운 사업기회를 발굴하고 있습니다.

Foundry는 오미크론 확산, 글로벌 경기 둔화 등으로 중국을 중심으로 모바일/PC 수요 둔화 조짐이 보이고 있으나, 모바일 5G 증가, HPC 수요 강세 등에 힘입어 공급 부족 상황이 지속 중이며, 이에 당사는 지속 안정적인 공급 역량 확보에 집중하고 있습니다. 당사의 선단 공정은 5나노/4나노 제품을 양산 진행 중이며, 기술 완성도 선행 확보 및 파생 공정 개발로 응용 포트폴리오 다변화를 준비하고 있으며, 레거시 공정은 기술/원가 개선을 통한 공정 경쟁력 확보에 집중하고 있습니다. 이를 통해 시장/고객 확대를 적극 추진하는 한편 시장의 수요와 공급을 고려한 가격 정책을 통해 수익성도 강화해 나갈 예정입니다.

## [SDC]

### (산업의 특성 등)

디스플레이(Display)는 각종 전자기기에 사용되는 화면표시장치를 지칭합니다. 표시방식 측면에서 표시 소자가 능동적으로 구동되는(Active Matrix) 방식이 주류이며, OLED(Organic Light Emitting Diode)와 TFT-LCD(Thin Film Transistor Liquid Crystal Display)가 이에 해당합니다.

OLED는 스스로 빛을 내는 유기물질을 이용한 화면표시장치로, 명암비와 색 일치율이 높고 색 재현 범위가 넓으며 응답 속도가 빠르다는 장점이 있습니다. 이러한 장점을 바탕으로 OLED 디스플레이는 멀티미디어 콘텐츠, 인터넷 사용 등 디스플레이의 성능이 중시되는 스마트폰 시장에서 채용이 빠르게 증가하고 있습니다. 과거에는 OLED로 고해상도의 장수명 패널을 구현하는 것에 대해 시장의 큰 우려가 있었으나, 당사는 기술적 한계를 극복하여 시장을 발전시켜 왔습니다. OLED는 LCD 디스플레이의 단점을 극복할 뿐만 아니라, 앞으로 폴더블, 롤러블, 전장 등 다른 응용처로 확대 적용이 가능하며 앞으로 시장이 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.

TFT-LCD는 액정을 이용한 화면표시장치로서, 가볍고 얇으면서도 높은 해상도를 구현할 수 있어, 휴대성이 강조되는 휴대전화에서부터 높은 해상도와 밝기를 요구하는 대형 TV까지 응용처가 매우 다양합니다. 대형 TFT-LCD 산업은 노트북을 시작으로 모니터, TV 순서로 시장이 급속히 성장하여 왔으나, 보급률이 크게 높아짐에 따라 성장률은 둔화하는 추세를 보이고 있습니다.

### (국내외 시장여건 등)

스마트폰용 디스플레이 패널의 시장은 2021년 17.4억대에서 2022년 16.2억대로 감소될 것으로 전망합니다. 반면 스마트폰용 OLED 디스플레이 패널의 경우 2021년 6.1억대에서 2022년 6.8억대로 확대될 전망이며, 전체 스마트폰 디스플레이 패널에서 차지하는 비중 또한 2021년 35%에서 2022년 42%로 증가할 것으로 전망됩니다(출처: Omdia 2022.01).

대형 디스플레이 패널 시장은 2021년 9.8억대에서 2022년 10.2억대로 증가될 전망입니다. 코로나19(COVID-19)로 인해 확대된 비대면 활동이 지속되며 모니터, 노트북의 수요 증가가 2022년에도 유지될 것으로 예상되고 있습니다.

### < 스마트폰 패널 시장점유율 추이 >

제 품	2022년 1분기	2021년	2020년
스마트폰 패널	50.1%	51.4%	44.8%

※ 시장점유율은 외부조사기관인 Omdia의 세계시장점유율 자료(금액 기준)를 활용하였습니다.  
(2022년 1분기 시장점유율은 외부조사기관의 예측치입니다.)

### (영업의 개황 등)

당사는 2007년 세계 최초로 OLED 제품의 상용화에 성공한 이후 현재까지 중소형 OLED 시장에서 독보적인 점유율을 유지하고 있습니다. 또한 스마트폰 외에도 폴더블, 태블릿, 워치, 노트북, 전장 등으로 제품군을 다각화하여 명실상부한 OLED 디스플레이의 선도 기업으로 자리매김하였습니다.

당사는 Flexible OLED와 Rigid OLED 패널을 통해 프리미엄부터 보급형 제품까지 최적의 제품 포트폴리오를 구축하여 소비자의 고도화되는 Needs에 적극 대응하고 있습니다. 또한 차별화된 기능과 디자인의 폴더블·OLED IT 제품을 지속적으로 출시하여 시장으로부터 업계 최고의 기술력을 인정받고 있습니다.

2022년에는 거시 환경의 변화 속에서, 스마트폰 시장은 제한적으로 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 당사는 고객사 Needs에 발맞춰 저소비전력, 고속구동, UPC(Under Panel Camera) 등 신기술 적용을 확대하는 한편, 원가 경쟁력을 강화하여 스마트폰 제품에서의 OLED 패널 채용률을 지속적으로 높여가겠습니다. 또한 스마트폰에 편중된 중소형 패널 사업을 다각화하여, IT, Game, Auto 제품 등으로 제품 포트폴리오를 확대하고 사업 리더십을 더욱 견고히 하겠습니다.

한편, 대형 패널 사업은 차별화된 기술 기반의 QD 디스플레이를 본격 양산하여 프리미엄 제품군에서 확실히 자리매김할 수 있는 사업 기반을 구축하도록 하겠습니다.

## [Harman]

### (산업의 특성 등)

Harman은 전장부품(Automotive)과 라이프스타일 오디오(Lifestyle Audio) 산업에서 경쟁하고 있습니다.

전장부품(디지털 콕핏, 텔레매틱스, 카 오디오 등)의 소비자들이 지속해서 가장 최신 기술을 요구함에 따라, 자동차 제조사는 교통수단 공유, 자율주행 등의 분야에서 가장 앞선 기술을 요구하고 있습니다. 특히 전장산업의 커넥티비티(Connectivity) 및 엔터테인먼트 솔루션 시장에서 주요 업체(Alpine, Aptiv, Continental, Mitsubishi, Panasonic 등)간 경쟁이 매우 치열합니다. 당사는 카 오디오(Car Audio) 분야에서 시스템 솔루션뿐만 아니라 오디오 컴포넌트(스피커, 앰프 등)도 제공하고 있으며, 주요 업체(Bose, Pioneer, Panasonic) 간 경쟁이 매우 치열합니다. 이 분야는 지속적인 기술 발전이 예상되며, 여러 카 오디오 업체가 다양한 음향관리 솔루션 개발 등으로 차별화해 나갈 것으로 전망됩니다. 따라서 향후 지속해서 업체 간 경쟁이 치열할 것으로 예상됩니다.

라이프스타일 오디오 산업은 소비자 오디오와 프로페셔널(Professional) 오디오 솔루션으로 구분됩니다. 소비자 오디오(포터블 스피커, 헤드폰, 커넥티드 오디오 솔루션 등) 산업은 상대적으로 시장점유율 집중도가 낮으며 소수의 선도 업체(Amazon, Beats, Bose, Ultimate Ears 등)가 있습니다. 특히 커넥티드 홈(Connected Home)과 스마트 스피커 제품이 시장을 계속 포화 상태로 만들고 있기 때문에 다른 산업에서 진입하는 새로운 업체와 기존 업체 간 경쟁 상황이 지속될 것으로 전망됩니다. 특히 휴대폰 제조사가 절대적인 시장점유율을 차지하고 있는 True Wireless 헤드폰 분야는 폭발적인 성장이 예상됩니다.

프로페셔널 오디오 솔루션(상업용 · 대규모 공연장 등에서의 오디오, 특수조명, 영상컨트롤 솔루션 등) 산업은 제품 종류에 따라 세분화되어 있고 제품의 응용 방식에 따라 다양한 업체가 진출한 상태입니다. QSC와 Yamaha가 현재 산업 내에서 널리 알려진 선도 업체입니다.

## (국내외 시장여건 등)

전장부품 시장과 연관성이 높은 자동차의 2021년 글로벌 생산량은 2020년 대비 3% 증가하였습니다. 전장부품 시장은 반도체 공급부족으로 자동차 제조사들의 2021년 자동차 생산에 제약이 있었으며 Harman 또한 이에 따른 부정적 영향이 있었으나, 라이프스타일 오디오 제품에 대한 수요는 코로나19(COVID-19)가 완화되어 일부 회복되었습니다.

2022년 전세계 자동차 생산은 2021년 대비 7% 수준 증가할 것으로 예상됩니다(출처: 2022 IHS Global Light Vehicle Production Forecast).

### < 디지털 콕핏 시장점유율 추이 >

제 품	2022년 1분기	2021년	2020년
디지털 콕핏	24.7%	25.3%	27.5%

- ※ 디지털 콕핏(Digital Cockpit)은 인포테인먼트 시스템 등을 통해 안전한 운전 환경을 제공하는 디지털 전장부품입니다.
- ※ 시장점유율은 외부조사기관인 I.H.S 와 LMC의 자료(수량 기준)를 활용한 당사 추정치입니다.



## (영업의 개황 등)

당사의 Harman은 전장부품 시장에서 선도 기업의 위상을 유지하고 있습니다. 대량 판매 시장에서부터 고급 특화 시장에 걸쳐 차량에 지속적으로 폭넓고 다양한 브랜드를 활용하는 한편, Harman 브랜드에 부합하는 품질 수준을 유지할 계획입니다. 더불어, 카 오디오와 커넥티비티(Connectivity) 분야에서 끊임없이 혁신에 집중하는 것은 자동차 제조사와의 공존을 견고히 하는데 도움이 될 것입니다. 추가적으로 선도기술인 OTA(Over the Air)와 소프트웨어 서비스를 통해 커넥티드 서비스를 지속적으로 제공할 것입니다.

자동차 시장에서의 여러 성공 요인은 소비자 오디오 및 프로페셔널 오디오 솔루션 시장에서도 유사하게 적용될 것입니다. 그래미상 3회, 아카데미상 2회 등을 수상한 바와 같이 여러 Harman 브랜드는 일상적인 소비자와 음악 애호가 사이에서 명성을 쌓아왔습니다. 무선 스마트 스피커와 같은 전도 유망한 분야에서 신제품을 제공하는 것은 신규 고객을 당사로 유인함과 동시에 브랜드 평판을 더욱 강화하는데 지속적으로 도움이 될 것입니다.

2020년 코로나19(COVID-19)의 세계적 유행은 자동차 생산의 중단, 소비·유동 인구의 감소, 소매점의 영업 중단 등 부정적인 영업 환경을 초래하였습니다. 특히, 프로페셔널 오디오 솔루션 사업은 대규모 모임 및 이벤트 축소 등으로 인해 부정적인 영향을 받았습니다. 당사는 코로나19(COVID-19)의 대유행이 시작되었을 때 다양한 비용 절감 방안을 도입하였으며, 비용을 절감한 분야에 대해서는 향후 재투자를 통해 효율적으로 시장에서 경쟁할 계획입니다.

## 라. 사업부문별 요약 재무 현황

2022년(제54기) 1분기 매출은 DX 부문이 48조 687억원(61.8%), DS 부문이 26조 8,674억원(34.5%)이며, SDC가 7조 9,705억원(10.2%), Harman은 2조 6,663억원(3.4%)입니다.

2022년 1분기 영업이익은 DX 부문이 4조 5,555억원으로 전체이익의 32.3%, DS 부문이 8조 4,501억원으로 전체이익의 59.8%를 차지하며, SDC가 1조 929억원(7.7%), Harman은 1,016억원(0.7%)입니다.

(단위 : 억원, %)

부문	구 분	제54기 1분기		제53기		제52기	
		금액	비중	금액	비중	금액	비중
DX 부문	매출액	480,687	61.8%	1,662,594	59.5%	1,489,135	62.9%
	영업이익	45,555	32.3%	173,866	33.7%	151,520	42.1%
	총자산	2,617,596	43.2%	2,479,832	42.0%	2,303,623	43.6%
DS 부문	매출액	268,674	34.5%	953,872	34.1%	740,540	31.3%
	영업이익	84,501	59.8%	291,920	56.5%	188,062	52.2%
	총자산	2,301,502	38.0%	2,258,223	38.3%	1,885,692	35.7%
SDC	매출액	79,705	10.2%	317,125	11.3%	305,857	12.9%
	영업이익	10,929	7.7%	44,574	8.6%	22,369	6.2%
	총자산	649,992	10.7%	668,836	11.3%	661,929	12.5%
Harman	매출액	26,663	3.4%	100,399	3.6%	91,837	3.9%
	영업이익	1,016	0.7%	5,991	1.2%	555	0.2%
	총자산	156,327	2.6%	158,874	2.7%	147,020	2.8%

※ 각 사업부문별 요약 재무 현황은 부문 등 간 내부거래를 포함하고 있습니다.

※ 제53기, 제52기는 2021년 12월의 조직변경을 반영하여 제54기 기준으로 재작성하였습니다.

### (공통 판매비와 관리비 및 자산의 합리적 배부 기준 적용)

- 공통 판매비와 관리비의 경우 각 제품·모델별 귀속이 확실한 직접비용(위임성 경비)은 각 제품·모델부문에 직접 귀속시키고 귀속여부가 불분명한 공통경비는 각 배부 기준(매출액비, 인원수비 등)에 의거 적절히 배부하고 있습니다.
- 공통자산의 경우 직접귀속이 가능한 자산(재고자산, 고정자산, 투자자산 등)은 해당 부서에 직접 귀속되나, 전사 공통관리가 필요한 자산 및 자산귀속이 불분명한 자산은 필요한 경우 합리적인 배부 기준(매출액비, 세전이익비 등)에 의거 각 부문에 배부하고 있습니다.

### III. 재무에 관한 사항

#### 1. 요약재무정보

##### 가. 요약연결재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제54기 1분기	제53기	제52기
	2022년 3월말	2021년 12월말	2020년 12월말
[유동자산]	232,369,082	218,163,185	198,215,579
· 현금및현금성자산	48,944,982	39,031,415	29,382,578
· 단기금융상품	75,121,426	81,708,986	92,441,703
· 기타유동금융자산	1,808,281	3,409,791	2,828,562
· 매출채권	44,464,968	40,713,415	30,965,058
· 재고자산	47,590,731	41,384,404	32,043,145
· 기타	14,438,694	11,915,174	10,554,533
[비유동자산]	206,957,877	208,457,973	180,020,139
· 기타비유동금융자산	14,697,680	15,491,183	13,778,185
· 관계기업 및 공동기업 투자	8,841,605	8,932,251	8,076,779
· 유형자산	149,618,019	149,928,539	128,952,892
· 무형자산	20,010,694	20,236,244	18,468,502
· 기타	13,789,879	13,869,756	10,743,781
자산총계	439,326,959	426,621,158	378,235,718
[유동부채]	90,463,701	88,117,133	75,604,351
[비유동부채]	33,572,339	33,604,094	26,683,351
부채총계	124,036,040	121,721,227	102,287,702
[지배기업 소유주지분]	306,391,870	296,237,697	267,670,331
· 자본금	897,514	897,514	897,514
· 주식발행초과금	4,403,893	4,403,893	4,403,893
· 이익잉여금	301,743,152	293,064,763	271,068,211
· 기타	△652,689	△2,128,473	△8,699,287
[비지배지분]	8,899,049	8,662,234	8,277,685
자본총계	315,290,919	304,899,931	275,948,016
	2022년 1월~3월	2021년 1월~12월	2020년 1월~12월
매출액	77,781,498	279,604,799	236,806,988
영업이익	14,121,409	51,633,856	35,993,876
연결총당기순이익	11,324,628	39,907,450	26,407,832
· 지배기업 소유주지분	11,129,094	39,243,791	26,090,846
· 비지배지분	195,534	663,659	316,986
기본주당순이익(단위 : 원)	1,638	5,777	3,841
희석주당순이익(단위 : 원)	1,638	5,777	3,841
연결에 포함된 회사수	232개	229개	242개

\* 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

[△는 부(-)의 값임]

\* 기본주당이익(보통주) 산출근거는 제52기~제53기 연결감사보고서 및 제54기 분기 연결검토보고서 주석사항을 참조하시기 바랍니다.

## 나.요약별도재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제54기 1분기	제53기	제52기
	2022년 3월말	2021년 12월말	2020년 12월말
[유동자산]	81,466,028	73,553,416	73,798,549
· 현금및현금성자산	9,129,795	3,918,872	989,045
· 단기금융상품	12,802,352	15,000,576	29,101,284
· 매출채권	34,711,648	33,088,247	24,736,740
· 재고자산	18,708,199	15,973,053	13,831,372
· 기타	6,114,034	5,572,668	5,140,108
[비유동자산]	177,887,983	177,558,768	155,865,878
· 기타비유동금융자산	1,590,164	1,664,667	1,542,766
· 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자	56,196,646	56,225,599	56,587,548
· 유형자산	104,032,562	103,667,025	86,166,924
· 무형자산	8,333,496	8,657,456	7,002,648
· 기타	7,735,115	7,344,021	4,565,992
자산총계	259,354,011	251,112,184	229,664,427
[유동부채]	56,799,776	53,067,303	44,412,904
[비유동부채]	4,278,465	4,851,149	1,934,799
부채총계	61,078,241	57,918,452	46,347,703
[자본금]	897,514	897,514	897,514
[주식발행초과금]	4,403,893	4,403,893	4,403,893
[이익잉여금]	193,973,301	188,774,335	178,284,102
[기타]	△998,938	△882,010	△268,785
자본총계	198,275,770	193,193,732	183,316,724
종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법
	2022년 1월~3월	2021년 1월~12월	2020년 1월~12월
매출액	56,724,258	199,744,705	166,311,191
영업이익	9,151,831	31,993,162	20,518,974
당기순이익	7,651,943	30,970,954	15,615,018
기본주당순이익(단위 : 원)	1,127	4,559	2,299
희석주당순이익(단위 : 원)	1,127	4,559	2,299

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

[△는 부(-)의 값임]

※ 기본주당이익(보통주) 산출근거는 제52기~제53기 감사보고서 및 제54기 분기 검토보고서 주석사항을 참조하시기 바랍니다.

## 2. 연결재무제표

### 연결 재무상태표

제 54 기 1분기말 2022.03.31 현재

제 53 기말 2021.12.31 현재

(단위 : 백만원)

	제 54 기 1분기말	제 53 기말
자산		
유동자산	232,369,082	218,163,185
현금및현금성자산	48,944,982	39,031,415
단기금융상품	75,121,426	81,708,986
단기상각후원가금융자산	1,755,225	3,369,034
단기당기손익-공정가치금융자산	53,056	40,757
매출채권	44,464,968	40,713,415
미수금	5,652,435	4,497,257
선급비용	3,042,846	2,336,252
재고자산	47,590,731	41,384,404
기타유동자산	5,743,413	5,081,665
비유동자산	206,957,877	208,457,973
기타포괄손익-공정가치금융자산	13,201,558	13,965,839
당기손익-공정가치금융자산	1,496,122	1,525,344
관계기업 및 공동기업 투자	8,841,605	8,932,251
유형자산	149,618,019	149,928,539
무형자산	20,010,694	20,236,244
순확정급여자산	2,430,319	2,809,590
이연법인세자산	4,178,984	4,261,214
기타비유동자산	7,180,576	6,798,952
자산총계	439,326,959	426,621,158
부채		
유동부채	90,463,701	88,117,133
매입채무	15,133,906	13,453,351
단기차입금	13,885,889	13,687,793
미지급금	18,301,154	15,584,866
선수금	1,458,905	1,224,812
예수금	934,237	1,294,052
미지급비용	25,100,718	27,928,031
당기법인세부채	7,193,754	6,749,149
유동성장기부채	864,905	1,329,968
총당부채	5,910,808	5,372,872
기타유동부채	1,679,425	1,492,239
비유동부채	33,572,339	33,604,094
사채	518,856	508,232

장기차입금	2,780,707	2,866,156
장기미지급금	2,566,573	2,991,440
순확정급여부채	476,903	465,884
이연법인세부채	23,705,374	23,198,205
장기충당부채	2,249,619	2,306,994
기타비유동부채	1,274,307	1,267,183
부채총계	124,036,040	121,721,227
자본		
지배기업 소유주지분	306,391,870	296,237,697
자본금	897,514	897,514
우선주자본금	119,467	119,467
보통주자본금	778,047	778,047
주식발행초과금	4,403,893	4,403,893
이익잉여금(결손금)	301,743,152	293,064,763
기타자본항목	(652,689)	(2,128,473)
비지배지분	8,899,049	8,662,234
자본총계	315,290,919	304,899,931
부채와자본총계	439,326,959	426,621,158

# 연결 손익계산서

제 54 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지

제 53 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지

(단위 : 백만원)

	제 54 기 1분기		제 53 기 1분기	
	3개월	누적	3개월	누적
수익(매출액)	77,781,498	77,781,498	65,388,503	65,388,503
매출원가	47,072,057	47,072,057	41,499,985	41,499,985
매출총이익	30,709,441	30,709,441	23,888,518	23,888,518
판매비와관리비	16,588,032	16,588,032	14,505,650	14,505,650
영업이익	14,121,409	14,121,409	9,382,868	9,382,868
기타수익	700,193	700,193	299,742	299,742
기타비용	453,110	453,110	324,240	324,240
지분법이익	232,477	232,477	147,519	147,519
금융수익	3,502,189	3,502,189	2,238,638	2,238,638
금융비용	3,033,318	3,033,318	1,993,882	1,993,882
법인세비용차감전순이익(손실)	15,069,840	15,069,840	9,750,645	9,750,645
법인세비용	3,745,212	3,745,212	2,608,960	2,608,960
계속영업이익(손실)	11,324,628	11,324,628	7,141,685	7,141,685
당기순이익(손실)	11,324,628	11,324,628	7,141,685	7,141,685
당기순이익(손실)의 귀속				
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	11,129,094	11,129,094	7,092,786	7,092,786
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	195,534	195,534	48,899	48,899
주당이익				
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,638	1,638	1,044	1,044
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,638	1,638	1,044	1,044



## 연결 포괄손익계산서

제 54 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지

제 53 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지

(단위 : 백만원)

	제 54 기 1분기		제 53 기 1분기	
	3개월	누적	3개월	누적
당기순이익(손실)	11,324,628	11,324,628	7,141,685	7,141,685
기타포괄손익	1,519,476	1,519,476	4,299,126	4,299,126
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(663,316)	(663,316)	1,866,697	1,866,697
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(604,180)	(604,180)	1,885,011	1,885,011
관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분	3,752	3,752	14,425	14,425
순확정급여부채(자산) 재측정요소	(62,888)	(62,888)	(32,739)	(32,739)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	2,182,792	2,182,792	2,432,429	2,432,429
관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분	(260,583)	(260,583)	(53,921)	(53,921)
해외사업장환산외환차이	2,437,033	2,437,033	2,457,265	2,457,265
현금흐름위험회피파생상품평가손익	6,342	6,342	29,085	29,085
총포괄손익	12,844,104	12,844,104	11,440,811	11,440,811
포괄손익의 귀속				
지배기업 소유주지분	12,607,150	12,607,150	11,221,179	11,221,179
비지배지분	236,954	236,954	219,632	219,632

# 연결 자본변동표

제 54 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지

제 53 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지

(단위 : 백만원)

	자본							
	지배기업 소유주지분						비지배지분	자본 합계
	자본금	주식발행초 과금	이익잉여금	기타자본항목	매각예정분류 기타자본항목	지배기업 소유주 지분 합계		
2021.01.01 (기초자본)	897,514	4,403,893	271,068,211	(8,687,155)	(12,132)	267,670,331	8,277,685	275,948,016
당기순이익(손실)			7,092,786			7,092,786	48,899	7,141,685
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익			1,029,405	727,402		1,756,807	128,204	1,885,011
관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분				(25,556)		(25,556)	(13,940)	(39,496)
해외사업장환산외환차이				2,400,810		2,400,810	56,455	2,457,265
순확정급여부채(자산) 재측정요소				(32,753)		(32,753)	14	(32,739)
현금흐름위험회피파생상품평가손익				29,085		29,085		29,085
매각예정분류				(28,187)	28,187	0		0
배당			(13,124,260)			(13,124,260)	(310)	(13,124,570)
연결실체내 자본거래 등						0	(288)	(288)
기타				4		4	4,618	4,622
2021.03.31 (기말자본)	897,514	4,403,893	266,066,142	(5,616,350)	16,055	265,767,254	8,501,337	274,268,591
2022.01.01 (기초자본)	897,514	4,403,893	293,064,763	(2,128,473)	0	296,237,697	8,662,234	304,899,931
당기순이익(손실)			11,129,094			11,129,094	195,534	11,324,628
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익			2,272	(615,197)		(612,925)	8,745	(604,180)
관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분				(257,360)		(257,360)	529	(256,831)
해외사업장환산외환차이				2,404,883		2,404,883	32,150	2,437,033
순확정급여부채(자산) 재측정요소				(62,884)		(62,884)	(4)	(62,888)
현금흐름위험회피파생상품평가손익				6,342		6,342		6,342
매각예정분류						0		0
배당			(2,452,977)			(2,452,977)	(527)	(2,453,504)
연결실체내 자본거래 등						0	(228)	(228)
기타						0	616	616
2022.03.31 (기말자본)	897,514	4,403,893	301,743,152	(652,689)	0	306,391,870	8,899,049	315,290,919

## 연결 현금흐름표

제 54 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지

제 53 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지

(단위 : 백만원)

	제 54 기 1분기	제 53 기 1분기
영업활동 현금흐름	10,453,069	13,803,078
영업에서 창출된 현금흐름	10,997,043	14,690,873
당기순이익	11,324,628	7,141,685
조정	13,905,730	10,883,856
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(14,233,315)	(3,334,668)
이자의 수취	334,026	326,714
이자의 지급	(159,077)	(77,591)
배당금 수입	50,084	54,930
법인세 납부액	(769,007)	(1,191,848)
투자활동 현금흐름	(636,511)	(1,577,609)
단기금융상품의 순감소(증가)	6,191,962	7,511,917
단기상각후원가금융자산의 순감소(증가)	1,673,885	(695,948)
단기당기손익-공정가치금융자산의 순감소(증가)	(12,299)	11,956
장기금융상품의 처분	4,035,852	2,940,505
장기금융상품의 취득	(2,843,388)	(3,260,672)
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	30	1,906,245
기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(5,594)	(56,131)
당기손익-공정가치금융자산의 처분	20,629	13,053
당기손익-공정가치금융자산의 취득	(54,931)	(8,153)
관계기업 및 공동기업 투자의 처분	5,300	0
관계기업 및 공동기업 투자의 취득	(6,100)	(14,500)
유형자산의 처분	68,730	99,129
유형자산의 취득	(8,706,839)	(9,997,540)
무형자산의 처분	126	15
무형자산의 취득	(853,443)	(671,020)
사업결합으로 인한 현금유출액	(23,237)	(5,926)
기타투자활동으로 인한 현금유출입액	(127,194)	649,461
재무활동 현금흐름	(495,346)	(594,323)
단기차입금의 순증가(감소)	213,034	(400,336)
장기차입금의 차입	1,000	0
사채 및 장기차입금의 상환	(708,717)	(193,240)
배당금의 지급	(461)	(458)
비지배지분의 증감	(202)	(289)
매각예정분류	0	(551,129)
외화환산으로 인한 현금의 변동	592,355	576,996
현금및현금성자산의 순증감	9,913,567	11,657,013

기초의 현금및현금성자산	39,031,415	29,382,578
기말의 현금및현금성자산	48,944,982	41,039,591

### 3. 연결재무제표 주석

제 54 기 분기 : 2022년 3월 31일 현재

제 53 기 : 2021년 12월 31일 현재

삼성전자주식회사와 그 종속기업

#### 1. 일반적 사항:

##### 가. 연결회사의 개요

삼성전자주식회사(이하 "회사")는 1969년 대한민국에서 설립되어 1975년에 대한민국의 증권거래소에 상장하였습니다. 회사 및 종속기업(이하 삼성전자주식회사와 그 종속기업을 일괄하여 "연결회사")의 사업은 DX 부문, DS 부문, SDC, Harman으로 구성되어 있습니다. DX(Device eXperience) 부문은 TV, 냉장고, 휴대폰, 통신시스템 등의 사업으로 구성되어 있으며, DS(Device Solutions) 부문은 메모리, Foundry, System LSI 등으로 구성되어 있습니다. SDC는 디스플레이 패널 사업을 영위하며, Harman은 전장부품사업 등을 영위하고 있습니다. 회사의 본점 소재지는 경기도 수원시입니다.

기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배회사인 회사는 삼성디스플레이(주) 및 Samsung Electronics America, Inc. (SEA) 등 231개의 종속기업을 연결대상으로 하고, 삼성전기(주) 등 41개 관계기업과 공동기업을 지분법적용대상으로 하여 연결재무제표를 작성하였습니다.

## 나. 종속기업 현황

당분기말 현재 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
미주	Samsung Electronics America, Inc. (SEA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung International, Inc. (SII)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Mexicana S.A. de C.V (SAMEX)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Home Appliances America, LLC (SEHA)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Research America, Inc (SRA)	R&D	100.0
	Samsung Next LLC (SNX)	해외자회사 관리	100.0
	Samsung Next Fund LLC (SNXF)	신기술사업자, 벤처기업 투자	100.0
	NeuroLogica Corp.	의료기기 생산 및 판매	100.0
	Samsung HVAC America, LLC	에어컨공조 판매	100.0
	Joyent, Inc.	클라우드서비스	100.0
	Dacor Holdings, Inc.	해외자회사 관리	100.0
	Dacor, Inc.	가전제품 생산 및 판매	100.0
	Dacor Canada Co.	가전제품 판매	100.0
	SmartThings, Inc.	스마트홈 플랫폼	100.0
	TeleWorld Solutions, Inc. (TWS)	네트워크장비 설치 및 최적화	100.0
	Samsung Semiconductor, Inc. (SSI)	반도체 · DP 판매	100.0
	Samsung Austin Semiconductor LLC (SAS)	반도체 생산	100.0
	Samsung Oak Holdings, Inc. (SHI)	해외자회사 관리	100.0
	SEMES America, Inc.	반도체 장비 서비스	100.0
	Samsung Electronics Canada, Inc. (SECA)	전자제품 판매	100.0
	AdGear Technologies Inc.	디지털광고 플랫폼	100.0

(\*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
미주	Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics Mexico S.A. de C.V. (SEM)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Digital Appliance Mexico, S.A. de C.V. (SEDAM)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Latinoamerica(Zona Libre), S. A. (SELA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Latinoamerica Miami, Inc. (SEMI)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronica Colombia S.A. (SAMCOL)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Argentina S.A. (SEASA)	마케팅 및 서비스	100.0
	Samsung Electronics Chile Limitada (SECH)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Peru S.A.C. (SEPR)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Venezuela, C.A. (SEVEN)	마케팅 및 서비스	100.0
	Samsung Electronics Panama. S.A. (SEPA)	컨설팅	100.0
	Harman International Industries, Inc.	해외자회사 관리	100.0
	Harman Becker Automotive Systems, Inc.	오디오제품 생산, 판매, R&D	100.0
	Harman Connected Services, Inc.	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services Engineering Corp.	Connected Service Provider	100.0
	Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	오디오제품 생산, 판매	100.0
	Harman de Mexico, S. de R.L. de C.V.	오디오제품 생산	100.0
	Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman Financial Group LLC	Management Company	100.0
	Harman International Industries Canada Ltd.	오디오제품 판매	100.0
	Harman International Mexico, S. de R.L. de C.V.	오디오제품 판매	100.0
	Harman KG Holding, LLC	해외자회사 관리	100.0
	Harman Professional, Inc.	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Beijing Integrated Circuit Industry International Fund, L.P	벤처기업 투자	61.4
	China Materialia New Materials 2016 Limited Partnership	벤처기업 투자	99.0

(\*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
유럽 · CIS	Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Ltd. (SEL)	해외자회사 관리	100.0
	Samsung Semiconductor Europe Limited (SSEL)	반도체 · DP 판매	100.0
	Samsung Electronics GmbH (SEG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Holding GmbH (SEHG)	해외자회사 관리	100.0
	Samsung Semiconductor Europe GmbH (SSEG)	반도체 · DP 판매	100.0
	Samsung Electronics France S.A.S (SEF)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Italia S.P.A. (SEI)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Iberia, S.A. (SESA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Portuguesa, Unipessoal, Lda. (SEP)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Hungarian Private Co., Ltd. (SEH)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS)	물류	100.0
	Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH)	해외자회사 관리	100.0
	Samsung Electronics Nordic Aktiebolag (SENA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Slovakia s.r.o. (SESK)	TV · 모니터 생산	100.0
	Samsung Display Slovakia s.r.o. (SDSK)	DP 임가공	100.0
	Samsung Electronics Polska, SP.Zo.o (SEPOL)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Poland Manufacturing SP.Zo.o (SEPM)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Romania LLC (SEROM)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Austria GmbH (SEAG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Switzerland GmbH (SESG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Czech and Slovak s.r.o. (SECZ)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Baltics SIA (SEB)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Greece S.M.S.A (SEGR)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. (SEACE)	에어컨공조 판매	100.0
	Samsung Nanoradio Design Center (SNDC)	R&D	100.0
	Samsung Denmark Research Center ApS (SDRC)	R&D	100.0
	Samsung Cambridge Solution Centre Limited (SCSC)	R&D	100.0
	Zhilabs, S.L.	네트워크Solution 개발, 판매	100.0
	Foodient Ltd.	R&D	100.0
	Samsung Electronics Rus Company LLC (SERC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Rus Kaluga LLC (SERK)	TV 생산	100.0
	Samsung Electronics Ukraine Company LLC (SEUC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung R&D Institute Ukraine (SRUKR)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Central Eurasia LLP (SECE)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Overseas B.V. (SEO)	전자제품 판매	100.0
	Samsung R&D Institute Rus LLC (SRR)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Caucasus Co., Ltd (SECC)	마케팅	100.0

(\*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.



지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
유럽 · CIS	AKG Acoustics GmbH	오디오제품 생산, 판매	100.0
	AMX UK Limited	오디오제품 판매	100.0
	Apostera GmbH	Connected Service Provider	100.0
	Apostera UA, LLC	Connected Service Provider	100.0
	Harman Audio Iberia Espana Sociedad Limitada	오디오제품 판매	100.0
	Harman Automotive UK Limited	오디오제품 생산	100.0
	Harman Becker Automotive Systems GmbH	오디오제품 생산, 판매, R&D	100.0
	Harman Becker Automotive Systems Italy S.R.L.	오디오제품 판매	100.0
	Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	오디오제품 생산, R&D	100.0
	Harman Belgium SA	오디오제품 판매	100.0
	Harman Connected Services AB.	Connected Service Provider	100.0
	Harman Finland Oy	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services GmbH	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services Poland Sp.Zo.o	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services UK Ltd.	Connected Service Provider	100.0
	Harman Consumer Nederland B.V.	오디오제품 판매	100.0
	Harman Deutschland GmbH	오디오제품 판매	100.0
	Harman Finance International GP S.a.r.l	해외자회사 관리	100.0
	Harman France SNC	오디오제품 판매	100.0
	Harman Holding GmbH & Co. KG	Management Company	100.0
	Harman Hungary Financing Ltd.	Financing Company	100.0
	Harman Inc. & Co. KG	해외자회사 관리	100.0
	Harman International Estonia OU	R&D	100.0
	Harman International Industries Limited	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman International Romania SRL	R&D	100.0
	Harman Finance International, SCA	Financing Company	100.0
	Harman International s.r.o.	오디오제품 생산	100.0
	Harman Management GmbH	해외자회사 관리	100.0
	Harman Professional Kft	오디오제품 생산, R&D	100.0
	Harman Professional Denmark ApS	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Red Bend Software Ltd.	소프트웨어 디자인	100.0
	Red Bend Software S.A.S	소프트웨어 디자인	100.0
	Studer Professional Audio GmbH	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman Connected Services OOO	Connected Service Provider	100.0
	Harman RUS CIS LLC	오디오제품 판매	100.0

(\*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
중동 · 아프리카	Samsung Gulf Electronics Co., Ltd. (SGE)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Turkey (SETK)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Industry and Commerce Ltd. (SETK-P)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Levant Co., Ltd. (SELV)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Maghreb Arab (SEMAG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Egypt S.A.E (SEEG)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics Israel Ltd. (SEIL)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Tunisia S.A.R.L (SETN)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Pakistan(Private) Ltd. (SEPAK)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Saudi Arabia Ltd. (SESAR)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Semiconductor Israel R&D Center, Ltd. (SIRC)	R&D	100.0
	Corephotonics Ltd.	R&D	100.0
	Samsung Electronics South Africa(Pty) Ltd. (SSA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics South Africa Production (Pty) Ltd. (SSAP)	TV · 모니터 생산	100.0
	Samsung Electronics West Africa Ltd. (SEWA)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics East Africa Ltd. (SEEA)	마케팅	100.0
	Global Symphony Technology Group Private Ltd.	해외자회사 관리	100.0
	Harman Connected Services Morocco	Connected Service Provider	100.0
	Harman Industries Holdings Mauritius Ltd.	해외자회사 관리	100.0
	Red Bend Ltd.	오디오제품 생산	100.0

(\*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
아시아 (중국 제외)	Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL)	해외자회사 관리	100.0
	Samsung Electronics Singapore Pte. Ltd. (SESP)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Malaysia Electronics (SME) Sdn. Bhd. (SME)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Display (M) Sdn. Bhd. (SDMA)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics (M) Sdn. Bhd. (SEMA)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Vina Electronics Co., Ltd. (SAVINA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT)	통신제품 생산	100.0
	Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV)	DP 생산	100.0
	PT Samsung Electronics Indonesia (SEIN)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	PT Samsung Telecommunications Indonesia (STIN)	전자제품 판매 및 서비스	100.0
	Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE)	전자제품 생산 및 판매	91.8
	Laos Samsung Electronics Sole Co., Ltd. (LSE)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Philippines Corporation (SEPCO)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Australia Pty. Ltd. (SEAU)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics New Zealand Limited (SENZ)	전자제품 판매	100.0
	Samsung India Electronics Private Ltd. (SIEL)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Display Noida Private Limited (SDN)	DP 생산	100.0
	Samsung R&D Institute India-Bangalore Private Limited (SRI-Bangalore)	R&D	100.0
	Samsung R&D Institute BanglaDesh Limited (SRBD)	R&D	100.0
	Samsung Nepal Services Pvt. Ltd. (SNSL)	서비스	100.0
	Samsung Japan Corporation (SJC)	반도체 · DP 판매	100.0
	Samsung R&D Institute Japan Co., Ltd. (SRJ)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Japan Co., Ltd. (SEJ)	전자제품 판매	100.0
	Harman Connected Services Corp. India Pvt. Ltd.	Connected Service Provider	100.0
	Harman International (India) Private Limited	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman International Industries Pty Ltd.	해외자회사 관리	100.0
	Harman International Japan Co., Ltd.	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman Singapore Pte. Ltd.	오디오제품 판매	100.0

(\*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
중국	Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Hong Kong Co., Ltd. (SEHK)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd. (SET)	전자제품 판매	100.0
	Tianjin Samsung Electronics Co., Ltd. (TSEC)	TV · 모니터 생산	91.2
	Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd. (SSEC)	가전제품 생산	88.3
	Samsung Suzhou Electronics Export Co., Ltd. (SSEC-E)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd. (SESC)	전자제품 생산, R&D	100.0
	Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (TSTC)	통신제품 생산	90.0
	Beijing Samsung Telecom R&D Center (SRC-Beijing)	R&D	100.0
	Samsung Electronics China R&D Center (SRC-Nanjing)	R&D	100.0
	Samsung Mobile R&D Center China-Guangzhou (SRC-Guangzhou)	R&D	100.0
	Samsung R&D Institute China-Shenzhen (SRC-Shenzhen)	R&D	100.0
	Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS)	반도체 · DP 판매	100.0
	Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS)	반도체 생산	100.0
	Samsung SemiConductor Xian Co., Ltd. (SSCX)	반도체 · DP 판매	100.0
	Samsung Electronics Suzhou Semiconductor Co., Ltd. (SESS)	반도체 임가공	100.0
	Tianjin Samsung LED Co., Ltd. (TSLED)	LED 생산	100.0
	Samsung Semiconductor (China) R&D Co., Ltd. (SSCR)	R&D	100.0
	Samsung Display Dongguan Co., Ltd. (SDD)	DP 생산	100.0
	Samsung Display Tianjin Co., Ltd. (SDT)	DP 생산	95.0
	SEMES (XIAN) Co., Ltd.	반도체 장비 서비스	100.0
	Samsung Semiconductor Investment L.P. I	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	Harman (China) Technologies Co., Ltd.	오디오제품 생산	100.0
	Harman (Suzhou) Audio and Infotainment Systems Co., Ltd.	오디오제품 판매	100.0
	Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd.	오디오제품 생산, R&D	100.0
	Harman Commercial (Shanghai) Co., Ltd.	오디오제품 판매	100.0
	Harman Connected Services Solutions (Chengdu) Co., Ltd.	Connected Service Provider	100.0
	Harman Holding Limited	오디오제품 판매	100.0
	Harman International (China) Holdings Co., Ltd.	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman Technology (Shenzhen) Co., Ltd.	오디오제품 판매, R&D	100.0

(\*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
국내	삼성디스플레이(주)	DP 생산 및 판매	84.8
	에스유머티리얼스(주)	DP 부품 생산	50.0
	스테코(주)	반도체 부품 생산	70.0
	세메스(주)	반도체 · FPD 장비 생산, 판매	91.5
	삼성전자서비스(주)	전자제품 수리 서비스	99.3
	삼성전자서비스씨에스(주)	고객상담서비스	100.0
	삼성전자판매(주)	전자제품 판매	100.0
	삼성전자로지텍(주)	종합물류대행	100.0
	삼성메디슨(주)	의료기기 생산 및 판매	68.5
	(주)미래로시스템	반도체 소프트웨어 개발 및 공급	99.9
	(주)도우인시스	DP 부품 생산	69.0
	지에프(주)	DP 부품 생산	100.0
	(주)하만인터내셔널코리아	소프트웨어 개발 및 공급	100.0
	SVIC 21호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 22호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 26호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 28호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 29호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 32호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 33호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 37호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 40호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 42호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 43호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 45호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 48호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 52호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 55호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 56호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	반도체성장 전문투자형 사모 투자신탁	반도체산업 투자	66.7
	시스템반도체 상생 전문투자형 사모 투자신탁	반도체산업 투자	62.5

(\*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

다. 당분기 및 전기의 주요 연결대상 종속기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.

(1) 당분기

(단위 : 백만원)

기업명(*1)	당분기말		당분기	
	자산	부채	매출액	분기순이익
삼성디스플레이㈜	53,952,375	6,982,867	7,100,976	1,026,633
Samsung Electronics America, Inc. (SEA)	43,135,977	18,941,425	11,340,468	(45,635)
Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT)	19,646,397	4,285,217	10,569,433	962,926
Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS)	18,982,283	4,664,987	2,415,594	156,539
Harman과 그 종속기업(*2)	15,632,712	5,606,047	2,662,741	89,844
Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL)	15,003,893	54,750	-	11,563
Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV)	14,347,580	2,745,930	5,820,671	429,100
Samsung Semiconductor, Inc. (SSI)	14,136,676	8,181,251	10,911,004	42,241
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH)	14,060,562	8,925,616	-	6,965
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)	13,401,189	9,301,910	833,148	106,882
Samsung India Electronics Private Ltd. (SIEL)	9,007,492	4,264,962	4,200,020	202,283
Samsung Austin Semiconductor LLC. (SAS)	8,806,779	897,254	788,621	(2,422)
Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS)	7,073,958	5,006,179	6,550,636	75,728
Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV)	6,624,391	2,065,988	5,672,054	131,506
Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA)	5,320,759	1,719,975	1,919,630	114,528
Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC)	3,391,235	931,521	1,952,034	202,206
Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK)	3,335,374	2,388,001	1,531,914	19,063
Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE)	3,284,369	701,891	1,414,046	(16,599)
Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS)	3,016,166	2,614,798	4,598,861	240,087
Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd. (SEH)	2,645,265	682,573	1,324,347	80,930
Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN)	2,556,682	740,314	807,471	6,902
Samsung International, Inc. (SII)	2,519,058	1,088,013	2,290,300	321,270
Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd. (SET)	2,330,093	1,719,189	1,688,546	41,677
Samsung Electronics GmbH (SEG)	2,290,873	2,287,119	1,701,102	(57,461)
Samsung Display Dongguan Co., Ltd. (SDD)	2,195,882	299,793	807,150	49,629

(\*1) 상기 요약 재무정보는 각 종속기업의 별도재무제표 기준입니다.

(\*2) Harman International Industries, Inc. 및 그 종속기업이 포함된 중간지배기업의 연결재무정보입니다.

## (2) 전기

(단위 : 백만원)

기업명(*1)	전기말		전분기	
	자산	부채	매출액	분기순이익
삼성디스플레이㈜	54,967,156	9,081,737	6,058,152	11,822
Samsung Electronics America, Inc. (SEA)	42,982,054	19,246,751	9,596,228	203,584
Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS)	19,049,536	5,168,738	1,485,543	382,193
Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT)	17,521,446	3,425,127	8,110,735	663,922
Harman과 그 종속기업(*2)	15,887,380	6,104,012	2,358,724	62,282
Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL)	14,683,789	58,381	-	16,819
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH)	14,651,496	8,998,502	-	913
Samsung Semiconductor, Inc. (SSI)	13,744,799	7,955,060	5,833,416	23,442
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)	13,599,093	9,685,278	733,700	114,462
Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV)	13,023,272	2,085,411	5,356,282	492,386
Samsung Austin Semiconductor LLC. (SAS)	8,705,085	958,537	922,961	267,988
Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS)	7,765,126	5,799,690	7,014,404	74,237
Samsung India Electronics Private Ltd. (SIEL)	7,765,019	3,236,745	3,459,334	192,905
Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV)	6,821,066	2,486,703	4,436,301	190,755
Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA)	4,589,505	1,671,097	1,531,207	141,928
Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC)	3,129,104	919,721	1,768,061	79,336
Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE)	3,018,358	474,223	1,079,687	(7,362)
Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK)	2,925,062	1,992,367	1,497,466	(16,323)
Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN)	2,612,357	766,034	729,325	5,251
Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd. (SEH)	2,504,075	641,004	1,010,623	(24,549)
Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS)	2,305,275	2,144,805	4,091,964	498,192
Samsung Electronics GmbH (SEG)	2,289,391	2,228,650	1,774,465	(59,360)
Samsung Display Dongguan Co., Ltd. (SDD)	2,149,277	339,425	943,609	47,368
Samsung International, Inc. (SII)	2,125,719	1,041,168	1,268,081	50,622
Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd. (SET)	2,033,992	1,459,353	1,223,980	4,999

(\*1) 상기 요약 재무정보는 각 종속기업의 별도재무제표 기준입니다.

(\*2) Harman International Industries, Inc. 및 그 종속기업이 포함된 중간지배기업의 연결재무정보입니다.

라. 연결대상범위의 변동

당분기 중 연결재무제표 작성대상범위의 변동 내용은 다음과 같습니다.

구분	지역	기업명	사유
신규연결	유럽 · CIS	Samsung R&D Institute Ukraine (SRUKR)	설립
		Apostera Gmbh	지분취득
		Apostera UA, LLC	



## 2. 중요한 회계처리방침:

### 2.1. 재무제표 작성기준

연결회사의 2022년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 분기연결재무제표는 기업 회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 분기연결재무제표는 보고 기간종료일인 2022년 3월 31일 현재 유효한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

#### 가. 연결회사가 채택한 제·개정 기준서

연결회사는 2022년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 주요 제·개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.

##### - 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정

코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있도록 하는 실무적 간편법의 적용대상이 2022년 6월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료에 영향을 미치는 리스료 감면으로 확대되었습니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 연결재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

##### - 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정

사업결합 시 인식할 자산과 부채의 정의를 개정된 재무보고를 위한 개념체계를 참조하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 및 해석서 제2121호 '부담금'의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점을 명확히 하였습니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 연결재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' 개정

기업이 자산을 의도한 방식으로 사용하기 전에 생산된 품목의 판매에서 발생하는 수익을 생산원가와 함께 당기손익으로 인식하도록 요구하며, 유형자산의 취득원가에서 차감하는 것을 금지하고 있습니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 연결재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 개정

손실부담계약을 식별할 때 계약이행원가의 범위를 계약 이행을 위한 증분원가와 계약 이행에 직접 관련되는 다른 원가의 배분이라는 점을 명확히 하였습니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 연결재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

## 나. 연결회사가 적용하지 않은 제·개정 기준서

제정 또는 공표됐으나 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 않았고, 연결회사가 조기 적용하지 않은 주요 제·개정 기준서는 다음과 같습니다.

### - 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정

보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된 경우는 제외됩니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다.

### - 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정

중요한 회계정책을 정의하고 공시하도록 하며, 중요성 개념을 적용하는 방법에 대한 지침을 제공하기 위하여 국제회계기준 실무서 2 '회계정책 공시'를 개정하였습니다. 동 개정 사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며 조기적용이 허용됩니다.

### - 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정

회계추정을 정의하고, 회계정책의 변경과 구별하는 방법을 명확히 하였습니다. 동 개정 사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며 조기적용이 허용됩니다.

## - 기업회계기준서 제1012호 '법인세' 개정

자산 또는 부채가 최초로 인식되는 거래의 최초 인식 예외 요건에 거래당시 동일한 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이를 발생시키지 않는 거래라는 요건을 추가하였습니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다.

### 2.2. 회계정책

분기연결재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1에서 설명하는 제·개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 2021년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

### 2.3. 중요한 회계추정 및 가정

분기연결재무제표 작성시 연결회사의 경영진은 회계정책의 적용과 보고되는 자산·부채의 장부금액 및 이익·비용에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다. 특히 코로나19로 연결회사의 추정 및 가정에 영향이 발생할 수 있으나, 당분기말 현재 그 영향을 합리적으로 추정할 수 없습니다.

분기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 2021년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

### 3. 범주별 금융상품:

보고기간종료일 현재 범주별 금융상품 내역은 다음과 같습니다.

#### (1) 당분기말

(단위 : 백만원)

금융자산	상각후원가 측정 금융자산	기타포괄손익-공정 가치 측정 금융자산	당기손익-공정가치 측정 금융자산	기타금융자산(*)	계
현금및현금성자산	48,944,982	-	-	-	48,944,982
단기금융상품	75,121,426	-	-	-	75,121,426
단기상각후원가금융자산	1,755,225	-	-	-	1,755,225
단기당기손익-공정가치금융자산	-	-	53,056	-	53,056
매출채권	44,464,968	-	-	-	44,464,968
기타포괄손익-공정가치금융자산	-	13,201,558	-	-	13,201,558
당기손익-공정가치금융자산	-	-	1,496,122	-	1,496,122
기타	10,142,354	-	566,822	61,731	10,770,907
계	180,428,955	13,201,558	2,116,000	61,731	195,808,244

(\*) 기타금융자산은 범주별 금융자산의 적용을 받지 않는 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

금융부채	상각후원가 측정 금융부채	당기손익-공정가치 측정 금융부채	기타금융부채(*)	계
매입채무	15,133,906	-	-	15,133,906
단기차입금	2,452,530	-	11,433,359	13,885,889
미지급금	16,607,339	-	-	16,607,339
유동성장기부채	43,098	-	821,807	864,905
사채	518,856	-	-	518,856
장기차입금	2,500	-	2,778,207	2,780,707
장기미지급금	2,121,276	-	-	2,121,276
기타	10,797,860	393,743	10,418	11,202,021
계	47,677,365	393,743	15,043,791	63,114,899

(\*) 기타금융부채는 범주별 금융부채의 적용을 받지 않는 담보부차입금, 리스부채 및 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

## (2) 전기말

(단위 : 백만원)

금융자산	상각후원가 측정 금융자산	기타포괄손익-공정 가치 측정 금융자산	당기손익-공정가치 측정 금융자산	기타금융자산(*)	계
현금및현금성자산	39,031,415	-	-	-	39,031,415
단기금융상품	81,708,986	-	-	-	81,708,986
단기상각후원가금융자산	3,369,034	-	-	-	3,369,034
단기당기손익-공정가치금융자산	-	-	40,757	-	40,757
매출채권	40,713,415	-	-	-	40,713,415
기타포괄손익-공정가치금융자산	-	13,965,839	-	-	13,965,839
당기손익-공정가치금융자산	-	-	1,525,344	-	1,525,344
기타	8,711,973	-	279,127	49,089	9,040,189
계	173,534,823	13,965,839	1,845,228	49,089	189,394,979

(\*) 기타금융자산은 범주별 금융자산의 적용을 받지 않는 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

금융부채	상각후원가 측정 금융부채	당기손익-공정가치 측정 금융부채	기타금융부채(*)	계
매입채무	13,453,351	-	-	13,453,351
단기차입금	2,131,692	-	11,556,101	13,687,793
미지급금	14,126,970	-	-	14,126,970
유동성장기부채	518,065	-	811,903	1,329,968
사채	508,232	-	-	508,232
장기차입금	1,500	-	2,864,656	2,866,156
장기미지급금	2,562,158	-	-	2,562,158
기타	10,444,290	323,526	13,868	10,781,684
계	43,746,258	323,526	15,246,528	59,316,312

(\*) 기타금융부채는 범주별 금융부채의 적용을 받지 않는 담보부차입금, 리스부채 및 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

#### 4. 공정가치금융자산:

가. 보고기간종료일 현재 공정가치금융자산의 구성 내역은 다음과 같습니다.

##### (1) 기타포괄손익-공정가치금융자산

(단위 : 백만원)

구 분	당분기말	전기말
비유동항목:		
지분상품	13,201,558	13,965,839

##### (2) 당기손익-공정가치금융자산

(단위 : 백만원)

구 분	당분기말	전기말
유동항목:		
채무상품	53,056	40,757
비유동항목:		
지분상품	852,208	905,094
채무상품	643,914	620,250
소 계	1,496,122	1,525,344
계	1,549,178	1,566,101

나. 보고기간종료일 현재 공정가치금융자산 중 상장주식의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주, %, 백만원)

기 업 명	당분기말				전기말
	보유주식수 (주)	지분율 (%)(*)	취득원가	장부금액 (시장가치)	장부금액 (시장가치)
삼성중공업㈜	134,027,281	15.2	932,158	761,275	759,935
㈜호텔신라	2,004,717	5.1	13,957	162,783	156,368
㈜아이마켓코리아	647,320	1.9	324	7,023	6,926
㈜에스에프에이	3,644,000	10.2	38,262	149,586	131,366
㈜원익홀딩스	3,518,342	4.6	30,821	16,906	17,521
㈜원익아이피에스	3,701,872	7.5	32,428	141,041	156,589
ASML Holding N.V.	6,297,787	1.5	363,012	5,190,569	5,974,280
Wacom Co., Ltd.	8,398,400	5.0	62,013	78,622	79,256
BYD Company Limited	2,380,100	0.1	79,049	103,931	118,862
Corning Incorporated	80,000,000	9.5	3,980,636	3,575,250	3,530,893
기타			559,450	971,345	1,155,113
계			6,092,110	11,158,331	12,087,109

(\*) 총발행보통주식수 기준 지분율입니다.



5. 재고자산:

보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기말			전기말		
	평가전금액	평가충당금	장부금액	평가전금액	평가충당금	장부금액
제품 및 상품	14,692,913	(793,386)	13,899,527	13,000,200	(719,621)	12,280,579
반제품 및 재공품	15,060,273	(646,600)	14,413,673	13,967,331	(493,713)	13,473,618
원재료 및 저장품	18,282,421	(817,017)	17,465,404	14,864,486	(679,645)	14,184,841
미착품	1,812,127	-	1,812,127	1,445,366	-	1,445,366
계	49,847,734	(2,257,003)	47,590,731	43,277,383	(1,892,979)	41,384,404

## 6. 관계기업 및 공동기업 투자:

가. 당분기 및 전분기 중 관계기업 및 공동기업 투자의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기	전분기
기초	8,932,251	8,076,779
취득	6,100	14,500
처분	(5,153)	(661)
이익 중 지분해당액	232,477	147,519
기타(*)	(324,070)	(141,416)
분기말	8,841,605	8,096,721

(\*) 기타는 배당, 손상, 계정재분류 등으로 구성되어 있습니다.

나. 보고기간종료일 현재 주요 관계기업 및 공동기업 투자 현황은 다음과 같습니다.

### (1) 관계기업 투자

기업명	관계의 성격	지분율(%)(*)	주사업장	결산월
삼성전기(주)	수동소자, 회로부품, 모듈 등 전자부품의 생산 및 공급	23.7	한국	12월
삼성에스디에스(주)	컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합·관리 등 IT 서비스 및 물류서비스 제공	22.6	한국	12월
삼성바이오로직스(주)	신사업 투자	31.5	한국	12월
삼성SDI(주)(*)	2차전지 등 전자제품의 생산 및 공급	19.6	한국	12월
(주)제일기획	광고 대행업	25.2	한국	12월

(\*) 총발행보통주식수 기준 지분율입니다.

(\*) 유통보통주식수 기준 지분율은 20.6%입니다.

### (2) 공동기업 투자

기업명	관계의 성격	지분율(%)(*)	주사업장	결산월
삼성코닝어드밴스드글라스(유)	기타 산업용 유리제품 생산 및 공급	50.0	한국	12월

(\*) 총발행보통주식수 기준 지분율입니다.

다. 보고기간종료일 현재 관계기업 및 공동기업 투자 내역은 다음과 같습니다.

(1) 관계기업 투자

(단위 : 백만원)

기 업 명	당분기말			전기말		
	취득원가	순자산가액(*)	장부금액	취득원가	순자산가액(*)	장부금액
삼성전기㈜	359,237	1,622,616	1,608,018	359,237	1,573,570	1,556,386
삼성에스디에스㈜	147,963	1,645,383	1,663,194	147,963	1,632,847	1,652,155
삼성바이오로직스㈜	443,193	1,361,033	1,367,422	443,193	1,571,809	1,577,664
삼성SDI㈜	1,242,605	3,052,283	2,584,083	1,242,605	2,960,235	2,529,650
㈜제일기획	506,162	307,300	607,953	506,162	320,301	621,292
기타	645,849	597,349	809,764	644,903	578,547	793,748
계	3,345,009	8,585,964	8,640,434	3,344,063	8,637,309	8,730,895

(\*) 순자산가액은 지분해당액 기준입니다.

(2) 공동기업 투자

(단위 : 백만원)

기 업 명	당분기말			전기말		
	취득원가	순자산가액(*)	장부금액	취득원가	순자산가액(*)	장부금액
삼성코닝어드밴스드글라스(유)	215,000	137,432	137,428	215,000	135,584	135,580
기타	259,994	66,147	63,743	259,994	67,517	65,776
계	474,994	203,579	201,171	474,994	203,101	201,356

(\*) 순자산가액은 지분해당액 기준입니다.

라. 당분기 및 전분기 중 지분법평가 내역은 다음과 같습니다.

(1) 당분기

(단위 : 백만원)

기 업 명	기초	지분법평가 내역			분기말
		지분법손익	지분법자본변동	기타증감액(*)	
삼성전기(주)	1,556,386	75,698	13,090	(37,156)	1,608,018
삼성에스디에스(주)	1,652,155	43,126	9,846	(41,933)	1,663,194
삼성바이오로직스(주)	1,577,664	46,810	(257,052)	-	1,367,422
삼성SDI(주)	2,529,650	39,702	28,193	(13,462)	2,584,083
(주)제일기획	621,292	12,850	2,559	(28,748)	607,953
삼성코닝어드밴스드글라스(유)	135,580	1,848	-	-	137,428
기타	859,524	12,443	(53,467)	55,007	873,507
계	8,932,251	232,477	(256,831)	(66,292)	8,841,605

(\*) 기타증감액은 취득, 처분, 배당, 손상 및 계정재분류 등으로 구성되어 있습니다.

(2) 전분기

(단위 : 백만원)

기 업 명	기초	지분법평가 내역			분기말
		지분법손익	지분법자본변동	기타증감액(*)	
삼성전기(주)	1,333,819	57,019	27,114	(24,770)	1,393,182
삼성에스디에스(주)	1,525,857	35,196	10,911	(41,933)	1,530,031
삼성바이오로직스(주)	1,453,012	20,766	105	-	1,473,883
삼성SDI(주)	2,326,037	16,804	9,100	(13,463)	2,338,478
(주)제일기획	586,057	9,350	4,596	(24,392)	575,611
삼성코닝어드밴스드글라스(유)	123,356	3,565	-	-	126,921
기타	728,641	4,819	(91,322)	16,477	658,615
계	8,076,779	147,519	(39,496)	(88,081)	8,096,721

(\*) 기타증감액은 취득, 처분, 배당, 손상 및 계정재분류 등으로 구성되어 있습니다.

마. 주요 관계기업 및 공동기업 투자의 요약 재무정보 등은 다음과 같습니다.

(1) 주요 관계기업

(단위 : 백만원)

구 분	당분기				
	삼성전기(주)	삼성에스디에스(주)	삼성바이오로직스(주)	삼성SDI(주)	(주)제일기획
I. 요약 재무정보(연결재무제표 기준)					
요약 재무상태표:					
유동자산	4,658,485	7,921,459	2,661,259	8,063,272	2,077,506
비유동자산	5,407,198	2,913,698	5,336,949	18,941,726	523,085
유동부채	2,093,674	2,632,966	1,748,077	6,717,646	1,326,335
비유동부채	882,821	701,392	1,928,325	4,627,094	191,617
비지배지분	160,822	216,578	-	498,766	10,840
요약 포괄손익계산서:					
매출	2,625,404	4,191,498	511,304	4,049,427	946,569
계속영업손익(*)	321,852	197,554	146,942	356,587	44,890
세후중단영업손익(*)	-	-	-	-	-
기타포괄손익(*)	106,951	43,587	(377)	167,584	10,032
총포괄손익(*)	428,803	241,141	146,565	524,171	54,922
II. 배당					
배당	37,155	41,933	-	13,463	28,748

(\*) 지배기업의 소유주에 귀속될 손익입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	전기				
	삼성전기㈜	삼성에스디에스㈜	삼성바이오로직스㈜	삼성SDI㈜	㈜제일기획
I. 요약 재무정보(연결재무제표 기준)					
요약 재무상태표(전기말):					
유동자산	4,598,269	7,575,968	2,823,175	7,444,907	2,018,598
비유동자산	5,343,105	2,941,464	5,146,835	18,388,286	523,513
유동부채	2,234,657	2,370,290	1,107,295	6,461,286	1,224,222
비유동부채	835,592	703,442	1,871,614	4,175,208	190,622
비지배지분	152,177	214,980	-	492,435	10,125
요약 포괄손익계산서(전분기):					
매출	2,371,949	3,061,308	260,797	2,963,211	696,744
계속영업손익(*)	235,291	156,029	60,976	134,207	32,522
세후중단영업손익(*)	(2,075)	-	-	-	-
기타포괄손익(*)	104,468	48,453	102	206,119	11,172
총포괄손익(*)	337,684	204,482	61,078	340,326	43,694
II. 배당(전분기)					
배당	24,770	41,933	-	13,463	24,392

(\*) 지배기업의 소유주에 귀속될 손익입니다.

(2) 주요 공동기업

(단위 : 백만원)

구 분	삼성코닝어드밴스드글라스(유)	
	당분기	전기
Ⅰ. 요약 재무정보		
요약 재무상태표:		
유동자산	163,734	163,083
비유동자산	136,707	141,411
유동부채	24,163	31,779
비유동부채	1,414	1,547
요약 포괄손익계산서(*):		
매출	42,485	46,067
계속영업손익	3,696	7,130
세후중단영업손익	-	-
기타포괄손익	-	-
총포괄손익	3,696	7,130
Ⅱ. 배당		
배당	-	-

(\*) 분기 3개월 기준 금액입니다.

(3) 개별적으로 중요하지 않은 관계기업과 공동기업의 손익 중 연결회사의 지분 해당액은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기		전분기	
	관계기업	공동기업	관계기업	공동기업
분기순손익	13,042	(599)	4,385	435
기타포괄손익	(52,025)	(1,442)	2,093	(1,507)
총포괄손익	(38,983)	(2,041)	6,478	(1,072)

바. 보고기간종료일 현재 시장성 있는 관계기업 투자주식의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주, 백만원)

기 업 명	당분기말		전기말
	주식수(주)	시장가치	시장가치
삼성전기(주)	17,693,084	2,919,359	3,494,384
삼성에스디에스(주)	17,472,110	2,419,887	2,734,385
삼성바이오로직스(주)	20,836,832	17,232,060	18,815,659
삼성SDI(주)	13,462,673	8,023,753	8,818,051
(주)제일기획	29,038,075	683,847	663,520



## 사. 기타사항

증권선물위원회는 연결회사의 관계기업인 삼성바이오로직스(주)가 Biogen Therapeutics Inc.와 합작 투자한 삼성바이오에피스(주) 지분에 대한 회계처리와 관련하여, 합작계약 약정사항의 재무제표 주식 미기재를 이유로 담당임원 해임권고, 검찰 고발, 감사인 지정 등의 조치(이하 "1차 처분")를 2018년 7월 12일에 의결하였으며, 연결대상 범위 회계처리 오류 등 회계기준 위반을 이유로 과징금 80억원 부과, 대표이사 해임권고, 재무제표 재작성, 검찰 고발 등의 조치(이하 "2차 처분")를 2018년 11월 14일 의결하였습니다.

이에 대하여 삼성바이오로직스(주)는 회계처리의 정당성을 입증하기 위하여 위 처분의 취소를 구하는 소송(이하 "본안 소송")을 서울행정법원에 제기하였고, 현재 소송을 진행 중입니다. 1차 처분의 취소를 구하는 소송과 관련하여, 서울행정법원은 2020년 9월 24일 증권선물위원회가 부과한 행정 처분을 취소한다고 판결하고, 항소심 판결 선고 시까지 위 처분의 효력을 정지하는 결정을 하였습니다. 이에 증권선물위원회는 2020년 10월 16일 항소하여 현재 서울고등법원에서 소송을 진행 중입니다. 또한, 삼성바이오로직스(주)는 위 처분에 대한 효력정지신청서를 서울행정법원에 제출하였으며, 법원은 2019년 1월 22일(2차 처분)과 2019년 2월 19일(1차 처분)에 본안 소송의 판결 시까지 처분의 효력을 정지하는 결정을 선고하였습니다. 이에 증권선물위원회는 위 집행정지 결정에 대하여 즉시항고하였으며, 서울고등법원은 2019년 5월 13일(2차 처분), 2019년 5월 24일(1차 처분) 항고를 기각하였습니다. 이에 증권선물위원회는 2019년 5월 23일(2차 처분), 2019년 6월 10일(1차 처분) 재항고하였으며, 대법원은 2019년 9월 6일(2차 처분), 2019년 10월 11일(1차 처분) 재항고를 기각하여 효력정지 결정이 확정되었습니다.

향후 행정소송의 결과를 예측하기 어려우나 소송 결과에 따라 삼성바이오로직스(주)가 삼성바이오에피스(주) 지분에 관한 과거 회계처리를 수정하여 재무제표를 재작성하게 될 경우, 이로 인해 연결회사의 2015년과 그 이후 기간 지분법평가손익, 관계기업투자주식, 이익잉여금과 2016년 일부 지분 처분이익 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 다만, 현재로서는 삼성바이오로직스(주)와 증권선물위원회 간의 행정소송에 대한 종결 시기와 그 결과를 예측할 수 없으므로, 연결회사의 당분기 재무제표에 이를 반영하기 어렵습니다.

## 7. 유형자산:

가. 당분기 및 전분기 중 유형자산의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기	전분기
기초장부금액	149,928,539	128,952,892
일반취득 및 자본적지출	8,098,867	10,176,110
감가상각	(9,009,031)	(7,147,736)
처분·폐기·손상	(82,485)	(133,013)
기타(*)	682,129	899,459
분기말장부금액	149,618,019	132,747,712

(\*) 기타는 환율변동에 의한 증감액, 정부보조금 차감 효과 등을 포함하고 있습니다.

나. 당분기 및 전분기 중 계정과목별 유형자산 상각 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기	전분기
매출원가	8,122,027	6,302,755
판매비와관리비 등	887,004	844,981
계	9,009,031	7,147,736

다. 당분기말 현재 유형자산에 포함된 사용권자산은 3,871,020백만원(전기말: 3,950,567백만원)입니다. 또한, 당분기 중 신규 발생한 사용권자산은 176,168백만원(전분기: 453,516백만원)이며, 사용권자산의 감가상각비는 253,084백만원(전분기: 225,514백만원)입니다.

8. 무형자산:

가. 당분기 및 전분기 중 무형자산의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기	전분기
기초장부금액	20,236,244	18,468,502
개별 취득	334,725	319,391
내부개발에 의한 취득	-	101,577
상각	(770,477)	(695,542)
처분·폐기·손상	(3,408)	(9,822)
기타(*)	213,610	202,577
분기말장부금액	20,010,694	18,386,683

(\*) 기타는 환율변동에 의한 증감액, 사업결합으로 인한 취득 등을 포함하고 있습니다.

나. 당분기 및 전분기 중 계정과목별 무형자산 상각 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기	전분기
매출원가	531,875	488,175
판매비와관리비 등	238,602	207,367
계	770,477	695,542

## 9. 차입금:

보고기간종료일 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : %, 백만원)

구 분	차입처	연이자율(%)	금 액	
		당분기말	당분기말	전기말
단기차입금:				
담보부차입금(*1)	우리은행 등	0.0~13.0	11,433,359	11,556,101
무담보차입금	씨티은행 등	0.0~28.2	2,452,530	2,131,692
계			13,885,889	13,687,793
유동성장기차입금:				
은행차입금	BNP Paribas	18.3~19.6	37,157	40,415
리스부채(*2)	CSSD 등	3.3	821,807	811,902
계			858,964	852,317
장기차입금:				
은행차입금	기업은행	1.5~1.7	2,500	1,500
리스부채(*2)	CSSD 등	3.3	2,778,207	2,864,656
계			2,780,707	2,866,156

(\*1) 담보부차입금과 관련하여 매출채권을 담보로 제공하였습니다.

(\*2) 리스부채와 관련하여 연이자율은 가중평균증분차입이자율이며 당분기 중 발생한 이자비용은 30,012백만원(전분기: 25,835백만원)입니다. 또한, 채무불이행이 발생할 경우에 대비하여 리스제공자에게 사용권자산에 대한 권리를 담보로 제공하였습니다.

## 10. 사채:

보고기간종료일 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : %, 백만원)

구 분	발행일	만기상환일	연이자율(%)	금 액	
			당분기말	당분기말	전기말
US\$ denominated Straight Bonds(*1)	1997.10.02	2027.10.01	7.7	36,324 (US\$ 30,000천)	35,565 (US\$ 30,000천)
US\$ denominated Debenture Bonds(*2)	2015.05.11	2025.05.15	4.2	484,320 (US\$ 400,000천)	474,200 (US\$ 400,000천)
EURO€ denominated Debenture Bonds(*3)	2015.05.27	2022.05.27	-	- -	469,819 (EUR€350,000천)
소 계				520,644	979,584
사채할인발행차금				(673)	(708)
사채할증발행차금				4,826	7,007
계				524,797	985,883
차감: 유동성사채				(5,941)	(477,651)
비유동성사채				518,856	508,232

(\*1) 10년 거치 20년 분할상환되며 이자는 6개월마다 후급됩니다.

(\*2) 종속기업 Harman International Industries, Inc.에서 발행하였고, 10년 만기 일시상환되며 이자는 6개월마다 후급됩니다.

(\*3) 종속기업 Harman Finance International, SCA에서 발행하였고, 7년 만기 일시상환되며 이자는 1년마다 후급됩니다. 한편 해당 사채는 2022년 3월 1일 전액 조기상환되었습니다.

11. 순확정급여부채(자산):

가. 보고기간종료일 현재 순확정급여부채(자산)의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기말	전기말
기금이 적립된 확정급여채무의 현재가치	14,744,784	14,391,209
기금이 적립되지 않은 확정급여채무의 현재가치	271,863	266,976
소 계	15,016,647	14,658,185
사외적립자산의 공정가치	(16,970,063)	(17,001,891)
순확정급여부채(자산) 계	(1,953,416)	(2,343,706)

나. 당분기 및 전분기 중 확정급여제도 관련 비용의 세부 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기	전분기
당기근무원가	347,661	312,360
순이자원가(수익)	(24,885)	(10,003)
과거근무원가	(77)	(15)
기타	1,573	3,443
계	324,272	305,785

다. 당분기 및 전분기 중 확정급여제도 관련 비용의 계정과목별 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기	전분기
매출원가	139,754	128,189
판매비와관리비 등	184,518	177,596
계	324,272	305,785

## 12. 충당부채:

당분기 중 충당부채의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	판매보증 (가)	기술사용료 (나)	장기성과급 (다)	기타 (라),(마)	계
기초	1,978,294	1,561,809	734,283	3,405,480	7,679,866
순전입(환입)	471,844	342,303	49,645	1,835,064	2,698,856
사용	(399,867)	(48,417)	(229,309)	(1,614,285)	(2,291,878)
기타(*)	27,232	30,643	2,050	13,658	73,583
당분기말	2,077,503	1,886,338	556,669	3,639,917	8,160,427

(\*) 기타는 환율변동에 의한 증감액 등을 포함하고 있습니다.

가. 연결회사는 출고한 제품에 대한 품질보증, 교환, 하자보수 및 그에 따른 사후서비스 등으로 인하여 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 보증기간 및 과거 경험률 등을 기초로 추정하여 충당부채로 설정하고 있습니다.

나. 연결회사는 협상 진행 중인 기술사용계약과 관련하여 향후 지급이 예상되는 기술사용료를 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다. 지급시기 및 금액은 협상결과에 따라 변동될 수 있습니다.

다. 연결회사는 임원을 대상으로 부여연도를 포함한 향후 3년간의 경영실적에 따라 성과급을 지급하는 장기성과 인센티브를 부여하였는 바, 향후 지급이 예상되는 금액의 경과 기간 해당분을 충당부채로 계상하고 있습니다.

라. 연결회사는 생산 및 판매 중단한 제품에 대하여 향후 부담할 것으로 예상되는 비용 등을 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다.

마. 연결회사는 온실가스 배출과 관련하여 해당 이행연도분 배출권의 장부금액과 이를 초과하는 배출량에 대해 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다.

(1) 당분기말 현재 당기 이행연도에 대한 무상할당 배출권과 온실가스 배출량 추정치는 다음과 같습니다.

(단위 : 만톤(tCO<sub>2</sub>-eq))

구 분	당분기말
무상할당 배출권	1,687
배출량 추정치	1,997

(2) 당분기 중 배출권 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기
기초	46,074
증가	-
당분기말	46,074

(3) 당분기 중 배출부채 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기
기초	45,049
순전입(환입)	12,462
사용	-
당분기말	57,511



### 13. 우발부채와 약정사항:

#### 가. 소송 등

당분기말 현재 연결회사는 다수의 회사 등과 정상적인 영업과정에서 발생한 소송, 분쟁 및 규제기관의 조사 등이 진행 중에 있습니다. 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며 연결회사의 경영진은 이러한 소송 등의 결과가 연결회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

14. 계약부채:

보고기간종료일 현재 계약부채는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기말	전기말
계약부채(*)	13,386,909	13,235,108

(\*) 계약부채는 선수금, 미지급비용, 기타유동부채 등에 포함되어 있습니다.

#### 15. 자본금:

보고기간종료일 현재 회사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 250억주(1주의 액면금액: 100원)이며, 회사가 발행한 보통주 및 우선주의 수(소각 주식수 제외)는 각각 5,969,782,550주와 822,886,700주입니다. 보고기간종료일 현재 유통주식수는 상기 발행주식의 수와 동일하며, 당분기 및 전기 중 변동사항은 없습니다. 한편, 발행주식의 액면총액은 679,267백만원(보통주 596,978백만원, 우선주 82,289백만원)으로 이익소각으로 인하여 납입자본금 897,514백만원과 상이합니다.

16. 연결이익잉여금:

가. 보고기간종료일 현재 연결이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기말	전기말
임의적립금 등	191,988,157	170,814,107
연결미처분이익잉여금	109,754,995	122,250,656
계	301,743,152	293,064,763

나. 당분기 및 전분기 중 배당금 산정 내역은 다음과 같습니다.

(1) 분기배당 (배당기준일: 2022년과 2021년 3월 31일)

(단위 : 주, %, 백만원)

구 분		당분기	전분기
배당받을 주식	보통주	5,969,782,550주	5,969,782,550주
	우선주	822,886,700주	822,886,700주
배당률(액면가 기준)	보통주 · 우선주	361%	361%
배당금액	보통주	2,155,092	2,155,092
	우선주	297,062	297,062
	계	2,452,154	2,452,154

17. 기타자본항목:

보고기간종료일 현재 기타자본항목의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기말	전기말
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	4,001,442	4,616,639
관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익누계액에 대한 지분	(90,525)	166,835
해외사업장환산외환차이	(1,419,850)	(3,824,733)
순확정급여부채(자산) 재측정요소	(3,236,861)	(3,173,977)
기타	93,105	86,763
계	(652,689)	(2,128,473)

18. 비용의 성격별 분류:

당분기 및 전분기 중 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기	전분기
제품 및 재공품 등의 변동	(2,559,003)	1,739,852
원재료 등의 사용액 및 상품 매입액 등	28,066,242	22,584,423
급여	7,732,949	6,702,731
퇴직급여	350,896	339,184
감가상각비	9,009,031	7,147,736
무형자산상각비	770,477	695,542
복리후생비	1,401,936	1,202,577
유틸리티비	1,398,568	1,200,411
외주용역비	1,482,533	1,406,449
광고선전비	1,467,701	1,110,369
판매촉진비	1,823,398	1,624,527
기타비용	12,715,361	10,251,834
계(★)	63,660,089	56,005,635

(★) 연결손익계산서 상 매출원가와 판매비와관리비를 합한 금액입니다.

19. 판매비와관리비:

당분기 및 전분기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기	전분기
(1) 판매비와관리비:		
급여	1,995,353	1,796,634
퇴직급여	77,294	77,734
지급수수료	1,730,391	1,460,993
감가상각비	378,741	382,074
무형자산상각비	168,494	135,583
광고선전비	1,467,701	1,110,369
판매촉진비	1,823,398	1,624,527
운반비	857,633	608,762
서비스비	893,544	820,657
기타판매비와관리비	1,273,251	1,047,773
소 계	10,665,800	9,065,106
(2) 경상연구개발비:		
연구개발 총지출액	5,922,232	5,542,121
개발비 자산화	-	(101,577)
소 계	5,922,232	5,440,544
계	16,588,032	14,505,650

20. 기타수익 및 기타비용:

당분기 및 전분기 중 기타수익 및 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기	전분기
(1) 기타수익:		
배당금수익	268,509	8,734
임대료수익	34,584	33,818
유형자산처분이익	50,420	75,471
기타	346,680	181,719
계	700,193	299,742
(2) 기타비용:		
유형자산처분손실	4,196	9,842
기부금	89,560	39,207
기타	359,354	275,191
계	453,110	324,240



21. 금융수익 및 금융비용:

당분기 및 전분기 중 금융수익 및 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기	전분기
(1) 금융수익:		
이자수익	369,032	332,548
- 상각후원가 측정 금융자산	368,967	332,473
- 당기손익-공정가치 측정 금융자산	65	75
외환차이	2,608,603	1,708,037
파생상품관련이익	524,554	198,053
계	3,502,189	2,238,638
(2) 금융비용:		
이자비용	149,231	96,442
- 상각후원가 측정 금융부채	74,663	43,267
- 기타금융부채	74,568	53,175
외환차이	2,460,682	1,734,852
파생상품관련손실	423,405	162,588
계	3,033,318	1,993,882

연결회사는 외화거래 및 환산으로 발생한 외환차이를 금융수익 및 금융비용으로 인식하고 있습니다.

## 22. 법인세비용:

법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 당분기 현재 2022년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상평균 연간법인세율은 24.9%입니다.

## 23. 주당이익:

### 가. 기본주당이익

당분기 및 전분기 중 기본주당이익 산정 내역은 다음과 같습니다.

#### (1) 보통주

(단위 : 백만원, 천주, 원)

구 분	당분기	전분기
지배회사지분 분기순이익	11,129,094	7,092,786
분기순이익 중 보통주 해당분	9,780,878	6,233,542
÷가중평균유통보통주식수(천주)	5,969,783	5,969,783
기본 보통주 주당이익(원)	1,638	1,044

#### (2) 우선주

(단위 : 백만원, 천주, 원)

구 분	당분기	전분기
지배회사지분 분기순이익	11,129,094	7,092,786
분기순이익 중 우선주 해당분	1,348,216	859,244
÷가중평균유통우선주식수(천주)	822,887	822,887
기본 우선주 주당이익(원)	1,638	1,044

### 나. 희석주당이익

회사가 보유하고 있는 희석성 잠재적보통주는 없으며, 당분기 및 전분기 중 기본주당이익과 희석주당이익은 동일합니다.

24. 현금흐름표:

가. 연결회사는 영업활동 현금흐름을 간접법으로 작성하였습니다. 당분기 및 전분기 중 영업활동 현금흐름 관련 조정 내역 및 영업활동으로 인한 자산부채의 변동은 다음과 같습니다.

(1) 조정 내역

(단위 : 백만원)

구 분	당분기	전분기
법인세비용	3,745,212	2,608,960
금융수익	(1,745,834)	(1,218,970)
금융비용	1,462,863	866,497
퇴직급여	350,896	339,184
감가상각비	9,009,031	7,147,736
무형자산상각비	770,477	695,542
대손상각비(환입)	11,425	(3,356)
배당금수익	(268,509)	(8,734)
지분법이익	(232,477)	(147,519)
유형자산처분이익	(50,420)	(75,471)
유형자산처분손실	4,196	9,842
재고자산평가손실(환입) 등	772,044	578,786
기타	76,826	91,359
계	13,905,730	10,883,856

(2) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(단위 : 백만원)

구 분	당분기	전분기
매출채권의 감소(증가)	(2,369,191)	(2,105,232)
미수금의 감소(증가)	(566,904)	(36,668)
장단기선급비용의 감소(증가)	(520,881)	(367,337)
재고자산의 감소(증가)	(6,407,793)	1,205,901
매입채무의 증가(감소)	616,577	254,272
장단기미지급금의 증가(감소)	(1,164,358)	473,480
선수금의 증가(감소)	223,193	(11,851)
예수금의 증가(감소)	(385,713)	20,122
미지급비용의 증가(감소)	(3,120,255)	(2,200,255)
장단기충당부채의 증가(감소)	406,978	72,707
퇴직금의 지급	(142,330)	(118,436)
기타	(802,638)	(521,371)
계	(14,233,315)	(3,334,668)

나. 당분기 및 전분기 중 리스부채와 관련하여 발생한 원금 상환에 따른 현금유출액(재무활동)은 238,374백만원 및 193,240백만원, 이자비용 현금유출액(영업활동)은 30,012백만원 및 25,835백만원입니다.

## 25. 재무위험관리:

연결회사의 재무위험관리는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험, 유동성위험 등을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 연결회사는 이를 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 재무위험관리정책과 프로그램을 운영하고 있습니다. 위험을 회피하기 위한 파생상품의 이용도 이 프로그램에 포함되어 있습니다.

재무위험관리는 재경팀이 주관하고 있으며, 글로벌 재무위험 관리정책을 수립한 후 주기적으로 재무위험 측정, 헷지 및 평가 등을 실행하고 있습니다.

한편, 해외 주요 권역별로 지역 금융센터(미국, 영국, 싱가포르, 중국, 브라질, 러시아)에서 환율변동 모니터링 및 환거래 대행을 통해 환율변동위험을 관리하고 있으며, 권역 내 자금을 통합운용하여 유동성위험을 관리하고 있습니다.

재무위험관리의 주요 대상인 자산은 현금및현금성자산, 단기금융상품, 상각후원가금융자산, 매출채권 등으로 구성되어 있으며, 부채는 매입채무, 차입금 등으로 구성되어 있습니다.

## 가. 시장위험

### (1) 환율변동위험

연결회사는 글로벌 영업 활동을 수행함에 따라 기능통화와 다른 통화로 거래를 하고 있어 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 USD, EUR, INR 등이 있습니다.

연결회사는 환율변동과는 무관하게 통화별 자산과 부채 규모를 일치하는 수준으로 유지하여 환율변동 영향을 최소화하는데 주력하고 있습니다. 이를 위해 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 금융 거래 발생 시 현지 통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치시킴으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있습니다. 또한, 연결회사는 효율적인 환율변동위험 관리를 위해 환위험을 주기적으로 모니터링 및 평가하고 있으며 투기적 외환거래는 엄격히 금지하고 있습니다.

### (2) 이자율변동위험

변동금리부 금융상품의 이자율변동위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치 변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 연결회사의 이자율변동위험은 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 연결회사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운영하고 있습니다.

### (3) 주가변동위험

연결회사는 전략적 목적 등으로 기타포괄손익-공정가치금융자산 및 당기손익-공정가치금융자산으로 분류된 지분상품에 투자하고 있습니다. 이를 위하여 직·간접적 투자수단을 이용하고 있습니다.

당분기말 현재 지분상품(상장주식)의 주가가 1% 변동할 경우 기타포괄손익(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향은 107,834백만원(전분기: 65,800백만원)이며, 당기손익(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향은 3,750백만원(전분기: 3,333백만원)입니다.

## 나. 신용위험

신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상의 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소를 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정·관리하고 있습니다. 그리고 위험국가에 소재한 거래처의 매출채권은 보험한도 내에서 적절하게 위험 관리되고 있습니다.

신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당 거래는 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등의 금융상품 거래를 포함합니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 연결회사는 국제 신용등급이 높은 은행(S&P A등급 이상)에 대해서만 거래를 하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 기존에 거래가 없는 금융기관과의 신규 거래는 재경팀과 지역 금융센터의 승인, 관리, 감독하에 이루어지고 있습니다. 연결회사가 체결하는 금융계약은 부채비율 제한 조항, 담보제공, 차입금 회수 등의 제약조건이 없는 계약을 위주로 체결하고 있으며, 기타의 경우 별도의 승인을 받아 거래하도록 되어 있습니다.

보고기간종료일 현재 연결회사의 금융자산 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 연결회사의 신용위험 최대노출액을 나타내고 있습니다.



## 다. 유동성위험

대규모 투자가 많은 연결회사 사업 특성상 적정 유동성의 유지가 매우 중요합니다. 연결회사는 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금 수준 산정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성을 유지·관리하고 있습니다.

연결회사는 주기적으로 미래 현금 흐름을 예측하여 유동성위험을 사전 관리하고 있습니다. 권역별로 Cash Pooling을 구축·활용하여 권역 내 자금 부족의 경우에도 내부 자금을 활용하여 유동성위험을 효율적으로 관리하고 있습니다. Cash Pooling은 자금 부족 회사와 자금 잉여 회사 간 자금을 공유하는 체제로 개별회사의 유동성위험을 최소화하는 한편 자금운용 부담 경감 및 금융비용 절감 등의 효과가 있어 연결회사의 사업 경쟁력 강화에 기여하고 있습니다.

또한, 만약의 대규모 유동성 필요에 대비하여 본사의 지급보증을 통해 해외 종속기업이 활용할 수 있는 차입한도를 확보하고 있습니다.

## 라. 자본위험

연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해관계자에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 건전한 자본구조를 유지하는 것입니다. 연결회사는 신용등급, 부채비율 등의 지표를 이용하여 자본위험을 관리하고 있습니다.

당분기말 현재 연결회사는 S&P로부터 AA-, Moody's로부터 Aa3 평가등급을 받고 있으며, 보고기간종료일 현재 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기말	전기말
부 채	124,036,040	121,721,227
자 본	315,290,919	304,899,931
부채비율	39.3%	39.9%

마. 공정가치 측정

(1) 보고기간종료일 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분	당분기말		전기말	
	장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
금융자산:				
현금및현금성자산	48,944,982	(*)	39,031,415	(*)
단기금융상품	75,121,426	(*)	81,708,986	(*)
단기상각후원가금융자산	1,755,225	(*)	3,369,034	(*)
단기당기손익-공정가치금융자산	53,056	53,056	40,757	40,757
매출채권	44,464,968	(*)	40,713,415	(*)
기타포괄손익-공정가치금융자산	13,201,558	13,201,558	13,965,839	13,965,839
당기손익-공정가치금융자산	1,496,122	1,496,122	1,525,344	1,525,344
기타(*2)	10,770,907	628,553	9,040,189	328,216
계	195,808,244		189,394,979	
금융부채:				
매입채무	15,133,906	(*)	13,453,351	(*)
단기차입금	13,885,889	(*)	13,687,793	(*)
미지급금	16,607,339	(*)	14,126,970	(*)
유동성장기부채	864,905	6,417	1,329,968	554,106
- 유동성장기차입금	858,964	(*)(*)	852,317	(*)(*)
- 유동성사채	5,941	6,417	477,651	554,106
사채	518,856	533,885	508,232	546,339
장기차입금	2,780,707	(*)(*)	2,866,156	(*)(*)
장기미지급금	2,121,276	(*)	2,562,158	(*)
기타(*2)	11,202,021	404,161	10,781,684	337,394
계	63,114,899		59,316,312	

(\*) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

(\*) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 일부 금융자산 10,142,354백만원(전기말: 8,711,973백만원)

및 금융부채 10,797,860백만원(전기말: 10,444,290백만원)은 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

(\*) 리스부채는 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시'에 따라 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

(2) 보고기간종료일 현재 공정가치로 측정 및 공시되는 금융상품의 공정가치 서열체계에 따른 수준별 공시는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기말			
	수준 1	수준 2	수준 3	계
금융자산:				
단기당기손익-공정가치금융자산	-	31,642	21,414	53,056
기타포괄손익-공정가치금융자산	10,783,382	-	2,418,176	13,201,558
당기손익-공정가치금융자산	374,950	-	1,121,172	1,496,122
기타	-	606,248	22,305	628,553
금융부채:				
유동성사채	-	6,417	-	6,417
사채	-	533,885	-	533,885
기타	-	398,723	5,438	404,161

(단위 : 백만원)

구 분	전기말			
	수준 1	수준 2	수준 3	계
금융자산:				
단기당기손익-공정가치금융자산	-	35,620	5,137	40,757
기타포괄손익-공정가치금융자산	11,608,708	-	2,357,131	13,965,839
당기손익-공정가치금융자산	478,401	-	1,046,943	1,525,344
기타	-	307,213	21,003	328,216
금융부채:				
유동성사채	-	554,106	-	554,106
사채	-	546,339	-	546,339
기타	-	331,956	5,438	337,394

공정가치 측정의 투입변수 특징에 따른 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다.

- '수준 1': 동일한 자산이나 부채에 대한 시장 공시가격
- '수준 2': 시장에서 관측가능한 투입변수를 활용한 공정가치  
(단, '수준 1'에 포함된 공시가격은 제외)
- '수준 3': 관측가능하지 않은 투입변수를 활용한 공정가치

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주하며, 이러한 상품은 '수준 1'에 포함됩니다. '수준 1'에 포함된 상품은 대부분 기타포괄손익-공정가치금융자산으로 분류된 상장주식으로 구성됩니다.

활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업고유정보는 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 '수준 2'에 포함됩니다.

만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 '수준 3'에 포함됩니다.

연결회사는 '수준 3'으로 분류되는 공정가치 측정을 포함하여 재무보고 목적의 공정가치를 측정하고 있습니다. 재무보고 일정에 맞추어 공정가치 평가 과정 및 그 결과에 대해 협의하고 있고, 공정가치 '수준' 간 이동을 발생시키는 사건이나 상황의 변동이 일어난 보고기간종료일에 '수준' 변동을 인식하고 있습니다.

금융상품의 공정가치를 측정하는 데 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.

- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격
- 파생상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당 금액을 현재가치로 할인하여 측정

나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법을 사용합니다. 유동자산으로 분류된 매출채권 및 기타채권의 경우 장부금액을 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하고 있습니다.

### (3) 가치평가기법 및 투입변수

연결회사는 공정가치 서열체계에서 '수준 2'로 분류되는 회사채, 국공채, 금융채 등에 대하여 미래현금흐름을 적정이자율로 할인하는 현재가치법을 사용하고 있습니다.

당분기말 현재 '수준 3'으로 분류된 주요 금융상품에 대하여 사용된 가치평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	공정가치	가치평가기법	'수준 3' 투입변수	투입변수 범위(가중평균)
기타포괄손익-공정가치금융자산:				
삼성벤처투자(주)	27,331	현금흐름할인법	영구성장률	-1.0%~1.0%(0.0%)
			가중평균자본비용	19.3%~21.3%(20.3%)
㈜미코세라믹스	25,666	현금흐름할인법 등	영구성장률	-1.0%~1.0%(0.0%)
			가중평균자본비용	13.2%~15.2%(14.2%)
TCL China Star Optoelectronics Technology Co. Ltd. (CSOT)	1,349,356	현금흐름할인법	영구성장률	-1.0%~1.0%(0.0%)
			가중평균자본비용	11.1%~13.1%(12.1%)
China Star Optoelectronics Semiconductor Display Technology Ltd (CSOSDT)	402,939	현금흐름할인법	영구성장률	-1.0%~1.0%(0.0%)
			가중평균자본비용	11.1%~13.1%(12.1%)
기타:				
지분 풋옵션	22,305	이항모형	무위험 이자율	2.4%~2.5%, 2.5%
			가격 변동성	19.2%~29.2%(24.2%) 24.3%~34.3%(29.3%)

(4) '수준 3'에 해당하는 금융상품의 변동 내역

(단위 : 백만원)

금융자산	당분기	전분기
기초	3,430,214	6,449,139
매입	76,803	21,581
매도	(20,629)	(36,180)
당기손익으로 인식된 손익	59,233	19,770
기타포괄손익으로 인식된 손익	51,749	1,145,421
기타	(14,303)	20,298
분기말	3,583,067	7,620,029

(단위 : 백만원)

금융부채	당분기	전분기
기초	5,438	9,248
당기손익으로 인식된 손익	-	-
기타	-	(2,176)
분기말	5,438	7,072

(5) '수준 3'으로 분류된 반복적인 공정가치 측정치의 민감도분석

금융상품의 민감도분석은 통계적 기법을 이용한 관측 불가능한 투입변수의 변동에 따른 금융상품의 가치 변동에 기초하여 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어집니다. 그리고 공정가치가 두 개 이상의 투입변수에 영향을 받는 경우에는 가장 유리하거나 또는 가장 불리한 금액을 바탕으로 산출됩니다.

당분기말 현재 '수준 3'으로 분류되는 주요 금융상품의 투입변수의 변동에 따른 손익효과(자본은 법인세효과 반영 전 효과)에 대한 민감도분석 결과는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	유리한 변동		불리한 변동	
	당기손익	자본	당기손익	자본
기타포괄손익-공정가치금융자산(*1)	-	164,689	-	(121,231)
기타(*2)	3,683	-	(4,378)	-

(\*1) 지분상품은 주요 관측불가능한 투입변수인 성장률(-1.0%~1.0%)과 할인율 사이의 상관관계를 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다.

(\*2) 주요 관측불가능한 투입변수인 가격 변동성을 5% 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다.



## 26. 부문별 보고:

### 가. 부문별 정보

연결회사는 전략적 의사결정을 수립하는 경영진(경영위원회)에게 보고되는 사업 단위를 기준으로 보고부문을 결정하고 있습니다. 경영위원회는 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 부문의 영업이익을 기준으로 검토하고 있습니다.

매출은 대부분 재화의 매출로 구성되어 있습니다. 연결회사의 보고부문은 조직 및 수익을 창출하는 제품의 유형을 기준으로 식별되었으며, 보고기간종료일 현재 보고부문은 DX 부문, DS 부문, SDC, Harman 등으로 구성되어 있습니다.

당분기와 전분기의 보고부문의 부문별 정보는 감가상각비, 무형자산상각비, 영업이익의 내부 거래조정이 배분된 후로 작성되었으며, 보고부문별 자산과 부채는 경영위원회에 정기적으로 제공되지 않아 포함하지 않았습니다.

(1) 당분기

(단위 : 백만원)

구 분	DX 부문	DS 부문	SDC	Harman	계(*)
매출액	48,068,667	26,867,414	7,970,491	2,666,346	77,781,498
감가상각비	604,849	6,884,322	1,399,564	78,371	9,009,031
무형자산상각비	393,762	207,287	59,388	57,526	770,477
영업이익	4,555,461	8,450,131	1,092,864	101,560	14,121,409

(\*) 기타는 별도로 표시하지 않았습니다.

당분기 주요 제품별 매출은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	영상기기	무선	메모리	DP	계(*)
매출액	8,718,021	31,227,757	20,091,464	7,970,491	77,781,498

(\*) 기타는 별도로 표시하지 않았습니다.

(2) 전분기

(단위 : 백만원)

구 분	DX 부문	DS 부문	SDC	Harman	계(*)
매출액	42,476,924	19,316,501	6,923,047	2,367,267	65,388,503
감가상각비	580,992	5,002,523	1,446,138	76,462	7,147,736
무형자산상각비	293,867	257,555	59,463	56,022	695,542
영업이익	5,509,503	3,360,769	364,428	113,125	9,382,868

(\*) 기타는 별도로 표시하지 않았습니다.

전분기 주요 제품별 매출은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	영상기기	무선	메모리	DP	계(*)
매출액	7,220,396	28,203,084	14,434,878	6,923,047	65,388,503

(\*) 기타는 별도로 표시하지 않았습니다.

## 나. 지역별 정보

당분기 및 전분기 중 지역별 영업현황(소재지 기준)은 다음과 같습니다.

### (1) 당분기

(단위 : 백만원)

구 분	국내	미주	유럽	아시아 및 아프리카	중국	연결실체 내 내부거래조정	계
순매출액	12,073,694	29,093,973	13,243,901	12,903,394	10,466,536	-	77,781,498
비유동자산(*)	126,618,363	11,036,417	5,863,349	9,047,693	17,930,153	(867,262)	169,628,713

(\*) 금융상품, 이연법인세자산, 관계기업 및 공동기업 투자 등이 제외된 금액입니다.

### (2) 전분기

(단위 : 백만원)

구 분	국내	미주	유럽	아시아 및 아프리카	중국	연결실체 내 내부거래조정	계
순매출액	10,033,479	20,686,422	13,209,383	10,827,379	10,631,840	-	65,388,503
비유동자산(*)	111,855,418	9,605,662	5,943,771	9,429,817	15,208,886	(909,159)	151,134,395

(\*) 금융상품, 이연법인세자산, 관계기업 및 공동기업 투자 등이 제외된 금액입니다.

## 27. 특수관계자와의 거래:

가. 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 매출·매입 등 거래 내역은 다음과 같습니다.

### (1) 당분기

(단위 : 백만원)

구 분	기업명(*1)	매출 등	비유동자산 처분	매입 등	비유동자산 매입
관계기업 및 공동기업	삼성에스디에스㈜	70,007	-	437,991	95,006
	삼성전기㈜	43,421	-	390,747	-
	삼성SDI㈜	28,489	-	193,174	546
	㈜제일기획	29,498	-	217,332	-
	기타	313,103	-	3,731,873	28,342
	관계기업 및 공동기업 계	484,518	-	4,971,117	123,894
그 밖의 특수관계자	삼성물산㈜	12,416	-	128,300	1,187,351
	기타	118,703	-	380,595	46,274
	그 밖의 특수관계자 계	131,119	-	508,895	1,233,625
기타(*2)	삼성엔지니어링㈜	138	-	1,353	277,553
	㈜에스원	2,558	-	122,482	7,729
	기타	48,115	-	65,256	74,363
	기타 계	50,811	-	189,091	359,645

(\*1) 연결회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.

(\*2) 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

## (2) 전분기

(단위 : 백만원)

구 분	기업명(*1)	매출 등	비유동자산 처분	매입 등	비유동자산 매입
관계기업 및 공동기업	삼성에스디에스㈜	70,200	-	403,699	83,691
	삼성전기㈜	29,507	-	385,710	-
	삼성SDI㈜	23,878	154	138,819	7,247
	㈜제일기획	25,126	-	157,185	-
	기타	293,248	68	2,833,972	28,475
	관계기업 및 공동기업 계	441,959	222	3,919,385	119,413
그 밖의 특수관계자	삼성물산㈜	28,303	-	63,226	900,762
	기타	104,634	-	543,452	217,726
	그 밖의 특수관계자 계	132,937	-	606,678	1,118,488
기타(*2)	삼성엔지니어링㈜	81	-	3,835	89,484
	㈜에스원	1,902	-	113,250	11,084
	기타	31,433	-	51,848	43,226
	기타 계	33,416	-	168,933	143,794

(\*1) 연결회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.

(\*2) 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

나. 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권·채무 등 잔액은 다음과 같습니다.

(1) 당분기말

(단위 : 백만원)

구분	기업명(*1)	채권 등	채무 등(*2)
관계기업 및 공동기업	삼성에스디에스(주)	66,637	513,124
	삼성전기(주)	38,708	160,936
	삼성SDI(주)	144,112	74,886
	(주)제일기획	28,897	371,176
	기타	349,961	1,290,726
	관계기업 및 공동기업 계	628,314	2,410,847
그 밖의 특수관계자	삼성물산(주)	216,322	767,759
	기타	57,437	231,479
	그 밖의 특수관계자 계	273,759	999,238
기타(*3)	삼성엔지니어링(주)	130	295,189
	(주)에스원	1,991	37,023
	기타	11,037	81,168
	기타 계	13,158	413,380

(\*1) 연결회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다.

(\*2) 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.

(\*3) 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

(2) 전기말

(단위 : 백만원)

구분	기업명(*1)	채권 등	채무 등(*2)
관계기업 및 공동기업	삼성에스디에스(주)	64,521	616,949
	삼성전기(주)	3,659	176,549
	삼성SDI(주)	130,638	100,835
	(주)제일기획	206	428,090
	기타	397,709	1,361,554
	관계기업 및 공동기업 계	596,733	2,683,977
그 밖의 특수관계자	삼성물산(주)	220,550	1,739,997
	기타	20,306	251,766
	그 밖의 특수관계자 계	240,856	1,991,763
기타(*3)	삼성엔지니어링(주)	338	1,151,536
	(주)에스원	2,423	40,558
	기타	48,703	185,256
	기타 계	51,464	1,377,350

(\*1) 연결회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다.

(\*2) 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.

(\*3) 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

다. 연결회사는 당분기 및 전분기 중 관계기업 및 공동기업에 6,100백만원 및 14,500백만원을 출자하였습니다. 또한 당분기 중 관계기업 및 공동기업으로부터 5,153백만원의 출자원금을 회수하였으며, 전분기 중 회수한 출자원금은 없습니다. 한편, 연결회사는 2022년 4월 중 관계기업인 삼성바이오로직스(주)의 유상증자에 참여하여 보통주 신주 1,380,477주(주당 발행가액 : 639,000원)를 추가 취득하였습니다.

라. 연결회사가 당분기 및 전분기 중 특수관계자에게 지급 결의한 배당금은 421,609백만원 및 2,261,462백만원입니다. 당분기말 현재 배당과 관련한 미지급금은 421,609백만원입니다. 또한, 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사에게 당분기 및 전분기 중 지급 결의한 배당금은 32,058백만원 및 171,566백만원입니다. 당분기말 현재 배당과 관련한 미지급금은 32,058백만원입니다.

마. 연결회사가 당분기 및 전분기 중 특수관계자와 체결한 리스 이용 계약은 없으며 특수관계자에게 지급한 리스료는 6,180백만원 및 8,369백만원입니다.

바. 연결회사가 당분기 및 전분기 중 주요 경영진(등기임원)에 대한 보상을 위해 비용으로 반영한 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기	전분기
단기급여	3,415	2,868
퇴직급여	127	222
기타 장기급여	2,072	1,625



## 28. 보고기간 후 사건:

연결회사는 2022년 4월 중 관계기업인 삼성바이오로직스(주)의 유상증자에 참여하여 보통주 신주 1,380,477주(주당 발행가액 : 639,000원)를 추가 취득하였습니다.

## 4. 재무제표

### 재무상태표

제 54 기 1분기말 2022.03.31 현재

제 53 기말 2021.12.31 현재

(단위 : 백만원)

	제 54 기 1분기말	제 53 기말
자산		
유동자산	81,466,028	73,553,416
현금및현금성자산	9,129,795	3,918,872
단기금융상품	12,802,352	15,000,576
매출채권	34,711,648	33,088,247
미수금	1,563,894	1,832,488
선급비용	1,131,164	817,689
재고자산	18,708,199	15,973,053
기타유동자산	3,418,976	2,922,491
비유동자산	177,887,983	177,558,768
기타포괄손익-공정가치금융자산	1,588,288	1,662,532
당기손익-공정가치금융자산	1,876	2,135
종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자	56,196,646	56,225,599
유형자산	104,032,562	103,667,025
무형자산	8,333,496	8,657,456
순확정급여자산	2,008,270	2,324,291
이연법인세자산	1,765,503	1,211,100
기타비유동자산	3,961,342	3,808,630
자산총계	259,354,011	251,112,184
부채		
유동부채	56,799,776	53,067,303
매입채무	13,406,261	11,557,441
단기차입금	10,237,826	9,204,268
미지급금	15,591,366	13,206,753
선수금	375,259	474,731
예수금	400,119	624,585
미지급비용	6,020,792	8,275,410
당기법인세부채	5,942,191	5,599,896
유동성장기부채	138,751	139,328
총당부채	4,278,452	3,643,853
기타유동부채	408,759	341,038
비유동부채	4,278,465	4,851,149
사채	29,710	29,048
장기차입금	419,079	431,915
장기미지급금	2,217,177	2,653,715

장기총당부채	1,544,849	1,659,774
기타비유동부채	67,650	76,697
부채총계	61,078,241	57,918,452
자본		
자본금	897,514	897,514
우선주자본금	119,467	119,467
보통주자본금	778,047	778,047
주식발행초과금	4,403,893	4,403,893
이익잉여금(결손금)	193,973,301	188,774,335
기타자본항목	(998,938)	(882,010)
자본총계	198,275,770	193,193,732
부채와자본총계	259,354,011	251,112,184

## 손익계산서

제 54 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지

제 53 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지

(단위 : 백만원)

	제 54 기 1분기		제 53 기 1분기	
	3개월	누적	3개월	누적
수익(매출액)	56,724,258	56,724,258	45,042,390	45,042,390
매출원가	39,184,912	39,184,912	33,137,562	33,137,562
매출총이익	17,539,346	17,539,346	11,904,828	11,904,828
판매비와관리비	8,387,515	8,387,515	7,459,352	7,459,352
영업이익	9,151,831	9,151,831	4,445,476	4,445,476
기타수익	283,271	283,271	1,357,247	1,357,247
기타비용	54,609	54,609	48,980	48,980
금융수익	1,739,895	1,739,895	920,764	920,764
금융비용	1,442,368	1,442,368	857,151	857,151
법인세비용차감전순이익(손실)	9,678,020	9,678,020	5,817,356	5,817,356
법인세비용	2,026,077	2,026,077	1,269,752	1,269,752
계속영업이익(손실)	7,651,943	7,651,943	4,547,604	4,547,604
당기순이익(손실)	7,651,943	7,651,943	4,547,604	4,547,604
주당이익				
기분주당이익(손실) (단위 : 원)	1,127	1,127	669	669
회석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,127	1,127	669	669

## 포괄손익계산서

제 54 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지

제 53 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지

(단위 : 백만원)

	제 54 기 1분기		제 53 기 1분기	
	3개월	누적	3개월	누적
당기순이익(손실)	7,651,943	7,651,943	4,547,604	4,547,604
기타포괄손익	(116,928)	(116,928)	16,006	16,006
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(116,928)	(116,928)	16,006	16,006
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(53,901)	(53,901)	53,976	53,976
순확정급여부채(자산) 재측정요소	(63,027)	(63,027)	(37,970)	(37,970)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	0	0	0	0
총포괄손익	7,535,015	7,535,015	4,563,610	4,563,610

# 자본변동표

제 54 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지

제 53 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지

(단위 : 백만원)

	자본				
	자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	자본 합계
2021.01.01 (기초자본)	897,514	4,403,893	178,284,102	(268,785)	183,316,724
당기순이익(손실)			4,547,604		4,547,604
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익				53,976	53,976
순확정급여부채(자산) 재측정요소				(37,970)	(37,970)
배당			(13,124,260)		(13,124,260)
2021.03.31 (기말자본)	897,514	4,403,893	169,707,446	(252,779)	174,756,074
2022.01.01 (기초자본)	897,514	4,403,893	188,774,335	(882,010)	193,193,732
당기순이익(손실)			7,651,943		7,651,943
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익				(53,901)	(53,901)
순확정급여부채(자산) 재측정요소				(63,027)	(63,027)
배당			(2,452,977)		(2,452,977)
2022.03.31 (기말자본)	897,514	4,403,893	193,973,301	(998,938)	198,275,770

## 현금흐름표

제 54 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지

제 53 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지

(단위 : 백만원)

	제 54 기 1분기	제 53 기 1분기
영업활동 현금흐름	9,736,848	8,961,915
영업에서 창출된 현금흐름	9,796,140	8,478,097
당기순이익	7,651,943	4,547,604
조정	8,705,638	5,241,834
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(6,561,441)	(1,311,341)
이자의 수취	57,351	68,537
이자의 지급	(50,096)	(23,076)
배당금 수입	676	1,027,775
법인세 납부액	(67,223)	(589,418)
투자활동 현금흐름	(5,534,357)	(1,628,399)
단기금융상품의 순감소(증가)	2,198,224	6,298,328
기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	0	(43,009)
당기손익-공정가치금융자산의 처분	150	90
종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 처분	75,028	31,766
종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 취득	(45,495)	(1,992)
유형자산의 처분	55,545	190,300
유형자산의 취득	(6,939,519)	(7,449,044)
무형자산의 처분	197	0
무형자산의 취득	(863,935)	(644,893)
기타투자활동으로 인한 현금유출입액	(14,552)	(9,945)
재무활동 현금흐름	1,008,432	(31,579)
단기차입금의 순증가(감소)	1,043,408	(1,785)
사채 및 장기차입금의 상환	(34,731)	(29,551)
배당금의 지급	(245)	(243)
외화환산으로 인한 현금의 변동	0	18
현금및현금성자산의 순증감	5,210,923	7,301,955
기초의 현금및현금성자산	3,918,872	989,045
기말의 현금및현금성자산	9,129,795	8,291,000

## 5. 재무제표 주석

제 54 기 분기 : 2022년 3월 31일 현재

제 53 기 : 2021년 12월 31일 현재

삼성전자주식회사

### 1. 일반적 사항:

삼성전자주식회사(이하 "회사")는 1969년 대한민국에서 설립되어 1975년에 대한민국의 증권거래소에 상장하였습니다. 회사의 사업은 DX 부문, DS 부문으로 구성되어 있습니다. DX(Device eXperience) 부문은 TV, 냉장고, 휴대폰, 통신시스템 등의 사업으로 구성되어 있으며, DS(Device Solutions) 부문은 메모리, Foundry, System LSI 등으로 구성되어 있습니다. 회사의 본점 소재지는 경기도 수원시입니다.

회사의 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표입니다.



## 2. 중요한 회계처리방침:

### 2.1. 재무제표 작성기준

회사의 2022년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 분기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 분기재무제표는 보고기간종료일인 2022년 3월 31일 현재 유효한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

#### 가. 회사가 채택한 제·개정 기준서

회사는 2022년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 주요 제·개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.

##### - 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정

코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있도록 하는 실무적 간편법의 적용대상이 2022년 6월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료에 영향을 미치는 리스료 감면으로 확대되었습니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

##### - 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정

사업결합 시 인식할 자산과 부채의 정의를 개정된 재무보고를 위한 개념체계를 참조하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 및 해석서 제2121호 '부담금'의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점을 명확히 하였습니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' 개정

기업이 자산을 의도한 방식으로 사용하기 전에 생산된 품목의 판매에서 발생하는 수익을 생산원가와 함께 당기손익으로 인식하도록 요구하며, 유형자산의 취득원가에서 차감하는 것을 금지하고 있습니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 개정

손실부담계약을 식별할 때 계약이행원가의 범위를 계약 이행을 위한 증분원가와 계약 이행에 직접 관련되는 다른 원가의 배분이라는 점을 명확히 하였습니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

나. 회사가 적용하지 않은 제·개정 기준서

제정 또는 공포됐으나 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 않았고, 회사가 조기 적용하지 않은 주요 제·개정 기준서는 다음과 같습니다.

- 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정

보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된 경우는 제외됩니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다.

- 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정

중요한 회계정책을 정의하고 공시하도록 하며, 중요성 개념을 적용하는 방법에 대한 지침을 제공하기 위하여 국제회계기준 실무서 2 '회계정책 공시'를 개정하였습니다. 동 개정 사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며 조기적용이 허용됩니다.

- 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정

회계추정을 정의하고, 회계정책의 변경과 구별하는 방법을 명확히 하였습니다. 동 개정 사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며 조기적용이 허용됩니다.

- 기업회계기준서 제1012호 '법인세' 개정

자산 또는 부채가 최초로 인식되는 거래의 최초 인식 예외 요건에 거래당시 동일한 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이를 발생시키지 않는 거래라는 요건을 추가하였습니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다.

## 2.2. 회계정책

분기재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1에서 설명하는 제·개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 2021년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

### 2.3. 중요한 회계추정 및 가정

분기재무제표 작성시 회사의 경영진은 회계정책의 적용과 보고되는 자산·부채의 장부금액 및 이익·비용에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다. 특히 코로나19로 회사의 추정 및 가정에 영향이 발생할 수 있으나, 당분기말 현재 그 영향을 합리적으로 추정할 수 없습니다.

분기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 2021년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

### 3. 범주별 금융상품:

보고기간종료일 현재 범주별 금융상품 내역은 다음과 같습니다.

#### (1) 당분기말

(단위 : 백만원)

금융자산	상각후원가 측정 금융자산	기타포괄손익-공정 가치 측정 금융자산	당기손익-공정가치 측정 금융자산	계
현금및현금성자산	9,129,795	-	-	9,129,795
단기금융상품	12,802,352	-	-	12,802,352
매출채권	34,711,648	-	-	34,711,648
기타포괄손익-공정가치금융자산	-	1,588,288	-	1,588,288
당기손익-공정가치금융자산	-	-	1,876	1,876
기타	5,323,358	-	259,530	5,582,888
계	61,967,153	1,588,288	261,406	63,816,847

(단위 : 백만원)

금융부채	상각후원가 측정 금융부채	기타금융부채(*)	계
매입채무	13,406,261	-	13,406,261
단기차입금	-	10,237,826	10,237,826
미지급금	15,294,921	-	15,294,921
유동성장기부채	5,941	132,810	138,751
사채	29,710	-	29,710
장기차입금	-	419,079	419,079
장기미지급금	1,883,559	-	1,883,559
기타	3,399,266	-	3,399,266
계	34,019,658	10,789,715	44,809,373

(\*) 기타금융부채는 범주별 금융부채의 적용을 받지 않는 담보부차입금 및 리스부채 등을 포함하고 있습니다.

(2) 전기말

(단위 : 백만원)

금융자산	상각후원가 측정 금융자산	기타포괄손익-공정 가치 측정 금융자산	당기손익-공정가치 측정 금융자산	계
현금및현금성자산	3,918,872	-	-	3,918,872
단기금융상품	15,000,576	-	-	15,000,576
매출채권	33,088,247	-	-	33,088,247
기타포괄손익-공정가치금융자산	-	1,662,532	-	1,662,532
당기손익-공정가치금융자산	-	-	2,135	2,135
기타	5,076,418	-	-	5,076,418
계	57,084,113	1,662,532	2,135	58,748,780

(단위 : 백만원)

금융부채	상각후원가 측정 금융부채	기타금융부채(*)	계
매입채무	11,557,441	-	11,557,441
단기차입금	-	9,204,268	9,204,268
미지급금	12,948,960	-	12,948,960
유동성장기부채	5,810	133,518	139,328
사채	29,048	-	29,048
장기차입금	-	431,915	431,915
장기미지급금	2,335,218	-	2,335,218
기타	3,056,156	-	3,056,156
계	29,932,633	9,769,701	39,702,334

(\*) 기타금융부채는 범주별 금융부채의 적용을 받지 않는 담보부차입금 및 리스부채 등을 포함하고 있습니다.

4. 공정가치금융자산:

가. 보고기간종료일 현재 공정가치금융자산의 구성 내역은 다음과 같습니다.

(1) 기타포괄손익-공정가치금융자산

(단위 : 백만원)

구 분	당분기말	전기말
지분상품	1,588,288	1,662,532

(2) 당기손익-공정가치금융자산

(단위 : 백만원)

구 분	당분기말	전기말
채무상품	1,876	2,135

나. 보고기간종료일 현재 공정가치금융자산 중 상장주식의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주, %, 백만원)

기 업 명	당분기말				전기말
	보유주식수 (주)	지분율 (%)(*)	취득원가	장부금액 (시장가치)	장부금액 (시장가치)
삼성중공업(주)	134,027,281	15.2	932,158	761,275	759,935
(주)호텔신라	2,004,717	5.1	13,957	162,783	156,368
(주)아이마켓코리아	647,320	1.9	324	7,023	6,926
(주)케이티스카이라이프	240,000	0.5	3,344	2,134	2,194
(주)용평리조트	400,000	0.8	1,869	2,164	1,958
(주)에이테크솔루션	1,592,000	15.9	26,348	22,049	26,188
(주)원익홀딩스	1,759,171	2.3	15,410	8,453	8,761
(주)원익아이피에스	1,850,936	3.8	16,214	70,521	78,295
(주)동진세미켐	2,467,894	4.8	48,277	96,988	125,863
솔브레인홀딩스(주)	461,741	2.2	30,752	13,875	15,976
솔브레인(주)	373,368	4.8	24,866	91,400	103,983
(주)에스앤에스텍	1,716,116	8.0	65,933	52,685	63,153
와이아이케이(주)	9,601,617	11.7	47,336	52,809	59,530
(주)케이씨텍	1,022,216	4.9	20,720	22,284	24,584
(주)엘오티베콤	1,267,668	7.1	18,990	19,079	21,805
(주)뉴파워프라즈마	2,140,939	4.9	12,739	11,711	13,723
(주)에프에스티	1,522,975	7.0	43,009	34,876	38,607
(주)디엔에프	810,030	7.0	20,964	16,768	18,509
Marvell	173,187	0.0	11,705	15,037	17,962
계			1,354,915	1,463,914	1,544,320

(\*) 총발행보통주식수 기준 지분율입니다.



5. 재고자산:

보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기말			전기말		
	평가전금액	평가충당금	장부금액	평가전금액	평가충당금	장부금액
제품 및 상품	4,657,124	(378,705)	4,278,419	3,884,713	(366,987)	3,517,726
반제품 및 재공품	10,851,334	(360,444)	10,490,890	9,384,285	(222,291)	9,161,994
원재료 및 저장품	3,852,431	(316,649)	3,535,782	3,211,380	(258,464)	2,952,916
미착품	403,108	-	403,108	340,417	-	340,417
계	19,763,997	(1,055,798)	18,708,199	16,820,795	(847,742)	15,973,053

6. 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자:

가. 당분기 및 전분기 중 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기	전분기
기초장부금액	56,225,599	56,587,548
취득	45,495	1,992
처분	(74,448)	(31,766)
분기말장부금액	56,196,646	56,557,774

나. 보고기간종료일 현재 주요 관계기업 투자 현황은 다음과 같습니다.  
(종속기업 현황은 주석 27 참조)

기업명	관계의 성격	지분율(%)(*1)	주사업장	결산월
삼성전기(주)	수동소자, 회로부품, 모듈 등 전자부품의 생산 및 공급	23.7	한국	12월
삼성에스디에스(주)	컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합·관리 등 IT서비스 및 물류서비스 제공	22.6	한국	12월
삼성바이오로직스(주)	신사업 투자	31.5	한국	12월
삼성SDI(주)(*2)	2차전지 등 전자제품의 생산 및 공급	19.6	한국	12월
(주)제일기획	광고 대행업	25.2	한국	12월

(\*1) 총발행보통주식수 기준 지분율입니다.

(\*2) 유통보통주식수 기준 지분율은 20.6%입니다.

다. 보고기간종료일 현재 시장성 있는 관계기업 투자주식의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주, 백만원)

기업명	당분기말			전기말	
	주식수	시장가치	장부금액	시장가치	장부금액
삼성전기(주)	17,693,084	2,919,359	445,244	3,494,384	445,244
삼성에스디에스(주)	17,472,110	2,419,887	560,827	2,734,385	560,827
삼성바이오로직스(주)	20,836,832	17,232,060	443,193	18,815,659	443,193
삼성SDI(주)	13,462,673	8,023,753	1,242,605	8,818,051	1,242,605
(주)제일기획	29,038,075	683,847	491,599	663,520	491,599

## 7. 유형자산:

가. 당분기 및 전분기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기	전분기
기초장부금액	103,667,025	86,166,924
일반취득 및 자본적지출	6,311,543	7,013,954
감가상각	(5,927,470)	(4,546,844)
처분·폐기·손상	(27,029)	(77,466)
기타	8,493	(1,571)
분기말장부금액	104,032,562	88,554,997

나. 당분기 및 전분기 중 계정과목별 유형자산 상각내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기	전분기
매출원가	5,488,037	4,126,460
판매비와관리비 등	439,433	420,384
계	5,927,470	4,546,844

다. 당분기말 현재 유형자산에 포함된 사용권자산은 713,070백만원(전기말: 730,325백만원)입니다. 또한, 당분기 중 신규 발생한 사용권자산은 22,317백만원(전분기: 75,321백만원)이며, 사용권자산의 감가상각비는 39,202백만원(전분기: 31,588백만원)입니다.

8. 무형자산:

가. 당분기 및 전분기 중 무형자산의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기	전분기
기초장부금액	8,657,456	7,002,648
내부개발에 의한 취득	-	101,577
개별 취득	303,200	323,214
상각	(628,517)	(553,854)
처분·폐기·손상	(3,150)	(9,758)
기타	4,507	14,866
분기말장부금액	8,333,496	6,878,693

나. 당분기 및 전분기 중 계정과목별 무형자산 상각 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기	전분기
매출원가	480,529	437,705
판매비와관리비 등	147,988	116,149
계	628,517	553,854

## 9. 차입금:

보고기간종료일 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	차입처	연이자율(%)	금 액	
		당분기말	당분기말	전기말
단기차입금:				
담보부차입금(*1)	우리은행 등	0.0~12.8	10,237,826	9,204,268
유동성장기차입금:				
리스부채(*2)	-	1.7	132,810	133,518
장기차입금:				
리스부채(*2)	-	1.7	419,079	431,915

(\*1) 담보부차입금과 관련하여 매출채권을 담보로 제공하였습니다.

(\*2) 리스부채와 관련하여 연이자율은 가중평균증분차입이자율이며, 당분기 중 발생한 이자비용은 2,310백만원(전분기: 1,155백만원)입니다. 또한, 채무불이행이 발생할 경우에 대비하여 리스제공자에게 사용권자산에 대한 권리를 담보로 제공하였습니다.

10. 사채:

보고기간종료일 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	발행일	만기상환일	연이자율(%)	금 액	
			당분기말	당분기말	전기말
US\$ denominated Straight Bonds(*)	1997.10.02	2027.10.01	7.7	36,324 (US\$ 30,000천)	35,565 (US\$ 30,000천)
사채할인발행차금				(673)	(707)
계				35,651	34,858
차감: 유동성사채				(5,941)	(5,810)
비유동성사채				29,710	29,048

(\*) 10년 거치 20년 분할상환되며 이자는 6개월마다 후급됩니다.

11. 순확정급여부채(자산):

가. 보고기간종료일 현재 순확정급여부채(자산)의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기말	전기말
기금이 적립된 확정급여채무의 현재가치	11,428,018	11,155,187
기금이 적립되지 않은 확정급여채무의 현재가치	18,900	18,449
소 계	11,446,918	11,173,636
사외적립자산의 공정가치	(13,455,188)	(13,497,927)
순확정급여(자산) 계	(2,008,270)	(2,324,291)

나. 당분기 및 전분기 중 확정급여제도 관련 비용의 세부 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기	전분기
당기근무원가	257,508	226,862
순이자원가(수익)	(22,976)	(10,026)
계	234,532	216,836

다. 당분기 및 전분기 중 확정급여제도 관련 비용의 계정과목별 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기	전분기
매출원가	93,630	84,710
판매비와관리비 등	140,902	132,126
계	234,532	216,836

## 12. 충당부채:

당분기 중 충당부채의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	판매보증 (가)	기술사용료 (나)	장기성과급 (다)	기타 (라),(마)	계
기초	386,713	1,496,525	558,982	2,861,407	5,303,627
순전입(환입)	141,893	387,867	44,778	1,870,078	2,444,616
사용	(117,058)	(48,417)	(194,281)	(1,608,584)	(1,968,340)
기타	-	30,643	-	12,755	43,398
당분기말	411,548	1,866,618	409,479	3,135,656	5,823,301

가. 회사는 출고한 제품에 대한 품질보증, 교환, 하자보수 및 그에 따른 사후서비스 등으로 인하여 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 보증기간 및 과거 경험률 등을 기초로 추정하여 충당부채로 설정하고 있습니다.

나. 회사는 협상 진행 중인 기술사용계약과 관련하여 향후 지급이 예상되는 기술사용료를 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다. 지급시기 및 금액은 협상결과에 따라 변동될 수 있습니다.

다. 회사는 임원을 대상으로 부여연도를 포함한 향후 3년간의 경영실적에 따라 성과급을 지급하는 장기성과 인센티브를 부여하였는 바, 향후 지급이 예상되는 금액의 경과 기간 해당분을 충당부채로 계상하고 있습니다.

라. 회사는 생산 및 판매 중단한 제품에 대하여 향후 부담할 것으로 예상되는 비용 등을 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다.



다. 회사는 온실가스 배출과 관련하여 해당 이행연도분 배출권의 장부금액과 이를 초과하는 배출량에 대해 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다.

(1) 당분기말 현재 당기 이행연도에 대한 무상할당 배출권과 온실가스 배출량 추정치는 다음과 같습니다.

(단위 : 만톤(tCO<sub>2</sub>-eq))

구 분	당분기말
무상할당 배출권	1,123
배출량 추정치	1,523

(2) 당분기 중 배출권 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기
기초	46,073
증가	-
당분기말	46,073

(3) 당분기 중 배출부채 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기
기초	45,049
순전입(환입)	12,454
사용	-
당분기말	57,503

### 13. 우발부채와 약정사항:

#### 가. 지급보증한 내역

(1) 당분기말 현재 회사가 해외종속기업의 자금조달 등을 위하여 제공하고 있는 채무보증 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

해외종속기업	보증처	보증종료일	금 액	
			관련 차입금	채무보증한도
SETK	BNP 외	2022-12-16	155,298	977,116
SETK-P	BNP 외	2022-12-16	68,178	157,404
SEIL	Citibank	2022-12-16	12,945	18,888
기타	기타	-	-	8,830,286
계			236,421 (US\$ 195,265천)	9,983,694 (US\$ 8,245,535천)

(2) 당분기말 현재 회사가 해외종속기업의 계약이행을 위하여 제공하고 있는 지급보증 한도액은 423,687백만원입니다.

(3) 당분기말 현재 회사가 특수관계자로부터 제공받고 있는 담보 및 지급보증은 없습니다.

#### 나. 소송 등

당분기말 현재 회사는 다수의 회사 등과 정상적인 영업과정에서 발생한 소송, 분쟁 및 규제기관의 조사 등이 진행 중에 있습니다. 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며 회사의 경영진은 이러한 소송 등의 결과가 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

#### 다. 분할과 관련된 연대채무

회사와 삼성디스플레이(주) 등은 분할된 삼성디스플레이(주) 등의 분할 전 채무에 관하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다.

14. 계약부채:

보고기간종료일 현재 계약부채는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기말	전기말
계약부채(*)	1,244,607	1,104,756

(\*) 계약부채는 선수금, 미지급비용, 기타유동부채 등에 포함되어 있습니다.

#### 15. 자본금:

보고기간종료일 현재 회사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 250억주(1주의 액면금액: 100원)이며, 회사가 발행한 보통주 및 우선주의 수(소각 주식수 제외)는 각각 5,969,782,550주와 822,886,700주입니다. 보고기간종료일 현재 유통주식수는 상기 발행주식의 수와 동일하며, 당분기 및 전기 중 변동사항은 없습니다. 한편, 발행주식의 액면총액은 679,267백만원(보통주 596,978백만원, 우선주 82,289백만원)으로 이익소각으로 인하여 납입자본금 897,514백만원과 상이합니다.

16. 이익잉여금:

가. 보고기간종료일 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기말	전기말
법정적립금	450,789	450,789
임의적립금 등	193,522,512	188,323,546
계	193,973,301	188,774,335

나. 당분기 및 전분기 중 배당금 산정 내역은 다음과 같습니다.

(1) 분기배당 (배당기준일: 2022년과 2021년 3월 31일)

(단위 : 주, %, 백만원)

구 분		당분기	전분기
배당받을 주식	보통주	5,969,782,550주	5,969,782,550주
	우선주	822,886,700주	822,886,700주
배당률(액면가 기준)	보통주 · 우선주	361%	361%
배당금액	보통주	2,155,092	2,155,092
	우선주	297,062	297,062
	계	2,452,154	2,452,154

17. 기타자본항목:

보고기간종료일 현재 기타자본항목의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기말	전기말
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	36,678	90,579
순확정급여부채(자산) 재측정요소	(2,796,024)	(2,732,997)
기타	1,760,408	1,760,408
계	(998,938)	(882,010)

18. 비용의 성격별 분류:

당분기 및 전분기 중 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기	전분기
제품 및 재공품 등의 변동	(2,089,589)	1,145,108
원재료 등의 사용액 및 상품 매입액 등	27,637,597	21,429,120
급여	4,240,048	3,563,516
퇴직급여	236,336	219,230
감가상각비	5,927,470	4,546,844
무형자산상각비	628,517	553,854
복리후생비	680,291	610,807
유틸리티비	832,675	686,350
외주용역비	803,742	814,449
광고선전비	353,048	249,023
판매촉진비	405,396	300,650
기타비용	7,916,896	6,477,963
계(★)	47,572,427	40,596,914

(★) 손익계산서 상 매출원가와 판매비와관리비를 합한 금액입니다.

19. 판매비와관리비:

당분기 및 전분기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기	전분기
(1) 판매비와관리비:		
급여	728,659	648,173
퇴직급여	41,455	41,089
지급수수료	660,812	579,165
감가상각비	98,783	100,529
무형자산상각비	88,795	54,037
광고선전비	353,048	248,988
판매촉진비	405,396	300,650
운반비	261,485	196,800
서비스비	275,303	280,293
기타판매비와관리비	439,996	392,582
소 계	3,353,732	2,842,306
(2) 경상연구개발비:		
연구개발 총지출액	5,033,783	4,718,623
개발비 자산화	-	(101,577)
소 계	5,033,783	4,617,046
계	8,387,515	7,459,352



20. 기타수익 및 기타비용:

당분기 및 전분기 중 기타수익 및 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기	전분기
(1) 기타수익:		
배당금수익	127,508	1,135,000
임대료수익	43,238	41,189
유형자산처분이익	48,098	132,884
기타	64,427	48,174
계	283,271	1,357,247
(2) 기타비용:		
유형자산처분손실	934	3,204
기부금	52,457	27,596
기타	1,218	18,180
계	54,609	48,980

21. 금융수익 및 금융비용:

당분기 및 전분기 중 금융수익 및 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기	전분기
(1) 금융수익:		
이자수익	83,458	82,289
- 상각후원가 측정 금융자산	83,458	82,289
외환차이	1,396,907	838,475
파생상품관련이익	259,530	-
계	1,739,895	920,764
(2) 금융비용:		
이자비용	53,921	32,114
- 상각후원가 측정 금융부채	11,817	9,038
- 기타금융부채	42,104	23,076
외환차이	1,388,447	825,037
계	1,442,368	857,151

회사는 외화거래 및 환산으로 발생한 외환차이를 금융수익 및 금융비용으로 인식하고 있습니다.

## 22. 법인세비용:

법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 당분기말 현재 2022년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상평균연간법인세율은 20.9%입니다.

### 23. 주당이익:

#### 가. 기본주당이익

당분기 및 전분기 중 기본주당이익 산정 내역은 다음과 같습니다.

##### (1) 보통주

(단위 : 백만원, 천주)

구 분	당분기	전분기
분기순이익	7,651,943	4,547,604
분기순이익 중 보통주 해당분	6,724,961	3,996,692
÷ 가중평균유통보통주식수	5,969,783	5,969,783
기본 보통주 주당이익(단위 : 원)	1,127	669

##### (2) 우선주

(단위 : 백만원, 천주)

구 분	당분기	전분기
분기순이익	7,651,943	4,547,604
분기순이익 중 우선주 해당분	926,982	550,912
÷ 가중평균유통우선주식수	822,887	822,887
기본 우선주 주당이익(단위 : 원)	1,127	669

#### 나. 희석주당이익

회사가 보유하고 있는 희석성 잠재적보통주는 없으며, 당분기 및 전분기 중 기본주당이익과 희석주당이익은 동일합니다.

24. 현금흐름표:

가. 회사는 영업활동 현금흐름을 간접법으로 작성하였습니다. 당분기 및 전분기 중 영업활동 현금흐름 관련 조정 내역 및 영업활동으로 인한 자산부채의 변동은 다음과 같습니다.

(1) 조정 내역

(단위 : 백만원)

구 분	당분기	전분기
법인세비용	2,026,077	1,269,752
금융수익	(787,805)	(527,907)
금융비용	566,791	334,183
퇴직급여	236,336	219,230
감가상각비	5,927,470	4,546,844
무형자산상각비	628,517	553,854
대손상각비(환입)	4,586	10,651
배당금수익	(127,508)	(1,135,000)
유형자산처분이익	(48,098)	(132,884)
유형자산처분손실	934	3,204
재고자산평가손실(환입) 등	275,743	96,196
기타	2,595	3,711
계	8,705,638	5,241,834

(2) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(단위 : 백만원)

구 분	당분기	전분기
매출채권의 감소(증가)	(1,568,826)	(4,229,735)
미수금의 감소(증가)	410,934	651,833
장단기선급비용의 감소(증가)	(313,005)	(269,865)
재고자산의 감소(증가)	(2,968,903)	885,829
매입채무의 증가(감소)	1,903,747	3,230,220
장단기미지급금의 증가(감소)	(1,499,235)	(67,580)
선수금의 증가(감소)	(99,472)	(10,238)
예수금의 증가(감소)	(224,466)	(27,301)
미지급비용의 증가(감소)	(2,286,705)	(1,243,732)
장단기충당부채의 증가(감소)	476,276	146,199
퇴직금의 지급	(90,289)	(46,829)
기타	(301,497)	(330,142)
계	(6,561,441)	(1,311,341)

나. 당분기 및 전분기 중 리스부채와 관련하여 발생한 원금 상환에 따른 현금유출액(재무활동)은 34,731백만원 및 29,551백만원, 이자비용 현금유출액(영업활동)은 2,310백만원 및 1,155백만원입니다.

## 25. 재무위험관리:

회사의 재무위험관리는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험, 유동성위험 등을 최소화 하는데 중점을 두고 있습니다. 회사는 이를 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 재무위험관리정책과 프로그램을 운영하고 있습니다. 위험을 회피하기 위한 파생상품의 이용도 이 프로그램에 포함되어 있습니다.

재무위험관리는 재경팀이 주관하고 있으며, 글로벌 재무위험 관리정책을 수립한 후 주기적으로 재무위험 측정, 헷지 및 평가 등을 실행하고 있습니다.

한편, 해외 주요 권역별로 지역 금융센터(미국, 영국, 싱가포르, 중국, 브라질, 러시아)에서 환율변동 모니터링 및 환거래 대행을 통해 환율변동위험을 관리하고 있으며, 권역 내 자금을 통합운용하여 유동성위험을 관리하고 있습니다.

재무위험관리의 주요 대상인 자산은 현금및현금성자산, 단기금융상품, 매출채권 등으로 구성되어 있으며, 부채는 매입채무, 차입금 등으로 구성되어 있습니다.

## 가. 시장위험

### (1) 환율변동위험

회사는 글로벌 영업 활동을 수행함에 따라 기능통화와 다른 통화로 거래를 하고 있어 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 USD, EUR, INR 등이 있습니다.

회사는 환율변동과는 무관하게 통화별 자산과 부채 규모를 일치하는 수준으로 유지하여 환율변동 영향을 최소화하는데 주력하고 있습니다. 이를 위해 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 금융 거래 발생 시 현지 통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치시킴으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있습니다. 또한, 회사는 효율적인 환율변동위험 관리를 위해 환위험을 주기적으로 모니터링 및 평가하고 있으며 투기적 외환거래는 엄격히 금지하고 있습니다.

### (2) 이자율변동위험

변동금리부 금융상품의 이자율변동위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치 변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 회사의 이자율변동위험은 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 회사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운영하고 있습니다.

### (3) 주가변동위험

회사는 전략적 목적 등으로 기타포괄손익-공정가치금융자산으로 분류된 지분상품에 투자하고 있습니다. 이를 위하여 직·간접적 투자수단을 이용하고 있습니다.

당분기말 현재 지분상품(상장주식)의 주가가 1% 변동할 경우 기타포괄손익(법인세효과 반영전)에 미치는 영향은 14,639백만원(전분기: 15,300백만원)입니다.



## 나. 신용위험

신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소를 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정·관리하고 있습니다. 그리고 위험국가에 소재한 거래처의 매출채권은 보험한도 내에서 적절하게 위험 관리되고 있습니다.

신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당 거래는 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등의 금융상품 거래를 포함합니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 회사는 국제 신용등급이 높은 은행(S&P A등급 이상)에 대해서만 거래를 하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 기존에 거래가 없는 금융기관과의 신규 거래는 재정팀과 지역 금융센터의 승인, 관리, 감독하에 이루어지고 있습니다. 회사가 체결하는 금융계약은 부채비율 제한 조항, 담보제공, 차입금 회수 등의 제약조건이 없는 계약을 위주로 체결하고 있으며, 기타의 경우 별도의 승인을 받아 거래하도록 되어 있습니다.

보고기간종료일 현재 회사의 금융자산 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 회사의 신용 위험 최대노출액을 나타내고 있습니다.

#### 다. 유동성위험

대규모 투자가 많은 회사 사업 특성상 적정 유동성의 유지가 매우 중요합니다. 회사는 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금 수준 산정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성을 유지·관리하고 있습니다.

회사는 주기적으로 미래 현금 흐름을 예측하여 유동성위험을 사전 관리하고 있습니다. 권역별로 Cash Pooling을 구축·활용하여 권역 내 자금 부족의 경우에도 내부 자금을 활용하여 유동성위험을 효율적으로 관리하고 있습니다. Cash Pooling은 자금 부족 회사와 자금 잉여 회사 간 자금을 공유하는 체제로 개별회사의 유동성위험을 최소화하는 한편 자금운용부담 경감 및 금융비용 절감 등의 효과가 있어 회사의 사업 경쟁력 강화에 기여하고 있습니다.

또한, 만약의 대규모 유동성 필요에 대비하여 본사의 지급보증을 통해 해외 종속기업이 활용할 수 있는 차입한도를 확보하고 있습니다.

## 라. 자본위험

회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해관계자에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 건전한 자본구조를 유지하는 것입니다. 회사는 신용등급, 부채비율 등의 지표를 이용하여 자본위험을 관리하고 있습니다.

당분기말 현재 회사는 S&P로부터 AA-, Moody's로부터 Aa3 평가등급을 받고 있으며, 보고 기간종료일 현재 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기말	전기말
부 채	61,078,241	57,918,452
자 본	198,275,770	193,193,732
부채비율	30.8%	30.0%

마. 공정가치 측정

(1) 보고기간종료일 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분	당분기말		전기말	
	장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
금융자산:				
현금및현금성자산	9,129,795	(*1)	3,918,872	(*1)
단기금융상품	12,802,352	(*1)	15,000,576	(*1)
매출채권	34,711,648	(*1)	33,088,247	(*1)
기타포괄손익-공정가치금융자산	1,588,288	1,588,288	1,662,532	1,662,532
당기손익-공정가치금융자산	1,876	1,876	2,135	2,135
기타	5,582,888	(*1)	5,076,418	(*1)
계	63,816,847		58,748,780	
금융부채:				
매입채무	13,406,261	(*1)	11,557,441	(*1)
단기차입금	10,237,826	(*1)	9,204,268	(*1)
미지급금	15,294,921	(*1)	12,948,960	(*1)
유동성장기부채	138,751	6,417	139,328	6,276
- 유동성장기차입금	132,810	(*2)	133,518	(*2)
- 유동성사채	5,941	6,417	5,810	6,276
사채	29,710	35,810	29,048	35,863
장기차입금	419,079	(*2)	431,915	(*2)
장기미지급금	1,883,559	(*1)	2,335,218	(*1)
기타	3,399,266	(*1)	3,056,156	(*1)
계	44,809,373		39,702,334	

(\*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

(\*2) 리스부채는 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시'에 따라 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

(2) 보고기간종료일 현재 공정가치로 측정 및 공시되는 금융상품의 공정가치 서열체계에 따른 수준별 공시는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기말			
	수준 1	수준 2	수준 3	계
금융자산:				
기타포괄손익-공정가치금융자산	1,463,914	-	124,374	1,588,288
당기손익-공정가치금융자산	-	-	1,876	1,876
금융부채:				
유동성사채	-	6,417	-	6,417
사채	-	35,810	-	35,810

(단위 : 백만원)

구 분	전기말			
	수준 1	수준 2	수준 3	계
금융자산:				
기타포괄손익-공정가치금융자산	1,544,320	-	118,212	1,662,532
당기손익-공정가치금융자산	-	-	2,135	2,135
금융부채:				
유동성사채	-	6,276	-	6,276
사채	-	35,863	-	35,863

공정가치 측정의 투입변수 특징에 따른 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다.

- '수준 1': 동일한 자산이나 부채에 대한 시장 공시가격
- '수준 2': 시장에서 관측가능한 투입변수를 활용한 공정가치  
(단, '수준 1'에 포함된 공시가격은 제외)
- '수준 3': 관측가능하지 않은 투입변수를 활용한 공정가치

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주하며, 이러한 상품은 '수준 1'에 포함됩니다. '수준 1'에 포함된 상품은 대부분 기타포괄손익-공정가치금융자산으로 분류된 상장주식으로 구성됩니다.

활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업고유정보는 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 '수준 2'에 포함됩니다.

만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 '수준 3'에 포함됩니다.

회사는 '수준 3'으로 분류되는 공정가치 측정을 포함하여 재무보고 목적의 공정가치를 측정하고 있습니다. 재무보고 일정에 맞추어 공정가치 평가과정 및 그 결과에 대해 협의하고 있고, 공정가치 '수준' 간 이동을 발생시키는 사건이나 상황의 변동이 일어난 보고기간종료일에 '수준' 변동을 인식하고 있습니다.

금융상품의 공정가치를 측정하는 데 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.

- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격
- 파생상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당 금액을 현재가치로 할인하여 측정

나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법을 사용합니다. 유동자산으로 분류된 매출채권 및 기타채권의 경우 장부금액을 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하고 있습니다.

### (3) 가치평가기법 및 투입변수

회사는 공정가치 서열체계에서 '수준 2'로 분류되는 회사채, 국공채, 금융채 등에 대하여 미래현금흐름을 적정이자율로 할인하는 현재가치법을 사용하고 있습니다.

당분기말 현재 '수준 3'으로 분류된 주요 금융상품에 대하여 사용된 가치평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	공정가치	가치평가기법	'수준 3' 투입변수	투입변수 범위(가중평균)
기타포괄손익-공정가치금융자산:				
삼성벤처투자주	27,331	현금흐름할인법	영구성장률	-1.0%~1.0%(0.0%)
			가중평균자본비용	19.3%~21.3%(20.3%)
㈜미코세라믹스	25,666	현금흐름할인법 등	영구성장률	-1.0%~1.0%(0.0%)
			가중평균자본비용	13.2%~15.2%(14.2%)

### (4) '수준 3'에 해당하는 금융상품의 변동내역

(단위 : 백만원)

금융자산	당분기	전분기
기초	120,347	130,242
매입	-	-
매도	(150)	(90)
평가(기타포괄손익)	6,163	(22)
기타	(110)	(14)
분기말	126,250	130,116

(5) '수준 3'으로 분류된 반복적인 공정가치 측정치의 민감도분석

금융상품의 민감도분석은 통계적 기법을 이용한 관측 불가능한 투입변수의 변동에 따른 금융상품의 가치 변동에 기초하여 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어집니다. 그리고 공정가치가 두 개 이상의 투입변수에 영향을 받는 경우에는 가장 유리하거나 또는 가장 불리한 금액을 바탕으로 산출됩니다.

민감도분석 대상인 '수준 3'으로 분류되는 주요 금융상품의 투입변수의 변동에 따른 손익효과(자본은 법인세효과 반영 전)에 대한 민감도분석 결과는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	유리한 변동		불리한 변동	
	당기손익	자본	당기손익	자본
기타포괄손익-공정가치금융자산(*)	-	1,773	-	(1,397)

(\*) 지분상품은 주요 관측불가능한 투입변수인 성장률(-1.0%~1.0%)과 할인율 사이의 상관관계를 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다.



## 26. 부문별 보고:

회사는 전략적 의사결정을 수립하는 경영진(경영위원회)에게 보고되는 사업 단위를 기준으로 보고부문을 결정하고 있습니다. 경영위원회는 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 부문의 영업이익을 기준으로 검토하고 있습니다.

매출은 대부분 재화의 매출로 구성되어 있습니다. 회사의 보고부문은 조직 및 수익을 창출하는 제품의 유형을 기준으로 식별되었으며, 보고기간종료일 현재 보고부문은 DX 부문, DS 부문 등으로 구성되어 있습니다.

보고부문별 자산과 부채는 경영위원회에 정기적으로 제공되지 않아 포함하지 않았습니다.

### (1) 당분기

(단위 : 백만원)

구 분	DX 부문	DS 부문	계(★)
매출액	31,116,363	26,376,300	56,724,258
감가상각비	136,120	5,749,389	5,927,470
무형자산상각비	382,201	193,802	628,517
영업이익	1,195,200	7,952,821	9,151,831

(★) 기타는 별도로 표시하지 않았습니다.

### (2) 전분기

(단위 : 백만원)

구 분	DX 부문	DS 부문	계(★)
매출액	26,641,063	19,021,916	45,042,390
감가상각비	134,196	4,371,027	4,546,844
무형자산상각비	278,376	246,843	553,854
영업이익	2,094,631	2,345,721	4,445,476

(★) 기타는 별도로 표시하지 않았습니다.

27. 특수관계자와의 거래:

가. 당분기말 현재 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
미주	Samsung Electronics America, Inc. (SEA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung International, Inc. (SII)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Mexicana S.A. de C.V (SAMEX)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Home Appliances America, LLC (SEHA)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Research America, Inc (SRA)	R&D	100.0
	Samsung Next LLC (SNX)	해외자회사 관리	100.0
	Samsung Next Fund LLC (SNXF)	신기술사업자, 벤처기업 투자	100.0
	NeuroLogica Corp.	의료기기 생산 및 판매	100.0
	Samsung HVAC America, LLC	에어컨공조 판매	100.0
	Joyent, Inc.	클라우드서비스	100.0
	Dacor Holdings, Inc.	해외자회사 관리	100.0
	Dacor, Inc.	가전제품 생산 및 판매	100.0
	Dacor Canada Co.	가전제품 판매	100.0
	SmartThings, Inc.	스마트홈 플랫폼	100.0
	TeleWorld Solutions, Inc. (TWS)	네트워크장비 설치 및 최적화	100.0
	Samsung Semiconductor, Inc. (SSI)	반도체 · DP 판매	100.0
	Samsung Austin Semiconductor LLC (SAS)	반도체 생산	100.0
	Samsung Oak Holdings, Inc. (SHI)	해외자회사 관리	100.0
	SEMES America, Inc.	반도체 장비 서비스	100.0

(\*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
미주	Samsung Electronics Canada, Inc. (SECA)	전자제품 판매	100.0
	AdGear Technologies Inc.	디지털광고 플랫폼	100.0
	Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics Mexico S.A. de C.V. (SEM)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Digital Appliance Mexico, S.A. de C.V. (SEDAM)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Latinoamerica(Zona Libre), S. A. (SELA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Latinoamerica Miami, Inc. (SEMI)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronica Colombia S.A. (SAMCOL)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Argentina S.A. (SEASA)	마케팅 및 서비스	100.0
	Samsung Electronics Chile Limitada (SECH)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Peru S.A.C. (SEPR)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Venezuela, C.A. (SEVEN)	마케팅 및 서비스	100.0
	Samsung Electronics Panama. S.A. (SEPA)	컨설팅	100.0
	Harman International Industries, Inc.	해외자회사 관리	100.0
	Harman Becker Automotive Systems, Inc.	오디오제품 생산, 판매, R&D	100.0
	Harman Connected Services, Inc.	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services Engineering Corp.	Connected Service Provider	100.0
	Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	오디오제품 생산, 판매	100.0
	Harman de Mexico, S. de R.L. de C.V.	오디오제품 생산	100.0
	Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman Financial Group LLC	Management Company	100.0
	Harman International Industries Canada Ltd.	오디오제품 판매	100.0
	Harman International Mexico, S. de R.L. de C.V.	오디오제품 판매	100.0
	Harman KG Holding, LLC	해외자회사 관리	100.0
	Harman Professional, Inc.	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Beijing Integrated Circuit Industry International Fund, L.P	벤처기업 투자	61.4
	China Materialia New Materials 2016 Limited Partnership	벤처기업 투자	99.0

(\*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
유럽 · CIS	Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Ltd. (SEL)	해외자회사 관리	100.0
	Samsung Semiconductor Europe Limited (SSEL)	반도체 · DP 판매	100.0
	Samsung Electronics GmbH (SEG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Holding GmbH (SEHG)	해외자회사 관리	100.0
	Samsung Semiconductor Europe GmbH (SSEG)	반도체 · DP 판매	100.0
	Samsung Electronics France S.A.S (SEF)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Italia S.P.A. (SEI)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Iberia, S.A. (SESA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Portuguesa, Unipessoal, Lda. (SEP)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Hungarian Private Co., Ltd. (SEH)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS)	물류	100.0
	Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH)	해외자회사 관리	100.0
	Samsung Electronics Nordic Aktiebolag (SENA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Slovakia s.r.o. (SESK)	TV · 모니터 생산	100.0
	Samsung Display Slovakia s.r.o. (SDSK)	DP 임가공	100.0
	Samsung Electronics Polska, SP.Zo.o (SEPOL)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Poland Manufacturing SP.Zo.o (SEPM)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Romania LLC (SEROM)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Austria GmbH (SEAG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Switzerland GmbH (SESG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Czech and Slovak s.r.o. (SECZ)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Baltics SIA (SEB)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Greece S.M.S.A (SEGR)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. (SEACE)	에어컨공조 판매	100.0
	Samsung Nanoradio Design Center (SNDC)	R&D	100.0
	Samsung Denmark Research Center ApS (SDRC)	R&D	100.0
	Samsung Cambridge Solution Centre Limited (SCSC)	R&D	100.0
	Zhilabs, S.L.	네트워크Solution 개발, 판매	100.0
	Foodient Ltd.	R&D	100.0
	Samsung Electronics Rus Company LLC (SERC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Rus Kaluga LLC (SERK)	TV 생산	100.0
	Samsung Electronics Ukraine Company LLC (SEUC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung R&D Institute Ukraine (SRUKR)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Central Eurasia LLP (SECE)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Overseas B.V. (SEO)	전자제품 판매	100.0
	Samsung R&D Institute Rus LLC (SRR)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Caucasus Co., Ltd (SECC)	마케팅	100.0

(\*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
유럽 · CIS	AKG Acoustics GmbH	오디오제품 생산, 판매	100.0
	AMX UK Limited	오디오제품 판매	100.0
	Apostera GmbH	Connected Service Provider	100.0
	Apostera UA, LLC	Connected Service Provider	100.0
	Harman Audio Iberia Espana Sociedad Limitada	오디오제품 판매	100.0
	Harman Automotive UK Limited	오디오제품 생산	100.0
	Harman Becker Automotive Systems GmbH	오디오제품 생산, 판매, R&D	100.0
	Harman Becker Automotive Systems Italy S.R.L.	오디오제품 판매	100.0
	Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	오디오제품 생산, R&D	100.0
	Harman Belgium SA	오디오제품 판매	100.0
	Harman Connected Services AB.	Connected Service Provider	100.0
	Harman Finland Oy	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services GmbH	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services Poland Sp.Zo.o	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services UK Ltd.	Connected Service Provider	100.0
	Harman Consumer Nederland B.V.	오디오제품 판매	100.0
	Harman Deutschland GmbH	오디오제품 판매	100.0
	Harman Finance International GP S.a.r.l	해외자회사 관리	100.0
	Harman France SNC	오디오제품 판매	100.0
	Harman Holding GmbH & Co. KG	Management Company	100.0
	Harman Hungary Financing Ltd.	Financing Company	100.0
	Harman Inc. & Co. KG	해외자회사 관리	100.0
	Harman International Estonia OU	R&D	100.0
	Harman International Industries Limited	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman International Romania SRL	R&D	100.0
	Harman Finance International, SCA	Financing Company	100.0
	Harman International s.r.o	오디오제품 생산	100.0
	Harman Management GmbH	해외자회사 관리	100.0
	Harman Professional Kft	오디오제품 생산, R&D	100.0
	Harman Professional Denmark ApS	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Red Bend Software Ltd.	소프트웨어 디자인	100.0
	Red Bend Software S.A.S	소프트웨어 디자인	100.0
	Studer Professional Audio GmbH	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman Connected Services OOO	Connected Service Provider	100.0
	Harman RUS CIS LLC	오디오제품 판매	100.0

(\*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
중동 · 아프리카	Samsung Gulf Electronics Co., Ltd. (SGE)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Turkey (SETK)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Industry and Commerce Ltd. (SETK-P)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Levant Co.,Ltd. (SELV)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Maghreb Arab (SEMAG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Egypt S.A.E (SEEG)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics Israel Ltd. (SEIL)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Tunisia S.A.R.L (SETN)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Pakistan(Private) Ltd. (SEPAK)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Saudi Arabia Ltd. (SESAR)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Semiconductor Israel R&D Center, Ltd. (SIRC)	R&D	100.0
	Corephotronics Ltd.	R&D	100.0
	Samsung Electronics South Africa(Pty) Ltd. (SSA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics South Africa Production (pty) Ltd. (SSAP)	TV · 모니터 생산	100.0
	Samsung Electronics West Africa Ltd. (SEWA)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics East Africa Ltd. (SEEA)	마케팅	100.0
	Global Symphony Technology Group Private Ltd.	해외자회사 관리	100.0
	Harman Connected Services Morocco	Connected Service Provider	100.0
	Harman Industries Holdings Mauritius Ltd.	해외자회사 관리	100.0
	Red Bend Ltd.	오디오제품 생산	100.0

(\*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
아시아 (중국 제외)	Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL)	해외자회사 관리	100.0
	Samsung Electronics Singapore Pte. Ltd. (SESP)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Malaysia Electronics (SME) Sdn. Bhd. (SME)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Display (M) Sdn. Bhd. (SDMA)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics (M) Sdn. Bhd. (SEMA)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Vina Electronics Co., Ltd. (SAVINA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT)	통신제품 생산	100.0
	Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV)	DP 생산	100.0
	PT Samsung Electronics Indonesia (SEIN)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	PT Samsung Telecommunications Indonesia (STIN)	전자제품 판매 및 서비스	100.0
	Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE)	전자제품 생산 및 판매	91.8
	Laos Samsung Electronics Sole Co., Ltd. (LSE)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Philippines Corporation (SEPCO)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Australia Pty. Ltd. (SEAU)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics New Zealand Limited (SENZ)	전자제품 판매	100.0
	Samsung India Electronics Private Ltd. (SIEL)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Display Noida Private Limited (SDN)	DP 생산	100.0
	Samsung R&D Institute India-Bangalore Private Limited (SRI-Bangalore)	R&D	100.0
	Samsung R&D Institute BanglaDesh Limited (SRBD)	R&D	100.0
	Samsung Nepal Services Pvt. Ltd. (SNSL)	서비스	100.0
	Samsung Japan Corporation (SJC)	반도체 · DP 판매	100.0
	Samsung R&D Institute Japan Co., Ltd. (SRJ)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Japan Co., Ltd. (SEJ)	전자제품 판매	100.0
	Harman Connected Services Corp. India Pvt. Ltd.	Connected Service Provider	100.0
	Harman International (India) Private Limited	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman International Industries PTY Ltd.	해외자회사 관리	100.0
	Harman International Japan Co., Ltd.	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman Singapore Pte. Ltd.	오디오제품 판매	100.0

(\*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
중국	Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Hong Kong Co., Ltd. (SEHK)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd. (SET)	전자제품 판매	100.0
	Tianjin Samsung Electronics Co., Ltd. (TSEC)	TV · 모니터 생산	91.2
	Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd. (SSEC)	가전제품 생산	88.3
	Samsung Suzhou Electronics Export Co., Ltd. (SSEC-E)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd. (SESC)	전자제품 생산, R&D	100.0
	Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (TSTC)	통신제품 생산	90.0
	Beijing Samsung Telecom R&D Center (SRC-Beijing)	R&D	100.0
	Samsung Electronics China R&D Center (SRC-Nanjing)	R&D	100.0
	Samsung Mobile R&D Center China-Guangzhou (SRC-Guangzhou)	R&D	100.0
	Samsung R&D Institute China-Shenzhen (SRC-Shenzhen)	R&D	100.0
	Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS)	반도체 · DP 판매	100.0
	Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS)	반도체 생산	100.0
	Samsung SemiConductor Xian Co., Ltd. (SSCX)	반도체 · DP 판매	100.0
	Samsung Electronics Suzhou Semiconductor Co., Ltd. (SESS)	반도체 임가공	100.0
	Tianjin Samsung LED Co., Ltd. (TSLED)	LED 생산	100.0
	Samsung Semiconductor (China) R&D Co., Ltd. (SSCR)	R&D	100.0
	Samsung Display Dongguan Co., Ltd. (SDD)	DP 생산	100.0
	Samsung Display Tianjin Co., Ltd. (SDT)	DP 생산	95.0
	SEMES (XIAN) Co., Ltd.	반도체 장비 서비스	100.0
	Samsung Semiconductor Investment L.P. I	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	Harman (China) Technologies Co., Ltd.	오디오제품 생산	100.0
	Harman (Suzhou) Audio and Infotainment Systems Co., Ltd.	오디오제품 판매	100.0
	Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd.	오디오제품 생산, R&D	100.0
	Harman Commercial (Shanghai) Co., Ltd.	오디오제품 판매	100.0
	Harman Connected Services Solutions (Chengdu) Co., Ltd.	Connected Service Provider	100.0
	Harman Holding Limited	오디오제품 판매	100.0
	Harman International (China) Holdings Co., Ltd.	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman Technology (Shenzhen) Co., Ltd.	오디오제품 판매, R&D	100.0

(\*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.



지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
국내	삼성디스플레이(주)	DP 생산 및 판매	84.8
	에스유머티리얼스(주)	DP 부품 생산	50.0
	스테코(주)	반도체 부품 생산	70.0
	세메스(주)	반도체 · FPD 장비 생산, 판매	91.5
	삼성전자서비스(주)	전자제품 수리 서비스	99.3
	삼성전자서비스씨에스(주)	고객상담서비스	100.0
	삼성전자판매(주)	전자제품 판매	100.0
	삼성전자로지텍(주)	종합물류대행	100.0
	삼성메디슨(주)	의료기기 생산 및 판매	68.5
	(주)미래로시스템	반도체 소프트웨어 개발 및 공급	99.9
	(주)도우인시스	DP 부품 생산	69.0
	지에프(주)	DP 부품 생산	100.0
	(주)하만인터내셔널코리아	소프트웨어 개발 및 공급	100.0
	SVIC 21호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 22호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 26호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 28호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 29호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 32호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 33호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 37호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 40호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 42호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 43호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 45호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 48호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 52호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 55호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 56호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	반도체성장 전문투자형 사모 투자신탁	반도체산업 투자	66.7
	시스템반도체 상생 전문투자형 사모 투자신탁	반도체산업 투자	62.5

(\*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

나. 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 매출·매입 등 거래 내역은 다음과 같습니다.

(1) 당분기

(단위 : 백만원)

구분	기업명(*1)	매출 등	비유동자산 처 분	매입 등	비유동자산 매 입
종속기업	삼성디스플레이(주)	68,306	-	218,362	-
	Samsung Electronics America, Inc. (SEA)	8,790,030	-	47,925	-
	Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT)	1,928,760	-	7,439,252	12
	Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS)	65,823	1,970	2,415,594	1,326
	Harman과 그 종속기업(*2)	-	-	20,459	-
	Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL)	8	-	7,589	-
	Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV)	1,013,161	-	3,998,238	-
	Samsung Semiconductor, Inc. (SSI)	10,414,888	-	116,713	-
	Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH)	-	-	-	-
	Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)	526,535	-	1,917	-
	Samsung India Electronics Private Ltd. (SIEL)	1,548,535	-	1,413,072	-
	Samsung Austin Semiconductor LLC. (SAS)	7	-	788,621	1,430
	Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS)	5,111,265	-	47	-
	Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV)	404,843	-	-	-
	Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA)	321,289	-	8,070	-
	Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC)	198,892	2,774	1,553,285	355
	Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK)	403,602	-	23,931	-
	Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE)	510,329	-	757,380	-
	Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS)	1,268,572	-	317	-
	Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd. (SEH)	139,262	-	644	-
	Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN)	187,508	-	651	-
	Samsung International, Inc. (SII)	96,852	211	2,239,227	-
	Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd. (SET)	1,455,427	-	290	-
	Samsung Electronics GmbH (SEG)	969,533	-	2,015	-
	Samsung Display Dongguan Co., Ltd. (SDD)	82,045	-	-	-
	기타	13,756,062	1,296	3,935,276	1,621
	종속기업 계	49,261,534	6,251	24,988,875	4,744

(\*1) 회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.

(\*2) Harman International Industries, Inc. 및 그 종속기업이 포함된 중간지배기업과의 거래 금액입니다.

(단위 : 백만원)

구분	기업명(*1)	매출 등	비유동자산 처분	매입 등	비유동자산 매입
관계기업 및 공동기업	삼성에스디에스㈜	69,649	-	390,598	90,780
	삼성전기㈜	43,051	-	263,361	-
	삼성SDI㈜	24,265	-	98,263	546
	㈜제일기획	29,336	-	213,423	-
	기타	114,486	-	176,608	-
	관계기업 및 공동기업 계	280,787	-	1,142,253	91,326
그 밖의 특수관계자	삼성물산㈜	10,250	-	14,653	1,045,938
	기타	103,636	-	162,697	11,123
	그 밖의 특수관계자 계	113,886	-	177,350	1,057,061
기타(*2)	삼성엔지니어링㈜	90	-	624	243,864
	㈜에스원	1,274	-	102,865	5,668
	기타	40,280	-	37,565	23,034
	기타 계	41,644	-	141,054	272,566

(\*1) 회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.

(\*2) 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

## (2) 전분기

(단위 : 백만원)

구분	기업명(*1)	매출 등	비유동자산 처 분	매입 등	비유동자산 매 입
종속기업	삼성디스플레이(주)	42,535	-	176,595	-
	Samsung Electronics America, Inc. (SEA)	7,065,554	-	38,696	-
	Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT)	1,426,615	182	5,256,804	68
	Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)	477,733	-	1,940	-
	Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS)	29,489	96,756	1,485,543	1,530
	Harman과 그 종속기업(*2)	-	-	13,208	-
	Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV)	948,627	202	3,628,169	264
	Samsung Semiconductor, Inc. (SSI)	5,343,196	-	101,874	-
	Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS)	4,963,669	-	370	-
	Samsung Austin Semiconductor LLC. (SAS)	5	1,183	922,961	-
	Samsung India Electronics Private Ltd. (SIEL)	1,115,060	2,543	1,042,385	-
	Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA)	248,504	13	3,155	-
	Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV)	238,010	-	-	-
	Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK)	392,934	-	24,107	-
	Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE)	409,497	-	546,893	-
	Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC)	199,542	2,006	1,444,339	-
	Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS)	981,086	-	2,191	-
	Samsung Electronics GmbH (SEG)	935,301	-	2,221	-
	Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd. (SEH)	178,266	-	95	-
	세메스(주)	1,052	-	628,192	-
	Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN)	135,745	-	664	-
	Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd. (SET)	1,088,959	-	131	-
	Samsung Display Dongguan Co., Ltd. (SDD)	67,376	-	-	-
	Samsung Electronics Hong Kong Co., Ltd. (SEHK)	168,678	-	768	-
	기타	13,183,761	4	3,990,791	3,785
	종속기업 계	39,641,194	102,889	19,312,092	5,647

(\*1) 회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.

(\*2) Harman International Industries, Inc. 및 그 종속기업이 포함된 중간지배기업과의 거래 금액입니다.

(단위 : 백만원)

구분	기업명(*1)	매출 등	비유동자산 처분	매입 등	비유동자산 매입
관계기업 및 공동기업	삼성에스디에스㈜	69,831	-	357,058	80,187
	삼성전기㈜	28,989	-	251,268	-
	삼성SDI㈜	23,054	154	75,166	7,247
	㈜제일기획	24,967	-	152,175	-
	기타	109,766	68	100,797	2,624
	관계기업 및 공동기업 계	256,607	222	936,464	90,058
그 밖의 특수관계자	삼성물산㈜	25,373	-	10,244	899,106
	기타	91,883	-	150,241	14,967
	그 밖의 특수관계자 계	117,256	-	160,485	914,073
기타(*2)	삼성엔지니어링㈜	29	-	3,152	75,584
	㈜에스원	588	-	97,152	5,513
	기타	26,530	-	27,819	1,879
	기타 계	27,147	-	128,123	82,976

(\*1) 회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.

(\*2) 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

다. 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권·채무 등 잔액은 다음과 같습니다.

(1) 당분기말

(단위 : 백만원)

구분	기업명(*1)	채권 등(*2)	채무 등(*3)
종속기업	삼성디스플레이(주)	11,418	106,693
	Samsung Electronics America, Inc. (SEA)	4,420,016	185,941
	Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT)	980,041	4,795,160
	Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS)	65,056	880,273
	Harman과 그 종속기업(*4)	-	11,437
	Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL)	1,118	2,115
	Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV)	638,751	2,455,110
	Samsung Semiconductor, Inc. (SSI)	7,462,298	177,725
	Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH)	-	-
	Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)	233,647	961
	Samsung India Electronics Private Ltd. (SIEL)	1,518,787	619,958
	Samsung Austin Semiconductor LLC. (SAS)	1,422	327,866
	Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS)	3,851,319	42
	Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV)	132,896	-
	Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA)	271,859	5,298
	Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC)	147,810	565,868
	Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK)	341,027	30,783
	Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE)	243,780	267,175
	Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS)	570,808	277
	Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd. (SEH)	54,968	2,088
	Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN)	84,314	7,043
	Samsung International, Inc. (SII)	68,614	462,905
	Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd. (SET)	559,094	33,676
	Samsung Electronics GmbH (SEG)	324,931	2,482
	Samsung Display Dongguan Co., Ltd. (SDD)	34,367	-
	기타	9,307,770	2,390,212
	종속기업 계	31,326,111	13,331,088

(\*1) 회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다.

(\*2) 종속기업 채권에 대하여 인식된 손실충당금은 없습니다.

(\*3) 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.

(\*4) Harman International Industries, Inc. 및 그 종속기업이 포함된 중간지배기업과의 거래 금액입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	기업명(*1)	채권 등	채무 등(*2)
관계기업 및 공동기업	삼성에스디에스(주)	66,355	483,692
	삼성전기(주)	38,708	109,974
	삼성SDI(주)	127,385	38,841
	(주)제일기획	28,761	367,506
	기타	132,648	148,205
	관계기업 및 공동기업 계	393,857	1,148,218
그 밖의 특수관계자	삼성물산(주)	193,237	569,204
	기타	52,137	121,409
	그 밖의 특수관계자 계	245,374	690,613
기타(*3)	삼성엔지니어링(주)	78	256,255
	(주)에스원	1,314	26,931
	기타	2,496	62,421
	기타 계	3,888	345,607

(\*1) 회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다.

(\*2) 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.

(\*3) 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른

동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

(2) 전기말

(단위 : 백만원)

구분	기업명(*1)	채권 등(*2)	채무 등(*3)
종속기업	삼성디스플레이(주)	23,791	119,401
	Samsung Electronics America, Inc. (SEA)	4,708,011	143,310
	Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS)	59,110	726,945
	Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT)	734,283	4,049,400
	Harman과 그 종속기업(*4)	-	7,541
	Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV)	414,781	2,301,949
	Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)	138,307	77,540
	Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH)	316	-
	Samsung Semiconductor, Inc. (SSI)	7,320,890	123,555
	Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL)	1,736	2,164
	Samsung Austin Semiconductor LLC (SAS)	4,645	277,682
	Samsung India Electronics Private Ltd. (SIEL)	1,099,927	463,652
	Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS)	4,337,520	217
	Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV)	161,441	-
	Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA)	258,490	1,040
	Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK)	201,717	19,595
	Samsung International, Inc. (SII)	32,564	259,847
	Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE)	132,508	334,943
	Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC)	167,225	430,960
	Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd. (SET)	372,716	32,145
	Samsung Electronics Hungarian Private Co., Ltd. (SEH)	58,694	99
	Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS)	629,882	1,715
	Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN)	45,171	3,351
	Samsung Electronics GmbH (SEG)	223,603	2,272
	Samsung Display Dongguan Co., Ltd. (SDD)	18,025	-
	기타	9,220,424	2,284,643
	계	30,365,777	11,663,966

(\*1) 회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다.

(\*2) 종속기업 채권에 대하여 인식된 손실충당금은 없습니다.

(\*3) 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.

(\*4) Harman International Industries, Inc. 및 그 종속기업이 포함된 중간지배기업과의 거래 금액입니다.



(단위 : 백만원)

구 분	기업명(*1)	채권 등	채무 등(*2)
관계기업 및 공동기업	삼성에스디에스(주)	64,364	574,443
	삼성전기(주)	2,415	108,103
	삼성SDI(주)	113,845	54,076
	(주)제일기획	59	421,901
	기타	192,550	166,311
	관계기업 및 공동기업 계	373,233	1,324,834
그 밖의 특수관계자	삼성물산(주)	195,355	1,640,615
	기타	15,839	125,470
	그 밖의 특수관계자 계	211,194	1,766,085
기타(*3)	삼성엔지니어링(주)	289	1,099,881
	(주)에스원	2,058	29,620
	기타	4,286	56,476
	기타 계	6,633	1,185,977

(\*1) 회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다.

(\*2) 채무 등은 리스부채가 포함된 금액입니다.

(\*3) 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른

동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

라. 회사는 당분기 및 전분기 중 종속기업에 45,495백만원 및 1,992백만원을 출자하였으며, 당분기 및 전분기 중 종속기업으로부터 출자원금 74,448백만원 및 31,766백만원을 회수하였습니다. 또한, 당분기 및 전분기 중 관계기업 및 공동기업에 출자 및 회수한 출자원금 내역은 없습니다. 한편, 회사는 2022년 4월 중 관계기업인 삼성바이오로직스(주)의 유상증자에 참여하여 보통주 신주 1,380,477주(주당 발행가액 : 639,000원)를 추가 취득하였습니다.

마. 회사가 당분기 및 전분기 중 특수관계자에게 지급 결의한 배당금은 421,609백만원 및 2,261,462백만원입니다. 당분기말 현재 배당과 관련한 미지급금은 421,609백만원입니다. 또한, 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나

「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사에게 당분기 및 전분기 중 지급 결의한 배당금은 32,058백만원 및 171,566백만원입니다. 당분기말 현재 배당과 관련한 미지급금은 32,058백만원입니다.

바. 회사가 당분기 및 전분기 중 특수관계자와 체결한 리스 이용 계약은 20백만원 및 63,887백만원이며, 특수관계자에게 지급한 리스료는 11,817백만원 및 14,417백만원입니다.

사. 회사는 보고기간종료일 현재 특수관계자의 채무에 대하여 채무보증을 제공하고 있습니다(주석 13 참조).

아. 회사가 당분기 및 전분기 중 주요 경영진(등기임원)에 대한 보상을 위해 비용으로 반영한 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기	전분기
단기급여	3,415	2,868
퇴직급여	127	222
기타 장기급여	2,072	1,625

28. 보고기간 후 사건:

회사는 2022년 4월 중 관계기업인 삼성바이오로직스(주)의 유상증자에 참여하여 보통주 신주 1,380,477주(주당 발행가액 : 639,000원)를 추가 취득하였습니다.

## 6. 배당에 관한 사항

당사는 제품 및 사업 경쟁력 강화와 함께 주주환원을 통하여 주주가치를 제고할 수 있도록 지속적으로 노력하고 있습니다. 당사는 2018~2020년의 주주환원 정책에 따라 3년간 잉여 현금흐름(Free Cash Flow)의 50%를 주주환원 재원으로 활용하여, 매년 연간 총 9.6조원 수준의 정규 배당을 실시하고 잔여 재원 10.7조원을 특별 배당금 성격으로 2020년 기말 정규 배당에 더해 지급하였습니다. 또한, 당사는 2021~2023년의 주주환원 정책을 2021년 1월에 발표하였습니다. 이에 따라 향후 3년의 사업연도에도 잉여현금흐름의 50%를 재원으로 활용하되 정규 배당을 연간 총 9.8조원 수준으로 확대하고 잔여 재원이 발생하는 경우에는 추가로 환원할 계획입니다.

[주요 배당지표]

(단위 : 원, 백만원, %, 주)

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기
		제54기 1분기	제53기	제52기
주당액면가액(원)		100	100	100
(연결)당기순이익(백만원)		11,129,094	39,243,791	26,090,846
(별도)당기순이익(백만원)		7,651,943	30,970,954	15,615,018
(연결)주당순이익(원)		1,638	5,777	3,841
현금배당금총액(백만원)		2,452,154	9,809,438	20,338,075
주식배당금총액(백만원)		-	-	-
(연결)현금배당성향(%)		22.0	25.0	78.0
현금배당수익률(%)	보통주	0.5	1.8	4.0
	우선주	0.6	2.0	4.2
주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-
	우선주	-	-	-
주당 현금배당금(원)	보통주	361	1,444	2,994
	우선주	361	1,445	2,995
주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-
	우선주	-	-	-

※ (연결)당기순이익은 연결당기순이익의 지배기업 소유주지분 귀속분입니다.

※ (연결)주당순이익은 보통주 기본주당이익입니다. 기본주당이익 산출근거는 'III. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주식' 중 '주당이익' 항목을 참조하시기 바랍니다.

※ 현금배당금총액의 자세한 내용은 'III. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주식' 중 '연결이익잉여금' 항목을 참조하시기 바랍니다. 분기 배당금은 제 54기 1분기 2,452,154백만원(주당 361원)이며,

제53기 1분기 2,452,154백만원(주당 361원), 2분기 2,452,154백만원(주당 361원), 3분기 2,452,154백만원(주당 361원)이며,

제52기 1분기 2,404,605백만원(주당 354원), 2분기 2,404,605백만원(주당 354원), 3분기 2,404,605백만원(주당 354원)입니다.

[배당 이력]

(단위: 회, %)

연속 배당횟수		평균 배당수익률	
분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간
34	41	2.8	2.7

- ※ 연속 배당횟수는 당기 분기배당 및 최근사업연도 결산배당을 포함하고 있습니다.
- ※ 중간배당은 1999년(제31기)부터 연속 배당 시작하였고, 분기배당은 2017년(제49기)부터 연속 배당중이며, 결산배당은 1981년(제13기)부터 연속 배당 중입니다.
- ※ 평균 배당수익률은 보통주 배당수익률입니다. 우선주에 대한 최근 3년간 평균 배당수익률은 3.1%, 최근 5년간 평균 배당수익률은 3.2%입니다.
- ※ 최근 3년간은 2019년(제51기)부터 2021년(제53기)까지 기간이며, 최근 5년간은 2017년(제49기)부터 2021년(제53기)까지 기간입니다. 2022년(제54기) 1분기 배당수익률은 상기 '주요 배당지표'를 참고하시기 바랍니다.(보통주 0.5%, 우선주 0.6%).

## 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항

### 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

당사는 공시대상기간 중 지분증권의 발행 실적이 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 03월 31일 )

(단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급 (평가기관)	만기일	상환 여부	주관회사
삼성전자㈜	회사채	공모	1997.10.02	121,080	7.7%	Aa3 (Moody's), AA- (S&P)	2027.10.01	일부상환	Goldman Sachs 등
Harman International Industries, Inc	회사채	공모	2015.05.11	484,320	4.2%	Baa1 (Moody's), A- (S&P)	2025.05.15	미상환	J.P. Morgan 등
Harman Finance International SCA (*1)	회사채	공모	2015.05.27	469,732	2.0%	Baa1 (Moody's), A- (S&P)	2022.05.27	상환	HSBC 등
㈜도우인시스	회사채	사모	2020.02.28	23,000	0.5%	-	2025.02.28	미상환	-
합 계	-	-	-	1,098,132	-	-	-	-	-

(\*1) 해당 사채는 2022년 3월 1일 전액 조기상환되었습니다.

## 나. 기업어음증권 미상환 잔액

해당사항 없습니다.

(기준일 : 2022년 03월 31일 )

(단위 : 백만원)

잔여만기		10일 이하	10일초과 30일이하	30일초과 90일이하	90일초과 180일이하	180일초과 1년이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년 초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 다. 전자단기사채 미상환 잔액

해당사항 없습니다.

(기준일 : 2022년 03월 31일 )

(단위 : 백만원)

잔여만기		10일 이하	10일초과 30일이하	30일초과 90일이하	90일초과 180일이하	180일초과 1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 라. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 )

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모	6,054	6,054	6,054	490,374	6,054	6,054	-	520,644
	사모	-	-	23,000	-	-	-	-	23,000
	합계	6,054	6,054	29,054	490,374	6,054	6,054	-	543,644

※ (주)도우인시스의 사모 회사채는 연결 내 내부거래 상계대상입니다.

### - 삼성전자(주)

(기준일 : 2022년 3월 31일 )

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모	6,054	6,054	6,054	6,054	6,054	6,054	-	36,324
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	6,054	6,054	6,054	6,054	6,054	6,054	-	36,324

### - Harman International Industries, Inc.와 그 종속기업

(기준일 : 2022년 3월 31일 )

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	484,320	-	-	-	484,320
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	484,320	-	-	-	484,320

※ 미상환잔액은 기준일 환율을 적용하였습니다.

### - (주)도우인시스

(기준일 : 2022년 3월 31일 )

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	23,000	-	-	-	-	23,000
	합계	-	-	23,000	-	-	-	-	23,000

※ (주)도우인시스의 회사채는 연결 내 내부거래 상계대상입니다.



**마. 신종자본증권 미상환 잔액**  
해당사항 없습니다.

(기준일 : 2022년 03월 31일 )

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 15년이하	15년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

**바. 조건부자본증권 미상환 잔액**  
해당사항 없습니다.

(기준일 : 2022년 03월 31일 )

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 사. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등(삼성전자)

(작성기준일 : 2022년 03월 31일 )

(단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사
US\$ 100,000,000 7.7% Debenture	1997.10.02	2027.10.01	121,080	1997.10.02	The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.

(이행현황기준일 : 2022년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	해당사항 없음
	이행현황	해당사항 없음
담보권설정 제한현황	계약내용	순유형자산의 10% 미만
	이행현황	계약내용 이행 중 (해당 자산에 대해 담보권 설정 없음)
자산처분 제한현황	계약내용	(보증인이) 자산의 전부 또는 대부분을 처분하려면 본채권에 대한 의무사항 승계 등 조건을 충족시켜야 함
	이행현황	계약내용 이행 중 (2022년 1분기 중 처분 자산은 전체의 0.04%)
지배구조변경 제한현황	계약내용	해당사항 없음
	이행현황	해당사항 없음
이행상황보고서 제출현황	이행현황	해당사항 없음

※ 발행액은 기준일 환율을 적용하였습니다.

※ 사채관리계약 체결일은 Fiscal Agency Agreement 체결일로서, The Bank of New York Mellon Trust Company,

N.A.는 Fiscal Agent의 지위에 있습니다.

※ 담보권설정 제한자산인 순유형자산은 생산설비 및 본사 보유주식입니다.

※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근 재무제표의 작성기준일입니다.

※ 지배구조변경 제한현황은 공시서류 작성기준일입니다.

## 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

공시대상기간 중 공시대상인 자금조달 실적이 없습니다.

## 8. 기타 재무에 관한 사항

### 가. 재무제표 재작성 등 유의사항

#### (1) 재무제표 재작성

해당사항 없습니다.

#### (2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항

##### (SSL, SSM 법인 매각)

중속기업 삼성디스플레이(주)는 2020년 8월 28일자 이사회 결의에 의거 2021년 4월 1일자로 수익성 악화에 따른 LCD 사업 축소를 위하여 Samsung Suzhou Module Co.,Ltd. (SSM) 지분 100%와 Samsung Suzhou LCD Co., Ltd. (SSL) 지분 60%를 TCL China Star Optoelectronics Technology Co. Ltd. (CSOT)에게 매각하였습니다.

#### (3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항

##### (자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리)

해당사항 없습니다.

##### (중요한 소송사건)

당사는 다수의 회사 등과 정상적인 영업과정에서 발생한 소송, 분쟁 및 규제기관의 조사 등이 진행 중에 있습니다. 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며 당사의 경영진은 이러한 소송 등의 결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

## (채무보증 내역)

### 1) 국내채무보증

해당사항 없습니다.

### 2) 해외채무보증

(단위 : 천US\$, %)

법인명 (채무자)	관계	채권자	내용	목적	보증시작일	보증종료일	채무보증한도		채무금액			이자율
							기초	기말	기초	증감	기말	
SEA	계열회사	BOA 등	지급보증	운영자금	2021.04.20	2022.12.16	1,328,000	1,328,000	-	-	-	
SEM	계열회사	BBVA 등	지급보증	운영자금	2021.06.14	2023.03.27	906,000	906,000	-	-	-	
SAMCOL	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	2021.06.14	2022.12.16	310,000	310,000	-	-	-	
SEDA	계열회사	BRADESCO 등	지급보증	운영자금	2021.09.30	2022.12.16	409,000	409,000	-	-	-	
SECH	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	2021.06.14	2022.12.16	62,000	62,000	-	-	-	
SEPR	계열회사	BBVA 등	지급보증	운영자금	2021.06.01	2022.12.16	150,000	150,000	-	-	-	
SSA	계열회사	SCB 등	지급보증	운영자금	2021.06.14	2022.12.16	318,000	318,000	-	-	-	
SEMAG	계열회사	SocGen 등	지급보증	운영자금	2021.11.09	2022.12.16	110,000	110,000	-	-	-	
SETK	계열회사	BNP 등	지급보증	운영자금	2021.06.14	2022.12.16	807,000	807,000	102,275	25,989	128,264	22.3%
SETK-P	계열회사	BNP 등	지급보증	운영자금	2021.11.09	2022.12.16	130,000	130,000	33,334	22,976	56,310	22.6%
SECE	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	2021.07.19	2022.12.16	73,722	72,871	-	-	-	
SEEG	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2021.06.14	2022.06.13	85,000	85,000	-	-	-	
SEIN	계열회사	BNP 등	지급보증	운영자금	2021.06.14	2022.11.08	70,000	70,000	-	-	-	
SJC	계열회사	Mizuho Bank 등	지급보증	운영자금	2021.04.30	2022.12.16	877,579	858,664	-	-	-	
SEUC	계열회사	Credit Agricole 등	지급보증	운영자금	2021.06.14	2022.12.16	150,000	150,000	-	-	-	
SEDAM	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	2021.06.14	2022.12.16	141,000	141,000	-	-	-	
SECA	계열회사	BoA	지급보증	운영자금	2021.11.09	2022.11.08	70,000	70,000	-	-	-	
SELA	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2021.12.17	2022.12.16	120,000	120,000	-	-	-	
SEEH	계열회사	HSBC 등	지급보증	운영자금	2021.06.14	2022.12.16	712,400	712,400	-	-	-	
SERK	계열회사	SocGen 등	지급보증	운영자금	2021.06.14	2022.12.16	290,000	290,000	-	-	-	
SELV	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2021.12.17	2022.12.16	10,000	10,000	-	-	-	
SEIL	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2021.12.17	2022.12.16	15,600	15,600	10,947	△256	10,691	1.4%
SAPL	계열회사	BOA 등	지급보증	운영자금	2021.06.14	2022.12.16	345,000	345,000	-	-	-	
SAVINA	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2021.06.14	2022.06.13	51,000	51,000	-	-	-	
SCIC	계열회사	HSBC 등	지급보증	운영자금	2021.06.14	2022.12.16	300,000	300,000	-	-	-	
SME	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	2021.11.09	2022.11.08	110,000	110,000	-	-	-	
SAMEX	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2021.12.17	2022.12.16	5,000	5,000	-	-	-	
SEASA	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2021.12.17	2022.12.16	2,000	2,000	-	-	-	
SSAP	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	2021.11.09	2022.11.08	35,000	35,000	-	-	-	
SEPM	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2021.06.14	2022.06.13	35,000	35,000	-	-	-	
SESAR	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2021.06.14	2022.06.13	50,000	50,000	-	-	-	

법인명 (채무자)	관계	채권자	내용	목적	보증시작일	보증종료일	채무보증한도		채무금액			이자 율
							기초	기말	기초	증감	기말	
AdGear Technologies Inc.	계열회사	BOA	지급보증	운영자금	2021.11.09	2022.11.08	2,000	2,000	-	-	-	
Harman International Industries, Inc.	계열회사	JP Morgan	지급보증	운영자금	2021.06.14	2022.06.13	100,000	100,000	-	-	-	
Harman International Japan Co., Ltd.	계열회사	MUFG	지급보증	운영자금	2021.11.09	2022.11.08	25,000	25,000	-	-	-	
Harman RUS CIS LLC	계열회사	SocGen	지급보증	운영자금	2021.11.09	2022.11.08	15,000	15,000	-	-	-	
Harman Holding Limited	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2021.06.14	2022.06.13	30,000	30,000	-	-	-	
Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	계열회사	SocGen	지급보증	운영자금	2021.11.09	2022.11.08	15,000	15,000	-	-	-	
Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	계열회사											
Harman Finance International, SCA	계열회사	JP Morgan 등	지급보증	운영자금	2015.05.27	2022.03.01	396,304	-	396,304	△396,304	-	
SDN	계열회사	SIEL	지급보증	운영자금 등	2020.01.03	2024.11.22	671,908	659,431	571,121	△10,605	560,516	5.8%
합 계							9,333,513	8,904,966	1,113,981	△358,200	755,781	

※ 연결 기준입니다. Harman Finance International, SCA와 SDN 간의 채무보증인은 각각 Harman International Industries, Inc.와 삼성디스플레이㈜입니다. [△는 부(-)의 값임]

※ 건별 채무보증금액이 자기자본의 0.1% 이상 2.5% 미만인 경우 경영위원회, 2.5% 이상인 경우 이사회 의결을 통해 결정됩니다.

또한 종속기업인 삼성디스플레이㈜의 경우 건별 채무보증금액이 100억원 이상인 경우 이사회 의결을 통해 결정됩니다.

※ 상기 채무보증에 대하여 당사가 보증하는 채무보증의 대가로 종속기업별 채무보증 만기, 일반적인 신용공여 조건의 이율 등을 감안하여 수수료를 수취하고 있습니다. 당사는 2021년 중 US\$266천의 수수료를 청구하여 2022년 중 수취하였습니다.

한편, 삼성디스플레이㈜는 SDN에게 2021년 중 US\$2,529천 수수료를 청구하여 2022년 중 수취하였습니다.

☞ 우발채무 등에 관한 사항은 'III. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석'을 참조하시기 바랍니다.

(4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항

(감사보고서상 강조사항과 핵심감사사항)

구 분	강조사항 등	핵심감사사항
제54기 1분기	해당사항 없음	해당사항 없음
제53기	해당사항 없음	(연결재무제표) 1. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감 (별도재무제표) 1. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감
제52기	해당사항 없음	(연결재무제표) 1. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감 2. 영업권 및 내용연수가 비한정인 무형자산 손상 (별도재무제표) 1. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감

## 나. 대손충당금(손실충당금) 설정 현황

### (1) 계정과목별 대손충당금(손실충당금) 설정내역

(단위 : 백만원, %)

구 분	계정과목	채권 금액	대손충당금 (손실충당금)	대손충당 설정률
제54기 1분기말	매출채권	44,794,471	329,503	0.7%
	단기대여금	16,492	158	1.0%
	미수금	5,728,495	76,060	1.3%
	선급금	1,128,529	3,857	0.3%
	장기매출채권	562,622	-	0.0%
	장기미수금	1,017,733	294	0.0%
	장기선급금	1,791,568	8,519	0.5%
	장기대여금	205,751	981	0.5%
	합 계	55,245,661	419,372	0.8%
제53기말	매출채권	41,024,295	310,880	0.8%
	단기대여금	17,895	73	0.4%
	미수금	4,569,772	72,515	1.6%
	선급금	1,122,660	3,847	0.3%
	장기매출채권	225,739	-	0.0%
	장기미수금	1,002,404	290	0.0%
	장기선급금	1,770,999	9,003	0.5%
	장기대여금	199,577	917	0.5%
	합 계	49,933,341	397,525	0.8%
제52기말	매출채권	31,283,789	318,731	1.0%
	단기대여금	7,813	73	0.9%
	미수금	3,663,822	59,283	1.6%
	선급금	890,413	3,371	0.4%
	장기매출채권	85,575	-	0.0%
	장기미수금	401,582	204	0.1%
	장기선급금	1,397,698	5,972	0.4%
	장기대여금	113,944	1,309	1.1%
	합 계	37,844,636	388,943	1.0%

※ 연결 기준입니다.

※ 채권 금액은 현재가치할인차금 차감 후 금액입니다.

## (2) 대손충당금(손실충당금) 변동 현황

(단위 : 백만원)

구 분	제54기 1분기	제53기	제52기
기초 대손충당금(손실충당금)	397,525	388,943	411,310
순대손처리액(① - ② + ③)	△7,933	25,926	65,575
① 대손처리액(상각채권액) 등	664	22,400	40,487
② 상각채권회수액	-	-	745
③ 기타증감액	△8,597	3,526	25,833
대손상각비 계상(환입)액	13,914	34,508	43,208
기말 대손충당금(손실충당금)	419,372	397,525	388,943

※ 연결 기준입니다.

[△는 부(-)의 값임]

## (3) 매출채권 관련 대손충당금(손실충당금) 설정 방침

### (설정방침)

- 매출채권과 기타채권 잔액에 대하여 과거의 대손경험률과 장래의 대손예상액을 고려하는 기대신용손실모형을 적용하여 대손충당금(손실충당금) 설정

### (대손경험률 및 대손예상액 산정근거)

- 대손경험률: 과거 3개년 평균채권잔액에 대한 신용손실 경험 등을 근거로 연령별 대손경험률을 산정하여 설정
- 대손예상액: 채무자의 파산, 강제집행, 사망, 실종 등으로 회수가 불투명한 채권의 경우 회수가능성, 담보설정여부 등과 채무자의 신용정보 및 미래 전망을 고려하여 합리적인 대손예상액 설정



[대손 설정 기준]

상 황	설정률
분 쟁	25 %
수금의뢰	50 %
소 송	75 %
부 도	100 %

(대손 처리 기준)

매출채권 등에 대해 다음과 같은 사유 발생 시 실대손처리

- 파산, 부도, 강제집행, 사업의 폐지, 채무자의 사망, 실종 등으로 인해 채권의 회수 불능이 객관적으로 입증된 경우
- 소송에 패소하였거나 법적 청구권이 소멸한 경우
- 외부 채권회수 전문기관이 회수가 불가능하다고 통지한 경우
- 담보설정 부실채권, 보험Cover 채권은 담보물을 처분하거나 보험사로부터 보험금을 수령한 경우
- 회수에 따른 비용이 채권금액을 초과하는 경우

(4) 경과기간별 매출채권 잔액 현황

(기준일 : 2022년 3월 31일 )

(단위 : 백만원, %)

구 분	6월 이하	6월 초과 1년 이하	1년 초과 3년 이하	3년 초과	계
금 액	45,167,274	13,565	97,226	79,028	45,357,093
구성비율	99.6%	0.0%	0.2%	0.2%	100.0%

※ 연결 기준입니다.

※ 매출채권 잔액은 현재가치할인차금 차감 후 금액입니다.

## 다. 재고자산 현황

### (1) 사업부문별 재고자산의 보유 현황

(단위 : 백만원, %, 회)

부문	계정과목	제54기 1분기말	제53기말	제52기말
DX 부문	제품 및 상품	9,198,172	8,894,766	7,088,063
	반제품 및 재공품	876,104	799,218	592,903
	원재료 및 저장품	14,100,895	11,384,887	7,862,310
	미착품	1,654,564	1,299,624	876,270
	소 계	25,829,735	22,378,495	16,419,546
DS 부문	제품 및 상품	3,562,939	2,490,097	1,719,095
	반제품 및 재공품	12,809,016	11,809,911	10,639,866
	원재료 및 저장품	2,379,005	2,118,424	1,674,081
	미착품	44,323	36,685	46,587
	소 계	18,795,283	16,455,117	14,079,629
SDC	제품 및 상품	479,241	294,777	134,963
	반제품 및 재공품	690,256	874,229	650,762
	원재료 및 저장품	1,021,666	810,325	603,779
	미착품	63,720	48,253	33,271
	소 계	2,254,883	2,027,584	1,422,775
Harman	제품 및 상품	598,305	533,008	502,117
	반제품 및 재공품	128,661	105,271	80,237
	원재료 및 저장품	883,943	736,109	337,386
	미착품	378,748	321,128	224,961
	소 계	1,989,657	1,695,516	1,144,701
총 계	제품 및 상품	13,899,527	12,280,579	9,387,886
	반제품 및 재공품	14,413,673	13,473,618	11,818,090
	원재료 및 저장품	17,465,404	14,184,841	9,790,766
	미착품	1,812,127	1,445,366	1,046,403
	소 계	47,590,731	41,384,404	32,043,145
총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산합계÷기말자산총계×100]		10.8%	9.7%	8.5%
재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가÷{(기초재고 + 기말재고)÷2}]		4.2회	4.5회	4.9회

※ 당사 연결 기준입니다.

※ 제53기, 제52기는 2021년 12월의 조직변경을 반영하여 제54기 기준으로 재작성하였습니다.

### (2) 재고자산의 실사내역 등

#### (실사내역)

- 5월말 및 11월말 기준으로 매년 2회 재고자산 실사 실시
- 재고조사 시점과 기말시점의 재고자산 변동내역은 해당 기간 전체 재고의 입출고 내역의 확인을 통해 재무상태표일 기준 재고자산의 실재성을 확인

#### (실사방법)

- 사내보관재고: 폐창식 전수조사 실시
    - ※ 반도체 및 DP 라인 재고 및 자동화창고보관 SVC자재는 표본조사
  - 사외보관재고: 제3자 보관재고, 운송 중인 재고에 대해선 전수로 물품보유확인서 또는 장치보관확인서 징구 및 표본조사 병행
  - 외부감사인은 당사의 기말 재고실사에 입회·확인하고 일부 항목에 대해 표본 추출하여 그 실재성 및 완전성 확인
- ※ 당사는 2021년 11월 28일부터 12월 1일까지 하반기 재고실사를 실시하였으며, 종속기업들도 동일 기준(11월말)으로 하반기 재고실사를 진행하였습니다. 단, 코로나19(COVID-19)의 유행으로 이동 제한이 있는 국가에 소재한 일부 법인 등의 경우, 현지 상황을 고려하여 실사일정을 조정하였습니다.

### (장기체화재고 등 내역)

재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우 저가법 등을 사용하여 재고자산의 재무상태표 가액을 결정하고 있으며, 2022년 1분기말 현재 재고자산에 대한 평가내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2022년 3월 31일 )

(단위 : 백만원)

계정과목	취득원가	보유금액	평가충당금	기말잔액
제품 및 상품	14,692,913	14,692,913	△793,386	13,899,527
반제품 및 재공품	15,060,273	15,060,273	△646,600	14,413,673
원재료 및 저장품	18,282,421	18,282,421	△817,017	17,465,404
미착품	1,812,127	1,812,127	-	1,812,127
합 계	49,847,734	49,847,734	△2,257,003	47,590,731

※ 당사 연결 기준입니다.

[△는 부(-)의 값임]

### 라. 수주계약 현황

2022년 1분기말 현재 당사 재무제표에 중요한 영향을 미치는 장기공급계약 수주거래는 없습니다.

## 마. 공정가치평가 내역

### (1) 금융상품의 공정가치평가 방법

#### [금융자산]

##### (분류)

당사는 공정가치 측정 금융자산 (기타포괄손익 또는 당기손익에 공정가치 변동 인식), 상각 후원가 측정 금융자산으로 금융자산을 분류합니다.

금융자산은 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에 근거하여 분류합니다.

공정가치로 측정하는 금융자산의 손익은 당기손익 또는 기타포괄손익으로 인식합니다. 채무상품에 대한 투자는 해당 자산을 보유하는 사업모형에 따라 당기손익 또는 기타포괄손익으로 인식합니다. 당사는 금융자산을 관리하는 사업모형을 변경하는 경우에만 채무상품을 재분류합니다.

단기매매항목이 아닌 지분상품에 대한 투자는 최초 인식시점에 후속적인 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시할 것을 지정하는 취소불가능한 선택을 할 수 있습니다. 지정되지 않은 지분상품에 대한 투자의 공정가치 변동은 당기손익으로 인식합니다.

##### (측정)

당사는 최초 인식시점에 금융자산을 공정가치로 측정하며, 당기손익-공정가치 측정 금융자산이 아닌 경우에 해당 금융자산의 취득이나 해당 금융부채의 발행과 직접 관련되는 거래원가는 공정가치에 가산합니다. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 거래원가는 당기손익으로 비용처리합니다.

내재파생상품을 포함하는 복합계약은 계약상 현금흐름이 원금과 이자로만 구성되어 있는지를 결정할 때 해당 복합계약 전체를 고려합니다.

## 1) 채무상품

금융자산의 후속적인 측정은 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상현금흐름 특성에 근거합니다. 당사는 채무상품을 다음의 세 범주로 분류합니다.

### ① 상각후원가 측정 금융자산

사업모형이 계약상 현금흐름을 수취하기 위해 보유하는 것이고, 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있는 경우, 금융자산은 상각후원가로 측정합니다. 상각후원가로 측정하는 금융자산으로서 위험회피관계의 적용 대상이 아닌 금융자산의 손익은 해당 금융자산을 제거하거나 손상할 때 당기손익으로 인식합니다. 유효이자율법에 따라 인식하는 금융자산의 이자수익은 '금융수익'에 포함됩니다.

### ② 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

사업모형이 계약상 현금흐름의 수취와 금융자산의 매도 둘 모두를 위해 보유하는 것이고, 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있는 경우, 금융자산은 기타포괄손익-공정가치로 측정합니다. 손상차손(환입)과 이자수익 및 외환손익을 제외하고는, 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 손익은 기타포괄손익으로 인식합니다. 금융자산을 제거할 때에는 인식한 기타포괄손익누계액을 자본에서 당기손익으로 재분류합니다. 유효이자율법에 따라 인식하는 금융자산의 이자수익은 '금융수익'에 포함됩니다. 외환손익은 '금융수익' 또는 '금융비용'으로 표시하고 손상차손은 '기타비용'으로 표시합니다.

### ③ 당기손익-공정가치 측정 금융자산

상기 상각후원가 측정이나 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이 아닌 채무상품은 당기손익-공정가치로 측정됩니다. 위험회피관계가 적용되지 않는 당기손익-공정가치 측정 채무상품의 손익은 당기손익으로 인식하고 발생한 기간에 손익계산서에 '기타수익' 또는 '기타비용'으로 표시합니다.

## 2) 지분상품

당사는 모든 지분상품에 대한 투자를 후속적으로 공정가치로 측정합니다. 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시할 것을 선택한 지분상품에 대해 기타포괄손익으로 인식한 금액은 해당 지분상품을 제거할 때에도 당기손익으로 재분류하지 않고 제거되는 시점에 자본에 누적된 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익을 이익잉여금으로 대체합니다. 이러한 지분상품에 대한 배당수익은 당사가 배당을 받을 권리가 확정된 때에 손익계산서에 '기타수익'으로 인식합니다.

당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 공정가치 변동은 손익계산서에 '기타수익' 또는 '기타비용'으로 표시합니다.

### (손상)

당사는 미래전망정보에 근거하여 상각후원가로 측정하거나 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품에 대한 기대신용손실을 평가합니다. 손상 방식은 신용위험의 유의적인 증가 여부에 따라 결정됩니다. 단, 매출채권에 대해 당사는 채권의 최초 인식시점부터 전체기간 기대신용손실을 인식하는 간편법을 적용합니다.

### (인식과 제거)

금융자산의 정형화된 매입 또는 매도는 매매일에 인식하거나 제거합니다. 금융자산은 현금 흐름에 대한 계약상 권리가 소멸하거나 금융자산을 양도하고 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 이전한 경우에 제거됩니다. 당사가 금융자산을 양도한 경우라도 채무자의 채무불이행시의 소구권 등으로 양도한 금융자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 당사가 보유하는 경우에는 이를 제거하지 않고 그 양도자산 전체를 계속하여 인식하되, 수취한 대가를 금융부채로 인식합니다. 해당 금융부채는 재무상태표에 '차입금'으로 분류하고 있습니다.

## (금융상품의 상계)

금융자산과 부채는 인식한 자산과 부채에 대해 법적으로 집행가능한 상계권리를 현재 보유하고 있고, 순액으로 결제하거나 자산을 실현하는 동시에 부채를 결제할 의도를 가지고 있을 때 상계하여 재무상태표에 순액으로 표시합니다. 법적으로 집행가능한 상계권리는 미래사건에 좌우되지 않으며, 정상적인 사업과정의 경우와 채무불이행의 경우 및 지급불능이나 파산의 경우에도 집행가능한 것을 의미합니다.

## [금융부채]

### (분류 및 측정)

모든 금융부채는 다음을 제외하고는 후속적으로 상각후원가로 측정되도록 분류합니다.

- 1) 당기손익-공정가치 측정 금융부채  
과생상품부채를 포함한 이러한 부채는 후속적으로 공정가치로 측정합니다.
- 2) 금융자산의 양도가 제거 조건을 충족하지 못하거나 지속적 관여 접근법이 적용되는 경우에 생기는 금융부채  
이러한 금융부채는 상기 금융자산의 내용을 적용하여 측정합니다.
- 3) 금융보증계약  
최초 인식 시 공정가치로 측정되며, 이후에 이러한 계약의 발행자는 해당 계약을 후속적으로 다음 중 큰 금액으로 측정합니다.
  - 기대신용손실에 따라 산정한 손실충당금
  - 최초 인식금액에서 기준서 제1115호에 따라 인식한 이익누계액을 차감한 금액
- 4) 시장이자율보다 낮은 이자율로 대출하기로 한 약정  
최초 인식 후에 이러한 약정의 발행자는 후속적으로 해당 약정을 다음 중 큰 금액으로 측정합니다.
  - 기대신용손실에 따라 산정한 손실충당금
  - 최초 인식금액에서 기준서 제1115호에 따라 인식한 이익누계액을 차감한 금액
- 5) 기준서 제1103호를 적용하는 사업결합에서 취득자가 인식하는 조건부 대가  
이러한 조건부 대가는 후속적으로 당기손익-공정가치로 측정합니다.



## (제거)

금융부채는 계약상 의무가 이행, 취소 또는 만료되어 소멸되거나 기존 금융부채의 조건이 실질적으로 변경된 경우에 재무상태표에서 제거됩니다. 소멸하거나 제3자에게 양도한 금융부채의 장부금액과 지급한 대가(양도한 비현금자산이나 부담한 부채를 포함)의 차액은 당기손익으로 인식합니다.

### [파생상품]

당사는 파생상품의 계약에 따라 발생된 권리와 의무를 공정가액으로 평가하여 자산과 부채로 계상하고, 동 계약으로부터 발생한 손익은 발생시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다. 다만, 요건을 충족한 현금흐름위험회피와 해외사업장에 대한 순투자에 대한 위험회피금액은 자본항목으로 이연하고 있습니다.

당사는 재고자산의 가격 변동 위험 등을 회피하기 위한 현금흐름 위험회피회계를 적용하고 있습니다. 현금흐름위험회피 대상으로 지정되어 적용요건을 충족하는 파생상품의 공정가치 변동 중 위험회피에 효과적인 부분은 기타포괄손익으로 인식하고, 비효과적인 부분은 '금융수익' 또는 '금융비용'으로 인식하고 있습니다.

## (2) 범주별 금융상품 내역

### 1) 제54기 1분기말

(단위 : 백만원)

금융자산	상각후원가 측정 금융자산	기타포괄손익-공정 가치 측정 금융자산	당기손익-공정가치 측정 금융자산	기타금융자산(*)	계
현금및현금성자산	48,944,982	-	-	-	48,944,982
단기금융상품	75,121,426	-	-	-	75,121,426
단기상각후원가금융자산	1,755,225	-	-	-	1,755,225
단기당기손익-공정가치금융자산	-	-	53,056	-	53,056
매출채권	44,464,968	-	-	-	44,464,968
기타포괄손익-공정가치금융자산	-	13,201,558	-	-	13,201,558
당기손익-공정가치금융자산	-	-	1,496,122	-	1,496,122
기타	10,142,354	-	566,822	61,731	10,770,907
계	180,428,955	13,201,558	2,116,000	61,731	195,808,244

(\*) 기타금융자산은 범주별 금융자산의 적용을 받지 않는 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

금융부채	상각후원가 측정 금융부채	당기손익-공정가치 측정 금융부채	기타금융부채(*)	계
매입채무	15,133,906	-	-	15,133,906
단기차입금	2,452,530	-	11,433,359	13,885,889
미지급금	16,607,339	-	-	16,607,339
유동성장기부채	43,098	-	821,807	864,905
사채	518,856	-	-	518,856
장기차입금	2,500	-	2,778,207	2,780,707
장기미지급금	2,121,276	-	-	2,121,276
기타	10,797,860	393,743	10,418	11,202,021
계	47,677,365	393,743	15,043,791	63,114,899

(\*) 기타금융부채는 범주별 금융부채의 적용을 받지 않는 담보부차입금, 리스부채 및 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

## 2) 제53기말

(단위 : 백만원)

금융자산	상각후원가 측정 금융자산	기타포괄손익-공정 가치 측정 금융자산	당기손익-공정가치 측정 금융자산	기타금융자산(*)	계
현금및현금성자산	39,031,415	-	-	-	39,031,415
단기금융상품	81,708,986	-	-	-	81,708,986
단기상각후원가금융자산	3,369,034	-	-	-	3,369,034
단기당기손익-공정가치금융자산	-	-	40,757	-	40,757
매출채권	40,713,415	-	-	-	40,713,415
기타포괄손익-공정가치금융자산	-	13,965,839	-	-	13,965,839
당기손익-공정가치금융자산	-	-	1,525,344	-	1,525,344
기타	8,711,973	-	279,127	49,089	9,040,189
계	173,534,823	13,965,839	1,845,228	49,089	189,394,979

(\*) 기타금융자산은 범주별 금융자산의 적용을 받지 않는 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

금융부채	상각후원가 측정 금융부채	당기손익-공정가치 측정 금융부채	기타금융부채(*)	계
매입채무	13,453,351	-	-	13,453,351
단기차입금	2,131,692	-	11,556,101	13,687,793
미지급금	14,126,970	-	-	14,126,970
유동성장기부채	518,065	-	811,903	1,329,968
사채	508,232	-	-	508,232
장기차입금	1,500	-	2,864,656	2,866,156
장기미지급금	2,562,158	-	-	2,562,158
기타	10,444,290	323,526	13,868	10,781,684
계	43,746,258	323,526	15,246,528	59,316,312

(\*) 기타금융부채는 범주별 금융부채의 적용을 받지 않는 담보부차입금, 리스부채 및 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

### (3) 금융상품의 공정가치 측정내역

#### (금융상품의 장부금액과 공정가치)

(단위 : 백만원)

구 분	제54기 1분기말		제53기말	
	장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
금융자산:				
현금및현금성자산	48,944,982	(*)	39,031,415	(*)
단기금융상품	75,121,426	(*)	81,708,986	(*)
단기상각후원가금융자산	1,755,225	(*)	3,369,034	(*)
단기당기손익-공정가치금융자산	53,056	53,056	40,757	40,757
매출채권	44,464,968	(*)	40,713,415	(*)
기타포괄손익-공정가치금융자산	13,201,558	13,201,558	13,965,839	13,965,839
당기손익-공정가치금융자산	1,496,122	1,496,122	1,525,344	1,525,344
기타(*2)	10,770,907	628,553	9,040,189	328,216
계	195,808,244		189,394,979	
금융부채:				
매입채무	15,133,906	(*)	13,453,351	(*)
단기차입금	13,885,889	(*)	13,687,793	(*)
미지급금	16,607,339	(*)	14,126,970	(*)
유동성장기부채	864,905	6,417	1,329,968	554,106
- 유동성장기차입금	858,964	(*)(*)	852,317	(*)(*)
- 유동성사채	5,941	6,417	477,651	554,106
사채	518,856	533,885	508,232	546,339
장기차입금	2,780,707	(*)(*)	2,866,156	(*)(*)
장기미지급금	2,121,276	(*)	2,562,158	(*)
기타(*2)	11,202,021	404,161	10,781,684	337,394
계	63,114,899		59,316,312	

(\*) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

(\*) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 일부 금융자산 10,142,354백만원(전기말: 8,711,973백만원) 및

금융부채 10,797,860백만원(전기말: 10,444,290백만원)은 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

(\*) 리스부채는 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시'에 따라 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

(공정가치로 측정 및 공시되는 금융상품의 공정가치 서열체계)

(단위 : 백만원)

구 분	제54기 1분기말			
	수준 1	수준 2	수준 3	계
금융자산:				
단기당기손익-공정가치금융자산	-	31,642	21,414	53,056
기타포괄손익-공정가치금융자산	10,783,382	-	2,418,176	13,201,558
당기손익-공정가치금융자산	374,950	-	1,121,172	1,496,122
기타	-	606,248	22,305	628,553
금융부채:				
유동성사채	-	6,417	-	6,417
사채	-	533,885	-	533,885
기타	-	398,723	5,438	404,161

(단위 : 백만원)

구 분	제53기말			
	수준 1	수준 2	수준 3	계
금융자산:				
단기당기손익-공정가치금융자산	-	35,620	5,137	40,757
기타포괄손익-공정가치금융자산	11,608,708	-	2,357,131	13,965,839
당기손익-공정가치금융자산	478,401	-	1,046,943	1,525,344
기타	-	307,213	21,003	328,216
금융부채:				
유동성사채	-	554,106	-	554,106
사채	-	546,339	-	546,339
기타	-	331,956	5,438	337,394

공정가치 측정의 투입변수 특징에 따른 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다.

- '수준 1': 동일한 자산이나 부채에 대한 시장 공시가격
- '수준 2': 시장에서 관측가능한 투입변수를 활용한 공정가치  
(단, '수준 1'에 포함된 공시가격은 제외)
- '수준 3': 관측가능하지 않은 투입변수를 활용한 공정가치

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주하며, 이러한 상품은 '수준 1'에 포함됩니다. '수준 1'에 포함된 상품은 대부분 기타포괄손익-공정가치금융자산으로 분류된 상장주식으로 구성됩니다.

활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업고유정보는 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 '수준 2'에 포함됩니다.

만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 '수준 3'에 포함됩니다.

당사는 '수준 3'으로 분류되는 공정가치 측정을 포함하여 재무보고 목적의 공정가치를 측정하고 있습니다. 재무보고 일정에 맞추어 공정가치 평가과정 및 그 결과에 대해 협의하고 있고, 공정가치 '수준' 간 이동을 발생시키는 사건이나 상황의 변동이 일어난 보고기간종료일에 '수준' 변동을 인식하고 있습니다.

금융상품의 공정가치를 측정하는 데 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.

- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격
- 파생상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당 금액을 현재가치로 할인하여 측정

나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법을 사용합니다. 유동자산으로 분류된 매출채권 및 기타채권의 경우 장부금액을 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하고 있습니다.

### (가치평가기법 및 투입변수)

당사는 공정가치 서열체계에서 '수준 2'로 분류되는 회사채, 국공채, 금융채 등에 대하여 미래현금흐름을 적정이자율로 할인하는 현재가치법을 사용하고 있습니다.

2022년 1분기말 현재 '수준 3'으로 분류된 주요 금융상품에 대하여 사용된 가치평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	공정가치	가치평가기법	'수준 3' 투입변수	투입변수 범위(가중평균)
기타포괄손익-공정가치금융자산:				
삼성벤처투자(주)	27,331	현금흐름할인법	영구성장률	△1.0%~1.0%(0.0%)
			가중평균자본비용	19.3%~21.3%(20.3%)
(주)미코세라믹스	25,666	현금흐름할인법 등	영구성장률	△1.0%~1.0%(0.0%)
			가중평균자본비용	13.2%~15.2%(14.2%)
TCL China Star Optoelectronics Technology Co. Ltd. (CSOT)	1,349,356	현금흐름할인법	영구성장률	△1.0%~1.0%(0.0%)
			가중평균자본비용	11.1%~13.1%(12.1%)
China Star Optoelectronics Semiconductor Display Technology Ltd (CSOSDT)	402,939	현금흐름할인법	영구성장률	△1.0%~1.0%(0.0%)
			가중평균자본비용	11.1%~13.1%(12.1%)
기타:				
지분 풋옵션	22,305	이항모형	무위험 이자율	2.4%~2.5%, 2.5%
			가격 변동성	19.2%~29.2%(24.2%) 24.3%~34.3%(29.3%)

[△는 부(-)의 값임]

( '수준 3'에 해당하는 금융상품의 변동내역)

(단위 : 백만원)

금융자산	제54기 1분기	제53기 1분기
기초	3,430,214	6,449,139
매입	76,803	21,581
매도	△20,629	△36,180
당기손익으로 인식된 손익	59,233	19,770
기타포괄손익으로 인식된 손익	51,749	1,145,421
기타	△14,303	20,298
분기말	3,583,067	7,620,029

[△는 부(-)의 값임]

(단위 : 백만원)

금융부채	제54기 1분기	제53기 1분기
기초	5,438	9,248
당기손익으로 인식된 손익	-	-
기타	-	△2,176
분기말	5,438	7,072

[△는 부(-)의 값임]



### ('수준 3'으로 분류된 반복적인 공정가치 측정치의 민감도분석)

금융상품의 민감도분석은 통계적 기법을 이용한 관측 불가능한 투입변수의 변동에 따른 금융상품의 가치 변동에 기초하여 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어집니다. 그리고 공정가치가 두 개 이상의 투입변수에 영향을 받는 경우에는 가장 유리하거나 또는 가장 불리한 금액을 바탕으로 산출됩니다.

2022년 1분기말 현재 '수준 3'으로 분류되는 주요 금융상품의 투입변수의 변동에 따른 손익 효과(자본은 법인세효과 반영전)에 대한 민감도분석 결과는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	유리한 변동 효과		불리한 변동 효과	
	당기손익	자본	당기손익	자본
기타포괄손익-공정가치금융자산	-	164,689	-	△121,231
기타	3,683	-	△4,378	-

- ※ 지분상품은 주요 관측불가능한 투입변수인 성장률(△1.0%~1.0%)과 할인율 사이의 상관관계를 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다. [△는 부(-)의 값임]
- ※ 기타는 주요 관측불가능한 투입변수인 가격 변동성을 5% 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다.

#### (4) 유형자산 재평가내역

당사는 공시대상기간 중 유형자산 재평가내역이 없습니다.

## IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

이사의 경영진단 및 분석의견은 기업공시서식 작성기준에 따라 분·반기보고서에 기재하지 않습니다.(사업보고서에 기재 예정)

## V. 회계감사인의 감사의견 등

### 1. 외부감사에 관한 사항

#### 가. 회계감사인의 감사의견 등

안진회계법인은 제52기, 제53기 감사 및 제54기 1분기 검토를 수행하였으며, 제52기, 제53기 감사결과 감사의견은 모두 적정이며, 제54기 1분기 검토 결과 재무제표에 한국채택국제회계기준 제1034호(중간재무보고)에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 않았습니다.

한편, 당사의 감사 대상 종속기업은 공시대상기간 중 모두 적정의견을 받았습니다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항
제54기 1분기 (당분기)	안진회계법인	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
제53기 (전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음	(연결재무제표) 1. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감 (별도재무제표) 1. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감
제52기 (전전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음	(연결재무제표) 1. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감 2. 영업권 및 내용연수가 비한정인 무형자산 손상 (별도재무제표) 1. 재화의 판매장려활동에 대한 매출차감

※ 감사의견은 별도·연결 재무제표에 대한 감사의견입니다.

[감사용역 체결 현황]

(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역		실제수행내역	
			보수	시간	보수	시간
제54기 1분기 (당분기)	안진회계법인	분·반기 재무제표 검토 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사 내부회계관리제도 감사	8,424	78,000	1,382	12,800
제53기 (전기)	안진회계법인	분·반기 재무제표 검토 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사 내부회계관리제도 감사	7,900	76,741	7,900	76,999
제52기 (전전기)	안진회계법인	분·반기 재무제표 검토 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사 내부회계관리제도 감사	8,400	85,721	8,400	86,128

(제54기 1분기 일정)

구 분		일 정
제54기 1분기	사전검토	2022.03.07 ~ 2022.03.25
	본검토	2022.04.05 ~ 2022.05.13

※ 별도·연결 재무제표 검토에 대한 일정입니다.

[비감사용역 체결 현황]

(단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고
제54기 1분기 (당분기)	해당사항 없음	-	-	-	-
제53기 (전기)	2017.06	E-Discovery 자문업무	2021.01~2021.12	394	안진회계법인
제52기 (전전기)	2017.06	E-Discovery 자문업무	2020.01~2020.12	59	안진회계법인

[내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과]

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용
1	2022.01.25	<ul style="list-style-type: none"> <li>감사위원회: 위원 3명</li> <li>회사: 감사팀장</li> <li>감사인: 업무수행이사 외 1명</li> </ul>	대면회의	<ul style="list-style-type: none"> <li>핵심감사사항 등 중점 감사사항</li> <li>내부회계관리제도 감사 진행 상황</li> <li>기타 감사종료단계 필수 커뮤니케이션 사항</li> </ul>
2	2022.04.26	<ul style="list-style-type: none"> <li>감사위원회: 위원 3명</li> <li>회사: 감사팀장</li> <li>감사인: 업무수행이사 외 4명</li> </ul>	대면회의	<ul style="list-style-type: none"> <li>연간 지배기구와의 커뮤니케이션 계획</li> <li>연간 회계감사 일정 계획</li> <li>분기 검토 경과보고</li> </ul>

[조정협의내용 및 재무제표 불일치정보]

해당사항 없습니다.

## 나. 회계감사인의 변경

제54기 1분기말(당분기) 현재 당사의 종속기업은 231개이며, 당분기 중 종속기업의 회계감사인 신규 선임 및 변경 내역은 없습니다.

제53기말(전기) 현재 당사의 종속기업은 228개이며, 종속기업 Samsung Electronics Singapore Pte. Ltd. (SESP)와 Samsung Electronics Industry and Commerce Ltd. (SETK-P)가 Deloitte를, 지에프(주)가 안진회계법인(Deloitte)을 회계감사인으로 신규 선임하였습니다. 또한 종속기업 Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN)이 Deloitte에서 E&Y로 감사인을 변경하였으며, 도우인시스(주)가 삼덕회계법인에서 안진회계법인(Deloitte)으로 변경하였습니다. 종속기업의 회계감사인 신규 선임 및 변경은 각 회사의 결정에 의한 것입니다.

또한, 당사는 제52기(전전기) 회계감사인을 삼일회계법인(PwC)에서 안진회계법인(Deloitte)으로 변경하였습니다. 이는 기존 감사인과 계약 기간 만료 후, 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제11조 제1항 및 제2항, 동법 시행령 제17조 및 「외부감사 및 회계 등에 관한 규정」 제10조 및 제15조 제1항에 따른 감사인 주기적지정에 의한 것입니다. 당사의 종속기업은 제52기말(전전기말, 2020년말) 현재 241개이며, 2020년 중 삼성디스플레이(주) 등 6개 국내종속기업은 삼일회계법인(PwC)에서 안진회계법인(Deloitte)으로 회계감사인을 변경하였으며, Samsung Electronics America, Inc. (SEA) 등 24개 해외종속기업은 PwC에서 Deloitte로, Samsung Eletronica da AmazoniaLtda. (SEDA) 등 2개 해외종속기업은 KPMG에서 Deloitte로 회계감사인을 변경하였습니다. 해당 종속기업들은 당사(지배회사)의 회계감사인 변경에 따라 연결감사 업무 효율화를 위해 회계감사인을 변경하였습니다.

[제52기 종속기업의 회계감사인 변경 현황]

종속법인명	변경전 회계감사인	변경후 회계감사인
삼성디스플레이(주)	삼일회계법인(PwC)	안진회계법인(Deloitte)
삼성전자서비스(주)	삼일회계법인(PwC)	안진회계법인(Deloitte)
삼성전자서비스씨에스(주)	삼일회계법인(PwC)	안진회계법인(Deloitte)
삼성전자판매(주)	삼일회계법인(PwC)	안진회계법인(Deloitte)
삼성전자로지텍(주)	삼일회계법인(PwC)	안진회계법인(Deloitte)
(주)미래로시스템	삼일회계법인(PwC)	안진회계법인(Deloitte)
Samsung Electronics America, Inc. (SEA)	PwC	Deloitte
Samsung Semiconductor, Inc. (SSI)	PwC	Deloitte
Samsung Mexicana S.A. de C.V (SAMEX)	PwC	Deloitte
Samsung International, Inc. (SII)	PwC	Deloitte
Samsung Austin Semiconductor LLC. (SAS)	PwC	Deloitte
Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. (SEM)	PwC	Deloitte
Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK)	PwC	Deloitte
Samsung Electronics Holding GmbH (SEHG)	PwC	Deloitte
Samsung Semiconductor Europe GmbH (SSEG)	PwC	Deloitte
Samsung Electronics GmbH (SEG)	PwC	Deloitte
Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN)	PwC	Deloitte

Samsung Vina Electronics Co., Ltd. (SAVINA)	PwC	Deloitte
Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL)	PwC	Deloitte
Samsung Electronics Australia Pty. Ltd. (SEAU)	PwC	Deloitte
Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE)	PwC	Deloitte
Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV)	PwC	Deloitte
Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV)	PwC	Deloitte
Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT)	PwC	Deloitte
Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC)	PwC	Deloitte
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC)	PwC	Deloitte
Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS)	PwC	Deloitte
Samsung Electronics Saudi Arabia Ltd. (SESAR)	PwC	Deloitte
Samsung Electronics Turkey (SETK)	PwC	Deloitte
Samsung Electronics Rus Company LLC (SERC)	PwC	Deloitte
Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA)	KPMG	Deloitte
Samsung Gulf Electronics Co., Ltd. (SGE)	KPMG	Deloitte

또한, 제52기(전전기) 중 신규 인수한 종속기업 TeleWorld Solutions, Inc. (TWS)는 PwC를 회계감사인으로 선임하였습니다. 회계감사인 신규 선임은 회사의 결정에 의한 것입니다.

## 2. 내부통제에 관한 사항

내부통제에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.  
(반기/사업보고서에 기재 예정)



## VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

### 1. 이사회에 관한 사항

이사회에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기/사업보고서에 기재 예정)

### 2. 감사제도에 관한 사항

감사제도에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.  
(반기/사업보고서에 기재 예정)

### 3. 주주총회 등에 관한 사항

주주총회 등에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.  
(반기/사업보고서에 기재 예정)

## VII. 주주에 관한 사항

### 1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 )

(단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말		
			주식수	지분율	주식수	지분율	
삼성생명보험㈜	최대주주 본인	보통주	508,157,148	8.51	508,157,148	8.51	-
삼성생명보험㈜	최대주주 본인	우선주	43,950	0.01	43,950	0.01	-
삼성생명보험㈜(특별계정)	최대주주 본인	보통주	13,860,804	0.23	13,630,979	0.23	장내 매매
삼성생명보험㈜(특별계정)	최대주주 본인	우선주	548,463	0.07	536,719	0.07	장내 매매
삼성물산㈜	계열회사	보통주	298,818,100	5.01	298,818,100	5.01	-
삼성화재해상보험㈜	계열회사	보통주	88,802,052	1.49	88,802,052	1.49	-
삼성복지재단	출연 재단	보통주	4,484,150	0.08	4,484,150	0.08	-
삼성문화재단	출연 재단	보통주	1,880,750	0.03	1,880,750	0.03	-
홍라희	최대주주의 특수관계인	보통주	137,244,666	2.30	117,302,806	1.96	시간외매매
홍라희	최대주주의 특수관계인	우선주	206,633	0.03	206,633	0.03	-
이재용	최대주주의 특수관계인	보통주	97,414,196	1.63	97,414,196	1.63	-
이재용	최대주주의 특수관계인	우선주	137,757	0.02	137,757	0.02	-
이부진	계열회사 임원	보통주	55,394,044	0.93	55,394,044	0.93	-
이부진	계열회사 임원	우선주	137,755	0.02	137,755	0.02	-
이서현	최대주주의 특수관계인	보통주	55,394,044	0.93	55,394,044	0.93	-
이서현	최대주주의 특수관계인	우선주	137,755	0.02	137,755	0.02	-
한중희	계열회사 임원	보통주	5,000	0.00	15,000	0.00	장내매매
경계현	계열회사 임원	보통주	0	0.00	10,050	0.00	신규 선임
노태문	계열회사 임원	보통주	0	0.00	13,000	0.00	신규 선임
박학규	계열회사 임원	보통주	0	0.00	18,000	0.00	신규 선임
이정배	계열회사 임원	보통주	0	0.00	10,000	0.00	신규 선임
박병국	계열회사 임원	보통주	1,000	0.00	1,500	0.00	장내매매
김한조	계열회사 임원	보통주	2,175	0.00	2,175	0.00	-
김기남	계열회사 임원	보통주	210,000	0.00	0	0.00	이사 사임
김현석	계열회사 임원	보통주	99,750	0.00	0	0.00	이사 사임
고동진	계열회사 임원	보통주	75,000	0.00	0	0.00	이사 사임
안규리	계열회사 임원	보통주	3,800	0.00	0	0.00	임기만료 퇴임
계		보통주	1,261,846,679	21.14	1,241,347,994	20.79	-
		우선주	1,212,313	0.15	1,200,569	0.15	-

※ 관계는 「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」 제3조 제1항에 기재되어 있는 관계를 참고하여 기재하였습니다.

※ 보통주는 의결권이 있으며, 우선주는 의결권이 없습니다. (단, 보통주 일부는 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한되어 있습니다.)

※ 2022년 3월 31일 기준입니다. 작성기준일 이후 변동은 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)의 '임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서' 등을 참고하십시오.

## 2. 최대주주 관련 사항

### 가. 최대주주의 개요

#### (1) 최대주주(삼성생명보험주)의 기본정보

1) 법적·상업적 명칭: 삼성생명보험주 (Samsung Life Insurance Co., Ltd.)

2) 설립일자: 1957년 4월 24일

3) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

주소: 서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동)

전화번호: 1588-3114

홈페이지: www.samsunglife.com

4) 최대주주(삼성생명보험주)의 대표이사·업무집행자·최대주주

(단위 : 명, %)

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)	
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
삼성생명보험주	121,283	전영목	0.00	-	-	삼성물산주	19.34
		-	-	-	-	-	-

※ 출자자수는 2021년 12월 31일 보통주 기준이며, 대표이사·업무집행자·최대주주의 성명 및 지분율은

2022년 3월 31일 기준입니다.

5) 최대주주(삼성생명보험주)의 대표이사·업무집행자·최대주주의 변동내역

변동일	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)	
	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
2020.03.19	현성철	0.00	-	-	-	-
2020.03.19	전영목	-	-	-	-	-
2020.03.23	전영목	0.00	-	-	-	-
2020.03.24	전영목	0.00	-	-	-	-
2021.03.16	전영목	0.00	-	-	-	-
2021.04.29	-	-	-	-	이건희	-
2021.04.29	-	-	-	-	삼성물산주	19.34

※ 2020년 3월 19일 현성철 대표이사가 사임하고, 전영목 사내이사가 대표이사로 선임되었습니다.

※ 2021년 4월 29일 최대주주(2020년 10월 25일 별세)가 소유하던 주식에 대한 상속으로 인하여 최대주주가 삼성물산주(주)로 변경되었습니다.

(2) 최대주주(삼성생명보험주)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분	
법인 또는 단체의 명칭	삼성생명보험주
자산총계	328,059,020
부채총계	296,565,859
자본총계	31,493,161
매출액	9,304,748
영업이익	323,812
당기순이익	302,174

※ 재무현황은 2022년 3월 31일, 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준입니다.

### (3) 최대주주(삼성생명보험주)의 사업현황 등

삼성생명보험(주)은 인보험 및 그와 관련된 재보험계약 등을 주요 영업목적으로 하는 생명보험회사로, 보험업법 및 기타 관계법령 등에 근거하여 사업을 영위하고 있습니다. 또한, 주요 종속기업인 삼성카드(주)는 여신전문금융업(신용카드업·시설대여업·할부금융업 등)을 영위하는 여신전문금융회사로, 여신전문금융업법 및 기타 관계법령에 근거하여 사업을 영위하고 있습니다.

☞ 최대주주에 대한 자세한 사항은 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시된 삼성생명보험(주)의 사업(분·반기)보고서를 참조하시기 바랍니다.

#### 나. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래

해당사항 없습니다.

## 다. 최대주주의 최대주주의 개요

### (1) 최대주주의 최대주주(삼성물산주)의 기본정보

1) 법적·상업적 명칭: 삼성물산주 (Samsung C&T Corporation)

2) 설립일자 및 존속기간

1963년 12월 23일에 동화부동산주식회사로 시작하여, 2014년 7월 제일모직주식회사로 사명을 변경하였습니다. 또한 1938년 3월 1일 설립된 삼성상회를 모태로 1951년 1월에 설립된 삼성물산주식회사와의 합병을 통하여 2015년 9월 2일(합병등기일) 삼성물산주식회사로 사명을 변경하였습니다.

3) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

주소: 서울특별시 강동구 상일로6길 26(상일동)

전화번호: 02-2145-5114

홈페이지: [www.samsungcnt.com](http://www.samsungcnt.com)

4) 최대주주의 최대주주(삼성물산주)의 대표이사·업무집행자·최대주주

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조함원)		업무집행자 (업무집행조함원)		최대주주 (최대출자자)	
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
삼성물산주	197,235	고정석	0.00	-	-	이재용	18.13
		오세철	0.00	-	-	-	-
		한승환	0.00	-	-	-	-

※ 2022년 3월 31일, 보통주 기준입니다.

5) 최대주주의 최대주주(삼성물산주)의 대표이사·업무집행자·최대주주의 변동내역

(단위 : %)

변동일	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)	
	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
2021.03.19	이영호	-	-	-	-	-
2021.03.19	정금용	-	-	-	-	-
2021.03.19	오세철	0.00	-	-	-	-
2021.03.19	한승환	0.00	-	-	-	-
2021.03.19	고정석	0.00	-	-	-	-
2021.04.29	-	-	-	-	이재용	18.13

※ 2021년 3월 19일 이영호, 정금용 대표이사가 사임하고, 오세철, 한승환 사내이사가 대표이사로 선임되었으며, 고정석 대표이사가 재선임되었습니다.

※ 2021년 4월 29일 상속(상속인: 이재용 외 3명)으로 인하여 최대주주의 지분율(보통주)이 변동(17.48%→18.13%)되었습니다.

## (2) 최대주주의 최대주주(삼성물산주)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분	
법인 또는 단체의 명칭	삼성물산주
자산총계	53,173,996
부채총계	22,499,583
자본총계	30,674,413
매출액	10,439,689
영업이익	541,607
당기순이익	649,188

※ 재무현황은 2022년 3월 31일, 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준입니다.

## (3) 최대주주의 최대주주(삼성물산주)의 사업현황 등

삼성물산주는 국내외의 건축, 토목, 플랜트, 주택 분야의 사업을 영위하고 있는 건설부문과 자원개발, 철강, 화학, 산업소재, 섬유 등 다양한 방면에서 국제무역을 하고 있는 상사부문, 의류제품 제조, 판매사업과 모제품(직물)가공, 판매사업을 하는 패션부문, 조정사업과 에버랜드(드라이파크), 캐리비안베이(워터파크), 골프장 및 전문급식, 식자재유통사업(삼성웰스토리)을 영위 운영하는 리조트부문, 바이오의약품 위탁생산사업 및 바이오시밀러 사업으로 구성되어 있습니다.

☞ 최대주주의 최대주주에 대한 자세한 사항은 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시된 삼성물산주의 사업(분·반기)보고서를 참조하시기 바랍니다.



## VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

### 1. 임원 및 직원 등의 현황

#### 가. 등기임원

(기준일 : 2022년 03월 31일 )

(단위 : 주)

성명	성 별	출생년월	직위	등기 임원 여부	상근 여부	담당 업무	주요경력	소유주식수		최대주주 와의 관계	재직기 간	임기 만료일
								의결권 있는 주식	의결권 없는 주식			
한중희	남	1962.03	부회장	사내 이사	상근	· 대표이사 (DX 부문 경영전반 총괄)	· 인하대 전자공학 학사 · 삼성전자 DX부문장	15,000	-	계열회사 임원	25개월	2023.03.17
경계현	남	1963.03	사장	사내 이사	상근	· 대표이사 (DS 부문 경영전반 총괄)	· 서울대 제어계측공학 박사 · 삼성전자 DS부문장	10,050	-	계열회사 임원	1개월	2025.03.15
노태문	남	1968.09	사장	사내 이사	상근	· MX사업부장	· 포항공대 전자전기공학 박사 · 삼성전자 MX사업부장	13,000	-	계열회사 임원	1개월	2025.03.15
박학규	남	1964.11	사장	사내 이사	상근	· CFO	· KAIST 경영학 석사 · 삼성전자 경영지원실장	18,000	-	계열회사 임원	1개월	2025.03.15
이정배	남	1967.02	사장	사내 이사	상근	· 메모리사업부장	· 서울대 전자공학 박사 · 삼성전자 메모리사업부장	10,000	-	계열회사 임원	1개월	2025.03.15
김한조	남	1956.07	이사	사외 이사	비상근	· 감사위원회 위원 · 내부거래위원회 위원 · 보상위원회 위원 · 지속가능경영위원회 위원	· 연세대 불어불문학 학사 · 하나금융그룹재단 이사장	2,175	-	계열회사 임원	37개월	2025.03.19
김선욱	여	1952.12	이사	사외 이사	비상근	· 감사위원회 위원 · 내부거래위원회 위원장 · 지속가능경영위원회 위원	· Konstanz대 법학 박사 · 이화여대 명예교수	-	-	계열회사 임원	49개월	2024.03.22
박병국	남	1959.04	이사	사외 이사	비상근	· 사외이사후보추천위원회 위원 · 보상위원회 위원장 · 지속가능경영위원회 위원	· Stanford대 전기공학 박사 · 서울대 전기·정보공학부 교수	1,500	-	계열회사 임원	49개월	2024.03.22
김종훈	남	1960.08	이사	사외 이사	비상근	· 감사위원회 위원 · 내부거래위원회 위원 · 사외이사후보추천위원회 위원장 · 지속가능경영위원회 위원	· Maryland대 신뢰성공학 박사 · Kiswe Mobile 회장	-	-	계열회사 임원	49개월	2024.03.22
한화진	여	1959.12	이사	사외 이사	비상근	· 사외이사후보추천위원회 위원 · 지속가능경영위원회 위원	· UCLA대 대기화학 박사 · 국가과학기술인력개발원 석좌교수	-	-	계열회사 임원	1개월	2025.03.15
김준성	남	1967.10	이사	사외 이사	비상근	· 보상위원회 위원 · 지속가능경영위원회 위원	· Carnegie Mellon대 경제학/산업공학 학사 · 싱가포르투자청 토털리턴그룹 이사	-	-	계열회사 임원	1개월	2025.03.15

※ 최대주주와의 관계는 「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」 제3조 제1항에 기재되어 있는 관계를 참고하여 기재하였습니다.

※ 등기임원 소유주식수는 작성기준일 현재 기준이며, 작성기준일 이후 변동은 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)의 '임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서' 등을 참고하십시오.

※ 2022년 2월 15일 김기남, 김현석, 고동진 사내이사가 대표이사직에서 사임하였으며, 동일 개최한 이사회에서 한중희 사내이사가 대표이사로 선임되었습니다.

※ 2022년 3월 16일 주주총회를 통해 경계현, 노태문, 박학규, 이정배 사내이사와 한화진, 김준성 사외이사가 신규 선임되었고, 김한조 사외이사가 재선임되었습니다.

- ※ 2022년 3월 16일 김기남, 김현석, 고동진 사내이사가 사임하였습니다.
- ※ 2022년 3월 16일 이사회를 통해 경계현 사내이사가 대표이사로 선임되었습니다.
- ※ 2022년 3월 19일 박재완, 안규리 사외이사의 임기가 만료되었습니다.
- ※ 2022년 4월 20일 한화진 사외이사가 사임하였습니다.
- ※ 2022년 4월 26일 김한조 사외이사가 감사위원회 위원장으로 선임되었습니다.
- ※ 2022년 4월 28일 김한조 사외이사가 지속가능경영위원회 위원장으로 선임되었습니다.

## 나. 동기임원의 타회사 임원겸직 현황

(기준일 : 2022년 3월 31일 )

겸 직 자		겸 직 회 사		
성 명	직 위	기업명	직 위	재임 기간
김종훈	사외이사	Kiswe Mobile	회장	2013년~현재

## 다. 미동기임원 현황

(기준일 : 2022년 3월 31일 )

(단위 : 개월)

성명	성별	출생 연월	직위	상근 여부	담당업무	주요경력	학력	최대주주 와의 관계	재직 기간
김기남	남	1958.04	회장	상근	종합기술원 회장	DS부문장	Univ. of California, LA(박사)	계열회사 임원	
이재용	남	1968.06	부회장	비상근	부회장	COO	Harvard Univ.(박사수료)	최대주주 의 특수관 계인	
정현호	남	1960.03	부회장	상근	사업지원T/F장	디지털이미징사업부장	Harvard Univ.(석사)	계열회사 임원	
강인엽	남	1963.07	사장	상근	미주담당 사장	System LSI사업부장	Univ. of California, LA(박사)	계열회사 임원	
김수목	남	1964.05	사장	상근	법무실장	법무실 송무팀장	서울대	계열회사 임원	19
박용인	남	1964.04	사장	상근	System LSI사업부장	System LSI 전략마케팅실장	연세대(석사)	계열회사 임원	
승현준	남	1966.06	사장	상근	Samsung Research연구소장	Samsung Research 담당임원	Harvard Univ.(박사)	계열회사 임원	46
이원진	남	1967.08	사장	상근	Mobile eXperience 서비스 Biz팀장	영상디스플레이 Service Business팀장	Purdue Univ.(석사)	계열회사 임원	
이인용	남	1957.03	사장	상근	Corporate Relations 담당	사회공헌업무총괄	서울대	계열회사 임원	
이재승	남	1960.07	사장	상근	생활가전사업부장	생활가전 개발팀장	고려대(석사)	계열회사 임원	
임영빈	남	1957.08	사장	상근	의료사업일류화추진단장	삼성생명 상근고문	Univ. of British Columbia(석사)	계열회사 임원	16
전경훈	남	1962.12	사장	상근	네트워크사업부장	네트워크 개발팀장	Univ. of Michigan, Ann Arbor(박사)	계열회사 임원	
정은승	남	1960.08	사장	상근	DS부문 CTO	Foundry사업부장	Univ. of Texas, Arlington(박사)	계열회사 임원	
진교영	남	1962.08	사장	상근	종합기술원장	메모리사업부장	서울대(박사)	계열회사 임원	
최경식	남	1962.03	사장	상근	북미총괄	무선 전략마케팅실장	한양대(석사)	계열회사 임원	
최시영	남	1964.01	사장	상근	Foundry사업부장	글로벌인프라총괄 메모리제조 기술센터장	The Ohio State Univ.(박사)	계열회사 임원	
황득규	남	1959.06	사장	상근	중국전략협력실장	기흥/화성단지장	Boston Univ.(석사)	계열회사 임원	

강문수	남	1969.08	부사장	상근	Foundry CP실 담당임원	Foundry 전략마케팅실 담당임원	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(박사)	계열회사 임원	33
강봉구	남	1962.02	부사장	상근	한국총괄	생활가전 전략마케팅팀장	홍익대	계열회사 임원	
강성철	남	1967.08	부사장	상근	Samsung Research Robot센터장	무선 개발실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	36
강현석	남	1963.08	부사장	상근	서남아총괄	무선 전략마케팅실 담당임원	서강대	계열회사 임원	
계종욱	남	1966.10	부사장	상근	Foundry Design Platform개발실 담당임원	Foundry 기술개발실 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	55
고관협	남	1966.01	부사장	상근	반도체연구소 메모리 TD실 담당임원	반도체연구소 차세대TD팀장	서울대(박사)	계열회사 임원	27
고대곤	남	1965.03	부사장	상근	SEPM법인장	SIEL-P(C)법인장	아주대	계열회사 임원	
고봉준	남	1972.01	부사장	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임원	Stanford Univ., Research Fellow	Columbia Univ.(박사)	계열회사 임원	25
고승환	남	1962.09	부사장	상근	영상디스플레이 구매팀장	생활가전 구매팀장	인하대	계열회사 임원	
고재윤	남	1973.01	부사장	상근	지원팀 담당임원	경영혁신팀 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	
고재필	남	1970.03	부사장	상근	메모리 인사팀장	DS부문 인사팀 담당임원	Purdue Univ.(석사)	계열회사 임원	
고형중	남	1970.11	부사장	상근	메모리 Design Platform개발실장	메모리 Design Platform개발실 담당임원	Univ. of Florida(박사)	계열회사 임원	
곽성웅	남	1965.05	부사장	상근	System LSI LSI개발실 담당임원	Maxim, Integrated Executive Director	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(박사)	계열회사 임원	40
곽연봉	남	1967.03	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	광운대	계열회사 임원	
구본영	남	1967.05	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
구자흠	남	1968.01	부사장	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	North Carolina State Univ.(박사)	계열회사 임원	
권상덕	남	1967.03	부사장	상근	반도체연구소 Logic TD실장	반도체연구소 Logic TD실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
권대훈	남	1968.02	부사장	상근	재경팀 담당임원	DS부문 일본총괄 담당임원	Univ. of North Carolina, Chapel Hill(석사)	계열회사 임원	
권환준	남	1971.09	부사장	상근	Samsung Research 차세대통신연구센터 담당임원	Qualcomm, Sr. Director	Univ. of California, San Diego(박사)	계열회사 임원	1
김강태	남	1972.10	부사장	상근	Samsung Research S/W혁신센터장	Samsung Research SE팀장	중앙대(박사)	계열회사 임원	
김경준	남	1965.02	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실장	무선 Global CS팀장	한양대(석사)	계열회사 임원	
김경진	남	1963.11	부사장	상근	DX부문 CSO, Global EHS센터장	영상디스플레이 Global제조팀장	숭실대	계열회사 임원	
김경환	남	1970.06	부사장	상근	법무실 법무팀장	법무실 담당임원	서울대	계열회사 임원	29
김경훈	남	1974.01	부사장	상근	영상디스플레이 디자인팀장	영상디스플레이 디자인팀 담당임원	중앙대	계열회사 임원	

김경희	여	1969.07	부사장	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	Moda Operandi, CMO	Yale Univ.(석사)	계열회사 임원	43
김기원	남	1963.04	부사장	상근	상생협력센터 대외협력팀장	상생협력센터 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	
김기훈	남	1968.05	부사장	상근	지원팀 담당임원	구주총괄 지원팀장	Univ. of Baltimore(석사)	계열회사 임원	
김대현	남	1964.08	부사장	상근	CIS총괄	SETK법인장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
김도현	남	1975.03	부사장	상근	DS부문 법무지원팀장	DS부문 법무지원팀 담당임원	서울대	계열회사 임원	
김도형	남	1964.10	부사장	상근	구주총괄 대외협력팀장	삼성물산 법무팀장	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	27
김동관	남	1969.10	부사장	상근	DS부문 정보보호센터장	삼성SDS 정보보호센터장	한양대	계열회사 임원	4
김동욱	남	1963.09	부사장	상근	생산기술연구소장	글로벌기술센터장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
김동욱	남	1968.10	부사장	상근	재경팀장	재경팀 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	
김두일	남	1971.07	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Samsung Research Platform팀장	경북대	계열회사 임원	
김만영	남	1969.07	부사장	상근	SEG법인장	무선 전략마케팅실 담당임원	Boston Univ.	계열회사 임원	
김명철	남	1968.09	부사장	상근	반도체연구소 공정개발실 담당임원	반도체연구소 메모리TD실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
김민구	남	1964.08	부사장	상근	System LSI SOC개발실장	System LSI SOC개발실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
김병도	남	1967.03	부사장	상근	글로벌마케팅센터 담당임원	무선 GDC센터 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	
김사필	남	1965.04	부사장	상근	상생협력센터 담당임원	상생협력센터 담당임원	경찰대	계열회사 임원	
김선식	남	1964.06	부사장	상근	DS부문 담당임원	메모리 인사팀장	성균관대(석사)	계열회사 임원	
김성욱	남	1968.06	부사장	상근	한국총괄 온라인영업팀장	인사팀 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	
김성윤	남	1966.10	부사장	상근	법무실 IP센터 담당임원	IP센터 책임변호사	Harvard Univ.(석사)	계열회사 임원	
김세호	남	1967.10	부사장	상근	SEI법인장	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	동국대	계열회사 임원	
김수진	여	1969.08	부사장	상근	지속가능경영추진센터 담당임원	Global Public Affairs팀 담당임원	Univ. of Pennsylvania(박사)	계열회사 임원	59
김연성	남	1966.05	부사장	상근	한국총괄 지원팀장	생활가전 지원팀 담당임원	MIT(석사)	계열회사 임원	
김영집	남	1971.03	부사장	상근	Mobile eXperience 모바일플랫폼센터 담당임원	무선 Global Mobile B2B팀 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
김영호	남	1964.12	부사장	상근	수원지원센터장	생활가전 지원팀 담당임원	Tulane Univ.(석사)	계열회사 임원	
김용관	남	1963.12	부사장	상근	의료기기사업부장	의료기기 전략지원담당	Thunderbird(석사)	계열회사 임원	

김용국	남	1968.01	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	삼성바이오에피스 생산본부 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	9
김용재	남	1972.03	부사장	상근	영상디스플레이 개발팀 부팀장	영상디스플레이 개발팀 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	
김우준	남	1968.05	부사장	상근	네트워크 전략마케팅팀장	네트워크 전략마케팅 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
김원경	남	1967.08	부사장	상근	Global Public Affairs팀장	북미총괄 대외협력팀장	The Johns Hopkins Univ.(석사)	계열회사 임원	
김유석	남	1965.04	부사장	상근	법무실 IP센터장	법무실 IP센터 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
김윤수	남	1967.12	부사장	상근	중국사업혁신팀장	SEIN-S법인장	Thunderbird(석사)	계열회사 임원	
김은중	남	1965.06	부사장	상근	TSP총괄 GPO팀장	메모리 Global운영팀장	성균관대	계열회사 임원	
김이태	남	1966.02	부사장	상근	커뮤니케이션팀 담당임원	기획팀 담당임원	Univ. of Missouri, Columbia(박사)	계열회사 임원	
김인식	남	1967.09	부사장	상근	재경팀 담당임원	삼성SDS 전략기획담당 담당임원	Univ. of Michigan, Ann Arbor(석사)	계열회사 임원	46
김재목	남	1965.05	부사장	상근	공급망인사이드T/F장	상생협력센터 상생협력팀장	국민대	계열회사 임원	
김재윤	남	1963.03	부사장	상근	기획팀장	삼성경제연구소 산업전략1실장	서울대(박사)	계열회사 임원	
김재준	남	1968.01	부사장	상근	DS부문 미주총괄 담당임원	메모리 전략마케팅실 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
김재훈	남	1972.08	부사장	상근	법무실 담당임원	법무실 Compliance팀 담당임원	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	
김재훈	남	1967.01	부사장	상근	SELA법인장	SEDA-S 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
김정식	남	1970.08	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 서비스사업실 담당임원	한양대(석사)	계열회사 임원	
김종현	남	1966.08	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인사팀장	Foundry 인사팀장	육사	계열회사 임원	
김주년	남	1969.12	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발2실 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	
김준	남	1964.02	부사장	상근	종합기술원 미세먼지연구소장	연세대, 교수	Univ. of Michigan, Ann Arbor(박사)	계열회사 임원	15
김준석	남	1969.04	부사장	상근	System LSI 기반설계실장	System LSI SOC개발실 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	
김진수	남	1971.10	부사장	상근	디자인경영센터 담당임원	무선 디자인팀 담당임원	국민대	계열회사 임원	
김진해	남	1963.12	부사장	상근	한국총괄 IM영업팀장	한국총괄 모바일영업팀장	광운대	계열회사 임원	
김찬우	남	1976.04	부사장	상근	Samsung Research Global AI센터 담당임원	Samsung Research AI센터 담당임원	Carnegie Mellon Univ.(박사)	계열회사 임원	50
김창업	남	1969.08	부사장	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	SELA법인장	한양대	계열회사 임원	
김철기	남	1968.03	부사장	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	경북대	계열회사 임원	

김학상	남	1966.09	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발2실 담당임원	Univ. of Massachusetts, Lowell(박사)	계열회사 임원	
김한석	남	1968.07	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	인하대	계열회사 임원	
김현도	남	1966.04	부사장	상근	Mobile eXperience 구미지원센터장	생활가전 광주지원센터장	연세대(석사)	계열회사 임원	
김현우	남	1970.02	부사장	상근	반도체연구소 기술기획팀장	반도체연구소 공정개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
김형남	남	1965.06	부사장	상근	Global CS센터장	영상디스플레이 Global CS팀장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
김형섭	남	1966.01	부사장	상근	반도체연구소장	반도체연구소 메모리TD실장	Univ. of Texas, Austin(박사)	계열회사 임원	
김홍경	남	1965.11	부사장	상근	DS부문 경영지원실장	DS부문 경영지원실 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
김홍식	남	1969.09	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	인하대	계열회사 임원	
나기홍	남	1966.03	부사장	상근	인사팀장	인사팀 담당임원	고려대	계열회사 임원	
남석우	남	1966.03	부사장	상근	DS부문 CSO, 글로벌 제조&인프라총괄	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터장	연세대(박사)	계열회사 임원	
노원일	남	1967.08	부사장	상근	SRA연구소장	네트워크 상품전략팀장	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	
노형훈	남	1964.11	부사장	상근	생활가전 Global운영팀장	SEV법인장	고려대	계열회사 임원	
다니엘리	남	1969.12	부사장	상근	Samsung Research Global AI센터장	SRA 담당임원	MIT(박사)	계열회사 임원	46
더못라이언	남	1962.09	부사장	상근	DS부문 구조총괄	DS부문 구조총괄 담당임원	Limerick Regional Technical College	계열회사 임원	
데이브다스	남	1975.06	부사장	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	SEA 담당임원	Northwestern Univ.(석사)	계열회사 임원	
데이브리	남	1969.07	부사장	상근	Samsung NEXT장	Refactor Capital, Co-founder	New York Univ.(석사)	계열회사 임원	14
도현호	남	1967.10	부사장	상근	설비기술연구소 담당임원	Applied Materials, Managing Director	서울대(박사)	계열회사 임원	1
디페쉬	남	1969.06	부사장	상근	SRI-Bangalore연구소장	SRI-Bangalore 副연구소장	Indian Inst. of Management, Bangalore(석사)	계열회사 임원	
마크리퍼트	남	1973.02	부사장	상근	북미총괄 대외협력팀장	YouTube, APAC 대외협력총괄	Stanford Univ.(석사)	계열회사 임원	1
메노	남	1968.06	부사장	상근	SEF법인장	SEBN법인장	Haarlem Business School	계열회사 임원	
명호석	남	1967.04	부사장	상근	Mobile eXperience Global Mobile B2B팀 담당임원	SEA 담당임원	중앙대	계열회사 임원	
문성우	남	1971.12	부사장	상근	경영혁신센터장	경영혁신센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
문승도	남	1968.10	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발1실 담당임원	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	

문종승	남	1971.08	부사장	상근	생활가전 Global운영팀 담당임원	SEDA-P(M) 공장장	Georgia Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	
문준	남	1974.06	부사장	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발2팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
문창록	남	1971.01	부사장	상근	반도체연구소 CIS TD팀장	System LSI Sensor사업팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
문희동	남	1971.07	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	종합기술원 인사팀장	한양대	계열회사 임원	
민종술	남	1968.03	부사장	상근	영상디스플레이 Micro LED팀 담당임원	영상디스플레이 개발팀 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	
바우만	남	1966.05	부사장	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	SEUK법인장	Univ. of Bath(석사)	계열회사 임원	
박길재	남	1966.04	부사장	상근	Mobile eXperience 품질혁신센터장	무선 Global CS팀장	연세대(석사)	계열회사 임원	
박문호	남	1965.01	부사장	상근	인사팀 담당임원	경영진단팀 담당임원	성균관대	계열회사 임원	
박봉출	남	1964.01	부사장	상근	생활가전 구매팀장	영상디스플레이 구매팀 담당임원	송실대	계열회사 임원	
박성선	남	1965.08	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발2실 담당임원	충남대	계열회사 임원	
박성준	남	1971.01	부사장	상근	반도체연구소 공정개발실 담당임원	종합기술원 Material연구센터 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	
박성호	남	1968.09	부사장	상근	SIEL-P(N)공장장	네트워크 Global운영팀장	경북대(석사)	계열회사 임원	
박순철	남	1966.07	부사장	상근	Mobile eXperience 지원팀장	사업지원T/F 담당임원	연세대	계열회사 임원	
박용기	남	1963.04	부사장	상근	경영지원실장 보좌역	인사팀장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
박재홍	남	1965.01	부사장	상근	System LSI 담당임원	System LSI Custom SOC사업팀장	Univ. of Texas, Austin(박사)	계열회사 임원	
박정민	남	1972.03	부사장	상근	Mobile eXperience Global Mobile B2B팀 담당임원	Virginia Tech, 교수	Purdue Univ.(박사)	계열회사 임원	15
박정훈	남	1969.10	부사장	상근	Samsung Research Visual Technology팀장	Samsung Research Media Research팀장	한양대(석사)	계열회사 임원	
박제민	남	1971.12	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	Univ. of California, Berkeley(박사)	계열회사 임원	40
박진영	여	1971.11	부사장	상근	DS부문 구매팀 담당임원	DS부문 구매팀 담당부장	서울대	계열회사 임원	
박찬우	남	1973.05	부사장	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	생활가전 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	
박찬익	남	1972.04	부사장	상근	DS부문 미주총괄 담당임원	메모리 기획팀장	서울대(박사)	계열회사 임원	
박찬훈	남	1962.04	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌 제조&인프라총괄 담당임원	電氣通信大學(박사)	계열회사 임원	
박철우	남	1971.10	부사장	상근	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	Mattel, SVP	Harvard Univ.(석사)	계열회사 임원	32
박현정	남	1969.12	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	고려대	계열회사 임원	59



반효동	남	1967.06	부사장	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조 기술센터 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
배광진	남	1968.02	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	무선 개발2실 담당임원	금오공대	계열회사 임원	
배상우	남	1970.10	부사장	상근	메모리 품질보증실장	메모리 품질보증실 담당임원	Purdue Univ.(박사)	계열회사 임원	
배용철	남	1970.05	부사장	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	DS부문 중국총괄 담당임원	Harvard Univ.(박사수료)	계열회사 임원	
백수현	남	1963.01	부사장	상근	커뮤니케이션팀장	커뮤니케이션팀 담당임원	서울대	계열회사 임원	
부성종	남	1964.10	부사장	상근	경영혁신센터 담당임원	지원팀 담당임원	성균관대	계열회사 임원	
서병훈	남	1963.07	부사장	상근	IR팀장	IR팀 담당임원	Carnegie Mellon Univ.(박사 )	계열회사 임원	40
서장석	남	1967.08	부사장	상근	혁신센터 담당임원	System LSI S/W Architecture팀장	연세대(석사)	계열회사 임원	
서한석	남	1968.02	부사장	상근	SEDA-S판매부문장	무선 전략마케팅실 담당임원	George Washington Univ.(석사)	계열회사 임원	
서형석	남	1968.02	부사장	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	DS부문 중국총괄 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	
성일경	남	1964.01	부사장	상근	영상디스플레이 영상전략마케 팅팀장	CIS총괄	연세대	계열회사 임원	
손성원	남	1969.02	부사장	상근	북미총괄 지원팀장	무선 지원팀 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	
손영수	남	1974.02	부사장	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 전략마케팅실 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	59
송두근	남	1968.07	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 글로벌 발환경안전/인프라센터장	글로벌 제조&인프라총괄 환경 안전센터 담당임원	아주대(박사수료)	계열회사 임원	59
송두현	남	1964.01	부사장	상근	종합기술원 Device연구센터장	메모리제조기술센터 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
송명주	여	1970.02	부사장	상근	TSE-S 담당임원	생활가전 전략마케팅팀 담당임 원	서강대(석사)	계열회사 임원	
송용호	남	1967.04	부사장	상근	메모리 Solution개발실 담당임 원	메모리 전략마케팅팀 담당임원	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	36
송원득	남	1964.01	부사장	상근	DS부문 IP팀장	법무실 IP센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
송재혁	남	1967.08	부사장	상근	메모리 Flash개발실장	메모리 Flash개발실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
송철섭	남	1967.12	부사장	상근	Foundry CP실 담당임원	DS부문 중국총괄 담당임원	인하대	계열회사 임원	
스틴지아 노	남	1966.02	부사장	상근	SEA 불법인장	SEA 담당임원	Rutgers Univ.	계열회사 임원	
신경섭	남	1968.09	부사장	상근	반도체연구소 공정개발실 담당 임원	반도체연구소 공정개발실 수석 임원	Univ. of California, Berkeley(박사)	계열회사 임원	
신명훈	남	1965.01	부사장	상근	법무실 담당임원	법무팀 담당임원	Columbia Univ.(석사)	계열회사 임원	
신승철	남	1973.04	부사장	상근	Foundry CP실 담당임원	Foundry 전략마케팅실 담당임 원	연세대	계열회사 임원	

신승혁	남	1968.01	부사장	상근	법무실 IP센터 담당임원	Samsung Research IP출원팀장	Polytechnic Univ. of NY(박사)	계열회사 임원	
신영주	남	1969.09	부사장	상근	DS부문 구매팀 담당임원	메모리제조기술센터 담당임원	Purdue Univ.(박사)	계열회사 임원	
신유균	남	1965.02	부사장	상근	반도체연구소 공정개발실장	글로벌인프라총괄 메모리제조 기술센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
심상필	남	1965.05	부사장	상근	Foundry CP실장	Foundry 전략마케팅실장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
심은수	남	1966.10	부사장	상근	종합기술원 System연구센터장	DIT센터장	Columbia Univ.(박사)	계열회사 임원	
안길준	남	1969.01	부사장	상근	Mobile eXperience 모바일플랫폼 센터장	무선 개발실 담당임원	George Mason Univ.(박사)	계열회사 임원	59
안덕호	남	1968.07	부사장	상근	Compliance팀장	DS부문 법무지원팀장	서울대	계열회사 임원	
안상호	남	1965.03	부사장	상근	SESS법인장	TSP총괄 TP센터 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
안수진	여	1969.12	부사장	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	반도체연구소 메모리TD실 담당 임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	
안용일	남	1971.02	부사장	상근	CX·MDE센터 담당임원	디자인경영센터 담당임원	서강대(박사)	계열회사 임원	
안장혁	남	1967.12	부사장	상근	SEVT 담당임원	무선 지원팀 담당임원	육사	계열회사 임원	
안재용	남	1968.08	부사장	상근	DS부문 감사팀 담당임원	DS부문 상생협력센터 담당임원	성균관대	계열회사 임원	
안재우	남	1969.12	부사장	상근	중국전략협력실 담당임원	한국총괄 인사팀장	고려대	계열회사 임원	
안정착	남	1970.12	부사장	상근	System LSI Sensor사업팀 담당 임원	반도체연구소 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	
안중현	남	1963.03	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	기획팀 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
양걸	남	1962.10	부사장	상근	중국전략협력실 폐실장	DS부문 중국총괄	서강대(석사)	계열회사 임원	
양장규	남	1963.09	부사장	상근	설비기술연구소장	생산기술연구소장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
양준호	남	1971.02	부사장	상근	Mobile eXperience CX실 담당 임원	무선 디자인팀 담당임원	세종대	계열회사 임원	
양대종	남	1970.11	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	United Health Group, SVP	Arizona State Univ.(석사)	계열회사 임원	25
양혜순	여	1968.02	부사장	상근	생활가전 CX팀장	생활가전 상품전략팀장	Michigan State Univ.(박사)	계열회사 임원	53
임대현	남	1966.03	부사장	상근	법무실 송무팀장	법무실 담당임원	한양대	계열회사 임원	40
임재훈	남	1966.06	부사장	상근	DS부문 상생협력센터 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	
여명구	남	1970.10	부사장	상근	DS부문 인사팀 담당임원	조직문화개선T/F 담당임원	충북대	계열회사 임원	
여형민	남	1971.06	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	삼성SDS 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	40

오경석	남	1965.06	부사장	상근	TSP총괄 Package개발실 담당 임원	TSP총괄 Package개발실장	Univ. of Illinois, Urbana- Champaign(박사)	계열회사 임원	
오다니엘	남	1974.03	부사장	상근	IR팀팀장	Morrow Sodali, Managing Director	The Johns Hopkins Univ.(석사)	계열회사 임원	2
오중훈	남	1969.10	부사장	상근	메모리 지원팀장	DS부문 미주총괄 담당임원	Purdue Univ.(석사)	계열회사 임원	
오치오	남	1967.01	부사장	상근	한국총괄 B2B영업팀장	한국총괄 B2B영업팀 담당임원	건국대(석사)	계열회사 임원	
왕통	남	1962.06	부사장	상근	중국전략협력실 담당임원	SCIC 담당임원	北京郵電大	계열회사 임원	
용석우	남	1970.09	부사장	상근	영상디스플레이 개발팀장	영상디스플레이 개발팀 부팀장	Polytechnic Univ. of NY(석 사)	계열회사 임원	
우영돈	남	1974.01	부사장	상근	법무실 담당임원	무선 지원팀 담당임원	한양대	계열회사 임원	
원성근	남	1968.05	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 평택사업장 담당임원	경북대	계열회사 임원	
원종현	남	1967.05	부사장	상근	영상디스플레이 지원팀장	영상디스플레이 지원팀 담당임 원	성균관대	계열회사 임원	
유미영	여	1968.07	부사장	상근	생활가전 개발팀 담당임원	영상디스플레이 개발팀 담당임 원	포항공대(석사)	계열회사 임원	
유병길	남	1970.09	부사장	상근	Mobile eXperience 전략기획팀 장	무선 전략마케팅실 담당임원	Univ. of Virginia(석사)	계열회사 임원	
유승호	남	1968.06	부사장	상근	지원팀 담당임원	생활가전 지원팀 담당임원	연세대	계열회사 임원	
유창식	남	1969.12	부사장	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	한양대, 교수	서울대(박사)	계열회사 임원	17
윤장현	남	1968.12	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	무선 서비스사업실 담당임원	Georgia Inst. of Tech.(박 사)	계열회사 임원	
윤종덕	남	1969.04	부사장	상근	커뮤니케이션팀 담당임원	커뮤니케이션팀 담당부장	고려대(석사)	계열회사 임원	
윤종식	남	1961.09	부사장	상근	Foundry CTO	Foundry 기술개발실장	Univ. of California, LA(박 사)	계열회사 임원	
윤준오	남	1967.06	부사장	상근	기획팀 담당임원	네트워크 기획팀장	건국대	계열회사 임원	
윤철운	남	1962.11	부사장	상근	SEHC법인장	영상디스플레이 Global운영팀 장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
윤대양	남	1968.12	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모 리제조기술센터장	글로벌인프라총괄 평택사업장	고려대(석사)	계열회사 임원	
이강협	남	1962.12	부사장	상근	생활가전 전략마케팅팀장	한국총괄 CE영업팀장	고려대	계열회사 임원	
이계성	남	1967.11	부사장	상근	법무실 해외법무팀장	구주총괄 대외협력팀장	St. Louis Univ.(석사)	계열회사 임원	
이광렬	남	1969.02	부사장	상근	영상디스플레이 Global CS팀장	Global CS센터 담당임원	한양대	계열회사 임원	
이광현	남	1971.06	부사장	상근	인사팀 담당임원	북미총괄 인사팀장	연세대	계열회사 임원	
이규열	남	1966.05	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 TP센 터장	TSP총괄 TP센터장	항공대	계열회사 임원	

이규필	남	1961.05	부사장	상근	DS부문 인사팀 담당임원	반도체연구소 메모리TD실장	Univ. of Florida(박사)	계열회사 임원	
이규호	남	1969.06	부사장	상근	인사팀 담당임원	영상디스플레이 인사팀장	서강대	계열회사 임원	
이근호	남	1970.02	부사장	상근	혁신센터 담당임원	DIT센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
이기수	남	1964.07	부사장	상근	생활가전 Global CS팀장	생활가전 개발팀장	한양대(석사)	계열회사 임원	
이기호	남	1964.06	부사장	상근	SAVINA-S법인장	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	성균관대	계열회사 임원	
이길호	남	1966.03	부사장	상근	상생협력센터 담당임원	삼성생명 기획1팀장	연세대	계열회사 임원	16
이동기	남	1969.05	부사장	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	DIT센터 담당임원	Univ. of California, San Diego(박사)	계열회사 임원	
이동우	남	1967.06	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	메모리 지원팀장	경북대	계열회사 임원	
이무형	남	1970.02	부사장	상근	생활가전 개발팀장	생활가전 개발팀 담당임원	Purdue Univ.(박사)	계열회사 임원	
이병국	남	1965.11	부사장	상근	SEVT법인장	SVCC장	부산대	계열회사 임원	
이병준	남	1968.01	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	삼성전기 경영지원실장	경희대(석사)	계열회사 임원	27
이병철	남	1965.10	부사장	상근	상생협력센터 담당임원	중국전략협력실 담당임원	淸華大(석사)	계열회사 임원	
이상도	남	1969.03	부사장	상근	SEA 담당임원	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	City Univ. of New York(석사)	계열회사 임원	
이상우	남	1972.11	부사장	상근	법무실 담당임원	법무팀 담당임원	연세대	계열회사 임원	
이상재	남	1965.12	부사장	상근	TSP총괄 품질팀장	TSP총괄 TP센터 담당임원	홍익대	계열회사 임원	
이상주	남	1970.09	부사장	상근	법무실 담당임원	법무실 Compliance팀장	Harvard Univ.(석사)	계열회사 임원	
이상현	남	1966.05	부사장	상근	Foundry Design Platform개발실장	메모리 Design Platform개발실장	서울대(박사)	계열회사 임원	
이석준	남	1965.07	부사장	상근	System LSI LSI개발실장	System LSI SOC개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
이성민	남	1964.09	부사장	상근	DS부문 동남아총괄	System LSI 전략마케팅팀 담당임원	성균관대	계열회사 임원	
이성수	남	1964.11	부사장	상근	DS부문 감사팀장	메모리 품질보증실 담당임원	경희대	계열회사 임원	
이승구	남	1969.08	부사장	상근	인사팀 담당임원	SEG 담당임원	성균관대	계열회사 임원	
이승욱	남	1967.02	부사장	상근	전자사업팀장	사업지원T/F 담당임원	Univ. of Akron(박사)	계열회사 임원	
이시영	남	1972.04	부사장	상근	Mobile eXperience CX실 담당임원	무선 개발실 담당임원	Univ. of Sussex(석사)	계열회사 임원	
이양우	남	1972.02	부사장	상근	영상디스플레이 Enterprise Business팀 부팀장	KNOWCK, 공동대표	Univ. of Colorado(석사)	계열회사 임원	13

이영수	남	1972.01	부사장	상근	SEVT 담당임원	글로벌기술센터 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
이영희	여	1964.11	부사장	상근	글로벌마케팅센터장	무선 마케팅팀장	Northwestern Univ.(석사)	계열회사 임원	
이왕익	남	1963.07	부사장	상근	재경팀 담당임원	삼성생명 지원팀 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
이우섭	남	1966.05	부사장	상근	Mobile eXperience 구매팀장	무선 구매팀 담당임원	성균관대	계열회사 임원	
이원준	남	1970.02	부사장	상근	재경팀 담당임원	중동총괄 지원팀장	연세대	계열회사 임원	
이은철	남	1965.07	부사장	상근	Foundry 품질팀장	Foundry 제품기술팀장	광운대	계열회사 임원	
이재범	남	1970.10	부사장	상근	영상디스플레이 기획팀장	영상디스플레이 지원팀 담당임원	홍익대	계열회사 임원	
이재열	남	1970.01	부사장	상근	System LSI LSI개발실 담당임원	System LSI LSI개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	40
이제현	남	1970.04	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	삼성디스플레이 경영지원실 담당임원	광운대	계열회사 임원	52
이종명	남	1970.03	부사장	상근	반도체연구소 공정개발실 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조 기술센터 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
이종열	남	1970.02	부사장	상근	혁신센터장	메모리 Solution개발실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
이종철	남	1968.01	부사장	상근	Compliance팀 담당임원	북미총괄 법무지원팀장	Univ. of Pennsylvania(석사)	계열회사 임원	
이주영	남	1966.07	부사장	상근	메모리 DRAM개발실장	반도체연구소 메모리TD실 담당임원	Univ. of California, LA(박사)	계열회사 임원	
이준현	남	1965.05	부사장	상근	생활가전 선행개발팀장	SRA연구소장	Univ. of Cincinnati(박사)	계열회사 임원	
이준화	남	1972.03	부사장	상근	TSE-P법인장	생활가전 개발팀 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
이준희	남	1969.03	부사장	상근	네트워크 개발팀장	네트워크 개발팀 담당임원	MIT(박사)	계열회사 임원	
이진엽	남	1970.02	부사장	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 수석	서강대(석사)	계열회사 임원	
이창수	남	1971.07	부사장	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	메모리 전략마케팅팀 담당임원	경희대	계열회사 임원	
이청용	남	1968.12	부사장	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	SGE법인장	MIT(석사)	계열회사 임원	
이충순	남	1967.09	부사장	상근	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	SERC 담당임원	고려대	계열회사 임원	
이태관	남	1971.12	부사장	상근	법무실 담당임원	삼성물산 법무팀 담당임원	George Washington Univ.(석사)	계열회사 임원	58
이학민	남	1972.04	부사장	상근	네트워크 지원팀장	사업지원T/F 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
이해창	남	1975.10	부사장	상근	System LSI Sensor사업팀 담당임원	Google, Sensor Team Lead	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	18
이현	남	1969.02	부사장	상근	TSE-S법인장	무선 전략마케팅실 담당임원	Syracuse Univ.(석사)	계열회사 임원	

이흥모	남	1962.10	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Samsung Research IP출원팀장	Franklin Pierce Law Center(석사)	계열회사 임원	
임건	남	1970.03	부사장	상근	반도체연구소 Logic TD실 담당임원	Qualcomm, Sr. Director Engineer	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	25
임병일	남	1970.01	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	삼성증권 기업금융1본부장	Univ. of Chicago(석사)	계열회사 임원	4
임석환	남	1974.11	부사장	상근	System LSI 담당임원	System LSI 기반설계실 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	39
임성택	남	1966.06	부사장	상근	중동총괄	SEI법인장	연세대	계열회사 임원	
임준서	남	1968.08	부사장	상근	System LSI Sensor사업팀장	System LSI Sensor사업팀 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
장문석	남	1969.03	부사장	상근	Mobile eXperience Global운영팀장	SIEL-P(N)공장장	항공대	계열회사 임원	
장성대	남	1964.08	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 환경안전센터장	글로벌인프라총괄 환경안전센터장	동국대	계열회사 임원	
장성재	남	1965.06	부사장	상근	생활가전 지원팀장	사업지원T/F 담당임원	서강대	계열회사 임원	
장성진	남	1965.07	부사장	상근	TSP총괄	메모리 품질보증실장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
장세연	남	1967.01	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술훈련센터 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조기술훈련센터 담당임원	광운대	계열회사 임원	
장우승	남	1970.02	부사장	상근	Big Data센터장	무선 차세대플랫폼센터 담당임원	Univ. of California, Berkeley(박사)	계열회사 임원	36
장재혁	남	1967.10	부사장	상근	DS부문 중국총괄	메모리 전략마케팅실 담당임원	淸華大(석사)	계열회사 임원	
장재훈	남	1969.07	부사장	상근	반도체연구소 메모리 TD실 담당임원	SCS 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
장종산	남	1964.12	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 환경안전연구소장	글로벌인프라총괄 환경안전연구소장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	24
장호영	남	1968.01	부사장	상근	네트워크 구매팀장	네트워크 Global운영팀 담당임원	경북대	계열회사 임원	
장호진	남	1970.09	부사장	상근	법무실 IP센터 담당임원	법무실 IP센터 책임변호사	Duke Univ.(석사)	계열회사 임원	
전경빈	남	1966.12	부사장	상근	로봇사업팀장	로봇사업화T/F장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
전병준	남	1966.02	부사장	상근	SEUK법인장	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	성균관대	계열회사 임원	
전준영	남	1962.05	부사장	상근	DS부문 구매팀장	System LSI 기획팀장	성균관대	계열회사 임원	
전충삼	남	1965.08	부사장	상근	반도체연구소 공정개발실 담당임원	메모리제조센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
정광열	남	1965.09	부사장	상근	DS부문 커뮤니케이션팀 담당임원	DS부문 커뮤니케이션팀장	연세대(석사)	계열회사 임원	
정기봉	남	1970.01	부사장	상근	DS부문 IP팀 담당임원	제일국제법률사무소 변호사	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	16
정기태	남	1965.09	부사장	상근	Foundry 기술개발실장	Foundry 기술개발실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	

정상섭	남	1966.11	부사장	상근	SAS법인장	글로벌인프라총괄 Foundry제조 기술센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
정서형	남	1967.05	부사장	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발2팀 담당임원	Univ. of Wisconsin, Madison(석사)	계열회사 임원	
정완영	남	1965.05	부사장	상근	DS부문 상생협력센터장	DS부문 중국총괄 담당임원	고려대	계열회사 임원	
정윤	남	1967.05	부사장	상근	SEA 담당임원	SEDA-S판매부문장	서울대(박사)	계열회사 임원	
정재웅	남	1969.02	부사장	상근	DS부문 커뮤니케이션팀장	커뮤니케이션팀 담당임원	국민대(석사)	계열회사 임원	
정재현	남	1962.09	부사장	상근	DS부문 미주총괄	메모리 Flash개발실장	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	
정해린	남	1964.11	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	무선 지원팀 담당임원	고려대	계열회사 임원	38
정혁준	남	1972.05	부사장	상근	System LSI SOC개발실 담당임 원	Qualcomm, Principal Engineer	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	16
정현준	남	1964.06	부사장	상근	영상디스플레이 Micro LED팀장	영상디스플레이 개발팀 담당임 원	한양대	계열회사 임원	
정호진	남	1971.05	부사장	상근	한국총괄 IM영업팀 담당임원	한국총괄 CE영업팀장	Rutgers Univ.(석사)	계열회사 임원	
조기재	남	1967.01	부사장	상근	DS부문 지원팀장	사업지원T/F 담당임원	Babson College(석사)	계열회사 임원	
조명호	남	1969.05	부사장	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임 원	감사팀 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	
조상연	남	1971.12	부사장	상근	메모리 Solution개발실 담당임 원	System LSI A-Project팀장	Univ. of Minnesota, Twin Cities(박사)	계열회사 임원	
조상호	남	1965.02	부사장	상근	동남아총괄	구주총괄	경희대	계열회사 임원	
조성혁	남	1970.05	부사장	상근	영상디스플레이 영상전략마케 팅팀 담당임원	SEA 담당임원	Univ. of California, Berkeley(석사)	계열회사 임원	
조시정	남	1969.11	부사장	상근	Mobile eXperience 인사팀장	인사팀 담당임원	경희대	계열회사 임원	
조영준	남	1971.05	부사장	상근	북미총괄 인사팀장	네트워크 인사팀장	성균관대	계열회사 임원	
조인하	여	1974.02	부사장	상근	SENA법인장	영상디스플레이 영상전략마케 팅팀 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	
조필주	남	1971.07	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 지원 팀장	종합기술원 기획지원팀장	서울대(박사)	계열회사 임원	
조홍상	남	1966.06	부사장	상근	중남미총괄	SEF법인장	연세대	계열회사 임원	
주드버클 리	남	1970.05	부사장	상근	SEA 담당임원	SEA EVP	Queensland Univ.(석사)	계열회사 임원	4
주영수	남	1965.08	부사장	상근	성균관대(파견)	삼성생명서비스 고객지원실 담 당임원	성균관대	계열회사 임원	27
주은기	남	1962.01	부사장	상근	상생협력센터장	상생협력센터 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
주창훈	남	1970.10	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	인사팀 담당임원	아주대(석사)	계열회사 임원	

주혁	남	1971.10	부사장	상근	종합기술원 Device연구센터 담당임원	종합기술원 Device & System연구센터 담당임원	Univ. of California, Berkeley(박사)	계열회사 임원	46
지현기	남	1968.01	부사장	상근	메모리 기획팀장	SCS 담당임원	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(석사)	계열회사 임원	
짐엘리엇	남	1970.11	부사장	상근	DS부문 미주총괄 담당임원	미주총괄 VP	California Polytechnic State Univ.	계열회사 임원	
차병석	남	1968.11	부사장	상근	커뮤니케이션팀 담당임원	삼성경제연구소 연구조정실 담당임원	Helsinki Sch. Of Economics & Business Administration(석사)	계열회사 임원	7
채원철	남	1966.05	부사장	상근	Mobile eXperience CX실 부실장	무선 상품전략팀장	광운대	계열회사 임원	
최강석	남	1965.12	부사장	상근	Mobile eXperience Global Mobile B2B팀장	무선 Global Mobile B2B팀 담당임원	Univ. of California, Irvine	계열회사 임원	29
최경세	남	1969.04	부사장	상근	TSP총괄 Package개발실장	TSP총괄 Package개발실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
최광보	남	1971.03	부사장	상근	사업지원T/F 담당임원	북미총괄 지원팀장	부산대	계열회사 임원	
최기환	남	1970.01	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 TP센터 담당임원	TSP총괄 TP센터 담당임원	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	
최길현	남	1966.10	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터장	글로벌인프라총괄 Foundry제조기술센터장	한양대(석사)	계열회사 임원	
최방섭	남	1963.04	부사장	상근	Mobile eXperience 전략마케팅 실장	SEA 담당임원	서울대	계열회사 임원	
최성현	남	1970.05	부사장	상근	Samsung Research 차세대통신연구센터장	서울대, 교수	Univ. of Michigan, Ann Arbor(박사)	계열회사 임원	31
최수영	남	1965.11	부사장	상근	동남아총괄 지원팀장	중남미총괄 지원팀장	고려대	계열회사 임원	
최승걸	남	1968.12	부사장	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터장	글로벌인프라총괄 인프라기술센터장	서울시립대	계열회사 임원	
최승범	남	1964.12	부사장	상근	Samsung Research 기술전략팀장	소프트웨어센터 S/W전략팀장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
최승식	남	1966.01	부사장	상근	중국총괄	무선 전략마케팅실 담당임원	고려대	계열회사 임원	
최승은	여	1969.07	부사장	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	무선 GDC센터 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	
최원우	남	1965.02	부사장	상근	DS부문 인사팀장	메모리 인사팀장	서강대	계열회사 임원	
최용원	남	1968.05	부사장	상근	설비기술연구소 설비개발실장	생산기술연구소 설비개발실장	고려대(석사)	계열회사 임원	
최용훈	남	1969.07	부사장	상근	영상디스플레이 Global운영팀장	영상디스플레이 개발팀장	고려대	계열회사 임원	
최원준	남	1970.09	부사장	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발2실 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	
최윤준	남	1967.09	부사장	상근	LED사업팀장	LED사업팀 담당임원	MIT(박사)	계열회사 임원	
최익수	남	1967.05	부사장	상근	SESA법인장	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(석사)	계열회사 임원	



최정준	남	1965.08	부사장	상근	지원팀장	지원팀 담당임원	성균관대	계열회사 임원	
최주호	남	1963.03	부사장	상근	베트남복합단지장	무선 인사팀장	아주대(석사)	계열회사 임원	
최중열	남	1967.06	부사장	상근	생활가전 담당임원	생활가전 디자인팀장	서울대(석사)	계열회사 임원	
최진원	남	1966.09	부사장	상근	재경팀 담당임원	재경팀 담당부장	서울대	계열회사 임원	
최진혁	남	1967.02	부사장	상근	메모리 Solution개발실장	메모리 Design Platform개발실 장	서울대(박사)	계열회사 임원	
최창규	남	1970.03	부사장	상근	종합기술원 AI연구센터장	종합기술원 AI&SW연구센터장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
추종석	남	1962.09	부사장	상근	구주총괄	영상디스플레이 영상전략마케 팅팀장	Univ. of Missouri, Columbia(석사)	계열회사 임원	
패트릭쇼 메	남	1964.05	부사장	상근	Mobile eXperience CX실장	무선 서비스사업실 담당임원	Institut d administration des entreprises(석사)	계열회사 임원	
피재걸	남	1964.04	부사장	상근	System LSI 전략마케팅실장	System LSI 전략마케팅실 담당 임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
하혜승	여	1967.11	부사장	상근	영상디스플레이 Enterprise Business팀장	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당임원	Wellesley College	계열회사 임원	
한상숙	여	1966.07	부사장	상근	영상디스플레이 Service Business팀 부팀장	영상디스플레이 Service Business팀 담당임원	Northwestern Univ.(석사)	계열회사 임원	
한승훈	남	1965.07	부사장	상근	DS부문 미주총괄 담당임원	Foundry 전략마케팅실 담당임 원	Iowa State Univ.(박사)	계열회사 임원	
한인택	남	1966.10	부사장	상근	종합기술원 Material연구센터장	종합기술원 Material연구센터 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
한지니	여	1969.04	부사장	상근	Mobile eXperience Digital Life팀장	무선 Digital Wallet팀장	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	19
한진만	남	1966.10	부사장	상근	메모리 전략마케팅실장	메모리 전략마케팅실 담당임원	서울대	계열회사 임원	
허길영	남	1965.08	부사장	상근	DS부문 재경팀장	DS부문 재경팀 담당임원	아주대(석사)	계열회사 임원	
허석	남	1973.10	부사장	상근	DS부문 기획팀장	DS부문 기획팀 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	
허성희	남	1969.01	부사장	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	반도체연구소 메모리TD실 담당 임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
허운행	남	1969.08	부사장	상근	System LSI SOC개발실 담당임 원	System LSI SOC개발실 담당임 원	Georgia Inst. of Tech.(박 사)	계열회사 임원	
홍기재	남	1969.06	부사장	상근	법무실 담당임원	법무법인 다전, 변호사	한양대	계열회사 임원	9
홍두희	남	1964.02	부사장	상근	감사팀장	무선 지원팀장	Wake Forest Univ.(석사)	계열회사 임원	
홍범석	남	1968.06	부사장	상근	아프리카총괄	Iran지점장	중앙대	계열회사 임원	
홍성희	남	1966.02	부사장	상근	DS부문 구매팀 담당임원	DS부문 일본총괄 담당임원	서강대	계열회사 임원	
홍유진	여	1972.05	부사장	상근	Mobile eXperience CX실 담당 임원	무선 Mobile UX센터 담당임원	Univ. of California, LA(석 사)	계열회사 임원	

홍형선	남	1963.08	부사장	상근	반도체연구소 메모리 TD실장	반도체연구소 메모리TD실 담당 임원	인하대(석사)	계열회사 임원	
황기현	남	1967.06	부사장	상근	반도체연구소 공정개발실 담당 임원	반도체연구소 공정개발실 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	
황상준	남	1972.01	부사장	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 전략마케팅실 담당임원	고려대(박사)	계열회사 임원	
황대환	남	1968.04	부사장	상근	한국총괄 CE영업팀장	생활가전 전략마케팅실 담당임 원	경희대	계열회사 임원	
황하섭	남	1964.03	부사장	상근	SCS법인장	SCS 담당임원	인하대	계열회사 임원	
강건혁	남	1978.11	상무	상근	System LSI 기반설계실 담당임 원	Qualcomm, Principal Manager	Purdue Univ.(박사)	계열회사 임원	7
강도희	남	1974.12	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	무선 품질혁신센터 담당임원	경북대(석사)	계열회사 임원	40
강동구	남	1976.12	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 수석	Purdue Univ.(박사)	계열회사 임원	40
강동우	남	1971.04	상무	상근	TSP총괄 Package개발실 담당 임원	TSP총괄 TP센터 담당임원	한양대(석사)	계열회사 임원	27
강동훈	남	1970.12	상무	상근	DS부문 법무지원팀 담당임원	법무실 담당임원	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	
강민석	남	1976.10	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당 임원	무선 CX실 담당부장	서울대(석사)	계열회사 임원	4
강병욱	남	1967.02	상무	상근	한국총괄 CE영업팀 담당임원	한국총괄 CE영업팀 담당부장	고려대	계열회사 임원	27
강상범	남	1969.02	상무	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	반도체연구소 Logic TD실 담당 임원	Stevens Inst. of Tech.(박 사)	계열회사 임원	
강상용	남	1972.09	상무	상근	전장사업팀 담당임원	SEG 담당임원	Univ. of Pennsylvania(석사 )	계열회사 임원	40
강석채	남	1971.06	상무	상근	DS부문 미주총괄 담당임원	Foundry 전략마케팅실 담당임 원	Georgia Inst. of Tech.(박 사)	계열회사 임원	53
강성욱	남	1971.05	상무	상근	지원팀 담당임원	SEUK 담당부장	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	27
강신광	남	1968.08	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 환경 안전센터 담당임원	글로벌인프라총괄 환경안전센 터 담당임원	아주대(석사)	계열회사 임원	12
강윤경	여	1968.12	상무	상근	인사팀 담당임원	Samsung Research 창의개발 센터 담당임원	Univ. of Michigan, Ann Arbor(석사)	계열회사 임원	53
강은경	여	1972.08	상무	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임 원	영상디스플레이 개발팀 수석	성균관대(석사)	계열회사 임원	4
강재원	남	1967.07	상무	상근	경영혁신센터 담당임원	경영혁신팀 담당부장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	59
강정대	남	1970.09	상무	상근	상생협력센터 담당임원	상생협력센터 담당부장	한국방송통신대	계열회사 임원	53
강진선	남	1975.09	상무	상근	한국총괄 CE영업팀 담당임원	한국총괄 CE영업팀 담당부장	한국외국어대	계열회사 임원	4
강태규	남	1972.01	상무	상근	IR팀 담당임원	IR그룹 담당임원	Indiana Univ., Bloomington(석사)	계열회사 임원	53
강태우	남	1973.10	상무	상근	재경팀 담당임원	재경팀 담당부장	고려대	계열회사 임원	40

강희성	남	1970.08	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조 기술센터 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	53
고경민	남	1975.03	상무	상근	System LSI Sensor사업팀 담당 임원	System LSI LSI개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	53
고광현	남	1968.08	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Intel, Senior Technical Staff	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	45
고승범	남	1971.07	상무	상근	DS부문 중국총괄 담당임원	메모리 Design Platform개발실 담당임원	아주대	계열회사 임원	40
고알시드	남	1977.12	상무	상근	글로벌마케팅센터 담당임원	Accenture, Mng. Director	Univ. of Sydney(석사)	계열회사 임원	20
고영관	남	1972.06	상무	상근	TSP총괄 Package개발실 담당 임원	삼성전기 중앙연구소 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	34
고유상	남	1969.05	상무	상근	경영지원실 담당임원	삼성경제연구소 담당임원	성균관대(박사)	계열회사 임원	16
고의중	남	1972.02	상무	상근	법무실 담당임원	법무실 수석변호사	서울대	계열회사 임원	4
고정욱	남	1976.02	상무	상근	한국총괄 IM영업팀 담당임원	한국총괄 IM영업팀 담당부장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	27
고주현	남	1974.08	상무	상근	System LSI Sensor사업팀 담당 임원	System LSI Sensor사업팀 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	16
고택균	남	1971.05	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	DS부문 중국총괄 담당부장	서강대	계열회사 임원	16
고형석	남	1972.09	상무	상근	SEA 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	Case Western Reserve Univ.(석사)	계열회사 임원	40
공병진	남	1971.09	상무	상근	SIEL-P(C) 공장장	생활가전 Global운영팀 담당부장	항공대	계열회사 임원	16
곽진환	남	1968.01	상무	상근	종합기술원 미래기술육성센터 장	SRIL연구소장	Santa Clara Univ.(석사)	계열회사 임원	
구관본	남	1975.01	상무	상근	System LSI LSI개발실 담당임원	On Semiconductor, Director	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	9
구봉진	여	1971.05	상무	상근	반도체연구소 공정개발실 담당 임원	반도체연구소 공정개발실 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	16
구윤본	남	1970.02	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조 기술센터 담당임원	한양대	계열회사 임원	40
구자천	남	1981.04	상무	상근	사업지원T/F 담당임원	System LSI 기획팀장	Northwestern Univ.(박사)	계열회사 임원	30
권기덕	남	1972.07	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	SCS 담당임원	경북대(석사)	계열회사 임원	40
권기덕	남	1977.10	상무	상근	법무실 담당임원	DS부문 법무지원팀 수석변호사	서울대	계열회사 임원	16
권기덕	여	1974.10	상무	상근	기획팀 담당임원	기획팀 담당부장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	16
권상욱	남	1968.08	상무	상근	Samsung Research Smart Device팀 담당임원	SRUK연구소장	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	53
권순범	남	1976.09	상무	상근	법무실 담당임원	법무실 수석변호사	연세대(석사)	계열회사 임원	27
권영재	남	1972.05	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	한양대(석사)	계열회사 임원	16

권영훈	남	1972.02	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	NXP, Technical Director	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	9
권오경	남	1977.08	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조 기술센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	16
권오상	남	1967.04	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	무선 개발2실 담당임원	Univ. of Texas, Austin(박 사)	계열회사 임원	
권오수	남	1968.04	상무	상근	Mobile eXperience 지원팀 담 당임원	SEA 담당임원	성균관대	계열회사 임원	
권진현	남	1968.07	상무	상근	System LSI Sensor사업팀 담당 임원	System LSI Sensor사업팀 담당 부장	Thunderbird(석사)	계열회사 임원	40
권춘기	남	1969.04	상무	상근	SEEG-P법인장	SEHC 담당부장	포항공대	계열회사 임원	16
권대훈	남	1971.02	상무	상근	경영혁신센터 담당임원	경영혁신센터 담당부장	서울대(석사)	계열회사 임원	16
권혁만	남	1973.06	상무	상근	System LSI 전략마케팅실 담당 임원	System LSI 상품기획팀 담당임 원	서울대(석사)	계열회사 임원	27
권형석	남	1973.02	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	DS부문 동남아총괄 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	53
권호범	남	1975.12	상무	상근	Samsung Research Platform팀 담당임원	Samsung Research Platform팀 수석	New York Univ., Tandon School of Engineering(석 사)	계열회사 임원	16
길대호	남	1977.11	상무	상근	Samsung Research Security & Privacy팀 담당임원	Samsung Research Security팀 담당임원	Univ. of Michigan, Ann Arbor(박사)	계열회사 임원	39
김강수	남	1966.09	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 환경 안전센터 담당임원	글로벌인프라총괄 인프라QA팀 장	성균관대	계열회사 임원	
김건우	남	1976.01	상무	상근	SEH-P 담당임원	영상디스플레이 지원팀 담당부 장	MIT(석사)	계열회사 임원	4
김경륜	남	1983.02	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	4
김경준	남	1969.01	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	DS부문 미주총괄 담당임원	광운대	계열회사 임원	40
김경태	남	1973.12	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모 리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조 기술센터 담당임원	부산대	계열회사 임원	16
김광연	남	1965.07	상무	상근	생활가전 개발팀 담당임원	영상디스플레이 개발팀 담당임 원	연세대(석사)	계열회사 임원	
김광익	남	1974.09	상무	상근	DS부문 지원팀 담당임원	글로벌인프라총괄 펌웨어사업장 부장	한양대	계열회사 임원	4
김구영	남	1975.03	상무	상근	TSP총괄 Package개발실 담당 임원	TSP총괄 Package개발실 수석 임원	연세대(석사)	계열회사 임원	4
김규태	남	1970.12	상무	상근	생활가전 구매팀 담당임원	생활가전 Global운영팀 담당임 원	RPI(석사)	계열회사 임원	42
김기건	남	1964.02	상무	상근	영상디스플레이 Global CS팀 담당임원	영상디스플레이 Global CS팀 담당부장	광운대	계열회사 임원	
김기남	남	1964.08	상무	상근	종합기술원 Material연구센터 담당임원	DMC연구소 ECO Solution팀 담당임원	Stevens Inst. of Tech.(박 사)	계열회사 임원	
김기삼	남	1965.11	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모 리제조기술센터 담당임원	DS부문 지원팀 담당임원	아주대(석사)	계열회사 임원	

김기수	남	1970.02	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조 기술센터 담당임원	성균관대	계열회사 임원	53
김기호	남	1966.03	상무	상근	SRA 담당임원	SRI-Delhi연구소장	George Washington Univ.(석사)	계열회사 임원	
김기환	남	1975.03	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	NVIDIA, Principal Research Scientist	Georgia Inst. of Tech.(박 사)	계열회사 임원	24
김대신	남	1970.03	상무	상근	혁신센터 담당임원	DIT센터 담당임원	Georgia Inst. of Tech.(박 사)	계열회사 임원	40
김대우	남	1970.03	상무	상근	TSP총괄 Package개발실 담당 임원	반도체연구소 Package개발팀 담당임원	연세대(박사)	계열회사 임원	53
김대주	남	1969.10	상무	상근	서남아총괄 지원팀장	지원팀 담당임원	Univ. of Illinois, Urbana- Champaign(석사)	계열회사 임원	
김대현	남	1974.06	상무	상근	Samsung Research Platform팀 담당임원	Samsung Research Media Research팀 담당임원	Cornell Univ.(박사)	계열회사 임원	58
김덕현	남	1975.06	상무	상근	상생협력센터 담당임원	메타볼라이트, Co-Founder	고려대	계열회사 임원	26
김덕호	남	1970.11	상무	상근	생활가전 개발팀 담당임원	SRI-Delhi연구소장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	27
김동근	남	1976.07	상무	상근	System LSI SOC개발실 담당임 원	System LSI SOC개발실 수석 원	Univ. of Maryland, College Park(박사)	계열회사 임원	4
김동수	남	1975.10	상무	상근	반도체연구소 인사팀장	DS부문 인사팀 부장	Univ. of Maryland, College Park(석사)	계열회사 임원	4
김동욱	남	1969.06	상무	상근	TSP총괄 Package개발실 담당 임원	Test&Package센터 담당임원	Univ. of California, Irvine(박사)	계열회사 임원	48
김동준	남	1973.05	상무	상근	TSLED법인장	글로벌인프라총괄 LED기술센 터 담당임원	광주과학기술원(박사)	계열회사 임원	59
김래훈	남	1975.07	상무	상근	System LSI 기반설계실 담당임 원	Qualcomm, Principal Engineer	Univ. of Illinois, Urbana- Champaign(박사)	계열회사 임원	12
김릉	남	1971.12	상무	상근	인사팀 담당임원	무선 인사팀 담당임원	중앙대	계열회사 임원	16
김명오	남	1972.09	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	연세대(석사)	계열회사 임원	16
김무성	남	1975.12	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 수석	포항공대(석사)	계열회사 임원	4
김로수	남	1977.12	상무	상근	SRI-Delhi연구소장	영상디스플레이 개발팀 담당임 원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	16
김민우	남	1978.06	상무	상근	SESP법인장	SAPL법인장	한양대	계열회사 임원	16
김범진	남	1975.02	상무	상근	SEAU 담당임원	SERC 담당임원	Southern Illinois Univ.(석사 )	계열회사 임원	40
김병우	남	1968.03	상무	상근	SEA 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	경북대	계열회사 임원	
김보성	남	1974.04	상무	상근	Samsung Research 담당임원	Awair, CDO	Royal Collge of Art(석사)	계열회사 임원	1
김보현	남	1973.02	상무	상근	Samsung Research 인사팀장	TSP총괄 인사팀장	서강대(석사)	계열회사 임원	53
김봉수	남	1971.06	상무	상근	반도체연구소 메모리 TD실 담 당임원	반도체연구소 메모리TD실 수석	고려대(석사)	계열회사 임원	16

김상윤	남	1972.01	상무	상근	SECE법인장	SECE 담당부장	인하대	계열회사 임원	16
김상윤	남	1969.10	상무	상근	Foundry Design Platform개발 실 담당임원	Synopsys, Technical Member	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	26
김상호	남	1967.10	상무	상근	SRA 담당임원	네트워크 지원팀 담당임원	Duke Univ.(석사)	계열회사 임원	
김상훈	남	1968.02	상무	상근	SEI 담당임원	SENA 담당임원	건국대	계열회사 임원	53
김석희	남	1971.11	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 인프라기술 센터 담당임원	부산대(석사)	계열회사 임원	16
김선정	남	1973.02	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조 기술센터 수석	National Univ. of Singapore(박사)	계열회사 임원	4
김성구	남	1975.01	상무	상근	Mobile eXperience 전략기획팀 담당임원	사업지원T/F 담당부장	Duke Univ.(석사)	계열회사 임원	16
김성권	남	1971.02	상무	상근	디자인경영센터 담당임원	디자인경영센터 수석	홍익대	계열회사 임원	40
김성기	남	1968.11	상무	상근	Mobile eXperience 품질혁신센 터 담당임원	복미총괄 CS팀장	연세대(석사)	계열회사 임원	
김성민	남	1976.03	상무	상근	영상디스플레이 지원팀 담당임 원	SEA 담당부장	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	4
김성은	남	1968.11	상무	상근	Mobile eXperience 구매팀 담 당임원	무선 기술전략팀 담당임원	항공대	계열회사 임원	59
김성은	남	1970.05	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	무선 개발실 수석	경북대	계열회사 임원	27
김성한	남	1974.09	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅 실 담당임원	SEAG법인장	광운대	계열회사 임원	40
김성한	남	1970.05	상무	상근	Foundry CP실 담당임원	Foundry 전략마케팅실 담당임 원	서울대(석사)	계열회사 임원	59
김세윤	남	1973.06	상무	상근	감사팀 담당임원	지원팀 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	59
김수련	여	1967.04	상무	상근	TSP총괄 Package개발실 담당 임원	메모리제조기술센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
김수형	남	1972.08	상무	상근	영상디스플레이 Micro LED팀 담당임원	영상디스플레이 개발팀 담당임 원	MIT(박사)	계열회사 임원	40
김수홍	남	1972.11	상무	상근	설비기술연구소 설비개발실 담 당임원	생산기술연구소 설비개발실 담 당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	53
김승연	여	1975.04	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅 실 담당임원	무선 전략마케팅실 담당부장	인하대	계열회사 임원	27
김승일	남	1970.07	상무	상근	네트워크 전략마케팅팀 담당임 원	네트워크 전략마케팅팀 담당부 장	단국대	계열회사 임원	53
김시우	남	1972.10	상무	상근	System LSI LSI개발실 담당임 원	System LSI LSI개발실 수석	단국대(석사)	계열회사 임원	16
김신	남	1971.12	상무	상근	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 개발팀 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	4
김연정	남	1975.12	상무	상근	Mobile eXperience 구매팀 담 당임원	무선 상품전략팀 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	53
김영대	남	1968.10	상무	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	Foundry 제품기술팀장	동국대(석사)	계열회사 임원	53

김영무	남	1976.09	상무	상근	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당부장	The Johns Hopkins Univ.(석사)	계열회사 임원	4
김영정	남	1972.03	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	4
김영주	남	1973.07	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 펌웨어사업장 수석	한양대(석사)	계열회사 임원	4
김용관	남	1976.04	상무	상근	DS부문 구매팀 담당임원	Apple, Manager	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(박사)	계열회사 임원	26
김용상	남	1972.08	상무	상근	Foundry CP실 담당임원	Foundry 전략마케팅실 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	16
김용성	남	1973.09	상무	상근	종합기술원 Device연구센터 담당임원	종합기술원 Material연구센터 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	27
김용완	남	1970.04	상무	상근	메모리 Global운영팀장	메모리 Global운영팀 담당부장	연세대	계열회사 임원	27
김용주	남	1970.08	상무	상근	Foundry 지원팀장	삼성SDI 종대형사업부 지원팀장	성균관대(석사)	계열회사 임원	4
김용찬	남	1969.03	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	경희대	계열회사 임원	40
김용한	남	1976.02	상무	상근	생활가전 선행개발팀 담당임원	생활가전 선행개발팀 수석	고려대(박사)	계열회사 임원	4
김용훈	남	1972.11	상무	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	생활가전 전략마케팅팀 담당부장	한양대	계열회사 임원	16
김우년	남	1970.09	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Qualcomm, Principal Engineer	포항공대(박사)	계열회사 임원	39
김원국	남	1975.11	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 수석	경북대(석사)	계열회사 임원	4
김원우	남	1970.03	상무	상근	SEDA-S 담당임원	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	성균관대	계열회사 임원	27
김원희	남	1971.04	상무	상근	SEAU법인장	SEAU 담당임원	Mcgill Univ.(석사)	계열회사 임원	40
김유나	여	1979.01	상무	상근	SRPOL연구소장	Samsung Research Platform팀 수석	포항공대(박사)	계열회사 임원	4
김윤재	남	1973.02	상무	상근	반도체연구소 메모리 TD실 담당임원	반도체연구소 공정개발실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	16
김윤철	남	1967.10	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	메모리 전략마케팅팀 담당임원	한국외국어대	계열회사 임원	40
김은경	여	1974.04	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 수석	단국대	계열회사 임원	40
김은하	여	1971.05	상무	상근	법무실 IP센터 담당임원	법무실 IP센터 수석	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	16
김이수	남	1973.03	상무	상근	Mobile eXperience Global제조센터 담당임원	SVCC 담당임원	아주대	계열회사 임원	59
김이태	남	1971.01	상무	상근	System LSI Sensor사업팀 담당임원	System LSI Sensor사업팀 수석	포항공대(석사)	계열회사 임원	40
김인형	남	1973.12	상무	상근	System LSI 기반설계실 담당임원	System LSI SOC개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	40
김일룡	남	1974.02	상무	상근	System LSI 제품기술팀장	System LSI 기반설계실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	40

김장경	남	1973.05	상무	상근	사업지원T/F 담당임원	영상디스플레이 지원팀 담당임원	홍익대	계열회사 임원	53
김장환	남	1975.08	상무	상근	설비기술연구소 설비개발실 담당임원	생산기술연구소 설비개발실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	27
김재성	남	1972.04	상무	상근	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당임원	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당부장	고려대	계열회사 임원	27
김재열	남	1965.07	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	중앙대	계열회사 임원	51
김재영	남	1971.11	상무	상근	SECA 담당임원	SIEL-S 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	53
김재윤	남	1970.07	상무	상근	전장사업팀 담당임원	재경팀 담당부장	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	40
김재진	남	1969.11	상무	상근	인사팀 담당임원	인사팀 담당부장	항공대	계열회사 임원	16
김재홍	남	1973.03	상무	상근	지원팀 담당임원	무선 지원팀 담당부장	성균관대(석사)	계열회사 임원	16
김재훈	남	1974.12	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Facebook, S/W Engineer	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	6
김정봉	남	1965.07	상무	상근	육상연맹(파견)	SSC 담당임원	부산대	계열회사 임원	
김정주	남	1969.01	상무	상근	메모리 품질보증실 담당임원	메모리제조기술센터 담당임원	광운대	계열회사 임원	53
김정현	남	1975.06	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당임원	무선 기획팀 담당임원	고려대	계열회사 임원	53
김정호	남	1972.01	상무	상근	생활가전 지원팀 담당임원	기획팀 담당임원	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	40
김종균	남	1966.08	상무	상근	경영혁신센터 담당임원	정보전략팀 담당부장	경상대	계열회사 임원	
김종근	남	1967.06	상무	상근	생산기술연구소 담당임원	글로벌기술센터 담당임원	경북대(석사)	계열회사 임원	
김종민	남	1968.03	상무	상근	SSC 담당임원	전장사업팀 담당임원	Univ. of Pennsylvania(석사)	계열회사 임원	
김종환	남	1971.05	상무	상근	System LSI SOC개발실 담당임원	System LSI SOC개발실 수석	Virginia Tech(박사)	계열회사 임원	53
김종훈	남	1969.12	상무	상근	메모리 품질보증실 담당임원	메모리 DRAM개발실 담당임원	중앙대	계열회사 임원	53
김준석	남	1972.10	상무	상근	System LSI Sensor사업팀 담당임원	System LSI SOC개발실 담당임원	연세대(박사)	계열회사 임원	53
김준엽	남	1969.10	상무	상근	SEHC담당임원	SESK 담당임원	경기대	계열회사 임원	53
김중정	남	1973.11	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	東北大(박사)	계열회사 임원	53
김지영	남	1970.04	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	반도체연구소 메모리TD실 담당임원	Univ. of California, LA(박사)	계열회사 임원	53
김지윤	여	1975.02	상무	상근	인사팀 담당임원	인사팀 담당부장	Cornell Univ.(석사)	계열회사 임원	40
김지훈	남	1971.08	상무	상근	한국총괄 B2B영업팀 담당임원	감사팀 담당부장	서강대(박사)	계열회사 임원	4



김진교	남	1973.05	상무	상근	상생협력센터 담당임원	베트남복합단지 담당부장	경찰대	계열회사 임원	4
김진기	남	1972.01	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조 기술센터 수석	인하대	계열회사 임원	4
김진성	남	1971.02	상무	상근	지원팀 담당임원	무선 지원팀 담당임원	성균관대	계열회사 임원	27
김진주	남	1969.05	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모 리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 펌웨어사업장 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	53
김찬우	남	1972.03	상무	상근	상생협력센터 담당임원	삼성물산 담당부장	연세대(석사)	계열회사 임원	16
김찬호	남	1975.06	상무	상근	SESA 담당임원	영상디스플레이 지원팀 담당임 원	Univ. of Illinois, Urbana- Champaign(석사)	계열회사 임원	16
김창영	남	1973.03	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅 실 담당임원	무선 전략마케팅실 담당부장	중앙대	계열회사 임원	53
김창용	남	1973.04	상무	상근	종합기술원 인사팀장	종합기술원 부장	고려대(석사)	계열회사 임원	4
김창태	남	1972.01	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	무선 개발실 수석	금오공대	계열회사 임원	53
김태균	남	1969.01	상무	상근	DS부문 지원팀 담당임원	SSIC 담당임원	성균관대	계열회사 임원	53
김태균	남	1976.02	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조 기술센터 수석	RPI(박사)	계열회사 임원	4
김태수	남	1971.11	상무	상근	한국총괄 CE영업팀 담당임원	생활가전 전략마케팅팀 담당부 장	부산대	계열회사 임원	27
김태수	남	1985.03	상무	상근	Samsung Research Security & Privacy팀 담당임원	Samsung Research Security팀 담당임원	MIT(박사)	계열회사 임원	11
김태영	남	1968.04	상무	상근	영상디스플레이 Service Business팀 담당임원	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당임원	LBS(석사)	계열회사 임원	26
김태우	남	1971.05	상무	상근	메모리 기획팀 담당임원	DS부문 기획팀 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	40
김태정	남	1972.12	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조 기술센터 담당임원	충북대	계열회사 임원	16
김태중	남	1971.05	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당 임원	무선 디자인팀 담당임원	한양대	계열회사 임원	53
김대진	남	1969.01	상무	상근	재경팀 담당임원	삼성경제연구소 사회인프라개 발실 담당부장	George Washington Univ.(석사)	계열회사 임원	53
김대훈	남	1969.04	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모 리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조 기술센터 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
김대훈	남	1970.10	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모 리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조 기술센터 담당임원	인하대	계열회사 임원	40
김대훈	남	1973.01	상무	상근	감사팀 담당임원	감사팀 담당부장	단국대	계열회사 임원	16
김평진	남	1973.12	상무	상근	법무실 담당임원	법무실 수석변호사	연세대	계열회사 임원	53
김향희	여	1972.07	상무	상근	SEROM법인장	SEH-S법인장	고려대	계열회사 임원	4
김현	남	1968.07	상무	상근	SEVT 담당임원	구미지원센터 인사팀장	서강대(석사)	계열회사 임원	53

김현근	남	1973.07	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	메모리 전략마케팅실 부장	경희대	계열회사 임원	4
김현석	남	1976.10	상무	상근	반도체연구소 메모리 TD실 담당임원	메모리 Flash개발실 수석	고려대(박사)	계열회사 임원	4
김현수	남	1970.09	상무	상근	Samsung Research 기술전략팀 담당임원	DMC연구소 기술전략팀 담당임원	성균관대(박사)	계열회사 임원	
김현조	남	1970.05	상무	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	반도체연구소 Logic TD실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	27
김현중	남	1977.11	상무	상근	법무실 담당임원	법무실 수석변호사	Columbia Univ.(석사)	계열회사 임원	16
김현중	남	1969.05	상무	상근	한국총괄 CE영업팀 담당임원	한국총괄 B2B영업팀 담당임원	Thunderbird(석사)	계열회사 임원	40
김현철	남	1969.05	상무	상근	반도체연구소 CIS TD팀 담당임원	반도체연구소 CIS TD팀 수석	Texas A&M Univ.(박사)	계열회사 임원	27
김형로	남	1973.01	상무	상근	인사팀 담당임원	법무법인 태평양, 변호사	고려대	계열회사 임원	4
김형섭	남	1970.12	상무	상근	상생협력센터 담당임원	상생협력센터 담당부장	중앙대	계열회사 임원	27
김형재	남	1970.12	상무	상근	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	53
김형준	남	1972.05	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	송실대(석사)	계열회사 임원	4
김호균	남	1968.12	상무	상근	중남미총괄 대외협력팀장	Samsung Research 인사팀장	연세대(석사)	계열회사 임원	59
김호진	남	1966.08	상무	상근	한국총괄 IM영업팀 담당임원	한국총괄 모바일영업팀 담당임원	성균관대	계열회사 임원	
김홍민	남	1971.10	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당임원	무선 디자인팀 담당임원	SAIC(석사)	계열회사 임원	31
김후성	남	1972.01	상무	상근	메모리 품질보증실 담당임원	DS부문 중국총괄 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	
김희승	남	1970.09	상무	상근	DS부문 인사팀 담당임원	SCS 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	27
나현수	남	1971.06	상무	상근	중국총괄 지원팀장	한국총괄 지원팀 담당임원	인하대	계열회사 임원	27
남경인	남	1973.03	상무	상근	SELS법인장	경영혁신센터 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	40
남기돈	남	1972.09	상무	상근	CIS총괄 지원팀장	재경팀 담당부장	중앙대	계열회사 임원	27
남정만	남	1967.06	상무	상근	생활가전 구매팀 담당임원	생활가전 Global운영팀 담당임원	전남기계공고	계열회사 임원	53
노강호	남	1978.05	상무	상근	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 Solution개발실 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	16
노경래	남	1976.12	상무	상근	SEM-S 담당임원	SEM-S 담당부장	서강대	계열회사 임원	40
노경윤	남	1972.09	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	Intel, Director	MIT(박사)	계열회사 임원	7
노미정	여	1971.04	상무	상근	Foundry Design Platform개발실 담당임원	Foundry Design Platform개발실 수석	연세대(석사)	계열회사 임원	27

노수혁	남	1970.04	상무	상근	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 개발팀 수석	연세대(박사)	계열회사 임원	16
노승남	남	1973.04	상무	상근	메모리 지원팀 담당임원	사업지원T/F 담당부장	연세대(석사)	계열회사 임원	16
노승환	남	1974.08	상무	상근	생활가전 지원팀 담당임원	SEF 담당부장	Indiana Univ., Bloomington(석사)	계열회사 임원	4
노태현	남	1969.09	상무	상근	Mobile eXperience Global Mobile B2B팀 담당임원	무선 서비스사업실 담당임원	George Washington Univ.(석사)	계열회사 임원	53
도성대	남	1966.12	상무	상근	서남아총괄 CS팀장	CS환경센터 담당부장	부산대	계열회사 임원	59
드미트리	남	1972.07	상무	상근	SERC 담당임원	SERC VP	Moscow Institute of Physics and Technology(석사)	계열회사 임원	16
라병주	남	1972.05	상무	상근	전장사업팀 담당임원	전장사업팀 담당부장	서울대(석사)	계열회사 임원	16
류일곤	남	1968.07	상무	상근	인사팀 담당임원	무선 인사팀 담당임원	경북대	계열회사 임원	53
류효경	남	1980.10	상무	상근	Foundry Design Platform개발 실 담당임원	Broadcom, Principal Engineer	Univ. of Michigan(박사)	계열회사 임원	17
마띠유	남	1981.10	상무	상근	기획팀 담당임원	사업지원T/F 담당부장	MIT(석사)	계열회사 임원	27
마이클고 다드	남	1965.11	상무	상근	SARC연구소장	SARC SVP	Univ. of Texas, Austin(석 사)	계열회사 임원	4
맹경무	남	1970.02	상무	상근	LED사업팀 담당임원	메모리 전략마케팅실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
명관주	남	1972.10	상무	상근	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 개발팀 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	27
모한	남	1973.07	상무	상근	SRI-Bangalore 담당임원	SRI-Bangalore VP	Acharya Nagarjuna Univ.	계열회사 임원	27
목진호	남	1968.09	상무	상근	생산기술연구소 담당임원	글로벌기술센터 담당임원	연세대(박사)	계열회사 임원	53
문국열	남	1969.01	상무	상근	SEVT 담당임원	SVCC 담당임원	구미1대	계열회사 임원	
문성훈	남	1974.09	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	무선 개발실 담당부장	경북대(박사)	계열회사 임원	40
문진옥	남	1971.12	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모 리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조 기술센터 담당임원	한양대(박사)	계열회사 임원	27
문형준	남	1968.07	상무	상근	Foundry 기획팀장	System LSI 기획팀장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	53
민병기	남	1963.02	상무	상근	상생협력센터 담당임원	에스원 커뮤니케이션팀 담당임 원	연세대(석사)	계열회사 임원	4
민재호	남	1976.09	상무	상근	반도체연구소 공정개발실 담당 임원	반도체연구소 공정개발실 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	4
박건태	남	1969.09	상무	상근	Mobile eXperience 구매팀 담 당임원	감사팀 담당부장	Univ. of Colorado, Boulder(석사)	계열회사 임원	59
박기웅	남	1973.12	상무	상근	한국총괄 온라인영업팀 담당임 원	로지올, 대표이사	서울대	계열회사 임원	18

박동수	남	1966.12	상무	상근	중남미총괄 CS팀장	Global CS센터 Global서비스팀 장	광주대	계열회사 임원	
박동욱	남	1974.01	상무	상근	System LSI 기획팀장	DS부문 기획팀 담당부장	한양대(석사)	계열회사 임원	16
박민규	남	1976.09	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	무선 개발실 수석	연세대(박사)	계열회사 임원	16
박민철	남	1972.09	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	반도체연구소 메모리TD실 담 당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	40
박범주	남	1966.04	상무	상근	Samsung Research S/W혁신 센터 담당임원	Samsung Research 담당임원	성균관대(박사)	계열회사 임원	
박병률	남	1968.09	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 TP센 터 담당임원	TSP총괄 TP센터 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	34
박봉일	남	1972.02	상무	상근	System LSI SOC개발실 담당임 원	System LSI Custom SOC사업 팀 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	16
박봉태	남	1974.10	상무	상근	SCS 담당임원	메모리 Flash개발실 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	27
박상교	남	1972.03	상무	상근	중국전략협력실 담당임원	중국본사 담당임원	성균관대	계열회사 임원	
박상권	남	1971.07	상무	상근	커뮤니케이션팀 담당임원	MBC 부장	서울대	계열회사 임원	13
박상도	남	1973.12	상무	상근	북미총괄 담당임원	북미총괄 담당부장	성균관대	계열회사 임원	27
박상훈	남	1978.02	상무	상근	Foundry Design Platform개발 실 담당임원	Foundry Design Platform개발 실 수석	포항공대(박사)	계열회사 임원	4
박상훈	남	1969.09	상무	상근	Mobile eXperience 지원팀 담 당임원	법무실 담당임원	Syracuse Univ.(석사)	계열회사 임원	59
박석민	남	1970.12	상무	상근	생활가전 Global운영팀 담당임 원	경영혁신센터 담당임원	Univ. of Texas, Austin(박 사)	계열회사 임원	
박성범	남	1984.10	상무	상근	System LSI SOC개발실 담당임 원	System LSI SOC개발실 수석	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	4
박성욱	남	1972.04	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모 리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 펌웨어사업 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	40
박성제	남	1971.05	상무	상근	영상디스플레이 담당임원	영상디스플레이 Global CS팀 담당임원	국민대(석사)	계열회사 임원	16
박세근	남	1974.01	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	성균관대(박사)	계열회사 임원	27
박수남	남	1970.10	상무	상근	설비기술연구소 설비개발실 담 당임원	생산기술연구소 설비개발실 담 당임원	Univ. of Minnesota, Minneapolis(박사)	계열회사 임원	39
박장목	남	1967.02	상무	상근	재경팀 담당임원	재경팀 담당부장	계명대	계열회사 임원	53
박장용	남	1979.01	상무	상근	법무실 담당임원	법무실 수석변호사	서울대	계열회사 임원	16
박재범	남	1977.08	상무	상근	DS부문 인사팀 담당임원	DS부문 인사팀 부장	서울대(석사)	계열회사 임원	4
박재성	남	1971.02	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프 라기술센터 담당임원	TSP총괄 TP센터 담당임원	인하대	계열회사 임원	40
박재현	남	1970.07	상무	상근	글로벌마케팅센터 담당임원	구주총괄 마케팅팀 담당부장	한양대(석사)	계열회사 임원	16

박정대	남	1976.12	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 담당 임원	글로벌인프라총괄 분석기술팀 장	포항공대(박사)	계열회사 임원	40
박정미	여	1968.07	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅 팀 담당임원	무선 GDC센터 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
박정재	남	1974.01	상무	상근	DS부문 일본총괄 담당임원	DS부문 일본총괄 담당부장	Univ. of Texas, Austin(석 사)	계열회사 임원	27
박정호	남	1971.09	상무	상근	Compliance팀 담당임원	DS부문 법무지원팀 담당임원	Michigan State Univ.(석사)	계열회사 임원	
박정호	남	1974.11	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 수석	연세대(박사)	계열회사 임원	27
박재영	남	1969.09	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모 리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조 기술센터 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	53
박제임스	남	1973.06	상무	상근	Mobile eXperience Global Mobile B2B팀 담당임원	무선 Global Mobile B2B팀 담 당부장	California Polytechnic State Univ.	계열회사 임원	53
박종규	남	1969.07	상무	상근	메모리 Solution개발실 담당임 원	메모리 Solution개발실 수석	경북대	계열회사 임원	53
박종만	남	1971.11	상무	상근	Mobile eXperience 모바일플랫 폼센터 담당임원	무선 모바일플랫폼센터 수석	서강대(석사)	계열회사 임원	4
박종범	남	1969.02	상무	상근	SIEL-S 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	
박종우	남	1972.02	상무	상근	한국총괄 B2B영업팀 담당임원	한국총괄 B2B영업팀 담당부장	서울시립대	계열회사 임원	4
박종욱	남	1968.11	상무	상근	Global CS센터 담당임원	영상디스플레이 개발팀 담당임 원	서울대(박사)	계열회사 임원	53
박종진	남	1970.12	상무	상근	경영지원실 담당임원	생활가전 구매팀 담당임원	Univ. of Michigan, Ann Arbor	계열회사 임원	25
박준영	남	1974.10	상무	상근	SEBN법인장	SEA 담당임원	Univ. of Paris 11(석사)	계열회사 임원	16
박준호	남	1972.05	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당 임원	무선 전략마케팅실 담당임원	한양대	계열회사 임원	
박지선	남	1974.09	상무	상근	SRA 담당임원	무선 개발실 담당임원	Univ. of Texas, Austin(박 사)	계열회사 임원	40
박진수	남	1969.07	상무	상근	DS부문 상생협력센터 담당임원	글로벌인프라총괄 펌웨어사업장 담당임원	인하대	계열회사 임원	40
박진표	남	1972.11	상무	상근	System LSI SOC개발실 담당임 원	System LSI Custom SOC사업 팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	40
박창서	남	1980.06	상무	상근	혁신센터 담당임원	DIT센터 담당임원	Univ. of California, Berkeley(박사)	계열회사 임원	13
박창진	남	1967.01	상무	상근	네트워크 Global CS팀장	네트워크 개발팀 담당임원	경북대	계열회사 임원	53
박철민	남	1971.01	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	Intel, Director	서울대(박사)	계열회사 임원	26
박철범	남	1966.03	상무	상근	상생협력센터 구매전략팀장	상생협력센터 담당임원	고려대	계열회사 임원	
박철웅	남	1973.01	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	무선 개발실 수석	연세대	계열회사 임원	4
박충신	남	1973.09	상무	상근	의료기기 인사팀장	무선 인사팀 담당임원	경북대(석사)	계열회사 임원	16

박대상	남	1975.01	상무	상근	생산기술연구소 담당임원	글로벌기술센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	40
박대호	남	1969.03	상무	상근	SEAG법인장	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	Univ. of Pittsburgh(석사)	계열회사 임원	
박대훈	남	1974.11	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 수석	연세대(석사)	계열회사 임원	4
박항엽	남	1968.01	상무	상근	DS부문 정보보호센터 담당임원	DS부문 인사팀 담당임원	포항공대(석사)	계열회사 임원	27
박행철	남	1970.01	상무	상근	상생협력센터 담당임원	상생협력센터 담당부장	부산대	계열회사 임원	16
박현근	남	1973.01	상무	상근	DS부문 기획팀 담당임원	DS부문 미주총괄 담당부장	고려대(석사)	계열회사 임원	27
박형민	남	1977.03	상무	상근	SEAG 담당임원	생활가전 전략마케팅팀 담당부장	서울대	계열회사 임원	16
박형원	남	1966.09	상무	상근	System LSI 품질팀장	System LSI SOC개발실 담당임원	한양대(석사)	계열회사 임원	
박호우	남	1971.03	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	Foundry 기술개발실 수석	성균관대(석사)	계열회사 임원	4
박훈중	남	1967.08	상무	상근	한국총괄 IM영업팀 담당임원	한국총괄 모바일영업팀 담당임원	인하대	계열회사 임원	59
박훈철	남	1974.05	상무	상근	생활가전 지원팀 담당임원	지원팀 담당부장	광운대	계열회사 임원	4
박희걸	남	1972.08	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	Ericsson, Sr.Architect	고려대(석사)	계열회사 임원	14
반일승	남	1974.11	상무	상근	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	SEJ 담당부장	경희대	계열회사 임원	27
발라지	남	1969.09	상무	상근	SSIR연구소장	SSIR VP	Birla Institute of Technology and Science, Pilani(석사)	계열회사 임원	40
방지훈	남	1973.11	상무	상근	System LSI SOC개발실 담당임원	System LSI 기반설계실 담당임원	Carnegie Mellon Univ.(석사)	계열회사 임원	50
배광운	남	1968.03	상무	상근	생활가전 구매팀 담당임원	생활가전 구매팀 담당부장	경희대	계열회사 임원	53
배상기	남	1974.04	상무	상근	SAS 담당임원	사업지원T/F 담당부장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	27
배승준	남	1976.03	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	40
배일환	남	1970.07	상무	상근	인사팀 담당임원	SEVT 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	53
배학범	남	1963.08	상무	상근	SESK법인장	SEHC 담당임원	경희대	계열회사 임원	
배희선	여	1974.02	상무	상근	SCIC 담당임원	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	경북대	계열회사 임원	16
백승엽	남	1967.01	상무	상근	경영혁신센터 담당임원	Samsung Research 지원팀장	California State Univ., Hayward(석사)	계열회사 임원	
백아론	남	1979.10	상무	상근	Samsung Research Robot센터 담당임원	Samsung Research Robot센터 수석	Stanford Univ.(석사)	계열회사 임원	4

백일섭	남	1968.08	상무	상근	Mobile eXperience 품질혁신센터 담당임원	무선 Global CS팀 담당임원	광운대	계열회사 임원	
백종수	남	1971.01	상무	상근	지원팀 담당임원	전장사업팀 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
백피터	남	1971.06	상무	상근	DS부문 IP팀 담당임원	법무실 IP센터 책임변호사	Univ. of Minnesota, Minneapolis(석사)	계열회사 임원	27
변준호	남	1972.07	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발2실 담당임원	Southern Illinois Univ.(박사)	계열회사 임원	
부민혁	남	1973.06	상무	상근	생활가전 디자인팀장	생활가전 디자인팀 담당임원	제주대	계열회사 임원	
부장원	남	1973.06	상무	상근	글로벌마케팅센터 담당임원	글로벌마케팅센터 담당부장	MIT(석사)	계열회사 임원	27
서경욱	남	1966.10	상무	상근	SEPOL법인장	SAVINA-S법인장	Michigan State Univ.(석사)	계열회사 임원	
서경현	남	1970.05	상무	상근	인사팀 담당임원	삼성전기 인사팀 담당임원	광운대	계열회사 임원	4
서보철	남	1972.01	상무	상근	Mobile eXperience Global제조센터 담당임원	무선 Global운영팀 담당임원	동국대	계열회사 임원	
서성기	남	1972.12	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	건국대	계열회사 임원	27
서영진	남	1969.05	상무	상근	Global CS센터 담당임원	CS환경센터 담당부장	Insa De Lyon(박사)	계열회사 임원	59
서원주	남	1976.07	상무	상근	DS부문 IP팀 담당임원	DS부문 미주총괄 VP	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	16
서정아	여	1971.05	상무	상근	Mobile eXperience 온라인 Biz센터 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	Columbia Univ.(석사)	계열회사 임원	57
서정혁	남	1972.07	상무	상근	네트워크 인사팀장	SRA 담당부장	건국대	계열회사 임원	4
서정현	남	1974.04	상무	상근	DS부문 지원팀 담당임원	사업지원T/F 담당부장	Univ. of Wisconsin, Madison(석사)	계열회사 임원	27
서치영	남	1974.12	상무	상근	Mobile eXperience 모바일플랫폼센터 담당임원	Airbnb, Director	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	1
서행룡	남	1967.09	상무	상근	혁신센터 담당임원	DIT센터 담당임원	부산대	계열회사 임원	
서현정	여	1978.02	상무	상근	DS부문 경영지원실 담당임원	ERM 코리아, 대표	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	5
석종욱	남	1969.06	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 LED제조기술팀장	글로벌인프라총괄 LED제조기술팀장	광운대	계열회사 임원	
선동석	남	1974.04	상무	상근	혁신센터 담당임원	DIT센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	16
설지윤	남	1974.12	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	27
설훈	남	1970.03	상무	상근	SEG 담당임원	SEROM법인장	고려대	계열회사 임원	53
성낙희	남	1973.03	상무	상근	System LSI LSI개발실 담당임원	System LSI SOC개발실 담당임원	Georgia Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	53
성덕용	남	1973.09	상무	상근	설비기술연구소 담당임원	생산기술연구소 담당임원	Carnegie Mellon Univ.(박사)	계열회사 임원	53

성백민	남	1971.05	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 인프라기술센터 수석	한양공고	계열회사 임원	4
성한준	남	1971.02	상무	상근	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 개발팀 수석	성균관대	계열회사 임원	27
소재민	남	1983.04	상무	상근	생산기술연구소 담당임원	영상디스플레이 개발팀 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	4
손동우	남	1971.04	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	메모리 전략마케팅실 담당부장	한양대	계열회사 임원	16
손석준	남	1974.07	상무	상근	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 개발팀 수석	전남대(석사)	계열회사 임원	16
손성민	남	1973.06	상무	상근	Mobile eXperience 구매팀 담당임원	SEV 담당부장	성균관대(석사)	계열회사 임원	4
손영웅	남	1970.10	상무	상근	반도체연구소 메모리 TD실 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조 기술센터 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	27
손용우	남	1968.09	상무	상근	SEDA-P(M) 담당임원	TSTC 담당임원	경희대	계열회사 임원	53
손용훈	남	1973.03	상무	상근	반도체연구소 메모리 TD실 담당임원	메모리 Flash개발실 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	4
손종율	남	1967.03	상무	상근	SAMCOL법인장	무선 전략마케팅실 담당임원	건국대	계열회사 임원	53
손종근	남	1970.09	상무	상근	LED사업팀 담당임원	LED사업팀 수석	State Univ. of New York, Stony Brook(박사)	계열회사 임원	53
손태용	남	1972.08	상무	상근	영상디스플레이 Micro LED팀 담당임원	영상디스플레이 개발팀 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	53
손한구	남	1969.06	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	메모리 전략마케팅실 담당임원	State Univ. of New York, Stony Brook(석사)	계열회사 임원	40
손호민	남	1969.02	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조 기술센터 담당임원	한양대(석사)	계열회사 임원	27
손호성	남	1968.04	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 구매팀 담당임원	경북대	계열회사 임원	
송기재	남	1970.04	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 TP센터 담당임원	TSP총괄 TP센터 담당임원	광운대(박사)	계열회사 임원	16
송기환	남	1970.07	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	59
송명숙	여	1972.11	상무	상근	글로벌마케팅센터 담당임원	SIEL-S 담당임원	성균관대	계열회사 임원	40
송방영	남	1974.10	상무	상근	Mobile eXperience 지원팀 담당임원	지원팀 담당임원	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(석사)	계열회사 임원	40
송병무	남	1973.08	상무	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	Intel, Yield Group Manager	Cornell Univ.(박사)	계열회사 임원	57
송상철	남	1973.09	상무	상근	Mobile eXperience 서비스 Biz팀 담당임원	Verizon Media, Chief Architect	Univ. of Maryland, College Park(박사)	계열회사 임원	13
송승엽	남	1968.08	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 TP센터 담당임원	TSP총괄 TP센터 담당임원	성균관대	계열회사 임원	
송우창	남	1968.01	상무	상근	한국총괄 B2B영업팀 담당임원	한국총괄 온라인영업팀 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	53
송원준	남	1969.04	상무	상근	생활가전 전략마케팅실 담당임원	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	Univ. of Illinois, Urbana-Champaign(석사)	계열회사 임원	53



송윤종	남	1971.10	상무	상근	반도체연구소 차세대TD팀장	Foundry 기술개발실 담당임원	Virginia Tech(박사)	계열회사 임원	40
송인강	남	1971.07	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 기술전략팀 담당부장	Vanderbilt Univ.(석사)	계열회사 임원	40
송대중	남	1971.04	상무	상근	Foundry CP실 담당임원	Foundry Design Platform개발실 담당임원	Georgia Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	53
송호건	남	1966.01	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 TP센터 담당임원	TSP총괄 TP센터 담당임원	Univ. of California, Berkeley(박사)	계열회사 임원	
송호영	남	1972.12	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	27
세인혁비	남	1972.05	상무	상근	SEA 담당임원	SEA VP	Fairleigh Dickinson Univ.(석사)	계열회사 임원	53
신규범	남	1972.06	상무	상근	Mobile eXperience 품질혁신센터 담당임원	무선 Global CS팀 담당부장	부산대	계열회사 임원	16
신대중	남	1971.11	상무	상근	SEDA-P(C)공장장	SEIN-P법인장	경북대	계열회사 임원	27
신민호	남	1970.03	상무	상근	System LSI SOC개발실 담당임원	System LSI SOC개발실 수석	연세대(박사)	계열회사 임원	16
신승원	남	1974.09	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	KAIST, 교수	Texas A&M Univ.(박사)	계열회사 임원	13
신승주	남	1972.04	상무	상근	SESA 담당임원	SECZ법인장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	27
신용우	남	1974.12	상무	상근	DS부문 기획팀 담당임원	DS부문 기획팀 부장	서울대(석사)	계열회사 임원	4
신인철	남	1974.06	상무	상근	DS부문 인사팀 담당임원	DS부문 인사팀 담당부장	고려대(석사)	계열회사 임원	16
신종신	남	1973.12	상무	상근	Foundry Design Platform개발실 담당임원	Foundry 기술개발실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	53
신현석	남	1969.05	상무	상근	Samsung Research Smart Device팀장	Samsung Research Intelligent Machine센터장	서강대(석사)	계열회사 임원	
신현진	남	1971.01	상무	상근	영상디스플레이 인사팀장	인사팀 담당임원	경북대	계열회사 임원	
심우철	남	1982.06	상무	상근	Samsung Research Security & Privacy팀 담당임원	Samsung Research Security팀 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	4
심재현	남	1972.01	상무	상근	Mobile eXperience 지원팀 담당임원	동남아총괄 지원팀장	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	53
심호준	남	1977.12	상무	상근	DS부문 중국총괄 담당임원	메모리 Solution개발실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	27
심황윤	남	1971.01	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	연세대(석사)	계열회사 임원	4
아라이	남	1968.08	상무	상근	DS부문 일본총괄	DS부문 일본총괄 VP	한국외국어대	계열회사 임원	16
안대현	남	1972.02	상무	상근	한국총괄 CE영업팀 담당임원	한국총괄 CE영업팀 담당부장	고려대	계열회사 임원	16
안성준	남	1975.01	상무	상근	System LSI S/W Architecture팀장	System LSI S/W Architecture팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	40
안승환	남	1970.10	상무	상근	SEA 담당임원	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당부장	연세대	계열회사 임원	40

안신현	남	1972.09	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리 제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 평택사업장 수석	한양대	계열회사 임원	4
안정희	남	1970.09	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	SEMAG법인장	경북대(석사)	계열회사 임원	53
안준	남	1978.02	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	AWS, S/W Engineer	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	4
안진우	남	1969.11	상무	상근	Compliance팀 담당임원	법무실 담당임원	동아대	계열회사 임원	53
양병덕	남	1971.03	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Apple, Principal Engineer	연세대(박사)	계열회사 임원	51
양세영	남	1975.08	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Apple, Engineering Manager	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	53
양시준	남	1974.01	상무	상근	네트워크 지원팀 담당임원	무선 지원팀 담당부장	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	16
양익준	남	1969.11	상무	상근	경영혁신센터 담당임원	아프리카총괄 지원팀장	성균관대	계열회사 임원	53
양준철	남	1972.06	상무	상근	영상디스플레이 구매팀 담당임원	영상디스플레이 구매팀 담당부장	성균관대(석사)	계열회사 임원	27
양진기	남	1971.05	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 담당부장	연세대(석사)	계열회사 임원	40
양택진	남	1971.08	상무	상근	Samsung Research 기술전략팀 담당임원	Samsung Research 기술전략팀 담당부장	연세대	계열회사 임원	40
양희철	남	1975.07	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당임원	무선 UX혁신팀 수석	포항공대(박사)	계열회사 임원	27
여태정	남	1970.06	상무	상근	전장사업팀 담당임원	전장사업팀 담당부장	서울대(박사)	계열회사 임원	53
연지현	여	1974.10	상무	상근	System LSI 전략마케팅실 담당임원	System LSI 전략마케팅실 부장	연세대(석사)	계열회사 임원	4
염강수	남	1972.08	상무	상근	커뮤니케이션팀 담당임원	커뮤니케이션팀 담당부장	서울대	계열회사 임원	16
염부호	남	1972.04	상무	상근	Mobile eXperience 온라인 Biz센터 담당임원	무선 GDC센터 담당부장	성균관대(석사)	계열회사 임원	4
오름	여	1977.02	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	고려대(박사)	계열회사 임원	4
오로욱	남	1974.02	상무	상근	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 Solution개발실 수석	서울대(석사)	계열회사 임원	53
오상진	남	1977.11	상무	상근	Foundry 지원팀 담당임원	사업지원T/F 부장	MIT(석사)	계열회사 임원	4
오석민	여	1974.07	상무	상근	디자인경영센터 담당임원	디자인경영센터 수석	New York Univ.(석사)	계열회사 임원	27
오승훈	남	1968.03	상무	상근	Mobile eXperience 품질혁신센터 담당임원	SRI-Noida연구소장	Aachen Univ. of Tech.(박사)	계열회사 임원	59
오양지	남	1968.10	상무	상근	DS부문 중국총괄 담당임원	DS부문 중국총괄 VP	淸華大	계열회사 임원	4
오재균	남	1972.02	상무	상근	System LSI 지원팀장	TSP총괄 지원팀장	Univ. of Iowa(석사)	계열회사 임원	53
오정석	남	1970.03	상무	상근	TSP총괄 지원팀장	System LSI 지원팀장	淸華大(석사)	계열회사 임원	59

오준영	남	1969.02	상무	상근	TSP총괄 Package개발실 담당 임원	메모리 Solution개발실 수석	The Ohio State Univ.(박사)	계열회사 임원	40
오창민	남	1965.02	상무	상근	SEJ법인장	무선 전략마케팅실 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	
오창호	남	1971.03	상무	상근	SEV 담당임원	무선 구매팀 담당임원	동아대	계열회사 임원	16
오창환	남	1969.01	상무	상근	DS부문 담당임원	DS부문 경영지원실 담당임원	George Washington Univ.(석사)	계열회사 임원	
오대영	남	1974.10	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	53
오혁상	남	1969.06	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 TP 센 터 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조 기술센터 담당임원	부산대(석사)	계열회사 임원	27
오형석	남	1970.09	상무	상근	DS부문 구매팀 담당임원	TSP총괄 구매팀장	고려대	계열회사 임원	53
오화석	남	1972.02	상무	상근	메모리 Solution개발실 담당임 원	메모리 Solution개발실 수석	서강대(석사)	계열회사 임원	59
올라프	남	1971.01	상무	상근	SEG 담당임원	SEG VP	Johannes Gutenberg Univ.(석사)	계열회사 임원	4
우형동	남	1970.09	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모 리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 펌웨어사업장 담당임원	경북대	계열회사 임원	40
원석준	남	1970.02	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조 기술센터 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	27
원순재	남	1972.01	상무	상근	메모리 Solution개발실 담당임 원	메모리 Solution개발실 수석	고려대(석사)	계열회사 임원	
원찬식	남	1975.12	상무	상근	생산기술연구소 담당임원	글로벌기술센터 수석	서강대(박사)	계열회사 임원	4
위훈	남	1970.04	상무	상근	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 개발팀 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	59
유미경	여	1974.05	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	무선 개발실 담당임원	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	7
유상민	남	1973.09	상무	상근	System LSI SOC개발실 담당임 원	System LSI 기반설계실 담당임 원	Univ. of Washington(박사)	계열회사 임원	16
유성호	남	1973.02	상무	상근	System LSI 지원팀 담당임원	System LSI 지원팀 부장	Stanford Univ.(석사)	계열회사 임원	4
유송	남	1975.05	상무	상근	SEA 담당임원	SEA 담당부장	연세대	계열회사 임원	4
유종민	남	1974.04	상무	상근	SSC 담당임원	인사팀 담당부장	경희대	계열회사 임원	27
유한중	남	1973.10	상무	상근	SEF 담당임원	재경팀 담당임원	Univ. of North Carolina, Chapel Hill(석사)	계열회사 임원	16
유화열	남	1971.11	상무	상근	System LSI LSI개발실 담당임 원	System LSI LSI개발실 수석	인하대(석사)	계열회사 임원	27
육근성	남	1968.08	상무	상근	한국총괄 지원팀 담당임원	SESA 담당임원	Indiana Univ., Bloomington(석사)	계열회사 임원	40
윤남호	남	1968.12	상무	상근	한국총괄 IM영업팀 담당임원	한국총괄 IM영업팀 담당부장	Univ. of Illinois, Urbana- Champaign(석사)	계열회사 임원	40
윤보영	여	1977.08	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 수석	이화여대(석사)	계열회사 임원	4

윤석진	남	1968.11	상무	상근	혁신센터 담당임원	DIT센터 담당임원	연세대(박사)	계열회사 임원	14
윤석호	남	1972.07	상무	상근	LED사업팀 담당임원	글로벌인프라총괄 LED기술센터 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	
윤성욱	남	1974.06	상무	상근	Mobile eXperience 인사팀 담당임원	인사팀 담당부장	연세대	계열회사 임원	4
윤송호	남	1974.10	상무	상근	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 Solution개발실 수석	광운대	계열회사 임원	4
윤승욱	남	1970.01	상무	상근	TSP총괄 Package개발실 담당임원	Statschippac, Director	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	30
윤여완	남	1972.02	상무	상근	영상디스플레이 지원팀 담당임원	영상디스플레이 지원팀 책임변호사	Syracuse Univ.(석사)	계열회사 임원	16
윤영조	남	1975.02	상무	상근	IR팀 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	24
윤우근	남	1972.01	상무	상근	생산기술연구소 담당임원	글로벌기술센터 담당임원	東北大(박사)	계열회사 임원	14
윤용아	남	1969.12	상무	상근	Mobile eXperience Digital Life팀 담당임원	Mobile eXperience 개발실 담당임원	Cornell Univ.(석사)	계열회사 임원	27
윤인수	남	1974.11	상무	상근	법무실 담당임원	법무팀 담당임원	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	
윤인철	남	1971.03	상무	상근	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 선행개발팀 담당임원	한양대(석사)	계열회사 임원	40
윤주한	남	1970.05	상무	상근	재경팀 담당임원	재경팀 담당부장	Univ. of California, Berkeley(석사)	계열회사 임원	59
윤찬현	남	1971.10	상무	상근	Mobile eXperience 구매팀 담당임원	무선 구매팀 담당부장	영남대	계열회사 임원	40
윤철웅	남	1970.07	상무	상근	SERC 담당임원	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	인하대	계열회사 임원	40
윤대식	남	1969.04	상무	상근	한국총괄 IMC팀장	한국총괄 IMC팀 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	
윤하룡	남	1971.12	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	메모리 전략마케팅팀 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	53
윤호용	남	1969.12	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	SECH법인장	Drexel Univ.(석사)	계열회사 임원	27
이강규	남	1972.09	상무	상근	DS부문 미추총괄 담당임원	Foundry 지원팀 담당부장	서울대(석사)	계열회사 임원	16
이강승	남	1977.07	상무	상근	System LSI Global운영팀장	System LSI Global운영팀 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	27
이경우	남	1969.04	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발2실 수석	한양대(박사)	계열회사 임원	53
이경준	남	1976.06	상무	상근	한국총괄 CE영업팀 담당임원	한국총괄 CE영업팀 담당부장	성균관대(석사)	계열회사 임원	16
이경호	남	1975.10	상무	상근	System LSI Sensor사업팀 담당임원	System LSI Sensor사업팀 수석	포항공대(박사)	계열회사 임원	4
이계복	남	1969.06	상무	상근	SEHA법인장	SEMA법인장	홍익대	계열회사 임원	27
이계원	남	1968.05	상무	상근	한국총괄 B2B영업팀 담당임원	인재개발원 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	

이계훈	남	1980.02	상무	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임원	영상디스플레이 개발팀 수석	서울대	계열회사 임원	4
이관수	남	1969.11	상무	상근	SAMEX 담당임원	SEHZ 담당임원	영남대	계열회사 임원	59
이광열	남	1974.11	상무	상근	아프리카총괄 지원팀장	사업지원T/F 담당부장	Emory Univ.(석사)	계열회사 임원	4
이귀호	여	1975.05	상무	상근	영상디스플레이 Service Business팀 담당임원	영상디스플레이 Service Business팀 담당부장	이화여대	계열회사 임원	27
이규영	남	1968.10	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	메모리 전략마케팅팀 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	
이규원	남	1974.03	상무	상근	DS부문 일본총괄 담당임원	DS부문 일본총괄 담당부장	Waseda Univ.(석사)	계열회사 임원	27
이근수	남	1970.12	상무	상근	상생협력센터 담당임원	상생협력센터 담당부장	세종대	계열회사 임원	40
이금주	여	1971.09	상무	상근	반도체연구소 공정개발실 담당임원	반도체연구소 메모리 TD실 담당임원	중앙대(석사)	계열회사 임원	53
이기욱	남	1970.08	상무	상근	Mobile eXperience 품질혁신센터 담당임원	무선 개발2실 수석	동아대	계열회사 임원	53
이기철	남	1972.11	상무	상근	네트워크 Quality Engineering팀장	네트워크 Global Technology Service팀 담당임원	고려대(박사)	계열회사 임원	27
이남호	남	1972.02	상무	상근	DS부문 재경팀 담당임원	두산, 부문장	성균관대(박사)	계열회사 임원	15
이달래	여	1970.04	상무	상근	생활가전 CX팀 담당임원	생활가전 상품전략팀 담당임원	한국외국어대	계열회사 임원	40
이대성	남	1970.09	상무	상근	SCIC 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	Thunderbird(석사)	계열회사 임원	16
이동근	남	1971.08	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 수석	한양대(박사)	계열회사 임원	40
이동진	남	1971.01	상무	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임원	영상디스플레이 개발팀 수석	성균관대	계열회사 임원	16
이동하	남	1968.07	상무	상근	혁신센터 담당임원	DIT센터 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	28
이동현	남	1972.09	상무	상근	DS부문 법무지원팀 담당임원	DS부문 법무지원실 수석변호사	고려대	계열회사 임원	59
이민철	남	1970.04	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	무선 PC사업팀 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	53
이법섭	남	1972.10	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	인하대	계열회사 임원	4
이병시	남	1969.01	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 Global Technology Service팀 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	40
이병진	남	1970.09	상무	상근	DS부문 법무지원팀 담당임원	DS부문 법무지원팀 담당부장	Univ. Of Wisconsin, Madison(석사)	계열회사 임원	16
이병철	남	1972.11	상무	상근	Mobile eXperience 인사팀 담당임원	글로벌기술센터 담당부장	성균관대(석사)	계열회사 임원	4
이병현	남	1974.11	상무	상근	Mobile eXperience 온라인 Biz센터 담당임원	사업지원T/F 담당부장	Manchester Business Sch.(석사)	계열회사 임원	4
이보나	여	1973.02	상무	상근	생활가전 CX팀 담당임원	생활가전 CX팀 담당부장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	4

이상수	남	1975.06	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	무선 개발실 수석	아주대(석사)	계열회사 임원	16
이상용	남	1970.02	상무	상근	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	GCT Semiconductor, Senior Director	서울대(박사)	계열회사 임원	33
이상욱	남	1972.08	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 품질혁신센터 담당임원	금오공대	계열회사 임원	53
이상원	남	1971.07	상무	상근	영상디스플레이 지원팀 담당임원	SEF 담당임원	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	
이상욱	남	1971.01	상무	상근	Mobile eXperience 품질혁신센터 담당임원	무선 제품기술팀 담당임원	경북대	계열회사 임원	53
이상윤	남	1968.09	상무	상근	지원팀 담당임원	CIS총괄 지원팀장	경희대	계열회사 임원	
이상직	남	1970.06	상무	상근	SEM-S법인장	무선 전략마케팅실 담당임원	한국외국어대	계열회사 임원	
이상현	남	1970.09	상무	상근	SRJ 담당임원	SCS 담당임원	인하대	계열회사 임원	53
이상희	남	1974.09	상무	상근	반도체연구소 Mask개발팀장	반도체연구소 Mask개발팀 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	4
이석림	남	1974.03	상무	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	생활가전 전략마케팅팀 담당부장	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	4
이석원	남	1970.07	상무	상근	설비기술연구소 담당임원	생산기술연구소 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	59
이선화	여	1975.08	상무	상근	글로벌마케팅센터 담당임원	글로벌마케팅센터 담당부장	서울대(석사)	계열회사 임원	4
이성원	남	1976.03	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	16
이성재	남	1974.12	상무	상근	Foundry Design Platform개발실 담당임원	IBM, Principal Manager	Purdue Univ.(박사)	계열회사 임원	6
이성현	남	1966.07	상무	상근	SGE법인장	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	홍익대	계열회사 임원	
이승관	남	1973.10	상무	상근	커뮤니케이션팀 담당임원	연합뉴스, 기자	고려대	계열회사 임원	26
이승목	남	1973.09	상무	상근	System LSI 인사팀장	동남아총괄 인사팀장	고려대	계열회사 임원	40
이승엽	남	1968.08	상무	상근	SEIN-S법인장	무선 전략마케팅실 담당임원	서울대	계열회사 임원	53
이승재	남	1974.08	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	53
이승철	남	1975.12	상무	상근	생활가전 지원팀 담당임원	경영혁신센터 담당부장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	16
이승호	남	1973.11	상무	상근	SEVT 담당임원	SEIN-P법인장	서울사이버대	계열회사 임원	16
이승환	남	1971.05	상무	상근	LED사업팀 담당임원	LED사업팀 수석	고려대(석사)	계열회사 임원	4
이신재	남	1972.11	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 담당부장	인하대	계열회사 임원	40
이애영	여	1968.12	상무	상근	Mobile eXperience 모바일플랫폼센터 담당임원	무선 차세대플랫폼센터 담당임원	포항공대(석사)	계열회사 임원	59

이영민	남	1964.03	상무	상근	Samsung Research 기술전략 팀 담당임원	SRPOL연구소장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
이영직	남	1967.08	상무	상근	SEH-P법인장	SERK법인장	아주대	계열회사 임원	59
이영춘	남	1967.10	상무	상근	Mobile eXperience 온라인 Biz센터 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	Columbia Univ.(석사)	계열회사 임원	47
이영호	남	1967.07	상무	상근	SCIC 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	Univ. of Maryland, College Park(석사)	계열회사 임원	
이윤경	여	1979.09	상무	상근	Big Data센터 담당임원	Samsung Research AI센터 수 석	Univ. of Illinois, Urbana- Champaign(박사)	계열회사 임원	16
이윤성	남	1971.09	상무	상근	메모리 품질보증실 담당임원	메모리 품질보증실 수석	서울대(석사)	계열회사 임원	16
이윤수	남	1975.11	상무	상근	Samsung Research Global AI센터 담당임원	Samsung Research AI센터 수 석	Univ. of Maryland(박사)	계열회사 임원	16
이재영	남	1974.11	상무	상근	사업지원T/F 담당임원	구주총괄 인사팀장	성균관대(석사)	계열회사 임원	27
이재환	남	1970.09	상무	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임 원	SEEG-S법인장	중앙대(석사)	계열회사 임원	59
이재훈	남	1974.01	상무	상근	SERC 담당임원	SEUC법인장	연세대	계열회사 임원	4
이정노	남	1971.02	상무	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임 원	영상디스플레이 담당임원	한양대(석사)	계열회사 임원	40
이정삼	남	1967.06	상무	상근	TSP총괄 기획팀장	TSP총괄 GPO팀장	인하대	계열회사 임원	
이정숙	여	1972.12	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당 임원	무선 Mobile UX센터 담당임원	Berlin Art Univ.(석사)	계열회사 임원	31
이정원	남	1971.07	상무	상근	네트워크 Global운영팀장	네트워크 Global운영팀 담당임 원	경북대	계열회사 임원	16
이정원	남	1977.04	상무	상근	System LSI SOC개발실 담당임 원	Marvell, Principal Engineer	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	15
이정자	여	1969.04	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모 리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 인프라기술 센터 담당임원	인하대	계열회사 임원	53
이정호	남	1974.11	상무	상근	한국총괄 인사팀장	인사팀 담당부장	경북대	계열회사 임원	4
이종규	남	1970.02	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	무선 개발1실 수석	한양대(석사)	계열회사 임원	53
이종민	남	1971.09	상무	상근	차세대플랫폼전략T/F 담당임원	무선 기획팀 담당임원	Illinois Inst. of Tech.(석사)	계열회사 임원	59
이종민	남	1973.06	상무	상근	사업지원T/F 담당임원	DS부문 지원팀 담당임원	Univ. of Washington, Seattle(석사)	계열회사 임원	27
이종우	남	1978.04	상무	상근	System LSI 기반설계실 담당임 원	System LSI 기반설계실 수석	Univ. of Michigan, Ann Arbor(박사)	계열회사 임원	40
이종포	남	1974.10	상무	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임 원	영상디스플레이 개발팀 수석	성균관대(석사)	계열회사 임원	27
이종필	남	1972.11	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	무선 개발실 수석	경북대(석사)	계열회사 임원	27
이종필	남	1973.11	상무	상근	System LSI Sensor사업팀 담당 임원	System LSI SOC개발실 담당임 원	충남대(석사)	계열회사 임원	27

이종호	남	1968.01	상무	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조 기술센터 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	
이종호	남	1976.02	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 TP센 터 담당임원	TSP총괄 Package개발실 담당 임원	서울대(박사)	계열회사 임원	27
이주형	남	1972.08	상무	상근	Samsung Research Global AI센터 담당임원	Samsung Research AI센터 담 당임원	Univ. of Texas, Austin(박 사)	계열회사 임원	31
이준	남	1972.04	상무	상근	중동총괄 지원팀장	SEF 담당임원	Cornell Univ.(석사)	계열회사 임원	16
이준표	남	1971.06	상무	상근	생활가전 C&M사업팀 담당임원	Carrier, Tech Engineer	Univ. of Maryland(박사)	계열회사 임원	4
이준환	남	1969.10	상무	상근	네트워크 전략마케팅팀 담당임 원	네트워크 전략마케팅팀 담당부 장	Univ. of Illinois, Urbana- Champaign(석사)	계열회사 임원	27
이종원	남	1975.06	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	4
이지수	남	1976.02	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당 임원	무선 개발실 담당임원	Georgia Inst. of Tech.(박 사)	계열회사 임원	
이지영	여	1976.08	상무	상근	Mobile eXperience CX실 담당 임원	무선 CX실 수석	제주대	계열회사 임원	4
이지훈	남	1970.11	상무	상근	SECA법인장	SEA 담당임원	State Univ. of New York, Stony Brook(석사)	계열회사 임원	27
이지훈	남	1976.02	상무	상근	구주총괄 지원팀장	SEG 담당임원	Northwestern Univ., Evanston(석사)	계열회사 임원	16
이진구	남	1973.02	상무	상근	Mobile eXperience 서비스 Biz팀 담당임원	무선 서비스사업실 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	53
이진석	남	1971.09	상무	상근	SIEL-S 담당임원	네트워크 개발팀 담당임원	Imperial College(박사)	계열회사 임원	43
이진우	남	1979.01	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	4
이진욱	남	1972.01	상무	상근	DS부문 상생협력센터 담당임원	DS부문 상생협력센터 부장	아주대(석사)	계열회사 임원	4
이진원	남	1973.03	상무	상근	생활가전 Global CS팀 담당임 원	생활가전 Global CS팀 담당부 장	서울대(박사)	계열회사 임원	27
이창엽	남	1970.04	상무	상근	DS부문 중국총괄 담당임원	DS부문 중국총괄 담당부장	영남대	계열회사 임원	40
이창원	남	1972.03	상무	상근	한국총괄 IM영업팀 담당임원	한국총괄 IM영업팀 담당부장	Pennsylvania State Univ.(석사)	계열회사 임원	4
이치훈	남	1969.08	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조 기술센터 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	59
이한관	남	1971.09	상무	상근	TSP총괄 인사팀장	DS부문 인사팀 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	53
이한용	남	1976.05	상무	상근	법무실 IP센터 담당임원	김앤장, Sr.Foreign Attorney	George Washington Univ.(석사)	계열회사 임원	1
이한형	남	1968.09	상무	상근	한국총괄 CE영업팀 담당임원	한국총괄 B2B영업팀 담당임원	경희대	계열회사 임원	53
이현	남	1971.01	상무	상근	SEF 담당임원	SEROM법인장	Duke Univ.(석사)	계열회사 임원	59
이현동	남	1972.02	상무	상근	SELV법인장	Lebanon지점장	영남대	계열회사 임원	4



이현우	남	1974.10	상무	상근	인사팀 담당임원	인사팀 담당부장	경북대(석사)	계열회사 임원	16
이현정	여	1971.11	상무	상근	한국총괄 Retail마케팅팀장	한국총괄 Retail마케팅팀 담당 부장	고려대(박사)	계열회사 임원	4
이형우	남	1970.03	상무	상근	북미총괄 대외협력팀 담당임원	Global Public Affairs팀 담당임 원	Univ. of Texas, Austin(석 사)	계열회사 임원	48
이호	남	1972.07	상무	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	Foundry 기술개발실 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	16
이호신	남	1970.12	상무	상근	법무실 IP센터 담당임원	법무실 IP센터 책임변호사	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	40
이홍빈	남	1964.04	상무	상근	SSEC법인장	생활가전 Global제조팀 담당임 원	명지대	계열회사 임원	
이화성	남	1970.09	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	Foundry 기술개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	40
이효석	남	1969.02	상무	상근	종합기술원 Material연구센터 담당임원	종합기술원 AI&SW연구센터 담 당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	53
이훈신	남	1974.09	상무	상근	Global EHS센터 담당임원	Dupont, APAC EHS Head	성균관대(석사)	계열회사 임원	3
이회윤	남	1968.08	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프 라기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 인프라기술 센터 담당임원	부산수산대	계열회사 임원	53
임경애	여	1975.02	상무	상근	생활가전 CX팀 담당임원	생활가전 상품전략팀 담당임원	이화여대(석사)	계열회사 임원	27
임근휘	남	1973.05	상무	상근	Big Data센터 담당임원	Samsung Research AI센터 담 당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	46
임백준	남	1968.07	상무	상근	SRUK연구소장	Samsung Research Global AI센터 담당임원	Indiana Univ., Bloomington(석사)	계열회사 임원	55
임산	남	1973.03	상무	상근	DS부문 감사팀 담당임원	DS부문 감사팀 부장	서울대(석사)	계열회사 임원	4
임성수	남	1978.11	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	27
임성택	남	1970.10	상무	상근	생활가전 C&M사업팀장	생활가전 C&M사업팀 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	40
임아영	여	1974.09	상무	상근	네트워크 전략마케팅팀 담당임 원	네트워크 전략마케팅팀 담당부 장	City Univ. of New York(석 사)	계열회사 임원	16
임영수	남	1969.06	상무	상근	한국총괄 B2B영업팀 담당임원	Honeywell, Sales Director	영남대	계열회사 임원	56
임용식	남	1971.01	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모 리제조기술센터 담당임원	메모리 Flash개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	59
임재우	남	1973.04	상무	상근	메모리 Design Platform개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 수석	한양대(석사)	계열회사 임원	16
임전식	남	1969.08	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모 리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조 기술센터 담당임원	전북대	계열회사 임원	40
임지훈	남	1972.12	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅 실 담당임원	Ogilvy Singapore, Mng. Partner	서울대	계열회사 임원	21
임휘용	남	1965.02	상무	상근	인재개발원 담당임원	네트워크 인사팀장	서강대	계열회사 임원	
장경훈	남	1970.02	상무	상근	로봇사업팀 담당임원	Samsung Research Robot센 터 담당임원	고려대(박사)	계열회사 임원	

장상익	남	1968.07	상무	상근	영상디스플레이 구매팀 담당임원	영상디스플레이 구매팀 담당부장	경북대	계열회사 임원	53
장세정	남	1974.04	상무	상근	메모리 품질보증실 담당임원	메모리 Solution개발실 수석	서울대	계열회사 임원	27
장소연	여	1971.06	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	무선 전략마케팅실 담당부장	이화여대	계열회사 임원	40
장순복	여	1977.04	상무	상근	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 Solution개발실 수석	부산대	계열회사 임원	16
장실완	남	1973.02	상무	상근	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 Solution개발실 수석	서울대	계열회사 임원	40
장용	남	1970.03	상무	상근	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	무선 Global Mobile B2B팀 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	40
장우영	남	1973.02	상무	상근	의료기기 DR사업팀장	의료기기 Global CS팀장	서울대(박사수료)	계열회사 임원	16
장인갑	남	1975.06	상무	상근	메모리 품질보증실 담당임원	메모리 품질보증실 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	4
장준희	남	1974.01	상무	상근	SEASA법인장	무선 전략마케팅실 담당부장	한국외국어대	계열회사 임원	16
장지호	남	1970.09	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	GCT, VP	서울대(박사)	계열회사 임원	20
장형택	남	1970.05	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	SIEL-S 담당임원	Washington Univ. in St. Louis(석사)	계열회사 임원	53
전대호	남	1971.01	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	반도체연구소 인사팀장	아주대(석사)	계열회사 임원	16
전병권	남	1967.02	상무	상근	SAMEX법인장	영상디스플레이 Global운영팀 담당임원	전북대	계열회사 임원	40
전성훈	남	1977.01	상무	상근	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 Solution개발실 수석	연세대(박사)	계열회사 임원	4
전소영	여	1974.05	상무	상근	SEA 담당임원	무선 지원팀 담당부장	Univ. of Texas, Dallas(석사)	계열회사 임원	16
전승수	남	1976.07	상무	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	Samsung Research 수석	고려대(박사)	계열회사 임원	16
전승훈	남	1971.08	상무	상근	Mobile eXperience 모바일플랫폼센터 담당임원	무선 차세대플랫폼센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	40
전진규	남	1974.05	상무	상근	SENA 담당임원	SEAG 담당부장	한양대	계열회사 임원	16
전진완	남	1974.03	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	메모리 전략마케팅실 담당부장	성균관대(석사)	계열회사 임원	16
정강일	남	1974.10	상무	상근	영상디스플레이 CX팀 담당임원	영상디스플레이 CX팀 담당부장	Illinois Inst. of Tech.(석사)	계열회사 임원	4
정광민	남	1971.07	상무	상근	SEPR법인장	Ecuador지정장	부산대	계열회사 임원	4
정광섭	남	1970.04	상무	상근	재경팀 담당임원	삼성물산 경영정보팀 수석	한양대(석사)	계열회사 임원	4
정광희	남	1971.08	상무	상근	DS부문 중국총괄 담당임원	메모리 전략마케팅실 담당임원	광운대	계열회사 임원	40
정기호	남	1973.08	상무	상근	생활가전 CX팀 담당임원	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	한국해양대	계열회사 임원	4

정다운	남	1980.09	상무	상근	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 Solution개발실 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	27
정우경	남	1971.05	상무	상근	Foundry CP실 담당임원	Foundry 전략마케팅실 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	27
정문일	남	1971.01	상무	상근	상생협력센터 담당임원	법무법인 지평, 전문위원	송실대	계열회사 임원	4
정상규	남	1970.03	상무	상근	SEM-P법인장	생활가전 선행개발팀 담당임원	조선대	계열회사 임원	53
정상인	남	1969.06	상무	상근	법무실 담당임원	DS부문 법무지원팀 담당임원	Case Western Reserve Univ.(석사)	계열회사 임원	
정상일	남	1967.09	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	중앙대	계열회사 임원	59
정상태	남	1972.01	상무	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	SEA 담당임원	중앙대	계열회사 임원	59
정성원	남	1974.07	상무	상근	메모리 Global운영팀 담당임원	메모리 Global운영팀 부장	서울대(박사)	계열회사 임원	4
정성원	남	1971.12	상무	상근	SCA법인장	Senegal지점장	고려대	계열회사 임원	4
정승목	남	1969.05	상무	상근	중국전략협력실 담당임원	중국전략협력실 담당임원	Thunderbird(석사)	계열회사 임원	40
정승진	남	1972.11	상무	상근	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 Solution개발실 수석	서울대(석사)	계열회사 임원	16
정신영	여	1973.03	상무	상근	Foundry 품질팀 담당임원	Foundry 제품기술팀 수석	Univ. of Florida(석사)	계열회사 임원	4
정용덕	남	1976.09	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	16
정용준	남	1969.10	상무	상근	Foundry CP실 담당임원	DS부문 미주총괄 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	
정원석	남	1971.07	상무	상근	상생협력센터 담당임원	감사팀 담당임원	한양대	계열회사 임원	27
정원철	남	1973.12	상무	상근	Foundry 기술개발실 담당임원	반도체연구소 Logic TD실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	27
정유진	여	1970.06	상무	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	생활가전 담당임원	서강대(석사)	계열회사 임원	40
정윤찬	남	1968.09	상무	상근	감사팀 담당임원	상생협력센터 상생협력팀 담당임원	성균관대	계열회사 임원	
정의욱	남	1968.07	상무	상근	Foundry CP실 담당임원	Foundry Global운영팀장	인하대	계열회사 임원	59
정의철	남	1969.12	상무	상근	Mobile eXperience 품질혁신센터 담당임원	무선 제품기술팀 담당임원	Seattle Pacific Univ.	계열회사 임원	27
정인호	남	1975.02	상무	상근	DS부문 지원팀 담당임원	DS부문 미주총괄 담당임원	MIT(석사)	계열회사 임원	27
정인호	남	1970.11	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 인프라기술센터 담당임원	인하대	계열회사 임원	27
정인희	여	1974.09	상무	상근	지속가능경영추진센터 담당임원	LG화학, Expert Advisor	Imperial College(석사)	계열회사 임원	4
정일규	남	1968.05	상무	상근	DS부문 미주총괄 담당임원	메모리 전략마케팅실 담당임원	광운대	계열회사 임원	40

정일룡	남	1970.10	상무	상근	DS부문 재경팀 담당임원	DS부문 재경팀 부장	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	4
정재연	여	1974.09	상무	상근	Mobile eXperience 모바일플랫폼센터 담당임원	무선 차세대플랫폼센터 담당임원	MIT(박사)	계열회사 임원	
정재용	남	1973.09	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	16
정준수	남	1970.09	상무	상근	SERK법인장	SEA 담당부장	영남대	계열회사 임원	4
정지은	여	1974.05	상무	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	생활가전 전략마케팅팀 담당부장	Northwestern Univ.(석사)	계열회사 임원	53
정진국	남	1975.10	상무	상근	SRR연구소장	Samsung Research 차세대통신연구센터 담당임원	서강대(박사)	계열회사 임원	40
정진민	남	1972.12	상무	상근	Samsung Research Platform팀장	Samsung Research Platform팀 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	59
정혁준	남	1974.09	상무	상근	생활가전 광주지원센터장	생활가전 광주지원센터 담당부장	전남대	계열회사 임원	4
정혜순	여	1975.12	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발1실 수석	부산대	계열회사 임원	53
정훈	남	1969.01	상무	상근	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당임원	SESA법인장	홍익대	계열회사 임원	
정희재	남	1971.04	상무	상근	생활가전 디자인팀 담당임원	생활가전 디자인팀 수석	서울시립대	계열회사 임원	16
제이콥	남	1978.11	상무	상근	DS부문 중국총괄 담당임원	DS부문 중국총괄 VP	中國科學技術大學(석사)	계열회사 임원	27
제임스휘슬러	남	1972.10	상무	상근	SEA 담당임원	SEA SVP	Ward Melville High Sch.	계열회사 임원	4
조기호	남	1971.03	상무	상근	네트워크 상품전략팀장	네트워크 상품전략팀 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
조민정	여	1974.07	상무	상근	메모리 품질보증실 담당임원	메모리 전략마케팅실 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	40
조성대	남	1969.06	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발1실 담당임원	RPI(박사)	계열회사 임원	59
조성일	남	1973.12	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 TP센터 담당임원	TSP총괄 TP센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	40
조성훈	남	1970.11	상무	상근	경영혁신센터 담당임원	SELS법인장	건국대(박사)	계열회사 임원	53
조성훈	남	1976.01	상무	상근	생활가전 인사팀장	생활가전 인사팀 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	27
조신형	남	1972.10	상무	상근	DS부문 커뮤니케이션팀 담당임원	DS부문 커뮤니케이션팀 담당부장	서강대	계열회사 임원	27
조용호	남	1970.03	상무	상근	DS부문 미주총괄 담당임원	메모리 DRAM개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	53
조욱래	남	1972.03	상무	상근	DS부문 재경팀 담당임원	DS부문 재경팀 담당부장	Purdue Univ.(석사)	계열회사 임원	16
조유미	여	1971.09	상무	상근	DS부문 글로벌마케팅팀장	메모리 전략마케팅실 담당임원	성균관대(석사)	계열회사 임원	16
조유성	남	1971.06	상무	상근	Global EHS센터 담당임원	Global EHS센터 담당부장	서울과학기술대(석사)	계열회사 임원	16

조익현	남	1972.01	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	성균관대(석사)	계열회사 임원	16
조종욱	남	1969.08	상무	상근	상생협력센터 담당임원	삼성바이오에피스 인사팀장	성균관대	계열회사 임원	4
조지호	남	1972.04	상무	상근	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 수석	부산대	계열회사 임원	4
조철민	남	1971.03	상무	상근	System LSI SOC개발실 담당임원	System LSI SOC개발실 수석	고려대(석사)	계열회사 임원	27
조철형	남	1971.03	상무	상근	SEDA-P(M)공장장	글로벌기술센터 담당임원	충북대	계열회사 임원	16
조철호	남	1971.07	상무	상근	Mobile eXperience 전략마케팅실 담당임원	SECA법인장	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	53
조학주	남	1969.03	상무	상근	반도체연구소 Logic TD실 담당임원	Foundry 기술개발실 담당임원	Univ. of Texas, Austin(박사)	계열회사 임원	59
조훈영	남	1973.08	상무	상근	Samsung Research Global AI센터 담당임원	NC Soft, Lab장	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	2
조희권	남	1976.06	상무	상근	SEA 담당임원	SEA 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	16
존테일러	남	1968.04	상무	상근	SAS 담당임원	SAS VP	Univ. of New Hampshire	계열회사 임원	40
주명휘	남	1963.08	상무	상근	DS부문 중국총괄 담당임원	DS부문 중국총괄 VP	上海大(석사)	계열회사 임원	53
주재완	남	1968.02	상무	상근	Global CS센터 담당임원	중국총괄 CS팀장	연세대(석사)	계열회사 임원	
주현대	남	1972.12	상무	상근	생활가전 Global운영팀 담당임원	생활가전 Global운영팀 담당부장	울산대	계열회사 임원	4
주형빈	남	1973.06	상무	상근	SESAR법인장	SEIL법인장	경희대	계열회사 임원	16
지송하	여	1973.01	상무	상근	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	글로벌마케팅센터 담당임원	이화여대	계열회사 임원	
지우정	남	1967.11	상무	상근	SEEG-S법인장	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	고려대(석사)	계열회사 임원	
지응준	남	1968.01	상무	상근	종합기술원 기획지원팀장	반도체연구소 기술기획팀장	연세대(박사)	계열회사 임원	
지혜령	여	1972.04	상무	상근	커뮤니케이션팀 담당임원	커뮤니케이션팀 담당부장	Univ. of Michigan, Ann Arbor(석사)	계열회사 임원	53
진인식	남	1971.03	상무	상근	혁신센터 담당임원	DIT센터 담당임원	서강대(박사)	계열회사 임원	16
차경환	남	1972.04	상무	상근	영상디스플레이 영상전략마케팅팀 담당임원	SEAU법인장	Univ. of California, Berkeley(석사)	계열회사 임원	53
차도현	남	1973.04	상무	상근	Mobile eXperience 담당임원	무선 개발실 수석	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	27
천기철	남	1970.09	상무	상근	메모리 품질보증실 담당임원	메모리 품질보증실 수석	Univ. Of Minnesota, Twin Cities(박사)	계열회사 임원	16
전상필	남	1969.05	상무	상근	Global Public Affairs팀 담당임원	구주총괄 대외협력팀 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	27
최경수	남	1971.12	상무	상근	상생협력센터 담당임원	상생협력센터 구매전략팀 담당임원	경북대	계열회사 임원	16

최기화	남	1969.03	상무	상근	네트워크 Quality Engineering팀 담당임원	네트워크 Global Technology Service팀 담당임원	Carnegie Mellon Univ.(박사)	계열회사 임원	59
최동준	남	1972.05	상무	상근	글로벌마케팅센터 담당임원	글로벌마케팅센터 담당부장	Univ. of Southern California(석사)	계열회사 임원	53
최병철	남	1971.06	상무	상근	영상디스플레이 지원팀 담당임원	영상디스플레이 지원팀 담당부장	성균관대(석사)	계열회사 임원	16
최병희	남	1970.05	상무	상근	SETK법인장	SEB법인장	경북대	계열회사 임원	16
최상종	남	1973.03	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	한양대(박사)	계열회사 임원	16
최서림	남	1972.02	상무	상근	설비기술연구소 기획지원팀장	생산기술연구소 부장	서울대(석사)	계열회사 임원	4
최선일	남	1971.11	상무	상근	System LSI 기반설계실 담당임원	System LSI 기반설계실 Master	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	4
최성욱	남	1969.02	상무	상근	생산기술연구소 담당임원	글로벌기술센터 담당임원	삼성전자공과대학	계열회사 임원	59
최순	남	1970.10	상무	상근	SEA 담당임원	SIEL-S 담당임원	Duke Univ.(석사)	계열회사 임원	53
최승림	남	1972.02	상무	상근	재경팀 담당임원	재경팀 담당부장	서울대(석사)	계열회사 임원	4
최영	남	1969.07	상무	상근	한국총괄 IM영업팀 담당임원	한국총괄 인사팀 담당부장	항공대	계열회사 임원	40
최영돈	남	1972.12	상무	상근	메모리 Design Platform개발실 담당임원	메모리 Design Platform개발실 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	4
최영상	남	1975.01	상무	상근	종합기술원 AI연구센터 담당임원	종합기술원 AI&SW연구센터 담당임원	Georgia Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	53
최영일	남	1973.08	상무	상근	Foundry 지원팀 담당임원	인사팀 담당임원	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	16
최영준	남	1967.09	상무	상근	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	LG전자, 자문역	Univ. of Minnesota, Twin Cities(석사)	계열회사 임원	20
최원경	여	1973.08	상무	상근	TSP총괄 Package개발실 담당임원	Statschippac, Director	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	27
최유중	남	1971.12	상무	상근	상생협력센터 담당임원	인사팀 담당임원	연세대(석사)	계열회사 임원	53
최유진	여	1979.06	상무	상근	영상디스플레이 UX팀장	영상디스플레이 UX팀 수석	Illinois Inst. of Tech.(석사)	계열회사 임원	4
최윤석	남	1974.09	상무	상근	TSP총괄 Package개발실 담당임원	TSP총괄 Package개발실 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	16
최윤정	여	1973.10	상무	상근	Samsung NEXT 담당임원	Samsung NEXT 담당부장	연세대(석사)	계열회사 임원	33
최일환	남	1972.11	상무	상근	Big Data센터 담당임원	Big Data센터 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	4
최재혁	남	1974.06	상무	상근	생활가전 지원팀 담당임원	생활가전 지원팀 담당부장	Georgetown Univ.(석사)	계열회사 임원	16
최정연	남	1974.11	상무	상근	메모리 Design Platform개발실 담당임원	Foundry Design Platform개발실 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	40
최종무	남	1975.08	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	아주대(석사)	계열회사 임원	16

최진필	남	1973.04	상무	상근	SCS 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조 기술센터 담당임원	연세대(박사)	계열회사 임원	27
최창훈	남	1972.02	상무	상근	설비기술연구소 설비개발실 담 당임원	생산기술연구소 설비개발실 담 당임원	서울시립대(박사)	계열회사 임원	40
최창훈	남	1973.08	상무	상근	SiEL-S 담당임원	영상디스플레이 영상전략마케 팅팀 담당부장	인하대	계열회사 임원	4
최철민	남	1973.09	상무	상근	Mobile eXperience 개발실 담 당임원	무선 개발2실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	59
최현호	남	1979.06	상무	상근	종합기술원 Material연구센터 담당임원	종합기술원 Material연구센터 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	16
최호규	남	1968.12	상무	상근	CX·MDE센터 담당임원	Mobile eXperience CX실 담당 임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	16
추민수	남	1973.10	상무	상근	SEPCO법인장	SENZ법인장	Univ. of California, LA(석 사)	계열회사 임원	4
코너피어 스	남	1970.04	상무	상근	SEUK 담당임원	SEUK VP	Univ. of Dublin(석사)	계열회사 임원	40
편정우	남	1970.10	상무	상근	메모리 품질보증실 담당임원	메모리 품질보증실 수석	Univ. of Texas, Austin(박 사)	계열회사 임원	53
피터리	남	1970.05	상무	상근	서남아총괄 대외협력팀장	Global Public Affairs팀 담당임 원	Univ. of Chicago(석사)	계열회사 임원	
하경수	남	1979.04	상무	상근	메모리 전략마케팅실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	4
한규한	남	1966.02	상무	상근	System LSI 전략마케팅실 담당 임원	DS부문 구주총괄 담당임원	State Univ. of New York, Stony Brook(석사)	계열회사 임원	
한규희	남	1974.01	상무	상근	설비기술연구소 설비개발실 담 당임원	생산기술연구소 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	4
한상섭	남	1972.04	상무	상근	Global CS센터 담당임원	Global CS센터 담당부장	광운대(석사)	계열회사 임원	4
한상연	남	1969.01	상무	상근	반도체연구소 메모리 TD실 담 당임원	메모리 DRAM개발실 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	53
한우섭	남	1967.01	상무	상근	생산기술연구소 담당임원	글로벌기술센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	
한의택	남	1974.02	상무	상근	SME법인장	SENZ법인장	State Univ. of New York, Stony Brook(석사)	계열회사 임원	27
한인국	남	1964.11	상무	상근	인사팀 담당임원	Samsung Research 창의개발 센터장	한양대	계열회사 임원	
한장수	남	1970.02	상무	상근	북미총괄 법무지원팀장	무선 지원팀 담당임원	State Univ. of New York, Buffalo(박사)	계열회사 임원	
한정남	남	1973.01	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 Foundry제조 기술센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	40
한종호	남	1976.01	상무	상근	SEG 담당임원	SEI 담당임원	Vanderbilt Univ.(석사)	계열회사 임원	16
한진규	남	1973.12	상무	상근	Samsung Research 차세대통 신연구센터 담당임원	Samsung Research 수석	연세대(박사)	계열회사 임원	27
함선규	남	1970.01	상무	상근	충남미총괄 지원팀장	SRA 담당임원	Washington Univ. in St. Louis(석사)	계열회사 임원	40
허준영	남	1977.02	상무	상근	구주총괄 인사팀장	무선 인사팀 담당부장	연세대	계열회사 임원	4

허준회	남	1979.03	상무	상근	System LSI SOC개발실 담당임원	System LSI 기반설계실 담당임원	Georgia Inst. of Tech.(박사)	계열회사 임원	9
허지영	남	1970.09	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 환경안전센터 담당임원	글로벌인프라총괄 환경안전센터 담당임원	부산대	계열회사 임원	53
허진욱	남	1971.09	상무	상근	복미총괄 CS팀장	ECSO장	한양대(박사)	계열회사 임원	16
허태영	남	1970.11	상무	상근	영상디스플레이 CX팀장	영상디스플레이 CX팀 담당임원	Univ. of California, LA	계열회사 임원	
허훈	남	1974.08	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 수석	Univ. of Southern California(박사)	계열회사 임원	16
현경호	남	1966.05	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	DS부문 감사팀 담당임원	한양대	계열회사 임원	
현대은	남	1975.10	상무	상근	영상디스플레이 개발팀 담당임원	영상디스플레이 개발팀 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	16
현상진	남	1972.02	상무	상근	반도체연구소 메모리 TD실 담당임원	반도체연구소 공정개발실 담당임원	서울대(박사)	계열회사 임원	40
홍경선	남	1970.08	상무	상근	커뮤니케이션팀 담당임원	커뮤니케이션팀 담당부장	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	40
홍기준	남	1971.05	상무	상근	System LSI 기반설계실 담당임원	System LSI SOC개발실 담당임원	Columbia Univ.(석사)	계열회사 임원	53
홍성민	남	1969.06	상무	상근	Foundry 인사팀장	글로벌인프라총괄 인사팀장	Univ. of Texas, Austin(석사)	계열회사 임원	59
홍성준	남	1969.03	상무	상근	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	삼성엔지니어링 담당임원	연세대	계열회사 임원	18
홍순상	남	1972.08	상무	상근	Mobile eXperience 서비스 Biz팀 담당임원	무선 서비스Biz팀 담당부장	연세대	계열회사 임원	4
홍승완	남	1971.06	상무	상근	반도체연구소 메모리 TD실 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	서울대(석사)	계열회사 임원	53
홍연석	남	1972.01	상무	상근	SEIN-P법인장	무선 Global제조센터 담당부장	경북대(석사)	계열회사 임원	4
홍영기	남	1970.03	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	Foundry 기술개발실 담당임원	Imperial College(박사)	계열회사 임원	59
홍영주	남	1977.08	상무	상근	네트워크 지원팀 담당임원	사업지원T/F 담당부장	서울대	계열회사 임원	4
홍유석	남	1972.12	상무	상근	법무실 담당임원	법무실 책임변호사	Univ. of Notre Dame(석사)	계열회사 임원	40
홍정호	남	1969.02	상무	상근	의료기기 지원팀장	전장사업팀 담당임원	Univ. of Washington, Seattle(석사)	계열회사 임원	59
홍주선	남	1971.10	상무	상근	영상디스플레이 Micro LED팀 담당임원	영상디스플레이 Global운영팀 담당임원	경희대(석사)	계열회사 임원	40
홍준식	남	1971.12	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	글로벌인프라총괄 메모리제조기술센터 담당임원	전북대(석사)	계열회사 임원	16
홍희일	남	1970.10	상무	상근	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	한양대(석사)	계열회사 임원	27
황근철	남	1973.03	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	27
황근하	남	1970.05	상무	상근	영상디스플레이 Global운영팀 팀장	영상디스플레이 Global제조팀 담당임원	아주대	계열회사 임원	53



황보용	남	1970.10	상무	상근	신사업T/F 담당임원	경영지원실 담당임원	한국과학기술원(석사)	계열회사 임원	
황성훈	남	1969.07	상무	상근	Global CS센터 담당임원	Global CS센터 담당부장	한양대(석사)	계열회사 임원	40
황완구	남	1972.02	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 Foundry제조기술센터 담당임원	삼성바이오로직스 Media 공급 망 개선 T/F장	서울대(박사)	계열회사 임원	4
황용호	남	1975.10	상무	상근	Samsung Research Security & Privacy팀장	Samsung Research Security팀 담당임원	포항공대(박사)	계열회사 임원	27
황인철	남	1977.11	상무	상근	Mobile eXperience 모바일플랫폼 센터 담당임원	Samsung Research Global AI센터 담당임원	한국과학기술원(박사)	계열회사 임원	40
황제임스	남	1971.07	상무	상근	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당임원	영상디스플레이 담당임원	West Point	계열회사 임원	40
황찬수	남	1975.07	상무	상근	네트워크 개발팀 담당임원	Tinoq, Co-Founder	Stanford Univ.(박사)	계열회사 임원	20
황호송	남	1967.01	상무	상근	글로벌 제조&인프라총괄 환경 안전센터 담당임원	글로벌인프라총괄 환경안전센터 담당임원	Imperial College(박사)	계열회사 임원	16
황희돈	남	1974.01	상무	상근	반도체연구소 메모리 TD실 담당 임원	메모리 DRAM개발실 수석	서울대(박사)	계열회사 임원	27

※ 미등기임원 소유주식수는 작성기준일 현재 보통주(의결권 있는 주식) 98,037,546주(이재용 부회장 97,414,196주 등),

우선주 (의결권 없는 주식) 186,904주(이재용 부회장 137,757주 등)이며, 작성기준일 이후 변동은 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)의 '임원 · 주요주주

특정증권등 소유상황보고서' 등을 참조하십시오.

※ 최대주주와의 관계는 「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」 제3조 제1항에 기재되어 있는 관계를 참고하여 기재하였습니다.

※ 재직기간은 기업공시서식 작성기준에 따라 미등기임원으로서 5년 이상 회사에 계속 재직해온 경우에는 기재를 생략하였습니다.

## 라. 미등기임원의 변동

작성기준일 이후 보고서 제출일 현재까지 변동된 미등기임원은 다음과 같습니다.

구분 (사유)	성명	성별	출생연월	직위	담당업무	최대주주와의 관계
임원선임	조웅	남	1972.08	부사장	법무실 송무팀 담당임원	계열회사 임원
	윤석민	남	1971.02	부사장	설비기술연구소 담당임원	계열회사 임원
임원사임	마이클고다드	남	1965.11	상무	SARC연구소장	계열회사 임원
	박재홍	남	1965.01	부사장	System LSI 담당임원	계열회사 임원
	안중현	남	1963.03	부사장	사업지원T/F 담당임원	계열회사 임원
	윤용아	남	1969.12	상무	Mobile eXperience Digital Life팀 담당 임원	계열회사 임원

※ 최대주주와의 관계는 「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」 제3조 제1항에 기재되어 있는 관계를 참고하여 기재하였습니다.

## 2. 임원의 보수 등

임원의 보수 등은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기/사업보고서에 기재 예정)

## IX. 계열회사 등에 관한 사항

계열회사 등에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.  
(반기/사업보고서에 기재 예정)

## X. 대주주 등과의 거래내용

### 1. 대주주 등에 대한 신용공여 등

당사는 2022년 1분기 현재 Samsung Electronics America, Inc. (SEA) 등 계열회사의 자금 조달 등을 위하여 채무보증을 제공하고 있습니다.

(단위 : 천US\$, %)

법인명 (채무자)	관계	채권자	내용	목적	보증시작일	보증종료일	채무보증한도		채무금액			이자율
							기초	기말	기초	종감	기말	
SEA	계열회사	BOA 등	지급보증	운영자금	2021.04.20	2022.12.16	1,328,000	1,328,000	-	-	-	
SEM	계열회사	BBVA 등	지급보증	운영자금	2021.06.14	2023.03.27	906,000	906,000	-	-	-	
SAMCOL	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	2021.06.14	2022.12.16	310,000	310,000	-	-	-	
SEDA	계열회사	BRADESCO 등	지급보증	운영자금	2021.09.30	2022.12.16	409,000	409,000	-	-	-	
SECH	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	2021.06.14	2022.12.16	62,000	62,000	-	-	-	
SEPR	계열회사	BBVA 등	지급보증	운영자금	2021.06.01	2022.12.16	150,000	150,000	-	-	-	
SSA	계열회사	SCB 등	지급보증	운영자금	2021.06.14	2022.12.16	318,000	318,000	-	-	-	
SEMAG	계열회사	SocGen 등	지급보증	운영자금	2021.11.09	2022.12.16	110,000	110,000	-	-	-	
SETK	계열회사	BNP 등	지급보증	운영자금	2021.06.14	2022.12.16	807,000	807,000	102,275	25,989	128,264	22.3%
SETK-P	계열회사	BNP 등	지급보증	운영자금	2021.11.09	2022.12.16	130,000	130,000	33,334	22,976	56,310	22.6%
SECE	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	2021.07.19	2022.12.16	73,722	72,871	-	-	-	
SEEG	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2021.06.14	2022.06.13	85,000	85,000	-	-	-	
SEIN	계열회사	BNP 등	지급보증	운영자금	2021.06.14	2022.11.08	70,000	70,000	-	-	-	
SJC	계열회사	Mizuho Bank 등	지급보증	운영자금	2021.04.30	2022.12.16	877,579	858,664	-	-	-	
SEUC	계열회사	Credit Agricole 등	지급보증	운영자금	2021.06.14	2022.12.16	150,000	150,000	-	-	-	
SEDAM	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	2021.06.14	2022.12.16	141,000	141,000	-	-	-	
SECA	계열회사	BoA	지급보증	운영자금	2021.11.09	2022.11.08	70,000	70,000	-	-	-	
SELA	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2021.12.17	2022.12.16	120,000	120,000	-	-	-	
SEEH	계열회사	HSBC 등	지급보증	운영자금	2021.06.14	2022.12.16	712,400	712,400	-	-	-	
SERK	계열회사	SocGen 등	지급보증	운영자금	2021.06.14	2022.12.16	290,000	290,000	-	-	-	
SELV	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2021.12.17	2022.12.16	10,000	10,000	-	-	-	
SEIL	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2021.12.17	2022.12.16	15,600	15,600	10,947	△256	10,691	1.4%
SAPL	계열회사	BOA 등	지급보증	운영자금	2021.06.14	2022.12.16	345,000	345,000	-	-	-	
SAVINA	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2021.06.14	2022.06.13	51,000	51,000	-	-	-	
SCIC	계열회사	HSBC 등	지급보증	운영자금	2021.06.14	2022.12.16	300,000	300,000	-	-	-	
SME	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	2021.11.09	2022.11.08	110,000	110,000	-	-	-	
SAMEX	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2021.12.17	2022.12.16	5,000	5,000	-	-	-	
SEASA	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2021.12.17	2022.12.16	2,000	2,000	-	-	-	
SSAP	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	2021.11.09	2022.11.08	35,000	35,000	-	-	-	
SEPM	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2021.06.14	2022.06.13	35,000	35,000	-	-	-	
SESAR	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2021.06.14	2022.06.13	50,000	50,000	-	-	-	

법인명 (채무자)	관계	채권자	내용	목적	보증시작일	보증종료일	채무보증한도		채무금액			이자 율
							기초	기말	기초	증감	기말	
AdGear Technologies Inc.	계열회사	BOA	지급보증	운영자금	2021.11.09	2022.11.08	2,000	2,000	-	-	-	
Harman International Industries, Inc.	계열회사	JP Morgan	지급보증	운영자금	2021.06.14	2022.06.13	100,000	100,000	-	-	-	
Harman International Japan Co., Ltd.	계열회사	MUFG	지급보증	운영자금	2021.11.09	2022.11.08	25,000	25,000	-	-	-	
Harman RUS CIS LLC	계열회사	SocGen	지급보증	운영자금	2021.11.09	2022.11.08	15,000	15,000	-	-	-	
Harman Holding Limited	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2021.06.14	2022.06.13	30,000	30,000	-	-	-	
Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	계열회사	SocGen	지급보증	운영자금	2021.11.09	2022.11.08	15,000	15,000	-	-	-	
Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	계열회사											
합 계							8,265,301	8,245,535	146,556	48,709	195,265	

※ 별도 기준입니다.

[△는 부(-)의 값임]

※ 건별 채무보증금액이 자기자본의 0.1% 이상 2.5% 미만인 경우 경영위원회, 2.5% 이상인 경우 이사회 의결을 통해 결정됩니다.

※ 상기 채무보증에 대하여 당사가 보증하는 채무보증의 대가로 종속기업별 채무보증 만기, 일반적인 신용공여 조건의 이율 등을  
감안하여 수수료를 수취하고 있습니다. 당사는 2021년 중 US\$266천의 수수료를 청구하였으며, 2022년 중 수취하였습니다.

## 2. 대주주와의 자산양수도 등

당사는 2022년 1분기 중 법인의 생산설비 증설 등 목적으로 자산을 Samsung China Semiconductor LLC. (SCS) 등의 계열회사에 매각하였으며, 국내 생산 효율화 등을 위해 자산을 계열회사로부터 매입하였습니다.

(단위 : 백만원)

법인명	관계	거래종류	거래일자	거래대상물	거래목적	거래금액	처분손익
SCS	계열회사	자산매각 · 매입	2022.03.17	기계장치 등	생산설비 증설 · 생산효율화 등	3,296	1,970
SEHC	계열회사	자산매각 · 매입	2022.03.31	기계장치 등	생산설비 증설 · 생산효율화 등	3,129	255
SESS	계열회사	자산매각 · 매입	2022.03.16	기계장치 등	생산설비 증설 · 생산효율화 등	2,912	220
SAS	계열회사	자산매입	2022.03.13	기계장치 등	생산설비 증설 · 생산효율화 등	1,430	0
SII	계열회사	자산매각	2022.01.13	기계장치 등	생산설비 증설 · 생산효율화 등	211	△15
SEVT	계열회사	자산매입	2022.02.15	기계장치 등	생산설비 증설 · 생산효율화 등	12	0
삼성메디슨(주)	계열회사	자산매각	2022.03.17	기계장치 등	생산설비 증설 · 생산효율화 등	5	5

※ 별도 기준입니다.

[△는 부(-)의 값임]

※ 거래일자는 최근 거래일자 기준입니다.

※ 거래금액은 시장 및 가치평가 등을 거쳐 적절히 산정되었으며, 거래 다음달 15일 · 30일 이내 현금 지급조건 등 통상적인 조건으로 거래되었습니다.

※ 상기 자산양수도 거래는 이사회 결의 대상이 아닙니다.

## 3. 대주주와의 영업거래

당사는 2022년 1분기 중 계열회사인 Samsung Semiconductor, Inc. (SSI) 등과 매출,매입 등의 영업거래를 하였습니다.

(단위 : 백만원)

법인명	관계	거래종류	거래기간	거래내용	거래금액
SSI	계열회사	매출 · 입 등	2022.01~2022.03	반도체 매출 등	10,531,601

※ 별도 기준입니다.

※ 공시대상은 최근사업연도 매출액의 5% 이상 기준입니다.

## XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

### 1. 공시내용 진행 및 변경사항

해당사항 없습니다.

### 2. 우발부채 등에 관한 사항

#### 가. 중요한 소송사건 등

당사는 다수의 회사 등과 정상적인 영업과정에서 발생한 소송, 분쟁 및 규제기관의 조사 등이 진행 중에 있습니다. 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며 당사의 경영진은 이러한 소송 등의 결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

당사(삼성전자(주), 삼성디스플레이(주))는 삼성디스플레이(주)의 분할 전 채무에 관하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다.

그 밖의 우발부채 및 약정사항에 대해서는 'III. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표주석' 및 '5. 재무제표 주석'을 참조하시기 바랍니다.

## 나. 채무보증내역

(단위 : 천US\$, %)

법인명 (채무자)	관계	채권자	내용	목적	보증시작일	보증종료일	채무보증한도		채무금액			이자율
							기초	기말	기초	증감	기말	
SEA	계열회사	BOA 등	지급보증	운영자금	2021.04.20	2022.12.16	1,328,000	1,328,000	-	-	-	
SEM	계열회사	BBVA 등	지급보증	운영자금	2021.06.14	2023.03.27	906,000	906,000	-	-	-	
SAMCOL	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	2021.06.14	2022.12.16	310,000	310,000	-	-	-	
SEDA	계열회사	BRADESCO 등	지급보증	운영자금	2021.09.30	2022.12.16	409,000	409,000	-	-	-	
SECH	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	2021.06.14	2022.12.16	62,000	62,000	-	-	-	
SEPR	계열회사	BBVA 등	지급보증	운영자금	2021.06.01	2022.12.16	150,000	150,000	-	-	-	
SSA	계열회사	SCB 등	지급보증	운영자금	2021.06.14	2022.12.16	318,000	318,000	-	-	-	
SEMAG	계열회사	SocGen 등	지급보증	운영자금	2021.11.09	2022.12.16	110,000	110,000	-	-	-	
SETK	계열회사	BNP 등	지급보증	운영자금	2021.06.14	2022.12.16	807,000	807,000	102,275	25,989	128,264	22.3%
SETK-P	계열회사	BNP 등	지급보증	운영자금	2021.11.09	2022.12.16	130,000	130,000	33,334	22,976	56,310	22.6%
SECE	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	2021.07.19	2022.12.16	73,722	72,871	-	-	-	
SEEG	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2021.06.14	2022.06.13	85,000	85,000	-	-	-	
SEIN	계열회사	BNP 등	지급보증	운영자금	2021.06.14	2022.11.08	70,000	70,000	-	-	-	
SJC	계열회사	Mizuho Bank 등	지급보증	운영자금	2021.04.30	2022.12.16	877,579	858,664	-	-	-	
SEUC	계열회사	Credit Agricole 등	지급보증	운영자금	2021.06.14	2022.12.16	150,000	150,000	-	-	-	
SEDAM	계열회사	Citibank 등	지급보증	운영자금	2021.06.14	2022.12.16	141,000	141,000	-	-	-	
SECA	계열회사	BoA	지급보증	운영자금	2021.11.09	2022.11.08	70,000	70,000	-	-	-	
SELA	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2021.12.17	2022.12.16	120,000	120,000	-	-	-	
SEEH	계열회사	HSBC 등	지급보증	운영자금	2021.06.14	2022.12.16	712,400	712,400	-	-	-	
SERK	계열회사	SocGen 등	지급보증	운영자금	2021.06.14	2022.12.16	290,000	290,000	-	-	-	
SELV	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2021.12.17	2022.12.16	10,000	10,000	-	-	-	
SEIL	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2021.12.17	2022.12.16	15,600	15,600	10,947	△256	10,691	1.4%
SAPL	계열회사	BOA 등	지급보증	운영자금	2021.06.14	2022.12.16	345,000	345,000	-	-	-	
SAVINA	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2021.06.14	2022.06.13	51,000	51,000	-	-	-	
SCIC	계열회사	HSBC 등	지급보증	운영자금	2021.06.14	2022.12.16	300,000	300,000	-	-	-	
SME	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	2021.11.09	2022.11.08	110,000	110,000	-	-	-	
SAMEX	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2021.12.17	2022.12.16	5,000	5,000	-	-	-	
SEASA	계열회사	Citibank	지급보증	운영자금	2021.12.17	2022.12.16	2,000	2,000	-	-	-	
SSAP	계열회사	SCB	지급보증	운영자금	2021.11.09	2022.11.08	35,000	35,000	-	-	-	
SEPM	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2021.06.14	2022.06.13	35,000	35,000	-	-	-	
SESAR	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2021.06.14	2022.06.13	50,000	50,000	-	-	-	



법인명 (채무자)	관계	채권자	내용	목적	보증시작일	보증종료일	채무보증한도		채무금액			이자 율
							기초	기말	기초	증감	기말	
AdGear Technologies Inc.	계열회사	BOA	지급보증	운영자금	2021.11.09	2022.11.08	2,000	2,000	-	-	-	
Harman International Industries, Inc.	계열회사	JP Morgan	지급보증	운영자금	2021.06.14	2022.06.13	100,000	100,000	-	-	-	
Harman International Japan Co., Ltd.	계열회사	MUFG	지급보증	운영자금	2021.11.09	2022.11.08	25,000	25,000	-	-	-	
Harman RUS CIS LLC	계열회사	SocGen	지급보증	운영자금	2021.11.09	2022.11.08	15,000	15,000	-	-	-	
Harman Holding Limited	계열회사	HSBC	지급보증	운영자금	2021.06.14	2022.06.13	30,000	30,000	-	-	-	
Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	계열회사	SocGen	지급보증	운영자금	2021.11.09	2022.11.08	15,000	15,000	-	-	-	
Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	계열회사											
Harman Finance International, SCA	계열회사	JP Morgan 등	지급보증	운영자금	2015.05.27	2022.03.01	396,304	-	396,304	△396,304	-	
SDN	계열회사	SIEL	지급보증	운영자금 등	2020.01.03	2024.11.22	671,908	659,431	571,121	△10,605	560,516	5.8%
합 계							9,333,513	8,904,966	1,113,981	△358,200	755,781	

- ※ 연결 기준입니다. Harman Finance International, SCA와 SDN 건의 채무보증인은 각각 Harman International Industries, Inc.와 삼성디스플레이㈜입니다. [△는 부(-)의 값임]
- ※ 건별 채무보증금액이 자기자본의 0.1% 이상 2.5% 미만인 경우 경영위원회, 2.5% 이상인 경우 이사회 의결을 통해 결정됩니다.
- 또한 종속기업인 삼성디스플레이㈜의 경우 건별 채무보증금액이 100억원 이상인 경우 이사회 의결을 통해 결정됩니다.
- ※ 상기 채무보증에 대하여 당사가 보증하는 채무보증의 대가로 종속기업별 채무보증 만기, 일반적인 신용공여 조건의 이율 등을 감안하여 수수료를 수취하고 있습니다. 당사는 2021년 중 US\$266천의 수수료를 청구하여 2022년 중 수취하였습니다.
- 한편, 삼성디스플레이㈜는 SDN에게 2021년 중 US\$2,529천 수수료를 청구하여 2022년 중 수취하였습니다.

### 3. 제재 등과 관련된 사항

제재 등과 관련된 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기/사업보고서에 기재 예정)

### 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기/사업보고서에 기재 예정)

## XII. 상세표

### 1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

연결대상 종속회사 현황(상세)는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기/사업보고서에 기재 예정)

### 2. 계열회사 현황(상세)

계열회사 현황(상세)는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기/사업보고서에 기재 예정)

### 3. 타법인출자 현황(상세)

타법인출자 현황(상세)는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기/사업보고서에 기재 예정)

## 4. 연구개발실적(상세)

☞ 본문 위치로 이동

부문		연구과제 등	연구결과 및 기대효과 등
DX 부문	영상디스플레이	QLED 8K TV (2019.02. ~2020.06.)	<input type="checkbox"/> Flat QLED 8K TV (65 · 75 · 85") <ul style="list-style-type: none"> <li>- 세계 최초 화면과 베젤 간 경계 없는 Infinity 스크린, 플랫한 디자인으로 벽면과의 조화, Floating한 느낌의 메탈 스탠드 적용한 혁신적 폼팩터</li> <li>- 실재를 보는 듯한 화질을 제공하는 QLED 8K 화질, AI Upscaling을 통한 고해상도 화질 경험, 어떤 환경에서도 True Reality화질 제공</li> <li>- 멀티사운드 채널과 Object Tracking Sound+ 적용하여 영상과 사운드가 일치되어 입체감 극대화</li> <li>- 다양한 콘텐츠, Multimedia Experience 및 엔터테인먼트 특화된 기능으로 편리하고 다양한 경험 제공</li> </ul>
		Neo QLED 8K (2021.03. ~2022.03.)	<input type="checkbox"/> Mini LED 기반 초고화질 & 슬림 8K TV (65 · 75 · 85") <ul style="list-style-type: none"> <li>- QN900 (65 · 75 · 85") / QN800 (65 · 75 · 85") / QN900 (65 · 75")</li> <li>- 세밀한 Mini LED의 향상된 명암비로 더욱 실재를 보는 듯한 QLED 8K 화질</li> <li>- 'OTS Pro(Object Tracking Sound Pro)' 기능 추가</li> </ul>
		Neo QLED 4K (2021.03. ~2022.03.)	<input type="checkbox"/> Mini LED 기반 3개 시리즈, 7개 사이즈 (43 · 50 · 55 · 65 · 75 · 85 · 98") <input type="checkbox"/> Mini LED 적용을 통한 Slim 구현 및 Bezel-less/Metal를 통한 디자인 프리미엄 Look <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quantum Nano-Layer Multi-Cell 구조를 적용하여 Slim하면서도 높은 광 효율과 광 Profile 조절이 가능한 New LED</li> <li>- 계조 표현력 4배 향상으로 밝고 어두운 영역을 더욱 자세하게 표현</li> </ul>
		QD-Display TV (~2022.03.)	<input type="checkbox"/> Quantum Dot 기반 self-emitting Display Flat 4K TV (55 · 65") <input type="checkbox"/> Quantum Dot 기반 self-emitting Display 고화질과 Sleek한 Blade Slim Design에 OTS 및 True Ch. ATMOS 까지 모두 적용된 진정한TV 가치를 제공하는QD-Display TV
		QLED 4K TV (~2022.03.)	<input type="checkbox"/> Flat QLED 4K TV (43 · 50 · 55 · 60 · 65 · 70 · 75 · 82 · 85") <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4K 최고의 화질(AI/밝기/시야각) 및 음질(OTS)을 통한 시청 경험을 극대화한 Flagship QLED</li> <li>- 최고의 명암비, 시야각 Free, Life-like 컬러와 최적의 밝기로 몰입감을 극대화</li> <li>- 음성인식 및 AI 기술 기반으로 외부 환경 및 사용자 Context를 인지하여 최적의 시청 경험 제공</li> <li>- 외장 Camera 적용을 통한 Google Duo 지원</li> </ul>
		UHD TV (~2022.03.)	<input type="checkbox"/> Flat UHD TV (43 · 50 · 55 · 58 · 60 · 65 · 70 · 75 · 82 · 85") <ul style="list-style-type: none"> <li>- Slim한 Bezel-less 디자인과 실제 자연색에 가까운 Color를 제공하는 UHD 스마트 TV</li> <li>- Dynamic Crystal Color 및 Dual LED를 통해 원본 콘텐츠의 화질을 그대로 표현하는 UHD 화질</li> <li>- Multi-media Screen 경험 제공, 풍부한 콘텐츠, Smart Home의 경험을 통해 완성된 Smart 경험 제공</li> <li>- Game Home, IoT Hub, Watch/Chat together 기능 추가를 통한Smart 경험 강화</li> </ul>
		Lifestyle TV (~2022.03.)	<input type="checkbox"/> The Sero (43") <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modern &amp; Simple 한 세로형 Screen에 판상형 Speaker가 부착된 360도 Design</li> <li>- 다양한 거주공간 어디에도 쉽게 거치 가능, 이동 가능한 Floor 스탠드 제공</li> <li>- 기울어진 폼팩터에도 외광/실내 조명 반사 없는 화질로 기존 제품의 VoC 대폭 개선</li> </ul> <input type="checkbox"/> The Frame (32 · 43 · 50 · 55 · 65 · 75 · 85") <ul style="list-style-type: none"> <li>- Real 액자 디자인 및 액자 설치 경험 완성</li> <li>- 다양한 영화, 사진 등 감상 가능, 인테리어와 조화로운 Lifestyle 디자인 채용</li> <li>- 초대형 Life Style 제품 니즈에 따른 85" 추가도입</li> <li>- 외광/실내 조명 반사 없이 항상 종이와 같은 질감을 표현하는 화질로 Real Frame 경험 완성</li> </ul> <input type="checkbox"/> The Serif (43 · 49 · 55 · 65") <ul style="list-style-type: none"> <li>- 'I' 형태 Serif Font 디자인으로 확실한 차별화 및 인테리어 감성 극대화</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- 대형 사이즈 제품 포지션 확대를 위한 65" 추가도입</li> <li>- 외광/실내 조명 반사 없이 항상 매트한 질감을 표현하는 화질로 가구와 같은 디자인 완성</li> </ul> <input type="checkbox"/> Outdoor TV(55 · 65 · 75") <ul style="list-style-type: none"> <li>- 옥외에서 휴식과 Entertainment를 동시에 즐기려는 Lifestyle 대응을 위한 차별화된 제품</li> </ul> <input type="checkbox"/> The Premiere (100~130") <ul style="list-style-type: none"> <li>- 초단초점 · 레이저 · 고화질 품팩터에 업계 최고 Smart UX/OTT 경험 제공</li> <li>- Blended 디자인으로 벽 근처에 쉽게 놓고 원하는 공간에 적합한 사이즈로 투영</li> <li>- 당사 TV의 완성된 콘텐츠 경험과 차별화된 화질 · 음질을 제공하는 프로젝트</li> </ul> <input type="checkbox"/> The Freestyle (30 ~ 100") <ul style="list-style-type: none"> <li>- 언제 어디서나 다양한 콘텐츠를 쉽게 감상할 수 있는 Movable Smart Screen</li> <li>- 다양한 공간에 쉽게 놓이며 각도/거리에 상관없이 최적 시청 경험 제공(Auto Focus/Auto Keystone)</li> <li>- 기본Cradle로 다양한 공간에 거치 사용성이 추가되고 소켓을 통해 신규 설치 확장도 가능</li> </ul>
		Micro-LED TV (~2022.01.)	<input type="checkbox"/> The Wall 2.0 (110") <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tech. leadership 및 Micro-LED 시장 장악력 강화하기 위해 Micro-LED 완품형 출시</li> <li>- 실제 세상을 화면에 재현하는 초대형 Home Screen</li> <li>- 해상도 제약없이, 실재를 보는 듯한 공간감 및 깊이감/입체감 있는 Micro-LED 화질</li> </ul>
		Sound Bar (~2022.03.)	<input type="checkbox"/> Sound Bar <ul style="list-style-type: none"> <li>- TV와 조화로운 'Bar' 형태의 오디오 제품</li> <li>- 음성 인식 AI Solution 채용</li> <li>- 3D 서라운드 채용으로 현장감 극대화 및 공간을 채우는 사운드 구현</li> </ul> <input type="checkbox"/> Sound Bar Q990B <ul style="list-style-type: none"> <li>- 업계 최초, TV에서 사운드바로 무선 ATMOS 전송(Wireless ATMOS)</li> <li>- TV와 Soundbar의 모든 채널을 활용하여 극장과 같은 최상의 Cinema True ATMOS 제공</li> <li>- 사운드바 자체 공간 보정 기술 탑재</li> </ul>
		모니터 (2021.01. ~2022.03.)	<input type="checkbox"/> 스페이스 모니터 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 모니터가 차지하는 공간을 최소화한 일체형 Arm Stand 적용</li> </ul> <input type="checkbox"/> Neo QLED 게이밍 모니터(49") <ul style="list-style-type: none"> <li>- Neo QLED 적용하여 향상된 명암비를 기반으로 블랙 표현력 강화</li> <li>- 세계 최고 곡률 1000R 적용하여 게이밍 몰입 강화</li> </ul> <input type="checkbox"/> 고해상도 QHD 모니터(34") <ul style="list-style-type: none"> <li>- Intelligent Eye Care 솔루션 등으로 눈에 편안한 화질 솔루션 제공</li> </ul> <input type="checkbox"/> LCD 스마트 모니터: 스마트 TV 서비스 활용하여 PC 없이 VOD 시청 (Netflix, Youtube 등) <input type="checkbox"/> 스마트 모니터 M80B (32") <ul style="list-style-type: none"> <li>- 초슬림, Flat Back, Warm White 컬러 적용 Lifestyle 디자인</li> <li>- Magnetic 방식의 전용 카메라 In-box 영상 커뮤니케이션</li> <li>- 스마트 경험 강화(VOD 시청/모바일 연결/PC-less기능/IoT/Communication/Game)</li> </ul>
		사이니지 (2019.10. ~2021.06.)	<input type="checkbox"/> LCD 기반의 B2B Smart Signage (LFD, Video Wall 등) (49 · 55 · 65 · 75 · 85 · 98") <input type="checkbox"/> LED 소자를 활용한 Indoor / Outdoor 사이니지 <input type="checkbox"/> 부가 장치 일체형 All-in-one Kiosk (24") <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tizen 결제모듈/주문 앱 개발 위한 결제 플랫폼, 항공 코팅</li> </ul> <input type="checkbox"/> FLIP-Edu (75 / 85") 교육용 인터랙티브 제품
	생활가전	냉장고 (~2022.02.)	<input type="checkbox"/> Chef Collection 냉장고 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 프리미엄 Bespoke 디자인 및 신규 CMF 적용</li> <li>- Water &amp; Ice Solution 적용: Auto Fill Pitcher, Auto Ice Maker (Dual Mode: Cocktail Ice, Standard Ice)</li> <li>- FDSR 에너지 1등급 구현</li> </ul> <input type="checkbox"/> Cube 냉장고 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Multi Cube 냉장고, 나에게 맞춘 디자인과 수납(와인, 맥주, 화장품 등 온도별 저장)</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peltier System 구현, 최적의 온도 제어 (5~18℃ 온도 조절 가능)</li> <li>- 2중 Glass System 적용으로 자외선 차단 및 정온 유지</li> <li>- Wi-Fi Control로 상시 모니터링 · 제어</li> <li>- RM(Remote Management) Function: 각종 오류 원격 진단 · 조치 및 보관중 음료의 유통기한 알림</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> 복미/중남미 신규 TMF</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대용량, 전문보관, New Design으로 경쟁력 강화 및 제품 차별화(440L/480L)</li> <li>- Flex Zone(Fridge 1℃ / Chilled -1℃ / Soft Freezing) &amp; Quick Chill Smart Alarm</li> <li>- Flat Door &amp; Bespoke CMF, 용량 및 최적 사이즈로 경쟁력 강화(20ℓ More)</li> <li>- Bi Volt(Free Voltage), Auto Icemaker, Water Dispenser, Big Box, Hygie</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> 1-Door Premium Kitchen Fit 냉장고 (냉동/냉장/김치/와인)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Premium Bespoke 디자인 및 신규 CMF 적용</li> <li>- Auto Door Open</li> <li>- Water &amp; Ice Solution 적용: Auto Fill Pitcher, Dual Auto Ice Maker(Cocktail Ice, Standard Ice)</li> </ul>
		세탁기 (~2022.01.)	<p><input type="checkbox"/> BESPOKE 세탁기 &amp; 건조기</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 당신의 공간에 딱 맞추는 비스포크 Flat 디자인</li> <li>- 국내 최대 용량 올인원 컨트롤 UX 디자인</li> <li>- 세탁부터 건조까지 AI 의류 케어(AI 맞춤세탁, 건조)</li> <li>- 99.9% 살균부터 세탁실 제습까지 위생관리 솔루션</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> Agitator 세탁기</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 복미 Agitator 신규 시장 진입(Top Loader 시장 중 50% 점유)</li> <li>- ActiveWave™ Agitator 구현으로 소음, 진동 및 엉킴 줄이는 동시에 강력 세탁 가능</li> <li>s- 'Active Water Jet' 구현으로 애벌 세탁 가능</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> 구주향 친환경 신냉매 건조기</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 친환경 냉매 : 온실가스감축을 위한 친환경 냉매(R290) 적용</li> <li>- 에너지 A+++ : 구주 에너지 최고 등급 달성</li> <li>- Sensor Dry : 건조행정 중 건조도 감지, 추가 건조부터 행정 종료까지 알아서 판단</li> <li>- Simple UX : 제품 사용성 개선 (상세한 건조 정보 전달 및 맞춤형 패널 설정)</li> <li>- Hygiene Care : 유해 세균3종(녹농균, 대장균, 황색포도상구균) 99% 이상 살균</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> 그랑데 AI 24kg 세탁기</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 24kg, Flat Design (Glass Type)</li> <li>- 핏케어 코스 적용(열룩, 냄새, 알러젠 제거)</li> <li>- Auto open door 적용(세탁 종료 후 자동으로 문 열림)</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> BESPOKE 그랑데 AI 20kg 건조기</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국내최초 최대 용량 20kg, Flat Design</li> <li>- 핏케어 코스 적용(털제거 특화),</li> <li>- Auto open door 적용(건조 종료 후 자동으로 문 열림)</li> <li>- 온/습도 센서추가하여 세탁실 주변 습도 감지하여 제습 솔루션 제공</li> </ul>
		에어컨 (~2021.04.)	<p><input type="checkbox"/> 무풍 갤러리 스탠드 에어컨(56.9 · 62.6 · 75.5 · 81.8 · 92.5㎡)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 에너지 우위 확보가 가능한 최고 효율 Next 무풍 플랫폼 개발(56.9㎡ 싱글 에너지 2등급 달성)</li> <li>- 1.5배 넓어진 무풍 면적(패널)과 강력한 부스터풍</li> <li>- 부스터 청정: 집진효율 99.95% 필터, 가구같이 편안한 갤러리 디자인</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> 무풍 벽걸이 와이드 에어컨(24.4 · 29.3 · 39.6 · 49.5㎡)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- QMD 기반의 신규 통합 플랫폼 개발로 원가경쟁력 확보, 제품 경쟁력 강화</li> <li>- 12% 더 커진 팬으로 빠르고 시원한 패스트 쿨링</li> <li>- 전기료 부담을 최대 77% 덜어주는 무풍 미세 초절전</li> <li>- 초미세먼지까지 제거하는 PM1.0 필터시스템의 무풍청정</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> BESPOKE 원도우핏 에어컨(17㎡, 그린/블루/핑크/베이지/그레이)</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- 실내외기 일체형으로 셀프 간편 설치</li> <li>- 2중 바람 날개로 냉기를 빠르게 순환하는 강력 회전 냉방</li> <li>- 트윈 인버터 컴프레서로 도서관 수준의 37dB 저소음&amp;저진동</li> <li>- 저소음 모드 사용 시 소비전력 최대70% 절전</li> </ul>
		청소기 (~2021.05.)	<input type="checkbox"/> BESPOKE 제트 스틱 청소기(최고 흡입력 210W) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일체형 자동 먼지배출기, 스마트한 정보전달(LCD Display)</li> <li>- 물분사 물걸레 브러시, 슬림 용 브러시</li> </ul> <input type="checkbox"/> 제트봇 AI 로봇 청소기 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Active 3D 센서 개발 및 세계최초 적용하여 세계 최소(1cm) 감지 실현으로 걸림 없는 주행</li> <li>- 우리집 구조와 사물 종류까지 인식하는 AI 자율주행</li> <li>- 제트 싸이클론과 디지털 인버터모터로 강력한 흡입력</li> <li>- 충전과 동시에 자동 먼지비움 일체형 청정스테이션</li> <li>- SmartThings로 더욱 편리해진 청소(AI 스마트컨트롤)</li> </ul> <input type="checkbox"/> BESPOKE 슬림 스틱 청소기 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 강력한 싸이클론과 디지털 인버터모터로 최대 150W 흡입력</li> <li>- 셀프 스탠딩 및 허리 부담없이 간편 먼지 비움(POP &amp; SHOOT)</li> <li>- 손목에 무리없이 가볍게 청소(인체공학 설계)</li> </ul>
		조리기기 (2021.03.)	<input type="checkbox"/> BESPOKE 쿠키(Qooker) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 열원이나 온도/시간이 다른 식품을 한번에 맞춤 조리하는 "멀티쿡"</li> <li>- Multi Cook: 하나 이상의 조리가 동시에 완료되어지는 모드 적용</li> <li>- 식품사(8개 회사)와 연계 쿠키 전용 알고리즘 적용</li> <li>- SmartThings 연계 스캔 한번으로 쉽게 자동 조리 구현</li> <li>- 열효율 및 고급감 STS 조리실: 법랑 → STS 적용</li> </ul>
		정수기 (2021.03.)	<input type="checkbox"/> 가정용 Water Purifier <ul style="list-style-type: none"> <li>- 소비자 라이프스타일에 따라 업그레이드하고 스스로 케어하는 모듈형 정수기</li> <li>- 소비자 니즈에 따라 선택 가능한 모듈(정수/냉수/온수)</li> <li>- Smart AI 케어 및 직수형 최다항목 NSF 인증 필터</li> <li>- 라이프 스타일과 공간 맞춤 『BESPOKE 정수기』</li> </ul>
		의류관리기 (2019.02. ~2021.05.)	<input type="checkbox"/> BESPOKE 에어드레서 (18 · 24") <ul style="list-style-type: none"> <li>- AI 건조 및 세탁기 코스 연동</li> <li>- 긴 옷도 편리하게 관리하는 긴 옷 케어존, 18인치 3벌 → 5벌 용량 확장</li> <li>- 리얼 케어(안감 케어, 저소음), 리얼 청정(미세먼지필터), 리얼 탈취(냄새분해필터)</li> <li>리얼 살균(제트스팀), 주름관리, 리얼 공간제습</li> </ul> <input type="checkbox"/> 슈드레서 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 에어워시와 UV 냄새분해필터로 강력 탈취</li> <li>- 매일 신는 신발 기분좋게 저온섬세검조</li> <li>- 국내 가전 최초 제논 UVC 살균으로 99.9% 살균</li> <li>- 제트슈트리로 다양한 신발 맞춤케어 관리</li> </ul>
		공기청정기 (2020.12.)	<input type="checkbox"/> BESPOKE Cube 공기청정기 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bespoke를 적용한 프리미엄 공기청정기</li> <li>- 살균 · 탈취 · Pet 3가지 전문 필터를 소비자의 필요에 따라 사용</li> <li>- 공간, 인테리어, 라이프 스타일 맞춤 Bespoke 공기청정기</li> <li>- 인테리어에 어울리게 벽에 붙여 사용해도 성능 저하 없는 입체 흡입 구조</li> </ul>
		청정환기 시스템 (2020.09.)	<input type="checkbox"/> 청정환기 시스템 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 청정성능 33㎡, 환기풍량 40~50CMH</li> <li>- 환기장치에 실내청정모듈 연결로 환기와 실내청정 동시 구현</li> <li>- 각 재실공간별 개별&amp;독립 청정 및 순환&amp;무풍 청정</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- CO2센서 등의 센서 탑재를 통한 상황맞춤 자동 환기제어</li> </ul>
			<input type="checkbox"/> Galaxy Fold (2019.09.) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 세계 최초 In-Foldable Smart Phone 개발을 통한 신규 시장 창출 및 Market Share 확보</li> <li>- 7.3" QXGA+(1,536×2,152) 1.5R In-Foldable Display</li> <li>- 세계 최초 In-Foldable용 Hinge 개발을 통해 표준 기술 확보(2019.02. 공개)</li> <li>- 폴더블 스마트폰에 맞는 새로운 User Experience 제공</li> <li>- 3분할 Multi Active Window 기능으로 독보적인 멀티태스킹 환경 제공</li> <li>- 폴딩 · 언폴딩 시 다른 스크린 간 자연스러운 연속적인 앱 사용성 경험 제공</li> </ul>
			<input type="checkbox"/> Galaxy Z Flip (2020.02.) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Design: The New Style with Innovative Foldable Display</li> <li>- 인치: Main 6.7" Flexible Ultra Thin Glass(2,636 x 1080) Cover 1.1" Super AMOLED(300 x 112)</li> <li>- 사이즈(W x H x D): (Unfolded) 73.6mm x 167.3mm x 6.9~7.2mm (Folded) 73.6mm x 87.4mm x 15.4~17.3mm</li> <li>- Platform(H/W, S/W): SDM855+, Android 10.0</li> <li>- Ultra Thin Glass 기술로 갤럭시 최초 접히는 유리 디스플레이 탑재하여 내구성 강화</li> <li>- Flip 폴드 형태의 Compact한 신규 폼팩터로 휴대성 강화</li> <li>- Free-Stop 기능을 통해 접히는 각도를 자유롭게 조절하는 Flex Mode 사용 경험 제공</li> <li>- 21.9 : 9 화면 비율로 상하 Multi Active Window 사용성 강화</li> </ul>
			<input type="checkbox"/> Galaxy Z Fold2 (2020.09.) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인치: 메인 디스플레이 7.6", 커버 디스플레이 6.2"</li> <li>- 사이즈(W x H x D): (접힘상태) 68 x 159.2 x 13.8 (~16.8) mm</li> <li>- Platform(H/W, S/W): SDM865 Plus, Android 10.0, One UI 2.5</li> <li>- 초고속 5G 이동통신 지원, 1,200만 화소 카메라</li> <li>- 인피니티 플렉스 디스플레이(Infinity Flex Display), 플렉스 모드 지원</li> <li>- 120Hz 가변 주사율의 다이내믹 아몰레드 2X 디스플레이(Dynamic AMOLED 2X display)</li> <li>- 삼성 Ultra Thin Glass</li> <li>- 무선 연결 삼성 덱스(Samsung Dex), UWB(초광대역) 지원</li> <li>- 최대 3개의 앱을 동시에 사용할 수 있는 진화된 멀티 액티브 윈도우</li> <li>- 커버 디스플레이에서 메인 디스플레이로 앱 연속성 제공</li> </ul>
			<input type="checkbox"/> Galaxy Z Fold3 5G (2021.08.) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인치: 메인 디스플레이 7.6", 커버 디스플레이 6.2"</li> <li>- 사이즈(W x H x D): (접었을 때) 158.2mm x 67.1mm x 14.4~16.0mm (펼쳤을 때) 158.2mm x 128.1mm x 6.4mm</li> <li>- Platform(H/W, S/W): 5나노 64비트 옥타코어 프로세서, Android 11, One UI 3.1.1</li> <li>- 폴더블 스마트폰 최초 IPX8 등급지원 (1.5m 담수에서 최대 30분간 방수지원)</li> <li>- 알루미늄 소재인 'Armor Aluminum'과 'Corning® Gorilla® Glass Victus™' 강화 유리 적용으로 내구성 강화</li> <li>- 7.6" 인피니티 플렉스 디스플레이 탑재 및 언더 디스플레이 카메라 (Under Display Camera) 적용</li> <li>- 에코스케어(Eco2) 기술로 디스플레이 화면 약 29% 밝기 향상</li> <li>- 메인 / 커버 디스플레이 모두 120Hz 화면 주사율 지원</li> <li>- 폴더블폰 최초로 S펜 적용</li> <li>- 플렉스 모드패널(Flex Mode Panel)로 최적화 되지 않은 앱도 원하는 각도에서 상하단 표시 지원</li> <li>- 최대 3개 앱까지 화면 분할해 사용하는 멀티 액티브 윈도우 (Multi-Active Windows) 지원</li> </ul>
	MX	갤럭시 폴더블 (2019.09. ~2021.08.)	<input type="checkbox"/> Galaxy Z Flip3 5G (2021.08.) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인치: 메인 디스플레이 6.7", 커버 디스플레이 1.9"</li> <li>- 사이즈(W x H x D): (접었을 때) 86.4mm x 72.2mm x 15.9~17.1mm</li> </ul>

			<p>(펼쳤을 때) 166mm x 72.2mm x 6.9mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Platform(H/W, S/W): 5나노 64비트 옥타코어 프로세서, Android 11, One UI 3.1.1</li> <li>- 폴더블 스마트폰 최초 IPX8 등급지원 (1.5m 담수에서 최대 30분간 방수지원)</li> <li>- 알루미늄 소재인 'Armor Aluminum'과 'Corning® Gorilla® Glass Victus™' 강화 유리 적용으로 내구성 강화</li> <li>- 커버 디스플레이 사용성 강화 : 알림/메시지 8줄까지 확인가능, 날씨/걸음수 위젯 지원, 삼성페이 결제 지원</li> <li>- 플렉스 모드 활용 강화: 촬영 인원에 따라 자동으로 구도를 조절하는 자동 프레임링(Auto Framing), 듀얼 프리뷰 (Dual Preview) 등 지원</li> <li>- 메인 디스플레이 120Hz 화면 주사율 지원</li> </ul>
		갤럭시 S (~2022.02.)	<p><input type="checkbox"/> Galaxy S10e • S10 • S10+ • S10 5G (5.8 • 6.1 • 6.4 • 6.7") (2019.03., 5G: 2019.04.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Design: Full Front Punch Hole Infinity Display</li> <li>- Platform(H/W, S/W): Exynos9820, SDM855, Android 9.0</li> <li>- 세계 최초 5G 기술 상용화 단말</li> <li>- Triple Camera 조합으로 Zoom, Tele, Ultra Wide 촬영 가능 (12M(Wide)+12M(Tele)+16M(Ultra Wide))</li> <li>- 세계 최초 HDR10+ 동영상 모바일 녹화 지원</li> <li>- Dynamic AMOLED Display로 원본에 가까운 색 표현, HDR 화질 지원</li> <li>- 초음파 방식 On-Screen 지문인식 센서 탑재</li> </ul>
			<p><input type="checkbox"/> Galaxy S20 • S20+ • S20 Ultra 5G (2020.03.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Design: Best Fit in hand compact, yet large screen design</li> <li>- 인치: S20 6.2", S20+ 6.7", S20 U 6.9"</li> <li>- 사이즈(W x H x D): S20 69.1 x 151.7 x 7.9 mm, S20+ 73.7 x 161.9 x 7.8 mm, S20 U 76.0 x 166.9 x 8.8 mm</li> <li>- Platform(H/W, S/W): Exynos990, SDM865, Android 10.0, One UI 2.1</li> <li>- 비약적으로 향상된 해상도와 8K 동영상 촬영으로 전에 없던 퀄리티의 사진과 영상을 찍고 5G로</li> <li>쉽고 빠르게 공유하여 모바일과 사진의 미래를 바꿀 스마트폰</li> <li>- 비약적으로 향상된 해상도로 완성하는 사진과 동영상: S20 • S20+ 64MP, S20 U 108MP</li> <li>- 스마트폰 사상 가장 높은 배율의 스페이스 줌(100배): S20 U 108MP</li> <li>- 3배 가까이 커진 센서로 야간에도 더 밝고 선명한 사진 • 동영상 기록(AI기술접목)</li> <li>- 스마트폰 사상 가장 뛰어난 8K 해상도의 동영상 촬영</li> <li>- 떨리는 순간에도 흔들림은 적게, 역동적인 모습은 고스란히 담은 슈퍼스테디</li> <li>- 단 한번의 촬영으로 베스트 사진과 동영상을 남길 수 있는 싱글테이크</li> </ul>
			<p><input type="checkbox"/> Galaxy S20 FE (2020.10.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 더 많은 고객에게 S 시리즈의 경험 제공</li> <li>- 인치: 6.5" FHD+ sAMOLED Infinity-O (2,400 x 1,080)</li> <li>- 사이즈(W x H x D): 74.5mm x 159.8mm x 8.4mm</li> <li>- Platform(H/W, S/W): Exynos990, SDM865, Android 10.0, One UI 2.5</li> <li>- 프리미엄 기능을 흡수한 새로운 Entry Flagship Line 제품으로 시장 영향력 확대 및 소비자에게 최적화된 다양한 기능의 경험 기회 부여</li> <li>- S20 핵심 기능 제공: 120Hz display, Camera, Battery 등 동일 체험 제공, Flagship 동등 AP 사용 및 One UI 2.5 UX</li> </ul>
			<p><input type="checkbox"/> Galaxy S21 5G • S21+ 5G • S21 Ultra 5G (2021.01.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Design: Iconic and premium full metal camera housing, Bezel-less Design</li> <li>- 인치: S21 5G 6.2", S21+ 5G 6.7", S21 Ultra 5G 6.8"</li> <li>- 사이즈(W x H x D): S21 5G 71.2 x 151.7 x 7.9 mm, S21+ 5G 75.6 x 161.5 x 7.8 mm, S21 Ultra 5G 75.6 x 165.1 x 8.9 mm</li> </ul>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Platform(H/W, S/W): Exynos2100, SDM888, Android 11.0, One UI 3.1</li> <li>- 초고속 5G 이동통신 지원, Wi-Fi 6E 지원, 고화소 카메라 탑재</li> <li>• 카메라: S21 Ultra 1억 8백만 화소, S21 • S21+ 6,400만 화소, Multi Camera Recording 기능</li> <li>• 최대 120Hz 가변 주사율 Dynamic AMOLED 2X Infinity-O 디스플레이 탑재</li> <li>• SmartTag와 연동한 쉬운 사물 등록 • 찾기 기능 지원</li> <li>• Digital Car Key 서비스 지원(S21+ 5G • S21 Ultra 5G only)</li> <li>• S Pen 지원(S21 Ultra 5G only)</li> </ul>
			<input type="checkbox"/> Galaxy S22 • S22+ • S22 Ultra (2022.02.) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Design: Enhance Galaxy Design attractiveness with geometric bold design and integrity on quality</li> <li>- 인치 : S22 6.1", S22+ 6.6", S22 Ultra 6.8"</li> <li>- 사이즈(W x H x D) : S22 70.6 x 146.0 x 7.6 mm, S22+ 75.8 x 157.4 x 7.6 mm, S22 Ultra 77.9 x 163.3 x 8.9 mm</li> <li>- Platform(H/W, S/W): SDM8450   Exynos2200, Android 12.0, One UI 4.1</li> <li>- 카메라 동영상 촬영 및 저조도 성능 강화               <ul style="list-style-type: none"> <li>• 동영상 : HDR, OIS+AI Stabilizer 성능 개선으로 풍부한 컬러 지원 및 흔들림/지터링 최소화</li> <li>• 저조도 성능강화 : Big Pixel 센서 및 On-device AI 알고리즘 적용</li> </ul> </li> <li>- S Pen 내장을 통한 Ultra/Note 통합 * Latency 최적화 : 5.6ms(S21 Ultra) → 2.8ms(S22 Ultra)</li> <li>- Display 야외 시인성 개선 * Peak 휘도: 1,500nit(S21 Ultra) → 1,800nit(S22 Ultra)</li> <li>- All day 사용 가능한 배터리와 초고속 45W 충전 속도 (S22 Ultra/S22+)</li> <li>- 내구성 강화 : 10% 개선된 Amor AL, Victus Glass 적용</li> <li>- Galaxy Foundation 경험 완성도 제고               <ul style="list-style-type: none"> <li>• One UI 4.1: 감성적 Interaction 경험과 사용자 개인경험 고도화</li> <li>• Galaxy Eco : End-to-End 완성도 제고 및 체감 편의 경험 강화</li> </ul> </li> </ul>
		갤럭시 노트 (~2020.08.)	<input type="checkbox"/> Galaxy Note10 • 10+ (6.3 • 6.8") (2019.08.) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Design: Full Front Punch Hole Infinity Display</li> <li>- Platform(H/W, S/W): Exynos9825, SDM855, Android 9.0</li> <li>- 업그레이드된 S Pen               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Battery 증대 및 BT Latency 개선으로 Pen 사용성 강화</li> <li>• 사진 촬영(모드 변경, 줌인아웃), 음량조절, 앱 실행, 스톱워치 동작 지원 등</li> </ul> </li> <li>- Note10+: Quad 카메라 탑재로 다양한 조도 환경에서 고해상도 및 최대 시야각 촬영 지원               <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12M(Wide) + 12M(Tele) + 16M(Ultra Wide) + VGA</li> </ul> </li> <li>※ Note10은 Triple 카메라 탑재</li> </ul>
			<input type="checkbox"/> Galaxy Note20 • 20 Ultra (6.7 • 6.9") (2020.08.) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사이즈(W x H x D): Note20 75.2 x 161.6 x 8.3 mm, Note20 Ultra 77.2 x 164.8 x 8.1 mm</li> <li>- Platform(H/W, S/W): Exynos990, SDM865 Plus, Android 10, One UI 2.5</li> <li>- 초고속 5G 이동통신 지원, Wi-Fi 6 지원</li> <li>- 갤럭시 스마트폰 최초로 UWB(Ultra Wideband, 초광대역통신) 지원(Note 20 Ultra)</li> <li>- 1억 8백만 화소 카메라(Note 20 Ultra), 6,400만 화소 카메라(Note 20)</li> <li>- 최대 120Hz 주사율의 디스플레이(Note 20 Ultra)</li> <li>- 최초 무선 연결 삼성 데क्स(Samsung DeX) 연결 지원</li> <li>- 완벽한 필기감과 함께 편리한 사용성을 제공하는 S펜과 삼성 노트, MS 엑스박스(Xbox) 게임 지원</li> </ul>
		갤럭시 탭 (~2022.02.)	<input type="checkbox"/> Galaxy Tab S7 • S7+ (2020.08.) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Design: Premium Tablet (Display, Pen, Performance)</li> <li>- 인치: 12.4" WQXGA sAMOLED(16:10, 2800x1752/120Hz), 11" WQXGA LTPS TFT(16:10, 2,560x1,600/120Hz)</li> <li>- 사이즈(W x H x D): 285.0 x 185.0 x 5.7mm(12.4"), 253.8 x 165.3 x 6.3mm(11")</li> <li>- Platform(H/W, S/W): SDM865+, Android 10.0, One UI 2.5</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 대형 Display 박형 Metal 디자인 구현으로 프리미엄 제품 경쟁력 확보</li> <li>- Tablet 최초 5G (mmWave) 탑재하여 Global 및 미주 4대 사업자 출시</li> <li>- 120Hz Display 고속 구동 및 Pen Latency(9ms) 최적화로 Samsung Notes 사용성 강화</li> <li>- N세대 AP 탑재로 Performance 극대화(Seamless multi-tasking &amp; gaming experience)</li> </ul>
		<p>□ Galaxy Tab S7 FE (2021.06.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인치: 12.4" WQXGA (2560 x 1600)</li> <li>- 사이즈(W x H x D) &amp; 무게: 284.8mmx 185mm x 6.3mm, 608g(LTE 기준)</li> <li>- 12.4" 대화면 Display와 slim 베젤로 몰입감 있는 디스플레이</li> <li>- 긴 배터리 사용시간 (10,090mAh, Up to 13 hours video play)</li> <li>- Dolby Atmos 적용으로 풍성한 사운드</li> <li>- Samsung Note 사용성 강화 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 간편하게 손글씨를 TEXT로 변환</li> <li>· 입력창에 직접 S Pen으로 입력</li> </ul> </li> <li>- PENUP Drawing 기능 강화 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Layer 구조 적용 및 컬러링 &amp; 라이브 드로잉 제공</li> </ul> </li> <li>- 경량화 키보드 커버 (330g)</li> <li>- 3Mic를 통한 주변 Noise 50%감소로 깨끗한 보이스 전달</li> <li>- Device 연결성 강화 <ul style="list-style-type: none"> <li>· Second Screen: Tablet을 PC의 보조 모니터로 사용</li> <li>· Hand off: Phone에서 사용하던 걸 Tablet에서 바로 이어서 사용 (Internet, Samsung Notes)</li> <li>· Copy &amp; Paste: Phone과 Tablet 간 Text 및 이미지를 복사 &amp; 붙이기</li> <li>· Auto Switching: 자동으로 Phone/Tablet 간 버즈 스위칭</li> </ul> </li> </ul>
		<p>□ Galaxy Tab A8 (2021.12.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인치: 10.5" WUXGA (1920 x 1200)</li> <li>- 사이즈(W x H x D) &amp; 무게: 246.8mm x 161.9mm x 6.9mm, 508 g</li> <li>- Platform(H/W, S/W): UniSOC T618(12nm) 프로세서, Android 11, One UI 3</li> <li>- Memory : 3GB + 32GB / 4GB + 64GB / 4GB + 128GB, microSD 최대 1TB</li> <li>전작 대비 RAM 4GB 및 ROM 128GB 옵션 신규 제공</li> <li>- 당사 Tablet Design ID 확립 및 적용 (Samsung Logo, Camera 형상 및 위치, 측면 전후면 대칭), Tab S8 Flagship Family 와 동일 컬러 적용 (Gray, Silver, Pink Gold)</li> <li>- 당사 태블릿 표준 Display 비율 16:10 적용, 10.5"대화면 및 Slim Bezel로 몰입감 있는 멀티미디어 경험 제공</li> <li>- Dolby Atmos 지원 및 Quad Speaker 탑재, Samsung TV Plus 등 콘텐츠 특화 앱 프리로드 (무료 Live Streaming 및 VOD 제공)</li> <li>- Multi-Active Window 로 2 Split Windows 및 Pop-up 창 지원, Fold3 적용된 Drag &amp; Split 태블릿 최초 지원으로 <ul style="list-style-type: none"> <li>멀티태스킹 경험 강화</li> </ul> </li> <li>- Tab A 시리즈 최초 Screen Recorder 지원으로 온라인 클래스 활용도 강화</li> <li>- One UI 3.1.1 Galaxy Experience 확산 지원 (Copy&amp;Paste, Auto Sync, Auto Switch)</li> </ul>
		<p>□ Galaxy Tab S8 · S8+ · S8 Ultra (2022.02.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인치 : Tab S8            11" WQXGA+ (2560 x 1600)  Tab S8+            12.4" WQXGA+ (2800 x 1752)  Tab S8 Ultra 14.6" WQXGA+ (2960 x 1848)</li> <li>- 사이즈(W x H x D) &amp; 무게 : Tab S8            253.8mm x 165.3mm x 6.3mm, 503g  Tab S8+            285.0mm x 185.0mm x 5.7mm, 567g  Tab S8 Ultra 326.4mm x 208.6mm x 5.5mm, 726g</li> <li>- Platform(H/W, S/W): SM8450 프로세서, Android 12, One UI 4.1</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memory : 8GB+128GB / 8GB+256GB / 12GB+256GB / 16G+512G, microSD up to 1TB</li> <li>- 화상 통화 경험 향상 [Tab S8 Ultra] Dual 전면 카메라(12M 80도, 12M 120도) 및 Auto Framing 기능 제공 [Tab S8+ / Tab S8] 12M 120도 전면 카메라 및 Auto Framing 기능 제공</li> <li>- AP 방열 설계 강화를 통한 AP Sustain 성능 개선(전작비 GPU 70%, CPU 25%↑), 게임 성능 향상</li> <li>- S Pen Latency 개선 (5.6ms → 2.65ms) 및 Prediction Algorithm 최적화 Writing &amp; Drawing 시 Real Pen과 같이 끊김 없고 정밀한 필기 경험 제공, 밀착감 개선</li> <li>- 3 MIC Noise Cancellation 성능 강화 (3종 잡음 제거 모드)로 화상 회의 오디오 경험 향상</li> <li>- 태블릿 최초로 WiFi 6E 기능을 탑재하여 Device 간 대용량 데이터 전송 시간 개선</li> <li>- D2D 15W 충전 기능 탑재하여 전작 대비 Phone Power Share 충전 시간 절반으로 단축</li> </ul>
		갤럭시 A (~2022.03.)	<input type="checkbox"/> Galaxy A52 LTE · 5G (2021.03.) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 핵심 사양 강화를 통한 소비자 경험 제공 및 경쟁력 강화</li> <li>- 인치: 6.5" FHD+ sAMOLED HID (2,400 x 1,080)</li> <li>- 사이즈(W x H x D): 75.1mm x 159.9mm x 8.4mm</li> <li>- Platform(H/W, S/W): SDM750G(5G) / SDM720G(LTE), Android 11, One UI 3.1</li> <li>- Supreme smooth UX/Dynamic refresh rate and Brightest (6.5" sAMOLED with 120Hz(5G)/90Hz(LTE), 800nit)</li> <li>- High-resolution 64MP Quad Camera (64M OIS/12M UW/5M Depth/5M Macro)</li> <li>- Powerful AP with High Capacity Battery (4,500mAh)</li> </ul>
			<input type="checkbox"/> Galaxy A72 (2021.03.) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 핵심 사양 강화를 통한 소비자 경험 제공 및 경쟁력 강화</li> <li>- 인치: 6.7" FHD+ sAMOLED HID (2,400 x 1,080)</li> <li>- 사이즈(W x H x D): 77.4mm x 165.0mm x 8.4mm</li> <li>- Platform(H/W, S/W): SDM720G, Android 11, One UI 3.1</li> <li>- High refresh Rate Brightest Display (6.7" FHD+ sAMOLED with 90Hz, 800nit)</li> <li>- Advanced High-res/Multi Camera, More detail with blur-less (64M OIS/12M UW/8M Tele/5M Macro)</li> <li>- Long-lasting Battery with bigger capacity (5,000mAh)</li> </ul>
			<input type="checkbox"/> Galaxy A32 LTE · 5G (LTE: 2021.03., 5G: 2021.01.) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 핵심 사양 강화를 통한 소비자 경험 제공 및 경쟁력 강화</li> <li>- 인치: LTE 6.4" FHD+ sAMOLED (2,400 x 1,080) / 5G 6.5" HD+ TFT (1,600 x 720)</li> <li>- 사이즈(W x H x D): LTE 73.6mm x 158.9mm x 8.4mm / 5G 76.1mm x 164.2mm x 9.1mm</li> <li>- Platform(H/W, S/W): LTE MT6769T / 5G MT6853V, Android 11, One UI 3.1</li> <li>- LTE             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Brightest Display: 800nit Super AMOLED</li> <li>• High Resolution Camera: 64MP Quad (64M W/8M UW/5M Macro/5M Depth)</li> <li>• High Capacity Battery: 5,000mAh</li> </ul> </li> <li>- 5G             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rich Camera Experience of 48MP Quad(48M W/8M UW/5M Macro/2M Depth)</li> <li>• High Capacity Battery: 5000mAh</li> </ul> </li> </ul>
			<input type="checkbox"/> Galaxy Quantum2 A82 (2021.04.) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인치: 6.7" QHD+ (3200 x 1440)</li> <li>- 사이즈(W x H x D) &amp; 무게: 161.9mm x 73.8mm x 8.1mm, 176g</li> <li>- Platform(H/W, S/W): SDM855+, Android 11, One UI 3.1</li> <li>- QRNG 보안칩셋 적용</li> <li>- 시원한 대화면과 부드러운 화면전환 120Hz지원</li> <li>- 전문가급 사진 촬영이 가능한 강력한 카메라 (초광각 12MP, 메인 64MP, 접사 5MP)</li> </ul>
			<input type="checkbox"/> Galaxy A03-Core (2021.12.) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인치: 6.5" FHD+ sAMOLED (2,400 x 1,080)</li> <li>- 사이즈(W x H x D): 161.9mm x 73.8mm x 8.1mm, 176g</li> <li>- Platform(H/W, S/W): SDM855+, Android 11, One UI 3.1</li> <li>- QRNG 보안칩셋 적용</li> <li>- 시원한 대화면과 부드러운 화면전환 120Hz지원</li> <li>- 전문가급 사진 촬영이 가능한 강력한 카메라 (초광각 12MP, 메인 64MP, 접사 5MP)</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- 인치 : 6.5" HD+(1480 x 720) TFT 60Hz</li> <li>- 사이즈(W x H x D) &amp; 무게: 164.2mm x 75.9mm x 9.1mm, 211g</li> <li>- Platform(H/W, S/W) : 28나노 옥타코어 프로세서, Android 11(Android GO)</li> <li>• 전작 A01-Core(28나노 쿼드코어 프로세서) 대비 CPU 성능 향상</li> <li>- Entry 시장 대응을 위한 대화면/대용량 배터리 적용 초저가 제품</li> <li>• 전작A01-Core 대비 디스플레이(5.3"→6.5" HD+), 배터리(3,000→5,000mAh) 강화</li> </ul>
			<input type="checkbox"/> Galaxy A23 LTE (2022.03.) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인치 : 6.6"FHD+ (2400 x 1080) 90Hz</li> <li>- 사이즈(W x H x D) &amp; 무게 : 76.9mm x 165.4mm x 8.4mm, 195g</li> <li>- Platform(H/W, S/W) : 6나노 옥타코어 프로세서, Android 12, One UI 4.1</li> <li>- 6.6" FHD+ 디스플레이, 90Hz 주사율 지원 (전작 A22 6.4" HD+ 90Hz)</li> <li>- 고화소 50MP OIS 카메라 적용으로 어두운 곳에서 흔들림 없는 선명한 사진 촬영 가능</li> <li>- 5,000mAh 대용량 배터리 적용 및 25W 초고속 충전 지원</li> </ul>
			<input type="checkbox"/> Galaxy A13 5G (2022.01.) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인치 : 6.5"HD+ (1600 x 720) 90Hz</li> <li>- 사이즈(W x H x D) &amp; 무게 : 76.5mm x 164.5mm x 8.8mm, 195g</li> <li>- 6.5" HD+ 디스플레이, 90Hz 주사율 지원 (전작 A12 6.5" HD+ 60Hz)</li> <li>- LTE 사용자 Migration 및 5G 시장 확산을 위한 초저가 5G 모델</li> <li>- Entry 시장 대응을 위한 AP(5G) AP(MT6765 → MT6833v)강화</li> <li>- 50MP 카메라 적용으로 전작(A12 16MP)비 고화소 사진 촬영 가능</li> </ul>
			<input type="checkbox"/> Galaxy A13 LTE (2022.03.) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인치 : 6.6"FHD+ (2400 x 1080) 60Hz</li> <li>- 사이즈(W x H x D) &amp; 무게 : 76.4mm x 165.1mm x 8.8mm, 195g</li> <li>- Platform(H/W, S/W) : 8나노 옥타코어 프로세서, Android 12, One UI Core 4.1</li> <li>- 6.6" FHD+ 디스플레이 적용하여 전작(A12 6.5" HD+)비 향상된 대화면 경험 제공</li> <li>- 50MP 카메라 적용하여 전작(A12 48MP)비 고화소 사진 촬영 가능</li> <li>- 5,000mAh 고용량 배터리 및 AI Power mode 적용하여 1회 충전으로 2 Days 사용 가능</li> </ul>
	갤럭시북 (~2021.04.)		<input type="checkbox"/> Galaxy Book Flex 2 (2020.12.) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Design: QLED 적용 2-in-1 PC with S Pen</li> <li>- 인치: 15.6" QLED FHD (16:9, 1920 x 1080), 13.3" QLED FHD (16:9, 1920 x 1080)</li> <li>- 사이즈(W x H x D): (15.6") 355.0mm x 227.2mm x 14.9mm, (13.3") 302.6mm x 202.9mm x 12.9mm</li> <li>- Platform, OS: Intel 11세대 CPU, Windows 10</li> <li>- QLED: Color Volume 100%, Super Bright Outdoor Mode Max 600nit</li> <li>- S Pen: Samsung Notes, Clip Studio, Gesture</li> <li>- SSD: Powerful performance &amp; Latest Gen4 SSD</li> </ul>
			<input type="checkbox"/> Galaxy Book Flex2 5G (2020.12.) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인치: 13.3" QLED FHD Up to 600nit Brightness, Color Volume 100%</li> <li>- 사이즈(W x H x D): 304.9mm x 202.3mm x 13.9~14.9mm</li> <li>- Platform, OS: Intel 11세대 CPU, Intel Iris Xe Graphics, Windows 10</li> <li>- 초고속 5G통신을 지원 (Sub-6)</li> <li>- 최신 무선랜 연결 802.11 ax (Wi-Fi6)</li> <li>- Double Camera: 키보드부 고화질 13M AF Camera와 전면부 1M Camera</li> <li>- 긴 배터리 사용시간 (20 hours battery life, based on MM14)</li> <li>- 제품에 내장된 S-Pen으로 창의적 영감 표현 가능 (Digitizer)</li> <li>- Tablet, Phone 연결성 강화               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Link to Windows: Phone의 App을 PC에서 바로 실행</li> <li>• Samsung Notes: Phone-Tablet-PC간 노트 연동</li> </ul> </li> </ul>

			<input type="checkbox"/> Galaxy Book Go (2021.04.) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인치: 14" FHD (1920 x 1080)</li> <li>- 사이즈(W x H x D) &amp; 무게: 323.9mm x 224.8mm x 14.9mm, 1,380 g</li> <li>- Platform: 2세대 스냅드래곤 7C, Windows 10</li> <li>- 언제 어디서나 인터넷이 가능한 LTE 지원</li> <li>- 휴대에 최적화된 슬림 디자인 (14.9mm 두께)</li> <li>- Dolby Atmos 적용으로 풍성한 사운드</li> <li>- 긴 배터리 사용시간 (up to 18 hours battery life)</li> <li>- Tablet, Phone 연결성 강화 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quick Share: Phone, Tablet의 파일을 손쉽게 공유</li> <li>• Second Screen: Tablet을 PC의 보조 모니터로 사용</li> <li>• Galaxy Book Smart Switch: 기존 노트북의 데이터를 간편하게 전송</li> <li>• SmartThings: 스마트 기기 연동</li> </ul> </li> </ul>
			<input type="checkbox"/> Galaxy Watch3 (2020.08.) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Design: Real Watch 디자인의 Premium Smart Watch</li> <li>- 인치: 1.4"(45mm), 1.2"(41mm) OLED Display(360 x 360)</li> <li>- 사이즈(W x H x D): 45.0 x 46.2 x 11.1mm(45mm), 41.0 x 42.5 x 11.3mm(41mm)</li> <li>- Platform(H/W, S/W): Exynos9110, Tizen 5.5</li> <li>- Titanium 소재의 고급 seg. Portfolio 확대</li> <li>- 헬스 관련 차별화 서비스 발굴 및 탑재 <ul style="list-style-type: none"> <li>• BP(혈압), ECG(심전도), Fall Detection(낙상 감지) 글로벌 상용화 등</li> </ul> </li> </ul>
			<input type="checkbox"/> Galaxy Watch4 & Galaxy Watch4 Classic(2021.08.) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인치: Watch4 : (44mm) 1.4" (450 x 450), (40mm) 1.2"(396 x 396) Watch4 Classic : (46mm) 1.4" (450 x 450), (42mm) 1.2"(396 x 396)</li> <li>- 사이즈(W x H x D): Watch4 : (44mm) 44.4 x 43.3 x 9.8mm, (40mm) 40.4 x 39.3 x 9.8mm Watch4 Classic : (46mm) 45.5 x 45.5 x 11.0mm, (42mm) 41.5 x 41.5 x 11.2mm</li> <li>- Platform(H/W, S/W) : AP Exynos W920(5나노 64비트 Dual-Core), Wear OS Powered By Samsung, One UI Watch 버전 3.0</li> <li>- Memory : 1.5GB RAM + 16GB ROM 탑재하여 성능 개선 및 사용자 가용량 확대 제공</li> <li>- 330 ppi Display 적용을 통한 가독성 개선</li> <li>- 체성분 측정 기능 최초 탑재 및 Health 사용성 강화로 차별화 추진</li> <li>- 산소포화도, 코골이 등 수면 상태 모니터링 강화</li> <li>- Wear OS 기반 App Eco 확장 및 Phone 연동 경험 강화 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Play store/구글맵/YT Music 등 구글 주요 서비스 제공</li> <li>• 최적화된 Fitness 전용 앱 및 다양한 서비스 앱 지원</li> </ul> </li> </ul>
		갤럭시 버즈 (2020.01. ~2021.08.)	<input type="checkbox"/> Galaxy Buds+ (2020.01.) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Design: Canal형 TWS(True Wireless Stereo)</li> <li>- Platform(H/W, S/W): MCU(BCM43015), OS(RTOS), BT 5.0</li> <li>- Battery: (Earbuds) 85mAh x 2, (Cradle) 270mAh</li> <li>- 2 Way 스피커(Woofer, Tweeter) 적용을 통한 중저음 강화 및 음질 최고 성능 확보</li> <li>- 외부 Beamforming Mic(2개), 내부 Mic(1개) 적용으로 통화 품질 최적화</li> <li>- Grip 센서 추가로 착용감지 오동작 개선</li> <li>- 업그레이드된 배터리 탑재를 통해 동급 최고의 사용시간 확보: 스트리밍 시 22H(Earbuds 11H, Cradle 11H)</li> </ul>
			<input type="checkbox"/> Galaxy Buds Live (2020.08.) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Design: 혁신적 Design과 고품질 Sound 를 구현한 오픈형 TWS</li> <li>- 사이즈(W x H x D): (Earbuds) 16.5 x 27.3 x 14.9mm,</li> </ul>

			<p>(Cradle) 50.0 x 50.2 x 27.8mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Platform(H/W, S/W): BCM43015, RTOS</li> <li>- 귀 형상에 최적화된 인체 공학적 설계로 편안하고 부드러운 착용감 제공</li> <li>- 귀가 먹먹하지 않는 오픈형ANC 기능 탑재로 저소음 모드 지원</li> <li>- 12mm 대형 스피커와 Bass Duct로 풍부하고 입체감 있는 라이브 사운드 제공</li> <li>- 3개의 마이크와 가속도 센서(보이스 픽업 유닛) 탑재로 우수한 통화품질 제공</li> </ul>
			<p>□ Galaxy Buds Pro (2021.01.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Design: Intelligent ANC 기능을 갖춘 커널 타입 Premium TWS</li> <li>- 사이즈(W x H x D): (Earbuds) 20.5 x 19.5 x 20.8mm, (Cradle) 50.0 x 50.2 x 27.8mm</li> <li>- Platform(H/W, S/W): BCM43015, RTOS</li> <li>- 2Way(Woofer + Tweeter) 11mm 스피커 탑재를 통한 사운드 품질 향상</li> <li>• 3개의 마이크와 가속도 센서 (보이스 픽업 유닛) 탑재로 우수한 통화품질 제공</li> <li>• 커널 타입 및 Intelligent ANC 기능 탑재 및 대화감지를 통해 주변소리 듣기로 자동 전환</li> <li>• 영화관에 온 듯한 공간감을 느낄 수 있는 3D Audio 기능 제공</li> <li>- IPx7 등급 방수 지원</li> </ul>
			<p>□ Galaxy Buds 2 (2021.08.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기본기능 강화와 ANC기능 추가로 Buds Mass모델의 경쟁력 강화</li> <li>- 사이즈(W x H x D) : (Earbuds) 17.0 x 20.9 x 21.1 mm (Cradle) 50.0 x 50.2 x 27.8 mm</li> <li>- BES2500 ZP-83 (BT + Codec + Flash) 저전력 신규 솔루션 *</li> <li>• ANC 기능 제공</li> <li>• 음악 재생 총 사용시간 29시간 확보 (Streaming, ANC OFF 기준)</li> <li>- Touch + BT Antenna FPCB 일체형 적용하여 RF 방사 성능 최적화</li> <li>- Canal형 무선 이어폰 Audio 성능 고도화</li> <li>• DNN 활용 통화 잡음 제거 성능 극대화 알고리즘 적용(DNN + 3-Mic +VPU)</li> <li>* DNN : Deep Neural Network , VPU : Voice Pickup Unit</li> <li>• 자연스러운 주변소리듣기 모드 전환 지연 속도 개선(3.2ms→0.65ms)</li> <li>• Woofer 진동판 신소재 적용을 통한 저역 강화</li> <li>• 무결점 Mic 단품 도입으로 Mic 노이즈 차단 강화</li> <li>• 통기홀 밀도 변경 및 FeedBack Mic 관로 개선을 통한 ANC 성능 및 음질 개선</li> <li>• Mic 챔버 공간 극대화 및 위치 최적화를 통한 Wind Noise 개선</li> </ul>
	네트워크	RAN S/W Package (2019.04. ~2021.06.)	<p>□ SVR18.3 5G S/W PKG (2019.04.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국내 5G NR 세계 최초 상용화를 위한 S/W Package</li> <li>• 서울/수도권에서 LTE 상용망 연동을 통해 NSA 기반 상용화</li> <li>• 5G 기지국 지원(3.5GHz, 28GHz, 39GHz 5G Massive MIMO)</li> </ul> <p>□ SVR21B NR vDU SW PKG (2021.06.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TDD 기반 C-Band vDU</li> <li>• H/W 변경없이 유연한 기지국Upgrade 및 자원 할당 가능</li> <li>* vDU(virtual DU): 5G 기지국 기능을 상용 서버 기반의 S/W 개발로 구현</li> </ul>
		Core S/W Package (2020.03.)	<p>□ SVR19B 5G Core S/W Package (2020.03.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Containerized 기반 5G Core Network Function 개발</li> <li>• 서버(Host OS)의 자원을 필요한 만큼 유동성 있게 할당하여 효율적이고 빠른 서비스 배포 및 유지보수 비용 절감 가능</li> </ul>
		기지국 (2019.09. ~2022.02.)	<p>□ NR DU 개발 (2019.09.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 신규 Dual CPU Based-Main Card, 5G 최초 SoC 모뎀 적용</li> <li>- 단일 HW 형상으로 LTE, NR Above/Below제품과 혼용실장</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 고용량, 저전력(Power Saving 포함) 및 가상화/비가상화 지원</li> </ul> <p>□ 26GHz NR RFIC Chip 개발 (2020.02.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 당사 1세대(28GHz/39GHz) 이후 2세대 RFIC Chip 개발 (1세대 대비 전력소모 개선, 양산성 향상 등)</li> </ul> <p>□ FSU10 개발 (2020.05.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vRAN 사업 지원을 위한 FSU(Fronthaul Switch Unit) 개발</li> <li>- LTE/NR(Below 6GHz) Spectrum Sharing 역할 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 사업자의 LTE DU와 NR vRAN을 Spectrum Sharing을 통해 한 개의 RU에서 LTE/NR 모두 정합 가능</li> </ul> </li> </ul> <p>□ NR Indoor AU 개발 (2020.08.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 당사 5G In-Building Solution AU 첫 제품</li> <li>- Small Form-Factor로 저전력, 실내(벽면, 기둥, 천장) 설치 가능</li> </ul> <p>□ NR C-Band MMU(Massive MIMO Unit) 개발(3.7GHz 64T64R 200W) (2020.12.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 미주 C-Band 대역 TDD 기반 MMU 첫 제품</li> <li>- 광대역(순시 대역폭 280MHz) 지원(C-Band 전 사업자 및 전국 Cover가능)</li> </ul> <p>□ MMU Beam Forming SoC 개발 (2021.02.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MMU 보드 내 Beam Forming FPGA가 수행하는 기능을 SoC로 구현</li> <li>- 기존 소모 전력의30% 수준으로 감축(최대 소모전력40W 이하)</li> </ul> <p>□ 미주 ORAN* RU 5종 개발 (2021.09.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DU-RU간 표준 interface를 정의하여, DU에서 RU 벤더에 상관없이 연동가능</li> <li>- AWS/PCS, 700/850 4T4R 40W 2종, 320W 2종, C-Band 8T8R 320W</li> </ul> <p>□ 북미향 AWS/PCS Dualband 16T16R FDD MMU (2021.10.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 당사 최초16T16R FDD Dualband MMU 상용 제품(자체 개발 Chip 적용)</li> </ul> <p>□ 국내 3.5GHz NR 32T32R TDD MMU (2022.02.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 당사 최초 Mechanical PSA(Phase Shift Antenna) 적용</li> <li>* 안테나 기울기(Tilt 0~12°)를 MMU 내부에서 Motor로 자동 제어</li> </ul>
DS 부문	메모리	<p>모바일용 DRAM (2019.07. ~2022.03.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 세계 최고 속도 · 최대 용량 모바일용 2세대 10나노급(1y) 12Gb LPDDR5 DRAM 양산 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 속도, 용량, 절전 특성 동시 강화 차세대 모바일 솔루션 제공</li> <li>- 1.3배 속도(5,500Mbps), 소비전력 30% 절감 5G 스마트폰 출시 기여</li> <li>- 12Gb LPDDR5 기반 라인업(6GB, 12GB) 최초 제공</li> </ul> </li> <li>□ 역대 최고 속도 · 최대 용량을 구현한 초격차 '16GB LPDDR5 모바일 DRAM' 세계 최초 양산 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기존 8GB LPDDR4X 대비 성능 약 30% 향상, 용량 2배, 소비전력 20% 감소</li> <li>- 스마트폰으로도 게이밍 PC 이상의 게임 퍼포먼스(화질 · 타격감) 가능</li> </ul> </li> <li>□ 업계 최초 LPDDR5X D램 개발 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기존 제품 대비 속도 30% 이상, 소비전력 효율 약 20% 개선</li> <li>- 업계 최선단 14나노 기반, 단일 패키지 용량 64GB까지 확대 가능하여 모바일 외, 서버/Automotive 등 고성능 저전력 메모리 적용 분야 확대</li> <li>- 퀄컴 스냅드래곤 모바일 플랫폼에 8GB LPDDR5X D램 패키지 탑재해 업계 최고 동작 속도(7.5Gbps) 검증</li> </ul> </li> </ul>
		<p>서버용 DRAM (2019.08. ~2021.03.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 세계 최대 용량 서버용 1세대 10나노급(1x) 256GB 3DS DDR4 DRAM 양산 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 초고성능 · 초고용량 256GB DRAM 세계 최초 양산</li> <li>- 128GB 대비 용량 2배 · 소비전력 효율 30% 향상</li> </ul> </li> <li>□ 세계 최고 서버용 3세대 10나노급(1z) 나노기반 8Gb DDR4 DRAM 개발 <ul style="list-style-type: none"> <li>- DDR5 · LPDDR5 양산 위한 초고속 · 초절전 솔루션 확보</li> <li>- 기존 2세대(1yna노) DRAM 대비 20% 이상 효율 향상</li> <li>- 평택 라인 1zna노DRAM 라인업 9월 양산으로 차세대 비중 확대</li> </ul> </li> <li>□ 업계 최초 HKMG 공정 적용 고용량 DDR5 메모리 개발</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- High-K Metal Gate, 8단 TSV 적용으로 512GB DDR5 모듈 구현</li> <li>- 기존 공정 대비 약 13% 전력소모 낮추고, 성능은 2배 이상 향상</li> <li>- 차세대 컴퓨팅, 슈퍼컴퓨터, 대용량 데이터센터 등에 적용 예정</li> </ul>
		HBM DRAM (2019.10. ~2021.08.)	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 세계 최대 HBM DRAM 용량 12단 3DS TSV PKG 기술 개발 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 슈퍼컴용 최고성능 · 최대용량 12GB HBM DRAM 업계 최초 개발</li> <li>- 8GB 패키지로 용량 1.5배 · 시스템 설계 편의성 향상</li> <li>- 패키지 기술 한계 돌파로 차세대 HPC DRAM 시장 선도 역량 강화</li> <li>- 고객 수요에 맞춰 업계 최대 24GB HBM 양산 예정</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> AI · 차세대 슈퍼컴퓨터용 초고속 DRAM 세계최초 출시 (16GB HBM2E 'Flashbolt') <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10나노급(1y) 16기가비트(Gb) DRAM 8개 쌓아 최고용량(16GB) 구현</li> <li>- 1초에 3.2기가비트 속도로 Full HD 영화 82편(410기가바이트) 전송 가능</li> <li>- 2세대 HBM2 및 3세대 HBM2E 동시 공급해 시장 확대 지속 주도</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> 세계 최초로 AI 엔진을 탑재한 인공지능 HBM-PIM 개발 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기존 HBM2 대비 성능 2배 이상 향상, 시스템 에너지 약 70% 이상 감소</li> <li>- 반도체 분야 최고 권위 학회 ISSCC에서 논문 공개('21.2월)</li> <li>- 기존 메모리 인터페이스 사용으로 별도 시스템 변경없이 적용 가능</li> <li>- 데이터센터, AI 고객들과 PIM 표준화, 에코 시스템 구축 협력</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> 인공지능 탑재 메모리 제품군 확대 (HBM-PIM 성능 평가결과 및 AXDIMM/LPDDR5-PIM 개발 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지난 2월 개발한 HBM-PIM 실제 시스템 적용 사례 공개 (자일링스 AI 가속시스템에 탑재시 성능 2.5배, 에너지사용 60% 이상 감소)</li> <li>- D램 모듈에 AI 기능 탑재한 AXDIMM은 기존 대비 성능 2배, 에너지사용 40% 감소</li> <li>- 모바일 D램과 PIM 기술을 결합한 LPDDR5-PIM 공개</li> </ul> </li> </ul>
		eStorage (2019.02. ~2020.03.)	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 세계 최초 차세대 스마트폰 메모리 eUFS 3.0 양산 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5세대(9x단) 셀 적층 512Gb 3비트 V낸드 업계 최초 탑재</li> <li>- eUFS 2.0 대비 2배 빠른 읽기 · 쓰기 속도 구현</li> <li>- 초고해상도 차세대 모바일 시장 선점 고성능 주도</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> 업계 유일 1200MB/s 쓰기 속도 구현한 초격차 '1TB eUFS 2.1' 본격 양산 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기존 512GB eUFS 3.0(연속 쓰기 속도 410MB/s) 대비 성능 3배 향상</li> <li>- 스마트폰 메모리 저장 속도(1200MB/s)가 PC(SSD 540MB/s)보다 2배 빨라짐</li> </ul> </li> </ul>
		PC용 SSD (2019.07.)	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 세계 최고 속도 6세대(1xx) 256Gb V낸드 기반 PC SSD 양산 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 100단 이상 셀 단일 공정 적층 V낸드 유일 양산</li> <li>- 기존 대비 속도 1.2배, 생산성 20% 이상 향상</li> <li>- 초고속 · 초절전 특성 우위로 스토리지 시장 성장 주도</li> </ul> </li> </ul>
		서버용 SSD (2019.08. ~2021.12.)	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 세계 최고 속도 · 최대 용량 서버용 5세대(9x단) V낸드 기반 30.72TB NVMe SSD 양산 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 속도, 용량, 경제성 강화 차세대 SSD 솔루션 확보</li> <li>- 기존 대비 2.2배 속도 8GB/s PCIe Gen4 SSD 출시</li> <li>- 3대 SW(Never Die SSD, FIP, ML) 솔루션 유일 제공</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> 데이터센터 전용 고성능 OCP SSD 양산 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 6세대 V낸드로는 업계 최초로 OCP 규격의 SSD 양산</li> <li>- 데이터센터 업계가 요구하는 성능, 전력효율, 신뢰성, 보안 모두 만족</li> <li>- 업계 최고 전력효율 특성으로 비용 절감 및 탄소 저감 효과에 기여</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> 업계 최고 성능 SAS 24Gbps 서버용 SSD 양산 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 이전 세대 SSD 대비 약 2배 향상된 속도 지원</li> <li>- 6세대 V낸드 기반으로 800GB 부터 30.72TB까지 고용량 제공</li> <li>- 전력효율 약40% 향상되어 서버 운영 비용 절감 및 탄소 저감 효과 기대</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> 차세대 기업 서버용 ZNS SSD 업계 최초 양산 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 데이터 성격에 따라 구역(Zone)별로 분류하여 저장하는 ZNS 기술 적용</li> </ul> </li> </ul>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- 기존 SSD 대비 수명연장 및 SSD 용량 최대 활용</li> <li>- AI, 빅데이터, IOT 등 차세대 서버/스토리지 시스템 효율 제고에 기여 및 다양한 오픈소스 프로젝트 활동으로 ZNS SSD 저변 확대</li> </ul> <input type="checkbox"/> PCIe 5.0 기반 고성능 SSD PM1743 개발 <ul style="list-style-type: none"> <li>- PCIe 4.0 기반 SSD 대비 읽기/쓰기 속도 약 2배 및 전력효율 약 30% 개선</li> <li>- 듀얼포트 지원 및 최신 보안 기술 적용으로 서버 운영 안전성 보장</li> </ul>
		브랜드 SSD (2020.01.~2021.03.)	<input type="checkbox"/> 업계 최고수준 성능의 프리미엄 포터블 SSD 'T7 Touch' 출시 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 세계 최고 성능의 5세대 512Gb V낸드와 초고속 인터페이스 NVMe 컨트롤러를 탑재</li> <li>- 외장형 HDD(110MB/s) 대비 최대 9.5배, 전작(삼성전자 포터블 SSD 'T5') 대비 약 2배 빨라진 1,050MB/s · 1,000MB/s의 읽기 · 쓰기 속도를 구현</li> </ul> <input type="checkbox"/> 고용량 4비트 SSD '870 QVO' 글로벌 출시 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 업계 최대 용량 8TB 모델 포함, 1/2/4TB 등 SATA SSD 4종 출시</li> <li>- SATA 인터페이스 한계치에 근접한 빠른 데이터 처리 속도로 고용량 · 고성능의 컴퓨팅 환경을 원하는 소비자에게 최적의 솔루션 제공</li> <li>- 속도와 용량, 합리적인 가격으로 전세계 40개국에 순차 출시</li> </ul> <input type="checkbox"/> PCIe Gen4 적용한 업계 최고 성능 SSD '980 PRO' 글로벌 출시 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 업계 최고 속도 소비자용 SSD로 초고해상도 구현</li> <li>- 8K · 4K급 영상편집, 고사양 게임 등에 활용되는 전문가용 PC · 워크스테이션 시장 지속 주도</li> <li>- 보증기간 5년(업계 최고 수준)</li> </ul> <input type="checkbox"/> 소비자용 SATA SSD 870 EVO 글로벌 출시 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 최신 V낸드, 컨트롤러 탑재, 인텔리전트 터보라이트 기술 적용</li> <li>- 업계 최고 수준 내구성 보유, 지속성능 30% 이상 향상</li> <li>- 250GB~4TB까지 5개 모델로, 한국 · 미국 · 독일 · 중국 등 40여개국 순차 출시</li> </ul> <input type="checkbox"/> 성능과 경제성을 모두 만족한 고성능 NVMe SSD 980 출시 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 6세대 V낸드 탑재, SATA SSD 대비 최대 6배 빠른 성능 제공</li> <li>- 비용을 고려한 DRAMless 설계와 컨트롤러, 펌웨어 최적화 기술 적용</li> <li>- 하이엔드 제품에 적용되는 열 제어 기능 탑재</li> <li>- 970 EVO 대비 전력효율 56% 향상, 소비자들 '착한 소비' 가능</li> </ul>
		EUV (2020.03.~2021.10.)	<input type="checkbox"/> 1세대 10나노급(D1x) DRAM 모듈 1백만개 공급 <ul style="list-style-type: none"> <li>- EUV DRAM 양산으로 업계 유일 EUV DRAM 양산체제 구축</li> <li>- 10나노급 공정 미세화 기술 및 양산성 확보로 차세대 DRAM 적기 출시 가능</li> <li>- 4세대 10나노급 DRAM부터 EUV전면 적용 후 5세대, 6세대도 확대 적용</li> </ul> <input type="checkbox"/> 업계 최선단 14나노 EUV DDR5 D램 양산 <ul style="list-style-type: none"> <li>- EUV 멀티레이어 적용 및 업계 최고 웨이퍼 집적도 구현으로 생산성 약 20% 향상</li> <li>- DDR4 대비 속도 2배 및 이전 공정 대비 소비전력 약 20% 개선</li> </ul>
		CXL (2021.05.~2021.10.)	<input type="checkbox"/> 업계 최초 CXL 기반 DRAM 메모리 기술 개발 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대용량 데이터센터가 요구하는 차세대 메모리 솔루션으로 DRAM 모듈의 물리적 한계 극복, 용량 대역폭의 획기적인 확장 가능</li> <li>- CXL 컨트롤러를 통해 인터페이스 컨버팅, 에러 관리 등 지원</li> <li>- 데이터센터, 서버, 칩셋 업체들과 협력으로 CXL DRAM 메모리에 최적화된 컨트롤러, 소프트웨어 기술 개발</li> </ul> <input type="checkbox"/> 업계 최초 CXL 메모리 오픈소스 소프트웨어 솔루션 개발 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 메인 메모리와 CXL 메모리가 최적으로 동작할 수 있도록 지원하여 시스템 메모리의 성능/용량 확장 가능</li> </ul>
		복합칩 (2021.06.)	<input type="checkbox"/> 업계 최고 성능의 uMCP5(LPDDR5 + UFS3.1) 멀티칩 패키지 양산 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기존 LPDDR4X 대비 속도 1.5배, UFS2.2 대비 2배 향상</li> <li>- 중저가 5G 스마트폰까지 탑재하여 5G 대중화 견인</li> </ul>
		브랜드 Card	<input type="checkbox"/> 성능·안정성을 강화한 마이크로 SD카드 신제품 출시

		(2021.09.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 'PRO Plus'는 이전세대 대비 읽기 속도 약 1.6배, 쓰기 속도 약 1.3배</li> <li>- 'EVO Plus'는 이전세대 대비 읽기 속도 약 1.3배</li> <li>- 강화된 성능과 외부 충격에 강한 디자인 설계로 일반 소비자 뿐만 아니라 4K UHD 영상과 같은 고사양의 콘텐츠를 제작, 고객까지 만족 기대</li> </ul>
		Automotive (2021.12.)	<input type="checkbox"/> Automotive향 메모리 토탈 솔루션 양산 <ul style="list-style-type: none"> <li>- IVI향 256GB SSD, 2GB DDR4/GDDR6 및 AD향 2GB GDDR6, 128GB UFS</li> <li>- 서버급에 탑재되는 고성능 SSD와 그래픽D램 공급 및 차량용 반도체 시장에서 요구하는 높은 안전성 확보(영하 40℃~영상 105℃ 동작보증구간 지원)</li> </ul>
	System LSI	이미지센서 (2019.01. ~2021.09.)	<input type="checkbox"/> 초소형 픽셀 적용 ISOCELL Slim 센서(3T2, 0.8um/20Mp) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1/3.4" 센서 중 최고 화소(20Mp)로 베젤리스 디스플레이에 최적화된 고화소 구현</li> <li>- 전면 테트라셀 기술 적용으로 저조도 촬영 성능 우수, 후면 고배율 사용시 모듈 사이즈 감소, 화질 개선</li> </ul> <input type="checkbox"/> 초고화소 ISOCELL Bright 센서(GW1, 0.8um/64Mp) <ul style="list-style-type: none"> <li>- DCG 구조 적용으로 Dynamic Range 증가</li> <li>- 슈퍼 PD 기술로 Auto Focus 성능 극대화 및 초당 480 프레임 Full-HD 슬로우 모션 기능 제공</li> <li>- 실시간 HDR 기능 지원으로 풍부한 색감 구현</li> </ul> <input type="checkbox"/> 고화소 ISOCELL Bright 센서(GM2, 0.8um/48Mp) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 슈퍼 PD 기술로 Auto Focus 성능 극대화 및 초당 240 프레임 Full-HD 슬로우 모션 기능 제공</li> </ul> <input type="checkbox"/> 세계 최초 1억8백만 화소 ISOCELL Bright 센서(HMX, 0.8um/108Mp) <ul style="list-style-type: none"> <li>- AI-ISO 적용하여 S/W로 광량 조절, 색재현력 향상</li> <li>- 최대 6K 해상도로 초당 30 프레임 촬영 가능</li> <li>- 아이소셀 플러스, 테트라셀 기술로 감도 개선</li> </ul> <input type="checkbox"/> 세계 최초 최소 픽셀 적용 ISOCELL Slim 센서(GH1, 0.7um/43.7Mp) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 모듈의 크기와 두께 소형화 가능하여 Full-Screen Display 세트 탑재 용이</li> <li>- 고해상도 녹화 지원 및 화각 손실 최소화</li> <li>- 아이소셀 플러스, 테트라셀 기술로 감도 개선</li> </ul> <input type="checkbox"/> 업계 최초 '노나셀' 기술로 감도 2배 높은 차세대 1억8백만 화소 ISOCELL Bright센서(HM1, 0.8um/108Mp) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 강화된 줌 기능으로 피사체 3배 확대해도 화질 저하 없이 프리뷰 가능</li> <li>- 스마트 ISO, 실시간 HDR, 전자식 이미지 흔들림 보정 등 최신 기술 적용</li> </ul> <input type="checkbox"/> 듀얼 픽셀 및 테트라셀 적용 센서(GN1, 1.2um/50Mp) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 한 픽셀당 2개 포토다이오드 탑재하는 듀얼 픽셀 기술로 1억 화소 수준 이미지도 출력 가능</li> <li>- 어두운 곳에서 감도 4배 향상되는 테트라셀 적용으로 밝고 섬세한 이미지 촬영</li> </ul> <input type="checkbox"/> 업계 최초 0.7um 픽셀 적용 이미지센서 라인업 구축(HM2, GW3, GM5, JD1) <ul style="list-style-type: none"> <li>- '아이소셀 2.0' 등 첨단 기술 적용해 초소형, 고화질 기술 리더십 선도</li> <li>- (HM2) 0.7um픽셀 최초 1억8백만 화소</li> <li>- (GW3) 4K 60프레임 동영상 촬영 가능한 6천4백만 화소</li> <li>- (GM5) 초광각과 풀디즈oom 지원하는 4천8백만 화소</li> <li>- (JD1) 베젤리스 디자인 구현에 최적화된 초소형 3천2백만 화소</li> </ul> <input type="checkbox"/> 1억8백만화소 프리미엄 이미지센서 '아이소셀 HM3' 출시 (HM3, 0.8um/108Mp) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 0.8um 크기 작은 픽셀 1억 8백만개를 '1/1.33인치'에 집적</li> <li>- '스마트 ISO 프로'로 잔상 최소화, 밝고 선명한 이미지 촬영 가능</li> <li>- 자동초점 최적 렌즈 탑재 '슈퍼 PD 플러스' 적용... 초점 검출 능력 50% 향상</li> <li>- 설계 최적화로 프리뷰 모드 동작 전력 기존 대비 약 6% 절감</li> </ul> <input type="checkbox"/> 사람 눈과 더욱 가까워진 이미지센서 '아이소셀 GN2' 출시 (GN2, 1.4um/50Mp) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 업계 최초, 픽셀을 대각선 분할하는 '듀얼 픽셀 프로' 적용</li> <li>- 1.4um 픽셀 구조, 보다 밝고 선명한 이미지 촬영</li> <li>- 스테거드 HDR, 기존 제품 대비 동작 전력 약 24% 감소</li> </ul> <input type="checkbox"/> 업계 최초 0.64um 픽셀 적용 '아이소셀 JN1' 출시(JN1, 0.64um/50Mp)

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 초소형 픽셀 크기 양산, 고화소 모바일 카메라 슬림 디자인 적용</li> <li>- 어두운 곳에서 촬영 감도 높이는 최첨단 이미지센서 기술 적용</li> <li>- 카메라 렌즈 모듈사 협력, 1/2.8" 제품과 호환 가능한 생태계 구축</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> 차량용 이미지센서 '아이소셀 오토 4AC' 본격 출시(4AC, 3.0um/1.2Mp)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 서라운드 뷰 모니터, 후방 카메라에 적용 예정</li> <li>- 극한 환경에서도 운전자 보조, 사각지대를 최소화하는 안전 솔루션</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> 초격차 모바일 이미지센서 신기술 공개(HP1, 0.64um/200Mp 및 GN5, 1.0um/50Mp)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 업계 최초 '2억화소' 벽을 넘어선 '아이소셀 HP1'</li> <li>- 업계 최소 크기의 듀얼 픽셀 이미지셀 '아이소셀 GN5'</li> </ul>
	엑시노스 (2019.01. ~2022.03.)	<p><input type="checkbox"/> 세계최초 5G 스마트폰용 모뎀 솔루션(엑시노스 모뎀 5100, 엑시노스 RF 5500, 엑시노스 SM 5800)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 데이터 통신 속도 1.7배 증가 (LTE대비)</li> <li>- 신규 RF·SM 탑재, 송수신 전력 효율 개선</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> 업계 최고 수준의 7나노 5G 모뎀(엑시노스 5123)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 6GHz 이하 5G 환경에서 기존대비 최고 2배 속도 향상</li> <li>- 4G 네트워크에서 최고속도 3.0Gbps 달성</li> <li>- 글로벌 Sub-6GHz/mmWave 대역 지원</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> 차량용 인포테인먼트용 SoC(엑시노스 오토 V9)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 옥타코어 CPU활용하여 디스플레이 6개 및 카메라 12개 동시 제어</li> <li>- GPU 3개 탑재로 계기판·CID·HUD 개별 지원</li> <li>- NPU 탑재로 디지털 음성·얼굴·동작 인식</li> <li>- ASIL-B 기능안전 지원으로 안정성 강화</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> 저전력·보안강화 단거리 IoT 전용 SoC(엑시노스 i T100)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 프로세서·메모리·통신기능 패키지화</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> Sub-6GHz 대역 지원 5G 모뎀 + AP 통합 원칩(엑시노스 980)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- EN-DC, Wi-Fi 6 등 최신 통신 기능 지원</li> <li>- 전세대 및 프리미엄 제품 대비 NPU 성능 향상</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> 5세대 CPU 및 프리미엄 GPU 탑재로 성능 강화(엑시노스 990)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- AI 연산 성능 10TOPS 이상 확보로 이미지 분석 및 안면 인식 기능 강화</li> <li>- 최신 LPDDR5 DRAM 및 50MP↑ 고해상도 카메라 지원</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> 5G 통합 프리미엄 모바일AP '엑시노스 2100' 출시(엑시노스 2100)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 최첨단 5나노 EUV 공정·최신 CPU/GPU 적용, 성능 대폭 향상</li> <li>- 설계 최적화로 전작 대비 성능 CPU 30%, GPU 40% 이상 개선</li> <li>- 온디바이스 AI 성능 강화, 초당 26조번 인공지능(AI) 연산</li> <li>- 소비전력 최대 20% 감소, 자체 전력 관리 솔루션 'AMIGO'도 적용</li> <li>- 초고주파 대역 5G 통신 지원, 최대 6개 이미지센서 처리 등</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> EUV(Extreme UltraViolet, 극자외선) 공정 기반 웨어러블용 '엑시노스 W920' 출시</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 최신 5나노 EUV 공정 및 설계 기술 적용으로 성능과 전력효율 향상</li> <li>- 최첨단 패키지 기술을 적용, 웨어러블용 초소형 패키지로 구현</li> <li>- 최신 ARM 코어 적용, 전세대(Exynos 9110) 대비 CPU 성능 20%, 그래픽 성능 10배 향상</li> <li>- 저전력 디스플레이용 코어 탑재, AOD(Always On Display) 모드에서 프로세서 전력소모 97% 개선</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> 업계 최초 5G 통신 서비스 제공하는 차량용 통신칩 '엑시노스 오토 T5123' 출시</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 초당 5.1Gb 다운로드 지원, 주행 중에도 끊김없이 고용량·고화질 콘텐츠 이용 가능</li> <li>- 최신 5G 기반 멀티모드 통신칩 내장돼 5G 단독망 및 LTE 혼합망 모두 지원</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> 차량 인포테인먼트용 프로세서 '엑시노스 오토 V7' 출시</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 신경망처리장치(NPU), 카메라 센서의 불량화소 및 왜곡 보정 기술, 이미지 압축기술 등 최신 차량용 기술 적용</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- 그래픽 장치는 디지털 계기판, 중앙 정보 디스플레이(CID, Center Information Display), 헤드업 디스플레이(HUD, Head Up Display) 등 독립된 4개 디스플레이 구동 및 최대 12개의 카메라 센서 지원</li> <li>- 보안 프로세서 탑재해 차량 주요 정보를 안전하게 보관 및 물리적 복제 방지 기술 제공</li> </ul> <input type="checkbox"/> 프리미엄 모바일 AP '엑시노스 2200' 출시 <ul style="list-style-type: none"> <li>- AMD와 공동 개발한 차세대 GPU '엑스클립스(Xclipse)' 탑재, 게임 성능 및 전력 효율 극대화</li> <li>- 업계 최초 모바일 기기에서 하드웨어 기반 '광선 추적(Ray Tracing)' 기술 구현</li> <li>- ARM 최신 CPU 아키텍처 'Armv9' 기반 코어 적용하여 성능 및 보안 강화</li> <li>- NPU 연산 성능 이전 대비 두 배 이상 향상, 머신러닝 성능 대폭 향상</li> </ul>
		LSI (2019.01.~2022.03.)	<input type="checkbox"/> USB-PD 3.0 표준 및 고속 충전 프로토콜 지원 TA용 PDIC(MM101) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 수분 감지, 전압 보호 기능 탑재</li> </ul> <input type="checkbox"/> 세계최초 PDIC + SE 통합 원 칩(SE8A) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Type-C 인증 지원으로 비인증 제품 차단</li> <li>- 보안키 · 인증서 저장, 암호화 · 복호화 지원 등 고성능 보안기능 탑재</li> </ul> <input type="checkbox"/> 업계 최초 무선이어폰용 통합 전력관리 칩(MUA01, MUB01) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 여러 칩을 하나로 통합해 소형 배터리에 최적화한 전력관리 칩</li> <li>- 급성장하는 무선이어폰 시장을 위한 최적의 솔루션 제공</li> </ul> <input type="checkbox"/> 8K TV 초고화질 영상 구현 최적화 및 전송 효율 향상 DDI(S6CT93P) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 이퀄라이저 S/W화로 신호 품질 및 개발 효율 향상</li> </ul> <input type="checkbox"/> 모바일 최고 수준의 통합 보안 솔루션(S3K250AF) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 보안 국제 공통 평가 기준(CC)에서 'EAL 5+' 등급을 획득한 H/W 보안칩에 독자 개발 S/W 탑재</li> <li>- 모바일 보안 솔루션으로 신규 모바일서비스 위한 기반 마련</li> </ul> <input type="checkbox"/> 모바일기기 최고 등급인 EAL 6+ 획득, 자체 S/W 탑재 솔루션(S3FV9RR) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 다양한 프로세서에 독립적으로 적용해 여러 종류의 스마트기기에 활용 가능</li> <li>- 하드웨어 보안 부팅, 기기 인증 등 다양한 기능 탑재해 보안 강화</li> </ul> <input type="checkbox"/> DDR5 D램 모듈용 전력관리반도체(S2FPD01, S2FPD02, S2FPC01) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 차세대 기기 성능향상 및 전력절감에 핵심, 전력관리반도체 3종</li> <li>- 전력 소비 및 발열 낮추는 자체 기술 적용, 동작 효율 최고 91%까지 향상</li> <li>- 메모리용 전력관리반도체 라인업 지속확대 및 기술 리더십 강화</li> </ul> <input type="checkbox"/> 차량 인포테인먼트 프로세서용 전력공급반도체(S2VPS01) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 차량용 시스템 안전기준 '에이실-B' 인증 획득, 기능 안전성 강화</li> <li>- 발열 차단 기능, 자가 진단 기능 등 시스템 안정성 강화</li> </ul> <input type="checkbox"/> 생체인증카드용 원칩 지문인증 IC 출시(S3B512C) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 하드웨어 보안칩(SE, Secure Element), 지문 센서, 보안 프로세서 기능을 하나의 IC로 통합</li> <li>- 보안 국제 공통 평가 기준(CC, Common Criteria)의 EAL6+ 등급 획득,</li> <li>- 글로벌 온라인 카드 결제 기술표준(EMVCo) 인증 및 마스터카드의 생체 인식 평가 통과로 보안성 입증</li> </ul>
	Foundry	eMRAM 솔루션 제품 출하 (28나노 FD-SOI 공정기반) (2019.03.)	<input type="checkbox"/> 저전력 특성 공정과 차세대 내장 메모리 기술 접목 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 낮은 동작 전압을 사용하며, 대기전력이 없으며, 데이터 삭제과정이 불필요해 전력효율 극대화</li> <li>- 기존 eFlash 대비 약 1000배 빠른 기록속도 지원</li> </ul> <input type="checkbox"/> 최소한의 레이어를 추가해 시스템 반도체에 내장 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 설계 구조 단순해 생산비용 절감 가능</li> </ul> <input type="checkbox"/> 저전력, 소형화 특성으로 MCU · IoT · AI 등에 최적화
		EUV 기술 적용 5나노 공정 (2019.04.)	<input type="checkbox"/> EUV 노광기술 적용한 5나노 공정 개발 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 셀 설계를 최적화해 7나노 공정 대비 로직면적 25% 감소, 전력효율 20% 및 성능 10% 향상 기대</li> <li>- 7나노에 적용된 설계자산(IP)을 활용 가능해 기존 7나노 고객의 설계 부담 경감</li> </ul>
		3차원 적층	<input type="checkbox"/> 3차원 적층 기술 'X-Cube' 및 설계 인프라 개발

		패키지 기술 'X-Cube' (2020.08.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 별도의 웨이퍼로 제조된 이중 칩을 실리콘 관통 전극(TSV)으로 얇게 적층하여 하나의 반도체로 구현</li> <li>· 전체 칩 면적을 줄이면서 고용량 메모리 솔루션 장착 가능해 설계 자유도 확보</li> <li>· 시스템 반도체의 데이터 처리속도 및 전력 효율 획기적 향상</li> <li>- 5, 7나노 공정에 'X-Cube' 적용을 위한 설계방법론 및 설계툴 검증 완료</li> <li>· EUV 7나노 공정 기반 로직 · SRAM을 적층한 테스트칩 업계 최초 생산</li> </ul>
		2.5D 반도체 패키지 기술 'I-Cube4' (2021.05.)	<input type="checkbox"/> 로직칩과 4개의 HBM칩을 한 패키지에 구현하여 하나의 반도체처럼 동작 <input type="checkbox"/> 실리콘 인터포저를 적용해 안정적 전력 공급 및 초미세 배선 구현 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 100마이크로미터 수준의 얇은 인터포저 변형을 막는 반도체 공정/제조 노하우 적용</li> </ul> <input type="checkbox"/> 열 방출 성능 우수한 독자 구조로 생산기간 단축 및 수율 향상
		8나노 RF 공정 (2021.06.)	<input type="checkbox"/> 서브 6GHz 및 밀리미터파까지 지원하는 5G 통신용 RF(Radio Frequency) 공정 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 멀티 채널, 멀티 안테나 지원 원칩 솔루션으로 소형, 저전력, 고품질 통신 제공</li> </ul> <input type="checkbox"/> 독자 개발 RF 전용 반도체 소자 'RFeFET(RF extremeFET)' 적용해 RF 성능 향상 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전자의 이동 통로인 채널 주변부에 물리적 자극을 가해 전자 이동 특성 극대화</li> </ul> <input type="checkbox"/> 전 세대 14나노 RF 공정 대비 전력 효율 35% 증가, 아날로그 회로 면적 35% 감소 <ul style="list-style-type: none"> <li>- RFeFET의 성능이 크게 향상되어 칩의 전체 트랜지스터 수 감소</li> </ul>
		2.5D 반도체 패키지 기술 'H-Cube' (2021.11.)	<input type="checkbox"/> 실리콘 인터포저 및 하이브리드 기판을 사용한 2.5D 솔루션 'Hybrid Cube' <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인터포저 위에 로직과 고대역폭 메모리(HBM)를 배치, 최대 6HBM 집적 구현</li> <li>- 하이브리드 기판은 상단의 고사양 메인 기판이 로직/메모리 칩을 연결하고, 대면적 구현이 용이한 하단의 보조 기판이 시스템 보드 연결을 담당하는 이중 구조</li> <li>- 두 기판을 전기적으로 연결하는 솔더볼(Solder ball) 간격을 35% 좁혀 기판 크기 감소</li> <li>- 칩 분석기술 적용해 안정적으로 전원을 공급하고 신호의 왜곡 및 손실을 축소</li> <li>- 고성능/대면적이 요구되는 데이터센터, AI, 네트워크 등 분야 반도체에 최적화</li> </ul>
SDC	DP	갤럭시 S10용 홀 디스플레이 OLED (2019.03.)	<input type="checkbox"/> 세계 최초 Flexible Hole in Display 상품화로 화면공간 극대화 <ul style="list-style-type: none"> <li>- S10 6.1" 3K QHD+(3,040 × 1,440) Hole 1개, S10+ 6.4" Hole 2개</li> </ul> <input type="checkbox"/> 블루라이트의 획기적인 감소로 눈이 편안한 디스플레이 제공 <ul style="list-style-type: none"> <li>- S9 대비 블루라이트 42% 감소(TUV 라인란드 아이컴포트 인증)</li> </ul>
		NPC용 15.6" UHD OLED (2019.05.)	<input type="checkbox"/> 세계 최초 NPC용 4K OLED 디스플레이 개발 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 15.6" UHD(3,840 × 2,160), 16:9</li> <li>- Blue Light 저감, 빠른 응답속도, 넓은 시야각으로 선명한 화질 제공</li> </ul>
		스마트폰용 4K 고해상도 OLED (2019.06.)	<input type="checkbox"/> 세계 최초 4K 모바일 OLED 디스플레이 개발 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 6.5" UHD(1,644 × 3,840), 643ppi, 16M Color</li> <li>- 21 : 9 화면 비율로 영화의 원본 비율 그대로 감상 가능</li> </ul>
		Gaming 모니터용 Curved LCD (2019.06.)	<input type="checkbox"/> 세계 최초 240Hz Curved LCD 디스플레이 개발 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 27" FHD(1920 × 1080), 16:9</li> <li>- 240Hz 고속주사율과 G-sync 지원으로 부드럽고 끊김없는 게임환경 제공</li> <li>- 곡률 1500R, 광시야각 기술로 몰입감 극대화</li> </ul>
		갤럭시 폴드용 폴더블 OLED (2019.09.)	<input type="checkbox"/> 세계 최초 폴더블 디스플레이 개발로 디스플레이 혁신 <ul style="list-style-type: none"> <li>- In-Foldable AM OLED (곡률반경 1.5R)</li> <li>- 7.3" QXGA+(1,536 × 2,152), 4:3</li> <li>- 복합 폴리머 소재 개발로 기존 디스플레이 대비 약 50% 두께 감소</li> </ul>
		갤럭시 Z 플립용 폴더블 OLED (2020.02.)	<input type="checkbox"/> 세계 최초 Glass type Window 폴더블 디스플레이 양산 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 6.7" Full HD+(1,080 × 2,640)</li> <li>- UTG(Ultra Thin Glass)적용 내구성 향상 및 폴더블 최초 카메라 홀 적용</li> </ul>
		갤럭시 S20용 WQ+ 고속구동 OLED (2020.03.)	<input type="checkbox"/> 세계 최초 WQ+ 해상도 120Hz 고속구동으로 Touch 성능 극대화 <ul style="list-style-type: none"> <li>- S20 6.23"/6.67"/6.87" QHD+(3,200 × 1,440)</li> <li>- 유해 Blue 6.5% 이하로 Eye Care Display 인증(국제 인증기관, SGS)</li> </ul>

		갤럭시 Z 폴드2용 폴더블 OLED (2020.09.)	<input type="checkbox"/> 세계 최초 곡률(1.4R) 폴더블 디스플레이 양산 - 7.6"(2,208 × 1,768) In - Foldable - 응력최소화 구조설계로 곡률반경 1.4R 달성 - 어댑티브 프리퀀시(화면에 맞춘 주사율 조정, 10~120Hz구동)로 소비전력 개선
		갤럭시 S21용 저소비전력 OLED (2021.01.)	<input type="checkbox"/> 저소비전력, 고휘도 혁신 OLED 디스플레이 양산 - S21 시리즈: 6.24" · 6.67" · 6.81" QHD+(3,200×1,440) - 신규 유기재료 적용으로 발광효율 개선: 전작 대비 소비전력 16% 개선 - 휘도 · 명암비 향상으로 우수한 야외시인성 확보 (Max/HBM 420/800 → 500/1100nit, Peak 1,785nit) → Sunlight Visibility 인증(UL, 글로벌 안정인증회사)
		갤럭시Z 폴드3용 폴더블 OLED개 발 (2021.08.)	<input type="checkbox"/> 다양한 신기술의 폴더블 최초 적용 - 7.6" QXGA+7.55" (2,208×1,768) - 언더 패널 카메라(Under Panel Camera) 기술로 화면 사각지대 제거 - 에코스퀘어(Eco2) 기술로 전작 대비 배터리 소모 절감
		55/65" QD-Display (2022.01.)	<input type="checkbox"/> 세계 최초 TV형 QD-Display (55" UHD, 65" UHD) - BT2020 90% 업계 최고의 넓고 선명한 색 표현 - 전방위 균일하게 빛을 발하는 QD 특성으로 어느 각도에서도 최고의 휘도와 색감 구현 - 뛰어난 HDR 성능, 깊고 디테일한 Black 표현
		34" QD-Display (2022.03.)	<input type="checkbox"/> 세계 최초 모니터형 QD-Display (34" QHD) - 175Hz, 0.1ms, 1800r, HDR True Black, G-Sync 지원으로 최고의 게이밍 경험 제공 - 뛰어난 색, 시야각, 명암비 특성 및 유해 블루라이트를 최소화

## 【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

2. 전문가와의 이해관계